목 차

사 업 보 고 서 1
【 대표이사 등의 확인 】 2
I. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
2. 회사의 연혁 10
3. 자본금 변동사항 17
4. 주식의 총수 등 18
5. 정관에 관한 사항 23
II. 사업의 내용 25
1. 사업의 개요 25
2. 주요 제품 및 서비스 27
3. 원재료 및 생산설비 28
4. 매출 및 수주상황 35
5. 위험관리 및 파생거래 40
6. 주요계약 및 연구개발활동 47
7. 기타 참고사항 52
III. 재무에 관한 사항 71
1. 요약재무정보 71
2. 연결재무제표 73
2-1. 연결 재무상태표 73
2-2. 연결 손익계산서 74
2-3. 연결 포괄손익계산서 75
2-4. 연결 자본변동표 75
2-5. 연결 현금흐름표 76
3. 연결재무제표 주석 78
1. 일반적 사항 (연결) 78
2. 중요한 회계처리방침 (연결) 89
3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결) 95
4. 범주별 금융상품 (연결) 97
5. 금융자산의 양도 (연결) 100
6. 공정가치금융자산 (연결) 101
7. 매출채권 및 미수금 (연결) 104
8. 재고자산 (연결) 106
9. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결) 107
10. 유형자산 (연결) 112
11. 무형자산 (연결) 115
12. 차입금 (연결) 118
13. 사채 (연결) 120
14. 순확정급여부채(자산) (연결) 121
15. 충당부채 (연결) 125
16. 우발부채와 약정사항 (연결) 127
17. 계약부채 (연결) 128
18. 자본금 (연결) 128
19. 연결이익잉여금 (연결) 130
20. 기타자본항목 (연결) 131

21. 비용의 성격별 분류 (연결) 132
22. 판매비와관리비 (연결) 133
23. 기타수익 및 기타비용 (연결) 134
24. 금융수익 및 금융비용 (연결) 134
25. 법인세비용 (연결) 135
26. 주당이익 (연결) 140
27. 현금흐름표 (연결) 140
28. 재무위험관리 (연결) 144
29. 부문별 보고 (연결) 158
30. 특수관계자와의 거래 (연결) 160
31. 비지배지분 (연결) 166
32. 매각예정분류(처분자산집단) (연결) 167
33. 보고기간 후 사건 (연결) 168
4. 재무제표 169
4-1. 재무상태표 169
4-2. 손익계산서 170
4-3. 포괄손익계산서 171
4-4. 자본변동표 171
4-5. 현금흐름표 172
5. 재무제표 주석 173
1. 일반적 사항 173
2. 중요한 회계처리방침 173
3. 중요한 회계추정 및 가정 179
4. 범주별 금융상품 180
5. 금융자산의 양도 183
6. 공정가치금융자산 184
7. 매출채권 및 미수금 188
8. 재고자산 190
9. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 190
10. 유형자산 193
11. 무형자산 196
12. 차입금 196
13. 사채 198
14. 순확정급여부채(자산) 199
15. 충당부채 202
16. 우발부채와 약정사항 204
17. 계약부채 206
18. 자본금 206
19. 이익잉여금 208
20. 기타자본항목 210
21. 비용의 성격별 분류 211
22. 판매비와관리비 212
23. 기타수익 및 기타비용 213
24. 금융수익 및 금융비용 214
25. 법인세비용 214
26. 주당이익 217
27. 현금흐름표 217

28. 재무위험관리 220
29. 부문별 보고 232
30. 특수관계자와의 거래 233
31. 보고기간 후 사건 255
6. 배당에 관한 사항 256
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 260
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 260
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 264
8. 기타 재무에 관한 사항 265
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 289
V. 회계감사인의 감사의견 등 309
1. 외부감사에 관한 사항 309
2. 내부통제에 관한 사항 317
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 320
1. 이사회에 관한 사항 320
2. 감사제도에 관한 사항 337
3. 주주총회 등에 관한 사항 344
VII. 주주에 관한 사항 352
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 361
1. 임원 및 직원 등의 현황 361
2. 임원의 보수 등 411
IX. 계열회사 등에 관한 사항 423
X. 대주주 등과의 거래내용 446
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 450
1. 공시내용 진행 및 변경사항 450
2. 우발부채 등에 관한 사항 450
3. 제재 등과 관련된 사항 453
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 460
XII. 상세표 465
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 465
2. 계열회사 현황(상세) 477
3. 타법인출자 현황(상세) 493
4. 연구개발실적(상세) 497
【 전문가의 확인 】 524
1. 전문가의 확인 524
2. 전문가와의 이해관계 524

사 업 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성전자주식회사
대 표 이 사 : 한 종 희
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
(전 화) 031-200-1114
(홈페이지) http://www.samsung.com/sec
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 김 동 욱
(전 화) 031-277-7218

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서
2024년 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여
직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의
누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된
기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이
기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에
따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2025. 3. 11

삼성전자 주식회사

대표이사: 한 종 희

신고업무 담당임원: 박 순 철

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 삼성전자주식회사이고 영문명은 Samsung Electronics Co., Ltd. 입니다.

나. 설립일자

당사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며,
1975년 6월 11일 기업공개를 실시하였습니다.
당사는 1984년 2월 28일 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를
삼성전자공업주식회사에서 삼성전자주식회사로 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
전화번호: 031-200-1114
홈페이지: https://www.samsung.com/sec

라. 주요 사업의 내용

당사는 제품의 특성에 따라 DX(Device eXperience), DS(Device Solutions) 2개의 부문과 패널 사업을 영위하는 SDC(삼성디스플레이㈜ 및 그 종속기업), 전장부품사업 등을 영위하는 Harman(Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업)으로 나누어 경영을 하고 있습니다.

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄, DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산・판매법인 및 SDC, Harman 산하 종속기업 등 228개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

각 부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

부문	주 요 제 품
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등
SDC	스마트폰용 OLED 패널 등
Harman	디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오, 포터블 스피커 등

[DX 부문]

DX 부문은 TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 및 스마트폰, 태블릿, 웨어러블(Wearable) 제품, 네트워크시스템 등을 생산・판매하는 사업으로 구성되어 있습니다.

TV사업은 2006년부터 2024년까지 19년 연속 판매 1위를 지키고 있습니다. 업체간 경쟁이 심화되는 가운데, 당사는 초대형 TV를 선두로 하여, 주력제품에 AI신기술을 대폭 적용해 경쟁사들과의 기술격차를 벌리고 있습니다. 또한, 가전 사업은 친환경·고효율 기술을 통해 제품의 기본 성능의 우위는 물론이고, 변화하는 라이프스타일에 대한 깊은 이해를 바탕으로 소비자의 삶을 편리하게 하는 제품과 서비스를 지속 출시하고 있습니다.

모바일사업은 2011년부터 2024년까지 14년 연속 글로벌 출하량 1위를 유지하고 있습니다. '갤럭시(Galaxy)' 브랜드를 통해 프리미엄부터 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업과 태블릿, 웨어러블, 디지털 월렛 등을 활용하여 시장 상황에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다.

당사는 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 지속적인 기술 혁신 및 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하겠습니다. 제품과 서비스의 지속적인 발전을 통해 친환경 기술 혁신을 이어가고, 연구개발을 통해 시장 패러다임 변화를 선도해 나가겠습니다.

[DS 부문]

DS 부문은 DRAM, NAND Flash 등 제품을 생산・판매하는 메모리 반도체 사업과 모바일 AP, 카메라 센서칩 등을 설계・판매하는 System LSI 사업, 반도체 제조 위탁 생산을 하는 Foundry 사업 등으로 구성되어 있습니다.

메모리 반도체 사업은 DRAM, NAND Flash 제품 등에 선단 공정 기술을 적용하고,
고부가 솔루션 중심의 사업 포트폴리오 운영을 통해 제품을 차별화하고 원가 경쟁력을 제고하는 등 질적 성장에 주력하여 전 세계 메모리 시장에서 선두 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다.

System LSI 사업은 모바일용 반도체 사업에서 차량용 반도체 사업으로 확장을 추진 중이며, On-Device AI 적용, 고성능 IP 탑재 등 제품의 차별화를 통해 고객과 협력 강화 및 응용처를 다변화하여 시장 지배력을 확대하는 한편, 차세대 기술 개발도 지속 추진하고 있습니다.

Foundry 사업은 Advanced 공정에서 지속적인 기술 경쟁력 강화를 통해 중장기 수요확보에 집중하고 있으며, Mature 공정에서는 응용처를 확대하는 한편 원가 경쟁력을
강화할 예정입니다.

[SDC]

SDC의 중소형 디스플레이 패널 사업은 차별화된 기술을 바탕으로 OLED 패널의 점유율을 확대하는 한편 폴더블・IT(태블릿/노트북)・Auto 등 다양한 응용처의 제품 출시를 통해 시장 영역을 넓혀 나가고 있습니다. 또한, 대형 디스플레이 패널 사업은 고화질, 초대형, 퀀텀닷(Quantum Dot) 등 프리미엄 제품 중심으로 사업을 특화하고,기술 및 생산성 향상을 지속 추진하여 사업 경쟁력을 제고하고 있습니다.

[Harman]

Harman은 커넥티드카 제품 및 솔루션 등을 개발 및 공급하는 전장부품 사업과 일반 오디오 제품 및 프로페셔널 오디오 솔루션을 제공하는 라이프스타일 오디오 사업을 운영하고 있습니다.

전장부품 시장의 선두업체로서 완성차 업체들에게 경쟁력 있는 제품을 공급하고 있을 뿐 아니라, 오디오 시장에서도 혁신 제품 판매를 통해 일반 소비자들과 음악 애호가들 사이에서 명성을 쌓아왔습니다.

또한, 당사 타 제품군과의 협업 확대를 통해 차별화된 고객 경험을 제공하고 자체 개발 및 전략적 인수 등을 통해 각 사업 분야에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

☞ 사업부문별 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 현황(요약)

기업회계기준서(K-IFRS) 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사(최상위)인 당사의 연결대상 종속기업은 2024년말 현재 228개사입니다. 전년말 대비 6개 기업이 증가하고 10개 기업이 감소하였습니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말	
상장	-	-	-	-	-
비상장	232	6	10	228	142
합계	232	6	10	228	142

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(당기 연결대상회사의 변동내용)

구 분	자회사	사 유
신규 연결	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	설립
	Oxford Semantic Technologies Limited	지분취득
	Sonio SAS	지분취득
	Sonio Corporation	지분취득
	Samsung Electronics Middle east and North Africa (SEMENA)	설립
	SVIC 67호 신기술투자조합	설립
연결 제외	Harman Financial Group LLC	청산
	Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK)	청산
	Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	청산
	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	매각
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	청산
	㈜도우인시스	매각
	지에프㈜	매각
	SVIC 48호 신기술투자조합	청산
	SVIC 29호 신기술투자조합	청산
	SVIC 40호 신기술투자조합	청산

바. 중소기업 해당 여부

당사는「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부		미해당
	벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 신용평가에 관한 사항

당사는 Moody's(미국) 및 S&P(미국)로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다.
2024년말 현재 Moody's의 당사 평가등급은 Aa2, 전망치는 안정적(Stable)이고, S&P의 당사 평가등급은 AA-, 전망치는 안정적(Stable)입니다.

평가대상 유가증권	평가일	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사	비고
회사채 US$ Bond ('97년 발행, '27년 만기)	2022.08	AA-	S&P	정기평가
	2022.09	Aa2	Moody's	정기평가
	2023.07	AA-	S&P	정기평가
	2023.08	Aa2	Moody's	정기평가
	2024.02	Aa2	Moody's	정기평가
	2024.07	AA-	S&P	정기평가

※ 신용평가등급 범위: Moody's (Aaa~C), S&P (AAA~D)

구 분	Moody's		S&P	
	등 급	정 의	등 급	정 의
투자적격 등급	Aaa	재무상환능력 최상, 신용위험 최소	AAA	채무상환능력이 극히 높음, 최고등급
	Aa1/Aa2/Aa3	재무상환능력 높음, 신용위험 매우 낮음	AA+/AA/AA-	채무상환능력이 매우 높음
	A1/A2/A3	재무상환능력 중상, 신용위험 낮음	A+/A/A-	채무상환능력은 충분하나 경제 상황 악화 및 변화에 다소 취약함
	Baa1/Baa2/ Baa3	채무상환능력 중간, 신용위험 크지 않으나 투기적 요소가 있음	BBB+/BBB/ BBB-	채무상환능력은 충분하나 상위 등급에 비해 경제 상황 악화에 좀 더 취약함
투기 등급	Ba1/Ba2/Ba3	투기적 성향, 신용위험 상당함	BB+/BB/BB-	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 낮으나 경영, 재무, 경제 상황 악화에 대한 불확실성이 큼
	B1/B2/B3	투기적 성향, 신용위험 높음	B+/B/B-	경영, 재무, 경제 상황 악화에 좀 더 취약하나 현재로서는 채무상환능력이 있음
	Caa	투기적 성향 높음, 신용위험 매우 높음	CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며 채무상환은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 가능함
	Ca	투기적 성향 매우 높음, 가까운 시일 내 부도발생 가능, 원리금 상환가능성 존재	CC	채무불이행 가능성이 높음, 부도 상태는 아니지만 사실상 부도가 예상됨
	C	부도 상태, 원리금 상환가능성 낮음	C	현재 채무불이행 가능성이 매우 높으며 최종 회수율은 상위등급 채무보다 낮게 추정됨
			D	금융채무불이행 상태 혹은 묵시적 계약 (imputed promises) 파기, 또는 파산 신청 혹은 이와 유사한 상태

☞ 당사의 종속기업이 발행한 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용등급 평가결과는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

아. 주권상장(또는 등록・지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

당사는 1975년 6월 11일 유가증권시장에 기업공개를 실시하였습니다.

주권상장 (또는 등록・지정)현황	주권상장 (또는 등록・지정)일자	특례상장 유형
유가증권시장 상장	1975년 06월 11일	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점소재지는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)입니다.
공시대상기간 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

당사의 이사회는 주주총회에서 선임한 이사로 구성되며 회사 업무의 중요사항을 결 의합니다. 2024년말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(한종희, 노태문, 이정배), 사외이사 6인(김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다.

당사의 대표이사는 이사회에서 선임하며 각자 회사를 대표합니다. 2024년말 현재 당사의 대표이사는 한종희 사내이사(2022년 2월 선임, 2023년 3월 재선임)입니다. 경계현 전)대표이사(2022년 3월 선임)는 2024년 5월 21일 대표이사직과 사내이사직을 사임하였습니다.

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임	
2020.03.18	정기주총	사내이사 한종희 사내이사 최윤호	-	-
2021.03.17	정기주총	-	사내이사 김기남 사내이사 김현석 사내이사 고동진 사외이사 박병국 사외이사 김종훈 (감사위원회 위원이 되는) 사외이사 김선욱	-
2021.03.17	-	-	대표이사 김기남 대표이사 김현석 대표이사 고동진	-
2021.12.31	-	-	-	사내이사 최윤호(사임)
2022.02.15	-	대표이사 한종희	-	대표이사 김기남(사임) 대표이사 김현석(사임) 대표이사 고동진(사임)
2022.03.16	정기주총	사내이사 경계현 사내이사 노태문 사내이사 박학규 사내이사 이정배 사외이사 한화진 사외이사 김준성	사외이사 김한조	사내이사 김기남(사임) 사내이사 김현석(사임) 사내이사 고동진(사임)
2022.03.16	-	대표이사 경계현	-	-
2022.03.19	-	-	-	사외이사 박재완(임기만료) 사외이사 안규리(임기만료)
2022.04.20	-	-	-	사외이사 한화진(사임)
2022.05.17	-	-	-	사외이사 박병국(기타퇴임)
2022.11.03	임시주총	사외이사 허은녕 사외이사 유명희	-	-
2023.03.15	정기주총	-	사내이사 한종희	-
2023.03.15	-	-	대표이사 한종희	-
2024.03.20	정기주총	사외이사 신제윤 (감사위원회 위원이 되는) 사외이사 조혜경	-	사외이사 김선욱(기타퇴임)
2024.03.22	-	-	-	사외이사 김종훈(임기만료)
2024.05.21	-	-	-	대표이사 및 사내이사 경계현(사임)
2024.12.26	-	-	-	사내이사 박학규(사임)

※ 2024년 3월 20일 주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인으로 조혜경 사외이사가 선임됨에 따라 2021년 동일한 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임된 김선욱 사외이사는 2024년 3월 20일 사임 형식으로 퇴임하게 되었습니다.

다. 최대주주의 변동

2021년 4월 29일에 기존 최대주주가 소유하던 당사 주식의 상속으로 인해 최대주주가 삼성생명보험㈜으로 변동되었습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2021.04.29	삼성생명보험㈜	1,263,050,053	21.16%	변동전 최대주주의 피상속	-

※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역이며,
의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

☞ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경

2021년 중에는 종속기업 Samsung Electronics Portuguesa S.A. (SEP) 사명이 Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)로 변경되었습니다.

2023년 중에는 종속기업 Emerald Intermediate, Inc. 사명이 Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)로 변경되었습니다.

☞ 당사(지배기업) 및 주요 종속기업 기준으로 작성하였습니다.
주요 종속기업에 대한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

마. 합병 등에 관한 사항

2021년 중 종속기업 Viv Labs, Inc.는 종속기업 Samsung Research America, Inc (SRA)에 합병되었습니다. 또한, 종속기업 Prismview, LLC는 종속기업 Samsung Electronics America, Inc. (SEA)에 합병되었습니다.

2023년 중 종속기업 Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)는 eMagin Corporation 지분을 인수하였습니다.

☞ 당사(지배기업) 및 주요 종속기업 기준으로 작성하였습니다.
주요 종속기업에 대한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(1) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

연도	내용
2020	'그랑데 AI' 인공지능 기반 세탁기・건조기 출시
	AI・차세대 슈퍼컴퓨터용 초고속 DRAM 출시
	'Galaxy Z 플립' 최초 폴더블폰 공개
	세계 최대 규모 평택 반도체 2라인 가동
2021	'Neo QLED TV' 공개
	전세계 반도체 업체 최초 전 사업장 '탄소/물/폐기물 저감' 인증
	업계 최선단 14나노 EUV DDR5 D램 양산
	미국 테일러市에 신규 파운드리 라인 투자 발표
2022	BESPOKE 인피니트 라인 공개
	세계 최초 3나노 GAA 파운드리 양산
	차세대 반도체 R&D단지 기공식
	1Tb 8세대 V낸드 양산
2023	초고화소 기술 집약된 2억 화소 이미지센서 '아이소셀 HP2' 출시
	업계 최선단 12나노급 D램 양산
	'Galaxy Z 폴드5', 'Galaxy Z 플립5' 공개
	현존 최대 용량 32Gb DDR5 D램 개발
	생성형 AI '삼성 가우스' 공개
2024	'Galaxy S24 시리즈' 공개
	업계 최초 '9세대 V낸드' 양산
	'Galaxy Z 폴드6', 'Galaxy Z 플립6' 공개
	브랜드가치 사상 첫 1천억 달러 기록, 5년 연속 세계 5위
	업계 최초 '24Gb GDDR7 D램' 개발

(2) 조직의 변경

당사는 2021년 12월 중 기존의 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience)사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

[2021년 12월]

<table>
<tr><th></th><th>변경전</th><th>변경후</th></tr>
<tr><td rowspan="4">사업
조직</td><td>CE 부문
(영상디스플레이,
생활가전, 의료기기)</td><td rowspan="2">DX 부문
(영상디스플레이,
생활가전, 의료기기,
Mobile eXperience, 네트워크)</td></tr>
<tr><td>IM 부문
(무선, 네트워크)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DS 부문
(메모리, System LSI, Foundry,
디스플레이 패널)</td><td>DS 부문
(메모리, System LSI, Foundry)</td></tr>
<tr><td>SDC
(디스플레이 패널)</td></tr>
<tr><td>Harman 부문</td><td>Harman</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지역
총괄</td><td>한국, 북미, 중남미, 구주,
CIS, 서남아, 동남아, 중국,
중동, 아프리카</td><td>한국, 북미, 중남미, 구주,
CIS, 서남아, 동남아, 중국,
중동, 아프리카</td></tr>
<tr><td>미주(DS), 구주(DS),
중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)</td><td>미주(DS), 구주(DS),
중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)</td></tr>
</table>

3. 자본금 변동사항

당사는 공시대상기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.
한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제56기말
보통주	발행주식총수	5,969,782,550
	액면금액	100
	자본금	596,978,255,000
우선주	발행주식총수	822,886,700
	액면금액	100
	자본금	82,288,670,000
합계	자본금	679,266,925,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2024년말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주") 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 "우선주")의 수는 각각 7,780,466,850주와 1,194,671,350주입니다. 당사는 2024년말 현재까지 보통주 1,810,684,300주와 우선주 371,784,650주를 이사회 결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 2024년말 현재 유통주식수는 보통주 5,940,082,550주, 우선주 818,836,700주입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 주, %)

구 분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계	
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		20,000,000,000	5,000,000,000	25,000,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		7,780,466,850	1,194,671,350	8,975,138,200	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		1,810,684,300	371,784,650	2,182,468,950	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	1,810,684,300	371,784,650	2,182,468,950	자사주소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		5,969,782,550	822,886,700	6,792,669,250	-
Ⅴ. 자기주식수		29,700,000	4,050,000	33,750,000	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		5,940,082,550	818,836,700	6,758,919,250	-
Ⅶ. 자기주식 보유비율		0.5	0.5	0.5	-

나. 자기주식

당사는 2024년 중 주주가치 제고의 목적으로 보통주 29,700,000주, 우선주 4,050,000주를 각각 취득하였습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주	-	29,700,000	-	-	29,700,000	-
			우선주	-	4,050,000	-	-	4,050,000	-
		장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주	-	29,700,000	-	-	29,700,000	-
			우선주	-	4,050,000	-	-	4,050,000	-
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	-	29,700,000	-	-	29,700,000	-
			우선주	-	4,050,000	-	-	4,050,000	-

[자기주식 직접 취득 · 처분 이행현황]

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간		예정수량 (A)	이행수량 (B)	이행률 (B/A)	결과 보고일
	시작일	종료일				
직접 취득	2024.11.20	2025.02.17	57,056,664	33,750,000	59.1	2025.02.17

※ 2024년 11월 15일 당사 이사회에서 주주가치 제고를 위해 자기주식 57,056,664주(보통주 50,144,628주, 우선주 6,912,036주) 매입을 결정하였고, 2024년 중 33,750,000주(보통주 29,700,000주, 우선주 4,050,000주)
매입을 완료하였습니다.

※ 2025년 2월 13일 자기주식 57,056,664주 (보통주 50,144,628주, 우선주 6,912,036주) 취득을 완료하고 이사회 결의를 거쳐 2025년 2월 20일(한국예탁결제원 소각 실행일) 위와 같이 취득한 주식 전량을 소각하였습니다.

다. 다양한 종류의 주식

당사는 보통주 외 비누적적 우선주를 발행하고 있습니다.
이 우선주는 보통주의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을
더 받을 수 있으며, 2024년말 현재 우선주의 발행주식수는 822,886,700주입니다.

(단위 : 원)

발행일자			1989.08.25	
주당 발행가액(액면가액)			576	100
발행총액(발행주식수)			119,467,135,000	1,194,671,350
현재 잔액(현재 주식수)			82,288,670,000	822,886,700
주식의 내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)		-	
	이익배당에 관한 사항		액면금액 기준 보통주보다 1%의 금전배당을 추가로 받음	
	잔여재산분배에 관한 사항		-	
	상환에 관한 사항	상환권자	없음	
		상환조건	-	
		상환방법	-	
		상환기간	-	
		주당 상환가액	-	
		1년 이내 상환 예정인 경우	-	
	전환에 관한 사항	전환권자	없음	
		전환조건 (전환비율 변동여부 포함)	-	
		발행이후 전환권 행사내역	N	
		전환청구기간	-	
		전환으로 발행할 주식의 종류	-	
		전환으로 발행할 주식수	-	
	의결권에 관한 사항		의결권 없음	
기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등)			-	

※ 발행일자 및 주당 발행가액는 최초 발행일 기준입니다. (주당 발행가액은 액면분할 후 기준)

※ 이익소각으로 인해 발행주식의 액면 총액은 82,289백만원으로 납입자본금(119,467백만원)과 상이합니다. 상기 발행주식수, 현재주식수 등은 2018년 주식분할로 인한 주식수의 변동을 반영한 수치입니다.

[우선주 발행일자별 내역] (단위 : 주, 원)

일 자	변 동	증가(감소)한 주식의 내용					
		종류	수량(주)	주 당 액면가액	액면가액 합계	주 당 발행가액	발행가액 합계
1989.08.25	유상증자	우선주	3,400,000	5,000	17,000,000,000	28,800	97,920,000,000
1989.08.25	무상증자	우선주	340,000	5,000	1,700,000,000	5,000	1,700,000,000
1990.10.29	전환권 행사	우선주	371,620	5,000	1,858,100,000	29,600	10,999,952,000
1991.03.19	전환권 행사	우선주	40,898	5,000	204,490,000	29,341	1,199,988,218
1991.03.30	전환권 행사	우선주	5,112	5,000	25,560,000	29,341	149,991,192
1991.04.08	전환권 행사	우선주	1,704	5,000	8,520,000	29,341	49,997,064
1991.05.17	DR 발행	우선주	1,907,671	5,000	9,538,355,000	37,973	72,439,990,883
1991.07.24	전환권 행사	우선주	34,081	5,000	170,405,000	29,341	999,970,621
1991.07.30	전환권 행사	우선주	20,449	5,000	102,245,000	29,341	599,994,109
1991.07.31	전환권 행사	우선주	64,754	5,000	323,770,000	29,341	1,899,947,114
1991.08.30	전환권 행사	우선주	214,716	5,000	1,073,580,000	29,341	6,299,982,156
1991.09.30	전환권 행사	우선주	20,448	5,000	102,240,000	29,341	599,964,768
1993.06.17	DR 발행	우선주	2,542,372	5,000	12,711,860,000	47,312	120,284,704,064
1993.10.29	전환권 행사	우선주	105,999	5,000	529,995,000	28,302	2,999,983,698
1993.11.12	DR 발행	우선주	2,158,273	5,000	10,791,365,000	55,975	120,809,331,175
1993.11.29	전환권 행사	우선주	58,295	5,000	291,475,000	28,302	1,649,865,090
1993.11.30	전환권 행사	우선주	19,079	5,000	95,395,000	28,302	539,973,858
1994.04.06	DR 발행	우선주	1,086,956	5,000	5,434,780,000	74,502	80,980,395,912
1994.06.03	전환권 행사	우선주	16,027	5,000	80,135,000	25,809	413,640,843
1994.06.06	전환권 행사	우선주	9,072	5,000	45,360,000	25,809	234,139,248
1994.06.13	전환권 행사	우선주	17,236	5,000	86,180,000	25,809	444,843,924
1994.06.22	전환권 행사	우선주	1,209	5,000	6,045,000	25,809	31,203,081
1994.06.27	전환권 행사	우선주	16,632	5,000	83,160,000	25,809	429,255,288
1994.06.28	전환권 행사	우선주	54,131	5,000	270,655,000	25,809	1,397,066,979
1994.06.29	전환권 행사	우선주	292,127	5,000	1,460,635,000	25,809	7,539,505,743
1994.06.30	전환권 행사	우선주	52,922	5,000	264,610,000	25,809	1,365,863,898
1994.07.01	전환권 행사	우선주	232,854	5,000	1,164,270,000	25,809	6,009,728,886
1994.07.04	전환권 행사	우선주	116,426	5,000	582,130,000	25,809	3,004,838,634
1994.07.05	전환권 행사	우선주	188,401	5,000	942,005,000	25,809	4,862,441,409
1994.07.06	전환권 행사	우선주	686,164	5,000	3,430,820,000	25,809	17,709,206,676
1994.07.07	전환권 행사	우선주	270,349	5,000	1,351,745,000	25,809	6,977,437,341
1994.07.08	전환권 행사	우선주	977,068	5,000	4,885,340,000	25,809	25,217,148,012
1994.07.12	전환권 행사	우선주	6,048	5,000	30,240,000	25,809	156,092,832
1994.07.19	전환권 행사	우선주	68,040	5,000	340,200,000	25,809	1,756,044,360
1994.07.20	전환권 행사	우선주	4,232	5,000	21,160,000	25,809	109,223,688
1994.08.12	전환권 행사	우선주	944	5,000	4,720,000	25,502	24,073,888
1995.03.13	무상증자	우선주	3,028,525	5,000	15,142,625,000	5,000	15,142,625,000
1996.03.13	무상증자	우선주	5,462,593	5,000	27,312,965,000	5,000	27,312,965,000
2003.04.14	이익소각	우선주	△470,000	5,000	△2,350,000,000	-	-
2004.01.15	이익소각	우선주	△330,000	5,000	△1,650,000,000	-	-
2004.05.04	이익소각	우선주	△260,000	5,000	△1,300,000,000	-	-
2016.01.15	이익소각	우선주	△1,240,000	5,000	△6,200,000,000	-	-
2016.04.20	이익소각	우선주	△530,000	5,000	△2,650,000,000	-	-
2016.07.19	이익소각	우선주	△320,000	5,000	△1,600,000,000	-	-
2016.09.28	이익소각	우선주	△230,000	5,000	△1,150,000,000	-	-

2017.04.12	이익소각	우선주	△255,000	5,000	△1,275,000,000	-	-
2017.05.02	이익소각	우선주	△1,614,847	5,000	△8,074,235,000	-	-
2017.07.24	이익소각	우선주	△225,000	5,000	△1,125,000,000	-	-
2017.10.25	이익소각	우선주	△168,000	5,000	△840,000,000	-	-
2018.01.30	이익소각	우선주	△178,000	5,000	△890,000,000	-	-
2018.05.03	주식분할	우선주	885,556,420	100	-	-	-
2018.12.04	이익소각	우선주	△80,742,300	100	△8,074,230,000	-	-
우선주 계			822,886,700		82,288,670,000		642,261,376,652

[△는 부(-)의 값임]

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력

당사는 제55기 정기주주총회(2024년 3월 20일)에서 정관 일부를 변경하였습니다.

☞ 정관변경에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 제55기 정기주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2024.03.20	제 55기 정기주주총회	- 주권의 종류 삭제 - 명의개서대리인의 사무처리 내용 변경, 명의개서 대리인에 대한 주주정보 신고 조항 삭제, 소유자명세에 기반한 주주명부 작성 등 신설 - 주주명부 폐쇄 관련 사항 삭제 - 주식, 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 근거조항 신설 - 이사회 산하 위원회로 보상위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회를 명시 - 이사회의 소집 통지기한을 '24시간 전'에서 '7일 전(단, 긴급시 24시간으로 단축 가능)'으로 변경 - 기타 조문 정비 : 제38조(이익금의 처분), 제40조(내부거래 등의 승인)	- 전자증권 관련 조문 정비 - 이사회 산하 설치되어 있는 위원회 종류 추가 - 이사회 소집통지 시점 변경

나. 사업 목적

[사업목적 현황]

구 분	사업목적	사업영위 여부
1	전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	영위
2	통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	영위
3	의료기기의 제작 및 판매업	영위
4	광디스크 및 광원응용기계기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업	영위
5	광섬유, 케이블 및 관련 기기의 제조, 판매, 임대, 서비스업	영위
6	전자계산조직 및 동 관련 제품의 제조, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	영위
7	저작물, 컴퓨터 프로그램 등의 제작, 판매, 임대업	영위
8	노우하우, 기술의 판매, 임대업	영위
9	정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공	영위
10	자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위
11	공작기계 및 부품의 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위
12	반도체 및 관련 제품의 제조, 판매업	영위

13	반도체 제조 장치의 제조, 판매업	영위
14	반도체 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업	영위
15	기타기계기구의 제작 및 판매업	영위
16	합성수지의 제조, 가공 및 판매업	영위
17	금을 제외한 금속의 제련가공 및 판매업	영위
18	수출입업 및 동 대행업	영위
19	경제성 식물의 재배 및 판매업	미영위
20	부동산업	영위
21	물품 매도 확약서 발행업	영위
22	계량기, 측정기 등의 교정 검사업 및 제작, 판매업	영위
23	전 각항의 기술용역, 정보통신 공사업 및 전기공사업	영위
24	주택사업 임대 및 분양	영위
25	운동, 경기 및 기타 관련사업	영위
26	전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업	영위
27	전기공급 및 제어장치 제조업	영위
28	교육 서비스업 및 사업 관련 서비스업	영위
29	각 항에 관련된 부대사업 및 투자	영위

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 228개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업별로 보면, Set 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등을 생산·판매하며, 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산·판매하고, SDC가 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산·판매하고 있습니다.
또한, Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오 등 전장제품과 포터블/사운드바 스피커 등 소비자오디오 제품 등을 생산·판매하고 있습니다.

☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본사와 31개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이㈜와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매㈜, 제품 수리 서비스를 담당하는 삼성전자서비스㈜, 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍㈜ 등 비상장 종속기업들로 구성되어 있습니다.

해외(미주, 유럽・CIS, 중동・아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 197개의 비상장 종속기업이 운영되고 있습니다.

미주에는 TV, 스마트폰 등 Set제품의 미국판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA), TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체・디스플레이 패널 판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set 제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA) 등을 포함하여 총 47개의 판매・생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽・CIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy) 등 Set 제품 판매법인과 SEH(Hungary) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 SEPM(Poland) 등을 포함하여 총 68개의 법인이 운영되고 있습니다.

중동・아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set 제품 판매법인과 SEEG (Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 21개 법인이 운영되고 있습니다 .

아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과 스마트폰 등 생산법인 SEV・SEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), 디스플레이 패널 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 32개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set제품 판매법인과 SSS(Shanghai), SSCX(Xian) 등 반도체・디스플레이 패널 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set 제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 29개의 법인이 운영되고 있습니다.

2024년 당사의 매출은 300조 8,709억원으로 전년 동기 대비 16.2% 증가하였으며, 주요 매출처로는 Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics, Verizon 등(알파벳순)이 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산・판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등을 생산・판매하고 있습니다.

2024년 매출은 DX 부문이 174조 8,877억원(58.1%), DS 부문이 111조 660억원(36.9%)이며, SDC가 29조 1,578억원(9.7%), Harman은 14조 2,749억원(4.7%)입니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	주요 제품	매출액	비중
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등	1,748,877	58.1%
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	1,110,660	36.9%
SDC	스마트폰용 OLED패널 등	291,578	9.7%
Harman	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	142,749	4.8%
기타	부문간 내부거래 제거 등	△285,155	△9.5%
총 계		3,008,709	100.0%

※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2024년 TV의 평균 판매가격은 전년 대비 약 2% 하락하였으며, 스마트폰은 전년 대비 약 2% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 대비 약 63% 상승하였으며, 스마트폰용 OLED 패널은 약 29% 하락하였습니다. 한편 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년 대비 약 1% 상승하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황

당사의 주요 원재료로 DX 부문은 모바일AP 솔루션, Camera Module 등을 Qualcomm, 삼성전기㈜ 등에서 공급받고 있으며, TV・모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Chemical, Wafer 등을 솔브레인㈜, SUMCO 등으로부터, SDC는 FPCA, Cover Glass 등을 ㈜비에이치, Apple 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 MCU(Micro Controller Unit)를 포함한 SOC(System-On-Chip), 통신 모듈 등을 NVIDIA, WNC 등에서 공급받고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	품 목	구체적 용도	매입액	비중	주요 매입처
DX 부문	모바일AP 솔루션	CPU	109,326	16.1%	Qualcomm, MediaTek
	디스플레이 패널	TV・모니터용 화면표시장치	75,825	11.2%	CSOT, AUO 등
	Camera Module	스마트폰 카메라	55,356	8.2%	삼성전기, 파트론 등
	기타	-	437,451	64.5%	
	소 계		677,958	100.0%	
DS 부문	Chemical	원판 가공	27,234	16.7%	솔브레인㈜, 동우화인켐(주) 등
	Wafer	반도체 원판	21,363	13.1%	SUMCO, SILTRONIC 등
	기타	-	114,876	70.2%	
	소 계		163,473	100.0%	
SDC	FPCA	구동회로	25,342	20.3%	㈜비에이치, 씨유테크 등
	Cover Glass	강화유리	16,248	13.0%	Apple, LENS 등
	기타	-	83,376	66.7%	
	소 계		124,966	100.0%	
Harman	SOC(System-On-Chip)	CPU	7,157	9.4%	NVIDIA, INTEL, RENESAS, ARROW
	통신 모듈	차량 통신	4,322	5.6%	WISTRON NEWEB CORP, COMPAL
	기타	-	65,068	85.0%	
	소 계		76,547	100.0%	
기타	-	-	420	-	
총 계			1,043,364	-	

※ 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.

※ 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.

※ 주요 매입처 중 삼성전기㈜는 계열회사입니다.

나. 주요 원재료 가격 변동 추이

DX 부문의 주요 원재료인 모바일AP 솔루션 가격은 전년 대비 약 7% 상승하였고, Camera Module은 약 4% 상승, TV・모니터용 디스플레이 패널은 약 11% 상승하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년 대비 약 4% 하락하였으며, SDC의 FPCA 가격은 약 21% 하락, 강화유리용 Cover Glass 가격은 약 23% 하락하였습니다. Harman의 원재료 중 SOC(System-On-Chip) 가격은 약 5% 하락하였으며, 통신 모듈은 약 8% 하락하였습니다.

※ 원재료 가격은 부문 등 간의 내부거래 등을 포함하고 있습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제56기	제55기	제54기
DX 부문	TV, 모니터 등	51,795	53,552	55,747
	스마트폰 등	265,700	284,700	332,170
DS 부문	메모리	2,238,240,405	1,926,651,546	1,905,731,836
SDC	디스플레이 패널	2,264	2,320	2,700
Harman	디지털 콕핏	8,520	10,912	11,257

※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다.

DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산 기준으로 환산 생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass(2,200×2,500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털 콕핏 생산능력은 '각 거래처・제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

2024년(제56기) DX 부문의 TV, 모니터 등 생산실적은 41,354천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. 스마트폰 등 생산실적은 193,500천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 2,238,240백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 디스플레이 패널 생산실적은 1,759천개(8세대 Glass 환산 기준)이며 한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 5,814천개이며, 주로 멕시코, 헝가리, 중국 등에서 생산되고
있습니다.

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제56기	제55기	제54기
DX 부문	TV, 모니터 등	41,354	40,085	41,802
	스마트폰 등	193,500	189,991	229,180
DS 부문	메모리	2,238,240,405	1,926,651,546	1,905,731,836
SDC	디스플레이 패널	1,759	1,407	2,008
Harman	디지털 콕핏	5,814	7,658	8,334

※ 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.

(가동률)

당사 DX 부문의 2024년(제56기) 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV, 모니터 등은 79.8%, 스마트폰 등은 72.8%입니다.

(단위 : 천대)

부 문	품 목	제56기		
		생산능력 대수	실제 생산 대수	가동률
DX 부문	TV, 모니터 등	51,795	41,354	79.8%
	스마트폰 등	265,700	193,500	72.8%

DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 디스플레이 패널 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 2024년(제56기) 가동일은 휴일을 포함하여 총 366일입니다. 가동률은 생산라인별 가동 가능시간 (가동일 ×생산라인 수 ×24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다.

(단위 : 시간)

부 문	품 목	제56기		
		가동 가능 시간	실제 가동 시간	가동률
DS 부문	메모리	87,840	87,840	100%
SDC	디스플레이 패널	43,920	43,920	100%

Harman의 2024년(제56기) 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 68.2%입니다.

(단위 : 천개)

부문	품 목	제56기		
		생산능력 개수	실제 생산 개수	가동률
Harman	디지털 콕핏	8,520	5,814	68.2%

라. 생산설비 및 투자 현황 등

(생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄,SDC 및 Harman 산하 종속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (DX 부문, DS 부문, SDC 산하 12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동)
	평택사업장	경기도 평택시 삼성로 114(고덕동)
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465(성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158(북수리)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181(명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244(공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동)
해외 (DX 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA
	구주 총괄	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK
	중국 총괄	No.31, Jinghui Street, Chaoyang, Beijing, China
	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore
	서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India
	CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia
	중동 총괄	7421 King Fahd Road Al Olaya Dist, Riyadh 12212, KSA
	아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa
	중남미 총괄	Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	3655 N. 1st St. San Jose, California, USA
	구주 총괄	Einsteinstrasse 174, 81677, Munich, Germany
	중국 총괄	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China
	동남아 총괄	3 Church Street, #26-01 Samsung Hub, Singapore
	일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan
Harman	미국 HQ	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany

	Harman Consumer Nederland B.V.	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2024년 말 현재 장부금액은 205조 9,452억원으로 전년말 대비 18조 6,889억원 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

구 분		토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	계
기초	기초장부금액	99,994	432,381	833,092	467,203	39,893	1,872,563
	- 취득원가	101,580	736,899	3,285,615	467,203	140,587	4,731,884
	- 감가상각누계액 (손상 포함)	△1,586	△304,518	△2,452,523	-	△100,694	△2,859,321
증감	일반취득 및 자본적지출	2,449	70,576	402,196	50,731	23,470	549,422
	사업결합을 통한 취득	-	-	-	-	2	2
	감가상각	△500	△42,683	△337,447	-	△15,870	△396,500
	처분・폐기・손상	△273	△5,250	△1,578	△504	△318	△7,923
	기타	812	15,295	12,803	13,743	△765	41,888
기말	기말장부금액	102,482	470,319	909,066	531,173	46,412	2,059,452
	- 취득원가	104,350	824,153	3,732,764	531,173	158,521	5,350,961
	- 감가상각누계액 (손상 포함)	△1,868	△353,834	△2,823,698	-	△112,109	△3,291,509

※ 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.

(시설투자 현황)

2024년 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설・전환과 인프라 투자를 중심으로 53.6조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 메모리 차세대 기술 경쟁력 강화 및 중장기 수요 대비를 위한 투자를 지속 추진하였고, 시스템 반도체는 Advanced 노드 CAPA 확보를 위한 투자도 진행 중입니다. 내실을 다지는 활동을 통해 투자 효율성 제고에도 집중할 계획입니다.

(단위 : 억원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액
DS 부문	신・증설, 보완 등	2024.01~2024.12	건물・설비 등	462,792
SDC	신・증설, 보완 등	2024.01~2024.12	건물・설비 등	48,351
기 타	신・증설, 보완 등	2024.01~2024.12	건물・설비 등	25,318
합 계				536,461

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

2024년 매출은 300조 8,709억원으로 전년 동기 대비 16.2% 증가하였습니다.
부문별로는 전년 대비 DX 부문이 2.9% 증가, DS 부문이 66.8% 증가하였으며,
SDC는 5.9% 감소, Harman은 0.8% 감소하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문	매출유형	품 목	제56기	제55기	제54기
DX 부문	제・상품, 용역 및 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등	1,748,877	1,699,923	1,824,897
DS 부문	제・상품, 용역 및 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	1,110,660	665,945	984,553
SDC	제・상품, 용역 및 기타매출	스마트폰용 OLED 패널 등	291,578	309,754	343,826
Harman	제・상품, 용역 및 기타매출	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	142,749	143,885	132,137
기 타	부문간 내부거래 제거 등		△285,155	△230,152	△263,099
합 계			3,008,709	2,589,355	3,022,314

※ 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

(1) 주요 제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제56기	제55기	제54기
TV, 모니터 등	309,316	303,752	332,795
스마트폰 등	1,144,249	1,086,325	1,154,254
메모리	844,630	441,254	685,349
디스플레이 패널	291,578	309,754	343,826

※ 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(2) 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제56기	제55기	제54기
제・상품	2,933,617	2,461,380	2,903,461
용역 및 기타매출	75,092	127,975	118,853
계	3,008,709	2,589,355	3,022,314

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 주요 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

구 분		제56기	제55기	제54기
내수	국내	202,978	205,196	221,799
수출	미주	613,533	510,934	659,617
	유럽	290,967	239,342	265,147
	아시아・아프리카	333,769	326,262	425,114
	중국	649,275	422,007	546,998
계		2,090,522	1,703,741	2,118,675

※ 별도 기준의 내수・수출 매출 현황입니다.

나. 판매경로 등

(1) 국내

판매자	판 매 경 로	소비자
생산 및 매입	전속 대리점	소비자
	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등)	
	통신사업자(SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스)	
	직접판매(B2B 및 온라인 등)	

(2) 해외

<table>
<tr><td>판매자</td><td colspan="4">판 매 경 로</td><td>소비자</td></tr>
<tr><td rowspan="7">생산법인</td><td rowspan="5">판매법인</td><td colspan="3">Retailer</td><td rowspan="7">소비자</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
<tr><td>Distributor</td><td>Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
<tr><td colspan="3">통신사업자, Automotive OEM</td></tr>
<tr><td colspan="3">직접판매(B2B 및 온라인)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">물류법인</td><td rowspan="3">판매법인</td><td colspan="2">Retailer</td></tr>
<tr><td>Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
<tr><td>Distributor</td><td>Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
</table>

(3) 판매경로별 매출액 비중

경 로	도매	소매	특직판	기타
비 중	16%	25%	50%	9%

다. 판매방법 및 조건

(1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	약정여신조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
통신사업자	SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담 (공동마케팅)
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

(2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래처 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

・프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
・브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
・고객・시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

마. 주요 매출처

2024년 당사의 주요 매출처로는 Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics, Verizon 등(알파벳순) 입니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 14% 수준입니다.

바. 수주상황

2024년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리정책

당사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다.

재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로구성되어 있습니다.

나. 주요 재무위험관리

(1) 시장위험

(환율변동위험)

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.

당사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 당사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제56기말		제55기말	
	환율 상승시	환율 하락시	환율 상승시	환율 하락시
USD	365,273	△365,273	418,776	△418,776
EUR	88,649	△88,649	151,740	△151,740

[△는 부(-)의 값임]

(이자율변동위험)

이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 변동금리부 금융자산 및 금융부채에 대하여 이자율이 1%p 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제56기말		제55기말	
	이자율 상승시	이자율 하락시	이자율 상승시	이자율 하락시
금융자산	141,671	△141,671	210,617	△210,617
금융부채	△5,702	5,702	△6,197	6,197
순효과	135,969	△135,969	204,420	△204,420

[△는 부(-)의 값임]

(주가변동위험)

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직・간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

2024년말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 76,865백만원(전기: 52,510백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 862백만원(전기: 3,472백만원)입니다.

(2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를
하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.

당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 당사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지・관리하고 있습니다.

당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.

보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

1) 제56기말

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과
금융부채	55,955,211	1,369,038	1,819,044	7,654,816	1,802,556

2) 제55기말

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과
금융부채	43,302,421	589,743	1,529,785	7,811,246	2,337,792

(4) 자본위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제56기말	제55기말
부 채	112,339,878	92,228,115
자 본	402,192,070	363,677,865
부채비율	27.9%	25.4%

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 환율변동 위험관리 목적상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적 및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다.

2024년말 현재 당사는 USD, EUR 등 총 32개 통화에 대하여 5,862건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 자산・부채 장부금액 및 관련손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	이익	손실
통화선도	89,982	94,559	911,628	700,046

그리고 당사는 레인보우로보틱스㈜ 및 그 최대주주 등과 체결한 주주간 계약에 따라, 일정 기간 동안 최대주주 등에게 최대주주 등이 보유하는 주식의 전부 또는 일부를 당사 또는 당사가 지정한 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 또한 레인보우로보틱스㈜의 최대주주 등은 일정한 사유가 발생할 경우, 당사가 보유한 레인보우로보틱스㈜ 지분의 전부 또는 일부를 최대주주 등에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 당사는 2024년 12월 31일 이사회에서 레인보우로보틱스㈜의 최대주주 등 6인이 보유한 지분 394만주를 인수하는 주식매도청구권(콜옵션)의 행사를 의결하였습니다. 인수대가는 267,463백만원이며, 당기말 현재진행 중인 지분인수 관련 행정절차가 완료되면 지급할 예정입니다. 2024년말 현재 해당 콜옵션의 공정가치는 안진회계법인이 평가하였습니다.

또한, 종속회사인 삼성디스플레이㈜는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할수 있는 풋옵션을 보유하고 있으며, TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이㈜가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 2024년말 현재 상기 풋옵션들의 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2014.01.25
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
GlobalFoundries	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
	체결시기	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
Google	계약 유형	EMADA
	체결시기 및 기간	2019.02.27~2025.03.31(연장)
	목적 및 내용	유럽 32개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한 라이선스 계약
Ericsson	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2021.05.07
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2022.07.06
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스・부제소를 통한 사업 자유도 확보
Huawei	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2022.07.13
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
Nokia	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2023.01.19
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보

※ 기타 영업기밀에 해당하는 사항은 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품,미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

2024년(제56기) 당사의 연구개발비용은 35조 215억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감되거나 자산화된 연구개발비를 제외하고 34조 9,981억원을 당기비용으로 회계처리하였습니다.

[연구개발비용] (단위 : 백만원, %)

과 목		제56기	제55기	제54기
연구개발비용 총계		35,021,531	28,352,769	24,929,171
(정부보조금)		△23,389	△13,045	△9,973
연구개발비용 계		34,998,142	28,339,724	24,919,198
회계처리	개발비 자산화(무형자산)	-	-	-
	연구개발비(비용)	34,998,142	28,339,724	24,919,198
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100]		11.6%	10.9%	8.2%

※ 연결 누계기준입니다.

※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

다. 연구개발 조직 및 운영

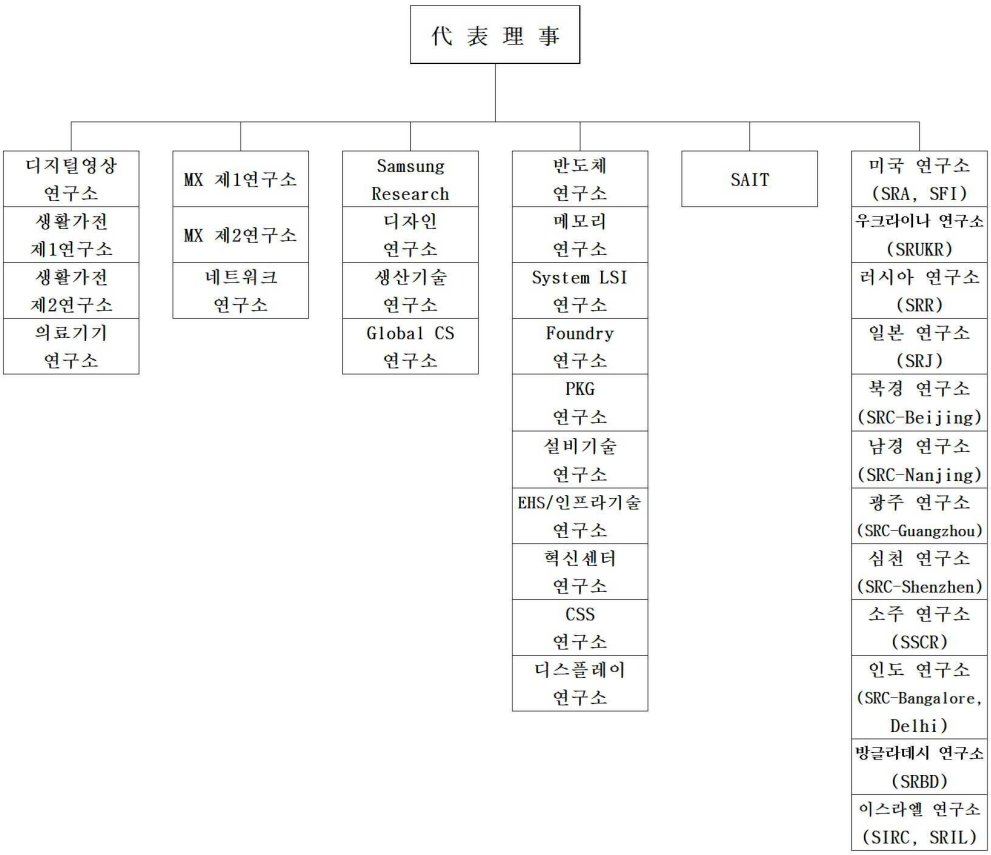
(국내)

당사는 연구개발 조직을 기술 상용화 시기에 따라 3단계로 체계화하여 운영하고 있습니다.

향후 1~2년 내 시장에 선보일 상품화 기술은 각 부문 산하 사업부 개발팀에서 개발하고 있으며, 3~5년 내 중장기 미래 유망 기술은 Samsung Research, 반도체연구소 등의 각 부문 연구소에서 개발하고 있습니다. 또한, 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술은 당사의 종합연구소인 SAIT에서 선행 개발하고 있습니다. SAIT는 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 주력 사업의 기술 경쟁력 강화, 창의적 R&D 체제를 구축하기 위한 연구개발 활동을 수행하고 있습니다.

(해외)

미국(SRA, SFI), 우크라이나(SRUKR), 러시아(SRR), 일본(SRJ), 중국(SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzhen, SSCR), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SIRC, SRIL) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및 기초 기술 연구 등을 진행하고 있습니다.


代 表 理 事
디지털영상 연구소
생활가전 제1연구소
생활가전 제2연구소
의료기기 연구소
MX 제1연구소
MX 제2연구소
네트워크 연구소
Samsung Research
디자인 연구소
생산기술 연구소
Global CS 연구소
반도체 연구소
메모리 연구소
System LSI 연구소
Foundry 연구소
PKG 연구소
설비기술 연구소
EHS/인프라기술 연구소
혁신센터 연구소
CSS 연구소
디스플레이 연구소
SAIT
미국 연구소 (SRA, SFI)
우크라이나 연구소 (SRUKR)
러시아 연구소 (SRR)
일본 연구소 (SRJ)
북경 연구소 (SRC-Beijing)
남경 연구소 (SRC-Nanjing)
광주 연구소 (SRC-Guangzhou)
심천 연구소 (SRC-Shenzhen)
소주 연구소 (SSCR)
인도 연구소 (SRC-Bangalore, Delhi)
방글라데시 연구소 (SRBD)
이스라엘 연구소 (SIRC, SRIL)

라. 연구개발실적

2024년 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	Galaxy 폴더블	· Galaxy Z Fold6 출시 · Galaxy Z Flip6 출시
	Galaxy S24	· Galaxy S24 · S24+ · S24 Ultra 출시
	Galaxy A	· Galaxy A55 5G 출시 · Galaxy A35 5G 출시 · Galaxy A25 5G 출시 · Galaxy A15 LTE · 5G 출시
	Galaxy북	· Galaxy Book4 Ultra 출시 · Galaxy Book4 Pro 360 출시 · Galaxy Book4 Pro 출시 · Galaxy Book4 Edge 출시
	Neo QLED 8K	· Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV 출시
	Neo QLED 4K	· Mini LED 기반 4개 시리즈, 7개 사이즈 출시
	냉장고	· 펠티어 소자 적용한 에너지 초고효율 BESPOKE AI 하이브리드 냉장고 출시 · AI 정온기능 적용한 'BESPOKE AI 김치플러스' 출시
	세탁기	· 세탁건조기 BESPOKE AI 콤보 출시
	청소기	· 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 출시
	RAN S/W Package	· 업계 최초 vRAN 기반 5G RedCap Energy-saving 기술 기능시험 완료 · AI 기반 5G 기지국 품질 최적화 기술(AI-RAN Parameter Recommender) 실증 완료
	기지국	· 고출력/고효율 신규 MMU(다중 안테나를 활용한 대용량 데이터 전송이 가능한 기지국) 개발
DS 부문	모바일 DRAM	· 업계 최고 속도 LPDDR5X 동작 검증 성공
	HBM	· 업계 최초 36GB HBM3E 12H D램 개발
	NAND	· 업계 최초 '9세대 V낸드' 양산
	Automotive	· 업계 최초 8세대 V낸드 기반 차량용 SSD 개발
	이미지센서	· 업계 최초 망원용 2억화소 모바일 이미지 센서 'HP9' 공개
	엑시노스	· 최신 기술 적용 웨어러블 SOC '엑시노스 W1000' 공개
SDC	OLED	· Galaxy S24 AMOLED 개발 · BMW Mini 13.4" Round OLED Display 적용 · Surface Pro 10 출시 · Galaxy Z Fold6 용 폴더블 OLED 개발 · Google Pixel 9 Pro XL 용 OLED 개발
	QD-Display	· 31.5"UHD, 27"QHD, QD-OLED 개발

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한이래 현재 세계적으로 총 265,410건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수(2024년말 현재, 연결 기준)] (단위 : 건)

구분	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가	계
등록건수	62,315	99,070	47,597	28,542	8,836	19,050	265,410

2024년 중 총 35조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 7,804건, 미국 특허 9,228건 등을 등록하였습니다.

[주요 국가 연도별 특허등록 건수] (단위 : 건)

구 분	2024년	2023년	2022년
한 국	7,804	8,908	9,136
미 국	9,228	8,958	8,500

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로서 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술・특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Google(2014.01.체결), Ericsson(2021.05.), Qualcomm(2022.07.), Huawei(2022.07.), Nokia(2023.01.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2024년 중 미국에서 460건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다.

나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직・간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수・재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기・전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국의 관련 법률은 다음과 같습니다.
1. 폐제품 회수・재활용법 (예: EU WEEE Directive)
2. 유해물질 사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기오염방지시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO 14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제:「물환경보전법」「대기환경보전법」「폐기물관리법」
「소음・진동관리법」「환경영향평가법」등
2. 온실가스 배출 관리:「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」
「기후위기대응을 위한 탄소중립・녹색성장기본법」등
3. 기타 사업장환경관리법:「화학물질관리법」
「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」
「악취방지법」「토양환경보전법」등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 국내에서「기후위기 대응을 위한 탄소중립・녹색성장기본법」제27조(관리업체의 온실가스 목표관리)에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제27조 3항 및 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제24조(배출량의 보고 및 검증)에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사의 국내 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO_2-eq, TJ)

구 분	2024년	2023년	2022년
온실가스(tCO_2-eq)	18,070,212	17,337,196	19,285,537
에너지(TJ)	326,800	301,616	290,024

※ 정부에 신고된 본사 및 자회사 포함 기준입니다.

※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.

※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.

※ 배출량 및 에너지사용량은 정부의 적합성 평가 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

다. 사업부문별 현황

[DX 부문]

(산업의 특성 등)

1) TV산업

TV 산업은 1926년 흑백 TV, 1954년 컬러 TV 등장 이후 지금까지, 평면 TV(LCD),스마트 TV, 초대형 TV(OLED/QLED/Neo QLED/8K), 마이크로 LED 등으로 발전하면서 최고 화질을 제공하기 위한 혁신활동들이 지속적으로 일어나는 분야입니다.

TV에는 칩 설계, 회로개발, 화질/신호처리, AI 화질 기술 뿐만 아니라, 플랫폼과 어플리케이션이 잘 작동되도록 하는 운영체계(Operating System)와 각종 S/W 기술들이 적용됩니다. 특히 AI기술의 급성장으로 인해 TV 화면에 나오는 상품 관련 정보를 실시간으로 검색하거나 관련된 콘텐츠들을 추천받을 수도 있고, 사용자 취향의 예술 이미지를 만들거나 대화 방식으로 기기를 제어하는 수준으로 발전하고 있습니다.

TV업계는 마이크로 LED, Neo QLED, OLED 기술을 적용하여 최고 화질을 구현하기 위한 제품 경쟁을 치열하게 하고 있습니다. 과거 55~65인치대가 주력이던 TV 시장은 75~83인치대가 주도하는 시대를 넘어서 85, 98, 100, 115인치급의 초대형 제품들이 성장을 이끌어 갈 것으로 전망됩니다. 이에 따라 4K 화질을 넘어서 8K 화질을 갖춘 제품이 새로운 시장을 열어가고 있으며, HD, FHD급 기존 화질을 고화질로 자동 업스케일하는 기술도 제품에 적용되고 있습니다.

TV업계는 AI 기술도 대거 채택하여 미래형 TV의 모습을 만들어 나가고 있습니다. 업체들마다 AI 관련 기술을 제품에 접목하기 위해 AI 반도체(System on Chip)를 통해 화질과 음질을 최적화하고, AI 기술을 활용하여 저화질 콘텐츠를 고화질로 업스케일링하는 기능도 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 기술력을 통해 TV는 집안내 가전 제품들을 연결하고 실시간으로 모니터링할 뿐만 아니라, 전력사용 최적화나 긴급상황 발생시 알림 서비스 등 새로운 서비스들을 제공하게 됩니다.

한편 TV 사용자들의 인식도 지난 수년간의 팬더믹 시기를 거치면서 크게 변화하고 있습니다. 사용자들은 TV를 통해 영화를 보고 뉴스를 시청하는 것 뿐만 아니라, 전세계 미술관의 예술작품들을 다운로드받아서 감상한다거나, 게임과 헬스케어, 화상회의와 온라인 교육과 같은 새로운 서비스를 체험하는데 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 자기만의 개성을 추구하는 구매자들을 위해 디자인과 이동설치 편의성, 주변기기들과의 연동성을 강조한 라이프스타일 제품군도 매년 새롭게 출시되면서 틈새 시장이 빠르게 확대되고 있습니다.

2) 모바일 산업

모바일 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되었으며, 2019년 초 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었습니다. 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2024년에는 8.7억대로 판매가 확대되었습니다. 이러한 5G의확산은 AI・XR・자율주행 등 5G 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: TechInsights 2025.2).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2024년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 85% 수준, 피처폰의 비중은 15% 수준입니다.(출처: TechInsights 2025.2) 스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 고화질 Display, 폴더블 폼팩터,멀티카메라, 센서, 방수・방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐만 아니라 플랫폼 기반의 Application, UX, Game, Media, Digital Wallet, AI, 보안 등 전반적인 소프트웨어 기반 경험 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

1) TV산업

TV 시장 수요는 글로벌 경기 불확실성에 따른 소비심리 악화 영향으로 2022년 2억 328만대에서 2023년 2억 139만대 수준으로 소폭 감소하였습니다. 2024년은 파리올림픽 등 스포츠 이벤트에 따른 수요 확대로 전년비 3.7% 성장한 2억 883만대를 기록하였습니다(출처: Omdia 2025.2).

< TV 시장점유율 추이 >

제 품	2024년	2023년	2022년
TV	28.3%	30.1%	29.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

2) 모바일 산업

스마트폰 시장은 경기 회복 기대에 따른 소비심리 상승과 AI 제품・서비스 확대 등으로 인해 2023년 11.5억대에서 2024년 12.2억대 수준으로 성장하였습니다. 2025년에는 글로벌 경제 환경의 불확실성이 커질 것으로 전망되나 AI 스마트폰의 수요 증가로 스마트폰 시장은 소폭 성장한 12.4억대로 전망됩니다. 태블릿 시장은 2023년 1.4억대에서 2024년 1.5억대 수준으로 성장하였으며, 2025년에는 1.6억대 수준으로 성장할 전망입니다(출처: TechInsights 2025.2).

< 스마트폰 시장점유율 추이 >

제 품	2024년	2023년	2022년
스마트폰	18.3%	19.7%	21.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 TechInsights의 세계시장점유율 자료(수량 기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

1) TV산업

당사는 2006년 이후 2024년까지 19년 연속으로 TV 판매 1위를 지키고 있습니다. 이 기간 동안 공격적으로 영업, 마케팅 활동을 전개하여 시장 점유율을 2006년말 14.2%에서 2024년말 약 28%로 두배 수준으로 증대하였습니다. 또한 전세계 소비자와 유통 파트너사들이 원하는 프리미엄 제품과 혁신 제품들을 선제적으로 지속 출시함으로써 TV 트렌드를 선도하는 기업이라는 평판을 쌓아가고 있습니다.

글로벌 TV 시장은 75인치 이상 초대형 TV와 1,500불 이상 프리미엄 TV군이 성장을 주도하고 있으며, 특히 북미와 유럽, 한국, 동남아, 중국 지역에서 판매가 크게 증가하고 있습니다. 하지만 업체들간 경쟁이 점점 더 치열해 지고 있고, 패널가격도 지속적으로 상승하고 있어 수익성 확보에 어려움이 가중되고 있습니다.

당사는 이러한 어려움을 제품 기술력으로 돌파하기 위해, 8K 해상도의 98인치 초대형 TV를 비롯해서, Neo QLED, OLED, QLED 주력제품과 라이프스타일 TV, 사운드바등 사업군에 AI 신기술을 대거 적용하여 경쟁사와의 기술격차를 벌려 나가고 있습니다.

'24년형 Neo QLED 8K TV에 탑재된 '8K AI 업스케일링 프로(8K Upscaling Pro)'는AI기술을 사용하여 SD/HD/Full HD 등과 같은 저해상도 영상을 8K급으로 향상시킵니다. 음질 부분에서도 AI 기술을 적극 도입하여, 영화내 대화를 인식해 소음과 분리한 후 화자의 목소리를 또렷하게 조정하거나, 물체의 움직임에 따라 입체적 사운드를구현하는 기능들을 가능하게 하였습니다.

또한, AI TV는 휴대폰, 사운드바를 비롯한 집안의 다양한 가전기기들과 손쉽게 연결되어 TV만의 서비스가 아니라 새로운 가치와 경험들도 선사합니다. TV와 연결된전자기기들의 에너지 사용량을 제어하여 최적화할 수도 있고, 부착된 카메라와 센서 등을 통해 집안의 상황을 파악하여, 외부에 있는 주인에게 알려줄 수도 있습니다. 이런 상황에서 모든 개인정보와 기기보안은 당사 보안 솔루션인 녹스(Knox)를 통해 철저히 보호됩니다.

당사는 AI 핵심 기술채용과 함께, 초대형 TV 시장 확대에 필요한 제품 라인업도 더욱 탄탄하게 구축하고 있습니다. 90인치대 이상 시장에서 성장을 주도하기 위해, 98인치 라인업을 Neo QLED 8K/4K, QLED에 이어 UHD급으로 확대하는 한편, 85인치 Neo QLED, 83인치 및 77인치 OLED 라인업도 글로벌로 강화했습니다.

미래 기술인 차세대 마이크로 LED 제품도 89인치, 101인치에 이어 114인치로 확대하고 있으며, AI와 광학 문자인식 기술을 활용하여 자막을 실시간으로 음성 변환시키는 '들리는 자막' 기술을 실용화하고, 화면 윤곽선과 색상을 저시력자 맞춤형으로 재조정해 주는 '릴루미노 모드(Relumino Mode)'기능도 향상시켜 '모두를 위한 TV' 공급에도 최선의 노력을 하고 있습니다.

2) 모바일 산업

당사는 주력 사업인 스마트폰 시장에서 2011년 이후 14년 연속 글로벌 출하량 1위를 유지하고 있습니다(출처: TechInsights 2025.2). 또한, 스마트폰 뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블(스마트워치, 무선이어폰 등), 액세서리 등의 제품과 함께 Digital Health, Digital Wallet 등 컨텐츠와 서비스 부문에서도 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 생성형 AI를 적용한 검색・실시간 통번역・자동 내용 요약・사진 편집, Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, UWB(Ultra Wideband)를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, 야간 촬영・8K 동영상특화 카메라 기능 등 고객이 필요로 하는 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 탑재한 Galaxy Z 폴드로 신규 시장을 개척한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 Galaxy Z 플립을 출시하였습니다. Galaxy Z 플립 시리즈는 아이코닉한 디자인과 높은 휴대성으로, 여성과 젊은 세대의 Galaxy 선호도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 이후 당사만의 기술 리더십과 소비자 가치 중심의 사용성을 기반으로 폴더블 특화 경험을 지속 강화한 5세대, 6세대 Galaxy Z 시리즈를 출시하며 폴더블 시장을 주도해 왔습니다.

2024년 1월 출시한 Galaxy S24 시리즈는 당사 최초로 Galaxy AI를 탑재하였습니다. Galaxy AI는 사용자가 세상을 경험하는 방식을 바꾸고 무한한 잠재력을 발휘할 수 있도록 완전히 새로워진 검색, 창의적인 사진 편집, 실시간 번역, 편리한 텍스트 요약등의 경험을 제공하고 있습니다. 또한 보다 강력한 보안성을 바탕으로 초연결 사회에서 소비자에게 안전한 AI 및 멀티 디바이스 사용 환경을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

2024년 7월 출시된 Galaxy Z 폴드6 및 Galaxy Z 플립6는 대화면과 폴더블 폼팩터에 최적화된 Galaxy AI 기능 탑재로 한 차원 높아진 폴더블 생산성을 제공하였습니다. 뿐만 아니라 역대 Galaxy Z시리즈 중 가장 얇고 가벼운 무게로 뛰어난 휴대성을 제공하면서도 성능과 내구성을 더욱 강화하여 제품 완성도를 한층 높였습니다.

스마트폰 외에도 대화면 디스플레이와 S Pen으로 노트 필기와 영상회의, 멀티태스킹등 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 생체 센서 기술을 적용하여 더욱 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 스마트 워치와 편안한 착용감으로 맞춤형 건강정보를 제공하는 스마트 링, 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰 등 다양한 Galaxy Ecosystem 제품군을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사는 제품과 더불어 그동안 Samsung Wallet(舊 Samsung Pay), Samsung Health 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔습니다. Samsung Wallet은 결제 외에도 신분증, 티켓 등의 다양한 기능을 제공하여 실물 지갑을 대체할 수 있는 서비스로 발전시켜 나가고 있으며, Samsung Health는 새로운 폼팩터와 AI 기능 적용을 통해 통합 건강관리 플랫폼으로서의 위상을 더욱 강화해 나가고자 합니다

뿐만 아니라 제품에 재활용 소재 적용을 확대하는 등, 친환경 기술 혁신도 지속하고 있습니다. 대표적으로 플라스틱 폐기물 중 하나인 폐어망을 재활용해 만든 소재를 Galaxy S22 시리즈 이후 많은 과제에 적용하고 있습니다. Galaxy S24 시리즈에는 재활용 코발트와 희토류를 적용하였고, Galaxy Z 폴드6 및 Galaxy Z 플립6에는 재활용금과 구리를 추가로 적용하였습니다.

추가로, 당사는 2023년 5월 자가 수리 프로그램을 도입하고 대상 모델과 국가를 확대해 나가며 e-waste를 최소화하고 있습니다.

당사는 앞으로도 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 지속적인 기술 혁신 및 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하겠습니다.

[DS 부문]

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

메모리 반도체는 읽고 쓸 수 있는 램(RAM, Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억 장치, 응용 프로그램의 일시적 로딩(Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로, 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처에 따라 종류가 다양하며, 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit), ISP(Image Signal Processor), Modem(Modulator-Demodulator) 등을 내장한 모바일 기기용 SOC(System-On-Chip)가 가장 대표적인 제품입니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 AP 제품과 이미지 센서 등을 공급하고 있습니다.

Foundry 사업은 팹리스(Fabless) 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해 주는 사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조 사업'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 많은 IDM(Integrated DeviceManufacturer)업체가 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스(Fabless) 업체로 전환하였습니다. 이에 따라 대규모 Capa를 보유 중인 5개 내외의 소수업체가 전체 Foundry 시장의 대부분을 영위하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

2024년 4분기 메모리 시장에서는 모바일/PC 고객사의 재고 조정이 심화되었으나,
주요 데이터센터 및 테크 기업들의 AI향 투자가 지속되며 HBM과 서버향 DRAM 수요 견조세가 지속되었습니다. 단, 서버 SSD는 일부 데이터센터 고객사들의 과제 지연으로 수요에 다소 영향이 있었습니다. 이러한 상황 속, 당사는 수요 모멘텀이 있는 HBM 및 고용량 DDR5를 중심으로 판매를 확대하는 데에 주력했습니다.

2025년 1분기 메모리 시장은, 모바일/PC의 경우 고객사 재고 조정이 1분기까지는 지속될 것으로 전망됩니다. 서버는 AI향 수요 모멘텀은 지속될 것으로 전망되지만, GPU 공급 상황에 따라 데이터센터 및 OEM 고객 수요가 변동될 가능성이 있고 AI향반도체 수출 통제로 인한 HBM 수요 변동성도 지속 발생하고 있습니다. 이러한 상황 속, 당사는 고부가가치 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 전환하고 있으며, 고용량/고사양 제품 수요대응을 위한 선단공정 전환을 가속화하고 있습니다. 이를 기반으로,
당사는 서버향 DDR5, PC/모바일향 LPDDR5x 및 서버향 QLC SSD 수요 대응에 집중할 계획입니다.

2024년 Foundry 시장은 모바일/PC 응용의 시황 반등 지연에 따른 수요 약세가 이어졌으나, Advanced 노드를 사용하는 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공지능(AI) 분야를 중심으로 성장이 지속되었습니다.

2025년 Foundry 시장은 고객사 재고조정 영향으로 성장세가 둔화될 우려는 있으나,
2024년과 유사하게 HPC/AI 응용의 수요 강세가 지속될 것으로 예상됨에 따라
Advanced 노드 시장을 중심으로 두 자릿수 성장이 전망됩니다.

< DRAM 시장점유율 추이 >

제 품	2024년	2023년	2022년
DRAM	41.5%	42.2%	43.1%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

메모리 사업의 1분기 서버 수요는 AI향 수요 모멘텀이 지속되지만, 신규 GPU 공급의 제약과 일부 고객사들의 재고 증가 및 지정학적 이슈 등으로 기회 요인과 리스크가 함께 존재하고 있습니다. PC/모바일은 수요 개선 기대치 대비 소비 심리 위축 및 고객사들의 재고 조정 영향으로 시장 수요 감소가 지속 전망되고 있습니다. 당사는 제품/응용 수요에 맞춰 Legacy 제품 중심으로 탄력적인 생산과 제품 믹스를 운영 중이며, HBM과 DDR5 등 고부가가치 제품 수요 대응을 위해 선단 공정 전환을 가속화 하고 있습니다. 이러한 상황 속에 고객이 필요로 하는 서버향 DDR5, 고용량의 서버향 QLC SSD 등의 수요에 적극 대응해 나갈 것입니다.

System LSI는 주요 고객사들이 연말 재고 건전화를 추진하는 가운데 수요는 소폭 감소하는 모습을 보이고 있으며 '25년 거시 경제 불확실성 확대로 성장률 감소 예상되나, On-Device AI 영향 프리미엄 시장 호조 기반으로 고부가 제품 수주 확대 및 응용처 다변화 등을 통해 극복하고 있습니다. SOC 사업은 Galaxy S24/FE와 A시리즈(A55/35) 스마트폰 판매 호조가 매출 확대를 견인하였으며 On-device AI 기반 고사양 제품 공급 확대를 추진하는 한편, 2나노 Exynos 샘플을 확보하는 등 미래 성장 지속을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 이미지센서는 광각 및 줌기능 소구점 강화로 2억화소 시장 지속 확대 및 플래그십외 스마트폰에 사용되는 이미지센서 신제품의 성능 우위 입증을 통해 M/S를 확대하고 있으며, 차량용 센서 시장에서도 글로벌 주요 완성차 업체들로부터 고화소 신제품 수주를 확대하고 있습니다. LSI 사업 중 스마트폰향 OLED mDDI는 선단 공정 경쟁력 기반 글로벌 Top tier향에 높은 M/S를 지속 유지하고 있으며, pDDI는 주요 고객사 과제 수주 기반 중장기 사업 성장 기반을 확보하였습니다. Power는 모바일향 신규 과제 적용 확대 및 메모리향 제품 Portfolio 강화를 통해 성장하고 있으며, Security는 스마트폰향 및 컨슈머향의 보안 니즈 증가에 맞춘 고사양 제품 적기 사업화 등을 통해 성장할 것으로 전망됩니다.

Foundry는 시장 변화에 맞춰 노드 및 응용별 전략 수립하여 기술/개발, 제조, 비즈니스 역량에 대한 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. Advanced 노드는 4나노 공정에서안정적인 수율을 기반으로 모바일 및 HPC 수요를 확대하고 있으며, GAA가 적용된 3나노는 '22년 양산 이후 축적된 경험과 노하우를 반영하여 '25년 상반기부터 모바일향 양산 출하를 준비하고 있습니다. Mature 노드는 RF 및 Automotive 등 Specialty 공정에 대한 투자 및 개발로 응용처 확대 및 사업 다변화를 지속하여 수익성 개선과 노드 장기 활용이 동시에 이뤄질 수 있는 전략을 마련하고 있습니다. 지속적인 고객 협력 및 개발/수주/생산/공급 등 전방위 경쟁력을 강화함으로써 변화하는 시장에 맞춰 사업 기회를 확대해 나가겠습니다.

[SDC]

(산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 QD-OLED(Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) 등이 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, IT(태블릿/노트북), Auto 등 다양한 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. QD-OLED는 수
나노 미터의 반도체 결정인 퀀텀닷(Quantum Dot)을 패널에 내재화해 색 재현력과 시야각을 극대화한 자발광 디스플레이로, 향후 프리미엄급 TV 및 모니터 시장을 주도할 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

스마트폰용 디스플레이 패널 시장은 2023년 14.4억대에서 2024년 15.5억대로 성장하였습니다. 스마트폰용 OLED 디스플레이의 경우 2023년 6.1억대에서 2024년 7.8억대로 증가하였으며, 전체 스마트폰 디스플레이 패널 시장에서 OLED가 차지하는 비중은 2023년 42.7%에서 2024년 50.7%로 상승하였습니다(출처: Omdia 2025.01).

또한, 대형 디스플레이 패널 시장은 2023년 8.1억대에서 2024년 8.7억대로 성장하였습니다 (출처: Omdia 2024.12).

< 스마트폰 패널 시장점유율 추이 >

제 품	2024년	2023년	2022년
스마트폰 패널	41.3%	50.1%	56.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)예측치를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블,태블릿, 워치, 노트북, AUTO 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블・IT(태블릿/노트북) 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

2024년에는 스마트폰 및 IT 중소형 패널 수요가 소폭회복되었으며 OLED 침투율은 계속하여 증가하고 있습니다. 패널 업체간 경쟁이 심화되는 가운데 당사는 저소비전력, 고화질, 디자인 등 차별화 기술을 지속 개발하여 경쟁우위를 확보하고 판매 확대를 추진하였습니다.

또한, 8.6G IT OLED라인을 건설하는 등 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 다각화하여 IT, AUTO, Gaming 제품 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 사업 리더십을 더욱 견고히 하고 있습니다.

대형 디스플레이 사업은 프리미엄 TV 및 모니터 제품 중심으로 역량을 집중하고 수율 향상, Loss절감 등 내실을 다져서 사업 경쟁력을 강화하였습니다.

[Harman]

(산업의 특성 등)

Harman은 전장부품(Automotive)과 라이프스타일 오디오(Lifestyle Audio) 산업에서경쟁하고 있습니다. 이 중 전장부문이 Harman 사업의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 디지털 콕핏, 카 오디오, 텔레매틱스 등 분야에 진출해 있습니다.

요즘 소비자들은 차량을 선택할 때 단순 이동수단 기능보다 이동시에 즐길 수 있는 차량내 경험(In-Cabin Experience)을 중요시하는 추세입니다. 이러한 소비자 니즈에 맞추어 자동차도 IT 제품처럼 SW로 업그레이드 가능한 SDV(Software Defined Vehicle)로 변화하고 있어 자동차 제조사들은 중앙집중형 전장 아키텍처 도입을 시도하고SW 기능을 강화하는 등 많은 혁신을 추진 중입니다. 이에 따라, 전장 부품업체들의 공급제품에도 빠른 기술적 변화가 진행되고 있어, 업체간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다. 이에, Harman은 자동차의 SDV로 변화에 대응할 수 있는 SW 기술역량을 강화하고, In-Cabin Experience의 핵심 전장부품과 고성장이 예상되는 AR HUD, 디스플레이, 운전자 모니터링 등 신제품을 육성하는 한편 전자의 SW/서비스 역량을 차량에 접목하여 보다 편리하고 차별화된 사용자 경험을 제공하는데 주력할 계획입니다.

라이프스타일 오디오 산업은 소비자 오디오와 프로페셔널 오디오 솔루션으로 구분됩니다. 소비자 오디오 제품(True Wireless Stereo, Portable Speaker, Headphone 등)은 과거 음원 재생 기기에 국한되었으나, 최근 무선 연결기술 적용 및 AI 탑재가 확산되어 기술 중심의 IT 기기로 진화하는 추세입니다. 이러한 기술 변화에 의해, IT 업체들이 소비자 오디오 시장에 참여하여 음향 설계 기술을 보유한 전통 오디오 업체들과
경쟁 중입니다.

소비자 오디오 시장은 TWS 헤드폰과 Home 오디오 및 게이밍 헤드폰 분야에서 고성장이 예상되고, 소비자들은 프리미엄 오디오를 경험(고음질/무손실 음원 등)하고자 하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이에 Harman은 고성장 분야에 사업역량과 경쟁력을 강화하고 신제품을 지속 출시하여 시장에 대응하고 있으며, 프리미엄 오디오 경험을 추구하는 소비자의 Needs에 부합하기 위해 고음질/무손실 음원 재생기술을 보유한 미국업체 Roon Labs LLC를 2023년 4분기에 인수하여 고품질의 오디오 경험을소비자들에게 제공하고 있습니다. 향후 타사업부 제품에도 Roon 기술을 적용하여 제품을 차별화하고 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.

(국내외 시장여건 등)

최근 유럽과 중동의 지정학적 이슈로 인한 원자재 가격 상승 및 미/중 무역 갈등 심화등 경기 불안 요소는 여전히 존재하나, 세계 자동차 공급망 불안요소는 많이 해소되었고, 고금리와 인플레이션이 점진적으로 정상화될 것으로 예상됩니다. 이러한 상황을 고려할 때 2025년 전세계 자동차 생산량은 전년 수준을 유지 할 것으로 전망됩니다. (출처: S&P Global Light Vehicle Production Forecast 2024.12)

< 디지털 콕핏 시장점유율 추이 >

제 품	2024년	2023년	2022년
디지털 콕핏	12.5%	16.5%	17.9%

※ 디지털 콕핏은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입니다.

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Techinsights의 자료(금액기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

Harman은 전장부품 시장에서 차량내 경험의 중심이 되는 디지털 콕핏, 카 오디오 분야에서 선도적 시장 입지를 유지하고 있습니다. 당사는 Harman의 선두 위상을 강화하기 위해 Harman의 전장사업에 당사의 무선통신, 디스플레이 등 IT 기술을 지속 접목시켜 차량의 IT기기화에 적극 대응해 나갈 계획입니다.

Harman은 차량의 SDV(Software Defined Vehicle)화 변화에 대응하기 위해 차별화된 기술 개발을 통해 끊임없는 혁신을 추구함으로써 소비자들의 차량내 경험이 한층 업그레이드되도록 노력해 나갈 것입니다.

Harman은 독자 보유한 음향 설계능력과 다양한 소비자층을 겨냥한 멀티 브랜드 전략을 구사하여 일반 소비자와 음악 애호가들 사이에서 오디오 전문 업체로서 브랜드 인지도 및 영향력을 확대해 왔습니다. 향후 타 사업부와의 협력을 강화하고 새로운 제품을 출시하여 오디오 산업내에서의 위상과 입지를 더욱 강화해 나갈 예정입니다.

라. 사업부문별 요약 재무 현황

2024년(제56기) 매출은 DX 부문이 174조 8,877억원(58.1%), DS 부문이 111조 660억원(36.9%)이며, SDC가 29조 1,578억원(9.7%), Harman은 14조 2,749억원(4.7%)입니다.

2024년(제56기) 영업이익은 DX 부문이 12조 4,399억원, DS 부문이 15조 945억원, SDC가 3조 7,334억원, 그리고 Harman은 1조 3,076억원입니다.

(단위 : 억원, %)

부문	구 분	제56기		제55기		제54기	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
DX 부문	매출액	1,748,877	58.1%	1,699,923	65.7%	1,824,897	60.4%
	영업이익	124,399	38.0%	143,847	219.0%	127,461	29.4%
	총자산	2,596,713	36.2%	2,342,534	37.2%	2,279,669	38.6%
DS 부문	매출액	1,110,660	36.9%	665,945	25.7%	984,553	32.6%
	영업이익	150,945	46.1%	△148,795	△226.6%	238,158	54.9%
	총자산	3,430,454	47.8%	2,871,411	45.6%	2,620,558	44.3%
SDC	매출액	291,578	9.7%	309,754	12.0%	343,826	11.4%
	영업이익	37,334	11.4%	55,665	84.8%	59,530	13.7%
	총자산	821,980	11.4%	792,752	12.6%	737,798	12.5%
Harman	매출액	142,749	4.7%	143,885	5.6%	132,137	4.4%
	영업이익	13,076	4.0%	11,737	17.9%	8,805	2.0%
	총자산	209,347	2.9%	179,566	2.9%	171,023	2.9%

※ 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용)

- 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품・모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품・모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제56기	제55기	제54기
	2024년 12월말	2023년 12월말	2022년 12월말
[유동자산]	227,062,266	195,936,557	218,470,581
· 현금및현금성자산	53,705,579	69,080,893	49,680,710
· 단기금융상품	58,909,334	22,690,924	65,102,886
· 기타유동금융자산	36,877	635,393	443,690
· 매출채권	43,623,073	36,647,393	35,721,563
· 재고자산	51,754,865	51,625,874	52,187,866
· 기타	19,032,538	15,256,080	15,333,866
[비유동자산]	287,469,682	259,969,423	229,953,926
· 기타비유동금융자산	11,756,681	8,912,691	12,802,480
· 관계기업 및 공동기업 투자	12,592,117	11,767,444	10,893,869
· 유형자산	205,945,209	187,256,262	168,045,388
· 무형자산	23,738,566	22,741,862	20,217,754
· 기타	33,437,109	29,291,164	17,994,435
자산총계	514,531,948	455,905,980	448,424,507
[유동부채]	93,326,299	75,719,452	78,344,852
[비유동부채]	19,013,579	16,508,663	15,330,051
부채총계	112,339,878	92,228,115	93,674,903
[지배기업 소유주지분]	391,687,603	353,233,775	345,186,142
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	370,513,188	346,652,238	337,946,407
· 기타	15,873,008	1,280,130	1,938,328
[비지배지분]	10,504,467	10,444,090	9,563,462
자본총계	402,192,070	363,677,865	354,749,604
	2024년 1월~12월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월
매출액	300,870,903	258,935,494	302,231,360
영업이익	32,725,961	6,566,976	43,376,630
연결총당기순이익	34,451,351	15,487,100	55,654,077
· 지배기업 소유주지분	33,621,363	14,473,401	54,730,018
· 비지배지분	829,988	1,013,699	924,059
기본주당순이익(단위 : 원)	4,950	2,131	8,057
희석주당순이익(단위 : 원)	4,950	2,131	8,057
연결에 포함된 회사수	229개	233개	233개

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는제54기~제56기 연결감사보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

나.요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제56기	제55기	제54기
	2024년 12월말	2023년 12월말	2022년 12월말
[유동자산]	82,320,322	68,548,442	59,062,658
· 현금및현금성자산	1,653,766	6,061,451	3,921,593
· 단기금융상품	10,187,991	50,071	137
· 매출채권	33,840,357	27,363,016	20,503,223
· 재고자산	29,154,115	29,338,151	27,990,007
· 기타	7,484,093	5,735,753	6,647,698
[비유동자산]	242,645,805	228,308,847	201,021,092
· 기타비유동금융자산	2,176,346	1,854,504	1,364,608
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	57,427,196	57,392,438	57,397,249
· 유형자산	151,446,870	140,579,161	123,266,986
· 무형자산	10,496,956	10,440,211	8,561,424
· 기타	21,098,437	18,042,533	10,430,825
자산총계	324,966,127	296,857,289	260,083,750
[유동부채]	80,157,976	41,775,101	46,086,047
[비유동부채]	8,411,494	30,294,414	4,581,512
부채총계	88,569,470	72,069,515	50,667,559
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	233,734,316	219,963,351	204,388,016
[기타]	△2,639,066	△476,984	△273,232
자본총계	236,396,657	224,787,774	209,416,191
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2024년 1월~12월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월
매출액	209,052,241	170,374,090	211,867,483
영업이익(손실)	12,361,034	△11,526,297	25,319,329
당기순이익	23,582,565	25,397,099	25,418,778
기본주당순이익(단위 : 원)	3,472	3,739	3,742
희석주당순이익(단위 : 원)	3,472	3,739	3,742

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는제54기~제56기 감사보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 56 기 2024.12.31 현재

제 55 기 2023.12.31 현재

제 54 기 2022.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 56 기	제 55 기	제 54 기
자산			
유동자산	227,062,266	195,936,557	218,470,581
현금및현금성자산 (주4,28)	53,705,579	69,080,893	49,680,710
단기금융상품 (주4,28)	58,909,334	22,690,924	65,102,886
단기상각후원가금융자산 (주4,28)	0	608,281	414,610
단기당기손익-공정가치금융자산 (주4,6,28)	36,877	27,112	29,080
매출채권 (주4,5,7,28)	43,623,073	36,647,393	35,721,563
미수금 (주4,7,28)	9,622,974	6,633,248	6,149,209
선급비용	3,362,824	3,366,130	2,867,823
재고자산 (주8)	51,754,865	51,625,874	52,187,866
기타유동자산 (주4,28)	6,046,740	5,038,838	6,316,834
매각예정분류자산 (주33)	0	217,864	0
비유동자산	287,469,682	259,969,423	229,953,926
기타포괄손익-공정가치금융자산 (주4,6,28)	10,580,932	7,481,297	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산 (주4,6,28)	1,175,749	1,431,394	1,405,468
관계기업 및 공동기업 투자 (주9)	12,592,117	11,767,444	10,893,869
유형자산 (주10)	205,945,209	187,256,262	168,045,388
무형자산 (주11)	23,738,566	22,741,862	20,217,754
순확정급여자산 (주14)	3,089,571	4,905,219	5,851,972
이연법인세자산 (주25)	14,236,468	10,211,797	5,101,318
기타비유동자산 (주4,7,28)	16,111,070	14,174,148	7,041,145
자산총계	514,531,948	455,905,980	448,424,507
부채			
유동부채	93,326,299	75,719,452	78,344,852
매입채무 (주4,28)	12,370,177	11,319,824	10,644,686
단기차입금 (주4,5,12,28)	13,172,504	7,114,601	5,147,315
미지급금 (주4,28)	18,547,365	15,324,119	17,592,366
선수금 (주17)	1,841,420	1,492,602	1,314,934
예수금 (주4,28)	991,812	892,441	1,298,244
미지급비용 (주4,17,28)	29,613,258	26,013,273	29,211,487
당기법인세부채	4,340,171	3,358,715	4,250,397
유동성장기부채 (주4,12,13,28)	2,207,290	1,308,875	1,089,162
충당부채 (주15)	8,216,469	6,524,876	5,844,907
기타유동부채 (주4,17,28)	2,025,833	2,308,472	1,951,354
매각예정분류부채 (주33)	0	61,654	0

비유동부채	19,013,579	16,508,663	15,330,051
사채 (주4,13,28)	14,530	537,618	536,093
장기차입금 (주4,12,28)	3,935,860	3,724,850	3,560,672
장기미지급금 (주4,28)	5,510,455	5,488,283	2,753,305
순확정급여부채 (주14)	521,410	456,557	268,370
이연법인세부채 (주25)	528,231	620,549	5,111,332
장기충당부채 (주15)	3,120,044	2,878,450	1,928,518
기타비유동부채 (주4,17,28)	5,383,049	2,802,356	1,171,761
부채총계	112,339,878	92,228,115	93,674,903
자본			
지배기업 소유주지분	391,687,603	353,233,775	345,186,142
자본금 (주18)	897,514	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주19)	370,513,188	346,652,238	337,946,407
기타자본항목 (주20,33)	15,873,008	1,280,130	1,938,328
비지배지분 (주31)	10,504,467	10,444,090	9,563,462
자본총계	402,192,070	363,677,865	354,749,604
부채와자본총계	514,531,948	455,905,980	448,424,507

2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서

제 56 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 56 기	제 55 기	제 54 기
매출액 (주29)	300,870,903	258,935,494	302,231,360
매출원가 (주21)	186,562,268	180,388,580	190,041,770
매출총이익	114,308,635	78,546,914	112,189,590
판매비와관리비 (주21,22)	81,582,674	71,979,938	68,812,960
영업이익 (주29)	32,725,961	6,566,976	43,376,630
기타수익 (주23)	1,960,338	1,180,448	1,962,071
기타비용 (주23)	1,625,229	1,083,327	1,790,176
지분법이익 (주9)	751,044	887,550	1,090,643
금융수익 (주24)	16,703,304	16,100,148	20,828,995
금융비용 (주24)	12,985,684	12,645,530	19,027,689
법인세비용차감전순이익	37,529,734	11,006,265	46,440,474
법인세비용(수익) (주25)	3,078,383	(4,480,835)	(9,213,603)

당기순이익	34,451,351	15,487,100	55,654,077
당기순이익의 귀속			
지배기업 소유지분	33,621,363	14,473,401	54,730,018
비지배지분	829,988	1,013,699	924,059
주당이익 (주26)			
기본주당이익 (단위 : 원)	4,950	2,131	8,057
희석주당이익 (단위 : 원)	4,950	2,131	8,057

2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 56 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 56 기	제 55 기	제 54 기
당기순이익	34,451,351	15,487,100	55,654,077
기타포괄손익	16,844,987	3,350,311	4,005,664
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	1,462,507	665,943	(822,137)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)	2,300,166	1,481,091	(1,969,498)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9,20)	(71,581)	13,150	(6,318)
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)	(766,078)	(828,298)	1,153,679
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	15,382,480	2,684,368	4,827,801
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9,20)	305,327	61,962	(44,192)
해외사업장환산외환차이 (주20)	15,116,099	2,621,479	4,884,886
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주20)	(38,946)	927	(12,893)
총포괄손익	51,296,338	18,837,411	59,659,741
포괄손익의 귀속			
지배기업 소유주지분	50,048,199	17,845,661	58,745,107
비지배지분	1,248,139	991,750	914,634

2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 56 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본						
	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본 합계
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계		

2022.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	293,064,763	(2,128,473)	296,237,697	8,662,234	304,899,931
당기순이익	0	0	54,730,018	0	54,730,018	924,059	55,654,077
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)	0	0	(38,937)	(1,867,530)	(1,906,467)	(63,031)	(1,969,498)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9,20)	0	0	0	(51,848)	(51,848)	1,338	(50,510)
해외사업장환산외환차이 (주20)	0	0	0	4,863,930	4,863,930	20,956	4,884,886
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)	0	0	0	1,122,367	1,122,367	31,312	1,153,679
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주20)	0	0	0	(12,893)	(12,893)	0	(12,893)
배당 (주19)	0	0	(9,809,437)	0	(9,809,437)	(5,523)	(9,814,960)
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	(176)	(176)
연결실체의 변동	0	0	0	0	0	124	124
자기주식의 취득 (주20)							0
기타	0	0	0	12,775	12,775	(7,831)	4,944
2022.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	337,946,407	1,938,328	345,186,142	9,563,462	354,749,604
2023.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	337,946,407	1,938,328	345,186,142	9,563,462	354,749,604
당기순이익	0	0	14,473,401	0	14,473,401	1,013,699	15,487,100
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)	0	0	4,041,867	(2,554,690)	1,487,177	(6,086)	1,481,091
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9,20)	0	0	0	70,157	70,157	4,955	75,112
해외사업장환산외환차이 (주20)	0	0	0	2,611,915	2,611,915	9,564	2,621,479
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)	0	0	0	(797,916)	(797,916)	(30,382)	(828,298)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주20)	0	0	0	927	927	0	927
배당 (주19)	0	0	(9,809,437)	0	(9,809,437)	(101,984)	(9,911,421)
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	(9,368)	(9,368)
연결실체의 변동	0	0	0	0	0	230	230
자기주식의 취득 (주20)							0
기타	0	0	0	11,409	11,409	0	11,409
2023.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	346,652,238	1,280,130	353,233,775	10,444,090	363,677,865
2024.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	346,652,238	1,280,130	353,233,775	10,444,090	363,677,865
당기순이익	0	0	33,621,363	0	33,621,363	829,988	34,451,351
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)	0	0	49,024	1,960,896	2,009,920	290,246	2,300,166
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9,20)	0	0	0	239,431	239,431	(5,685)	233,746
해외사업장환산외환차이 (주20)	0	0	0	14,963,848	14,963,848	152,251	15,116,099
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)	0	0	0	(747,417)	(747,417)	(18,661)	(766,078)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주20)	0	0	0	(38,946)	(38,946)	0	(38,946)
배당 (주19)	0	0	(9,809,437)	0	(9,809,437)	(1,102,625)	(10,912,062)
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	(8,511)	(8,511)
연결실체의 변동	0	0	0	0	0	(76,626)	(76,626)
자기주식의 취득 (주20)	0	0	0	(1,811,775)	(1,811,775)	0	(1,811,775)
기타	0	0	0	26,841	26,841	0	26,841
2024.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	370,513,188	15,873,008	391,687,603	10,504,467	402,192,070

2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 56 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 56 기	제 55 기	제 54 기
영업활동현금흐름	72,982,621	44,137,427	62,181,346
영업에서 창출된 현금흐름	75,830,873	46,547,889	71,728,568

당기순이익	34,451,351	15,487,100	55,654,077
조정 (주27)	42,947,079	36,519,534	33,073,439
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주27)	(1,567,557)	(5,458,745)	(16,998,948)
이자의 수취	4,008,359	4,786,010	2,136,795
이자의 지급	(675,049)	(844,691)	(714,543)
배당금 수입	268,482	269,169	529,421
법인세 납부액	(6,450,044)	(6,620,950)	(11,498,895)
투자활동현금흐름	(85,381,702)	(16,922,817)	(31,602,804)
단기금융상품의 순감소(증가)	(32,976,756)	39,421,565	15,214,321
단기상각후원가금융자산의 순감소(증가)	620,858	(195,616)	3,050,104
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	(9,735)	2,718	11,677
장기금융상품의 처분	4,100,008	4,565,426	8,272,909
장기금융상품의 취득	(3,987,279)	(5,307,770)	(4,393,754)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	389,680	6,521,568	496,090
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(185,876)	(124,488)	(37,687)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	309,970	63,962	166,315
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(70,982)	(130,459)	(158,244)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	33,178	33,457	13,233
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(11,710)	(78,690)	(907,958)
유형자산의 처분	156,191	98,341	217,878
유형자산의 취득	(51,406,355)	(57,611,292)	(49,430,428)
무형자산의 처분	15,869	11,744	23,462
무형자산의 취득	(2,335,284)	(2,922,875)	(3,696,304)
사업결합으로 인한 현금유출액	(142,156)	(356,511)	(31,383)
매각예정자산의 처분으로 인한 현금유입액	101,563	0	0
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	17,114	(913,897)	(413,035)
재무활동현금흐름	(7,797,243)	(8,593,059)	(19,390,049)
단기차입금의 순증가(감소) (주27)	5,871,346	2,145,400	(8,339,149)
장기차입금의 차입 (주27)	404,954	354,712	271,997
사채 및 장기차입금의 상환 (주27)	(1,364,508)	(1,219,579)	(1,508,465)
배당금의지급	(10,888,749)	(9,864,474)	(9,814,426)
자기주식의 취득	(1,811,775)	0	0
비지배지분의 증감	(8,511)	(9,118)	(6)
매각예정분류 (주32)	0	(14,153)	0
외화환산으로 인한 현금의 변동	4,821,010	792,785	(539,198)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,375,314)	19,400,183	10,649,295
기초현금및현금성자산	69,080,893	49,680,710	39,031,415
기말현금및현금성자산	53,705,579	69,080,893	49,680,710

3. 연결재무제표 주석

1. 일반적 사항 (연결)

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 네트워크시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. SDC는 디스플레이 패널 사업을 영위하며,
Harman은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이㈜ 및 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 228개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성전기㈜ 등 35개 관계기업과 공동기업을 지분법적용 대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

당기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung Lennox HVAC North America, LLC	에어컨공조 판매	50.1
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	해외자회사 관리	100.0

	eMagin Corporation	디스플레이 패널 개발 및 생산	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0
	Sonio Corporation	소프트웨어 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Roon Labs, LLC.	오디오제품 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4

	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽・CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV・모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS	R&D	100.0

	(SDRC)		
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Oxford Semantic Technologies Limited (OST)	R&D	100.0
	Sonio SAS	소프트웨어 판매, R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽・CIS	AKG Acoustics Gmbh	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0

	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding Gmbh & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Management Gmbh	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
중동・아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co., Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Middle East and North Africa (SEMENA)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV・모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0

	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
아시아(중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0

	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co.,	R&D	100.0

	Ltd. (SSCR)		
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체・FPD 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
국내	삼성디스플레이㈜	디스플레이 패널 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스㈜	디스플레이 패널 부품 생산	50.0
	스테코㈜	반도체 부품 생산	70.0
	세메스㈜	반도체・FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스㈜	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스㈜	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5
	㈜희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	㈜미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0

	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 62호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 67호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5
	반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 주요 연결대상 종속기업의 재무정보

당기 및 전기의 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	자산	부채	매출액	당기순이익(손실)
삼성디스플레이㈜	67,541,382	8,305,660	25,401,419	5,989,037
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	50,777,503	18,653,435	40,650,074	1,628,652
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	31,226,978	353,722	-	5,326,248
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	27,546,958	16,107,374	4,998,707	1,171,180
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	21,719,875	13,462,128	46,873,584	779,010
Harman과 그 종속기업(*2)	20,934,732	6,714,174	14,257,130	1,003,560
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	18,796,411	900,205	11,180,211	1,195,361
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	16,111,528	15,246,946	2,754,791	300,719
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	13,497,264	3,802,597	32,962,634	2,078,833
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	9,561,708	3,226,735	17,048,976	1,408,392
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,093,393	3,452,430	-	195,012
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	7,819,080	2,167,121	21,294,69	1,359,308

(SEV)			6	
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	7,724,664	1,955,376	20,394,839	841,058
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	6,467,878	5,635,634	30,068,460	468,408
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	4,863,158	807,341	7,003,325	381,576
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,679,383	1,486,272	7,935,236	208,102
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	3,267,763	2,042,914	6,158,787	181,457
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	2,637,138	502,266	4,513,870	166,928
Samsung International, Inc. (SII)	2,484,711	646,678	7,473,309	138,140
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	2,411,145	1,642,510	5,744,458	62,255
세메스㈜	2,365,712	705,818	2,432,656	144,665
Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,118,638	2,049,463	6,259,384	(1,661)
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,017,910	845,480	4,086,721	125,857
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	1,928,760	1,710,124	15,682,546	(12,249)
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	1,894,968	726,412	2,918,779	12,514

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	자산	부채	매출액	당기순이익(손실)
삼성디스플레이㈜	65,328,568	7,266,213	27,083,336	8,268,314
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	41,926,899	15,322,780	39,551,809	477,338
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	22,234,942	282,614	-	14,140,195
Harman과 그 종속기업(*2)	17,956,557	6,009,675	14,367,766	896,384
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	16,714,945	7,791,914	4,109,744	301,778
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	15,808,283	870,453	8,693,788	877,892
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	12,796,440	6,276,293	23,465,031	136,458
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	12,554,481	3,593,527	30,639,349	2,240,480
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	10,222,557	8,797,991	3,148,858	189,887

(SCIC)				
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,660,481	4,585,806	-	103,387
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	7,738,259	3,373,730	15,216,331	1,153,256
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	7,383,485	1,570,459	24,200,246	1,143,824
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	7,301,860	2,215,062	20,154,119	1,476,382
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	5,542,627	1,587,911	7,222,304	333,812
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	5,262,086	4,552,030	15,649,307	244,210
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	4,043,677	843,736	6,152,983	402,418
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,039,379	640,512	4,213,492	150,510
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,902,722	1,976,067	5,859,133	185,113
세메스㈜	2,187,919	659,607	2,502,143	58,754
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,153,032	1,038,115	3,638,080	148,873
Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,097,706	2,033,152	6,374,670	(3,157)
Samsung International, Inc. (SII)	1,879,442	383,763	6,553,383	141,226
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	1,797,627	1,139,056	4,108,479	56,467
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	1,794,552	639,120	2,833,717	140,313
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	1,639,004	1,443,005	15,462,852	4,984

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

라. 연결대상범위의 변동

당기 중 연결재무제표 작성대상범위의 변동 내용은 다음과 같습니다.

구분	지역	기업명	사유
신규연결	미주	Sonio Corporation	지분취득
	유럽・CIS	Oxford Semantic Technologies Limited (OST)	지분취득
		Sonio SAS	지분취득
	중동・아프리카	Samsung Electronics Middle East and North Africa (SEMENA)	설립
	아시아(중국제외)	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	설립
	국내	SVIC 67호 신기술투자조합	설립
연결제외	미주	Harman Financial Group LLC	청산

	유럽・CIS	Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK)	청산
		Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	청산
	아시아(중국제외)	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	매각
	중국	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	청산
	국내	㈜도우인시스	매각
		지에프㈜	매각
		SVIC 29호 신기술투자조합	청산
		SVIC 40호 신기술투자조합	청산
		SVIC 48호 신기술투자조합	청산

2. 중요한 회계처리방침 (연결)

다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준

연결회사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

2.2 회계정책과 공시의 변경

가. 연결회사가 채택한 제・개정 기준서

연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

동 개정사항은 부채의 유동 및 비유동 분류에 영향을 미치며, 이는 보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되도록 요구합니다. 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

동 개정사항은 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계

처리되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다.
리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를
산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정

동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표 이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정의 주요 조건, 잔액, 결제기간 및 관련된 현금흐름 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제・개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지
않았고, 연결회사가 조기 적용하지 않은 주요 제・개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정

동 개정사항은 외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고와 해외사업장의 기능통화를 지배기업의 표시통화로 환산하는 규정을 명확히 하기 위해, 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다.

2.3 연결

연결회사는 기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따라 연결재무제표를 작성하고 있습니다.

가. 비지배지분

당기순손익과 기타포괄손익의 각 구성요소는 지배회사의 소유주와 비지배지분에 귀속되며, 비지배지분이 부(-)의 잔액이 되더라도 총포괄손익은 지배회사의 소유주와 비지배지분에 귀속시키고 있습니다.

나. 내부거래 제거

연결회사 내의 거래, 이와 관련된 잔액, 수익과 비용, 미실현손익(외환차손익제외)은 연결재무제표 작성시 모두 제거하고 있습니다. 한편, 연결회사는 지분법피투자기업과의 거래에서 발생한 미실현이익 중 연결실체의 몫을 제거하고 있으며, 미실현손실은 자산손상의 증거가 없다면 미실현이익과 동일한 방식으로 제거하고 있습니다.

2.4 외화환산

가. 기능통화와 표시통화

연결회사는 연결회사 내 개별기업의 재무제표에 포함되는 항목들을 각각의 영업활동이 이루어지는 주된 경제 환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니다. 지배회사의 기능통화는 대한민국 원화(KRW)이며 연결재무제표는 대한민국 원화(KRW)로 표시되어 있습니다.

나. 표시통화로의 환산

연결회사의 표시통화와 다른 기능통화를 가진 모든 연결회사 내 개별기업의 경영성과와 재무상태는 다음과 같은 방법으로 연결회사의 표시통화로 환산되고 있습니다.

(1) 자산과 부채는 보고기간종료일의 마감환율로 환산되고 있습니다.
(2) 손익계산서의 수익과 비용은 해당 기간의 평균환율로 환산되고 있습니다.
다만, 이러한 평균환율이 거래일의 전반적인 누적환율효과에 대한 합리적인 근사치가 아닐 경우에는 해당 거래일의 환율로 환산되고 있습니다.
(3) 위 (1), (2)의 환산에서 발생하는 외환차이는 기타포괄손익으로 인식됩니다.

2.5 현금및현금성자산

현금및현금성자산은 보유중인 현금, 요구불예금 및 취득일 현재 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고, 가치변동의 위험이 경미한 매우 유동적인 단기투자자산으로 구성되어 있습니다.

2.6 금융자산

가. 분류

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다. 계약상 현금흐름이 원금과 이자에 대한 지급만으로 이루어져 있는지를 평가할 때, 연결회사는 해당 상품의 계약조건을 고려합니다.

나. 손상

연결회사는 미래 전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 단, 매출채권에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식 시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

2.7 매출채권

매출채권은 유의적인 금융요소를 포함하는 경우를 제외하고는 최초에 거래가격으로 인식하며, 유효이자율을 적용한 상각후원가에서 손실충당금을 차감하여 측정하고 있습니다.

2.8 재고자산

연결회사는 미착품을 제외하고는 재고자산의 단위원가를 평균법에 따라 결정하고 있습니다. 제품과 재공품의 원가는 원재료비, 직접노무비 및 기타 직접원가와 정상조업도에 근거한 관련 제조간접비

로 이루어지며, 유휴 생산설비 원가나 폐기비용은 제외하고 있습니다.

연결회사는 재고자산을 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정에서의 추정 판매가격에서 적용 가능한 변동 판매비용을 차감한 금액으로, 판가의 하락 또는 완성시까지의 원가 상승을 반영하는 저가법 평가와 재고의 과잉 또는 진부화로 인한 가치의 하락을 반영하는 과잉/진부화평가의 두 가지 평가방법을 적용합니다.

2.9 유형자산

연결회사는 제품의 생산 등 자산을 경영진이 의도한 목적으로 사용할 수 있게 되었다고 판단된 시점을 기준으로 감가상각을 개시하고 있습니다

연결회사의 유형자산은 취득원가에서 잔존가액을 차감한 금액이 연결회사가 추정한 추정내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다. 토지는 상각되지 않으며, 자본화차입금이자를 포함한 장기건설자산의 취득에 사용된 원가는 관련 자산의 추정내용연수 동안 상각됩니다.

자산별로 연결회사가 사용하고 있는 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

구 분	대표추정내용연수
건물 및 구축물	15, 30 년
기계장치	5 년
기타	5 년

2.10 무형자산

영업권은 취득시점에 취득하는 종속기업, 관계기업 및 공동기업, 사업 등의 식별가능한 순자산 중 연결회사의 지분에 해당하는 공정가치를 초과하여 지급한 대가에 해당하며, 종속기업의 사업취득과 관련된 건은 무형자산으로, 관계기업 및 공동기업의 지분 취득과 관련한 건은 관계기업 및 공동기업투자에 포함하여 계상하고 있습니다.

영업권을 제외한 무형자산은 역사적 원가로 최초 인식되고, 원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시됩니다.

회원권 및 특정 상표권은 이용 가능 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 한정되지 않아 상각되지 않습니다. 하지만 회원권의 시장가치 하락 등 손상 징후 발견 시 합리적으로 추정하여 손상을 반영합니다. 특허권, 상표권 및 기타무형자산 등 한정된 내용연수를 가지는 무형자산은 추정내용연수동안 정액법에 따라 상각하고 있습니다.

자산별 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

구 분	대표추정내용연수
특허권, 상표권 및 기타무형자산	3년 ~ 25년

2.11 금융부채

연결회사는 계약상 내용의 실질과 금융부채의 정의에 따라 금융부채를 당기손익인식금융부채와 기타금융부채로 분류하고 계약의 당사자가 되는 때에 연결재무상태표에 인식하고 있습니다.

2.12 종업원급여

연결회사는 확정급여제도와 확정기여제도를 포함하는 다양한 형태의 퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 확정급여제도와 관련하여 연결재무상태표에 계상된 부채(자산)는 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 현재가치에 사외적립자산의 공정가치를 차감한 과소적립액(자산인식상한을 한도로 하는 초과적립액)이며, 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정됩니다.

2.13 법인세비용

필라 2 법률에 따라 납부하는 글로벌 최저한세는 기업회계기준서 제1012호 '법인세'의 적용대상 입니다. 연결회사는 글로벌 최저한세 납부액이 발생하는 시점에 당기법인세로 회계처리하고 있으며, 글로벌 최저한세와 관련된 이연법인세의 인식과 공시에 대한 예외규정을 적용하고 있습니다.

연결회사는 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여 소멸시점을 통제할 수 있고 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한 이러한 자산으로부터 발생하는 차감할 일시적차이에 대하여 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높고 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.

2.14 파생상품

연결회사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피 금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

연결회사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름위험회피회계를적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

2.15 수익인식

연결회사의 수익은 재화의 판매에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가액에서 부가가치세, 반품, 판매장려금 및 가격 할인액 등을 차감한 순액으로 표시하고 있습니다.

(1) 수행의무의 식별

연결회사는 고객과의 계약에 따라 재화 및 용역에 대한 통제를 이전할 의무가 있습니다. 연결회사는 Incoterms Group C조건(무역조건 CIF 등)에 따라 제품 및 상품을 수출하는 경우, 고객에게 재화의 통제가 이전된 이후 제공하는 운송서비스(보험 포함)를 별도의 수행의무로 인식합니다.

(2) 한시점에 이행하는 수행의무

연결회사의 수익은 주로 재화의 판매에서 발생하고 있으며, 재화의 통제가 고객에게 이전되는 시점에 수익을 인식하고 있습니다.
(3) 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

용역 수행 경과에 따른 결과물을 고객이 직접 통제하게 되는 소프트웨어 판매, 운송용역, 설치용역 등의 경우, 기간에 걸쳐 수익을 인식하고 있습니다.

(4) 변동대가

연결회사는 인센티브, 판매장려금, 매출에누리 등 다양한 판매촉진 정책을 운영하고 있습니다. 이러한 판매촉진 정책으로 인해 고객과 약속한 대가에 변동가능성이 있는 경우, 고객으로부터 이미 받았거나 받을 대가 중 권리를 갖지 않을 것으로 예상하는 금액(변동대가)을 기대값 또는 가능성이 가장 높은 금액 중 보다 신뢰성 있는 방법으로 추정하고 있습니다. 변동대가의 추정치는 관련 불확실성이 해소될 때 이미 인식한누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 거래가격에 포함하며, 관련 매출이 발생한 시점과 고객에게 변동대가를 지급하기로 결정한 시점 중 늦은 시점에 수익 및 계약부채를 인식합니다.

연결회사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대해 경험률에 기초한 기대값 방법으로 반품율을 예측하여 계약부채(환불부채)를 인식하고 있습니다. 고객이 반품 권리를 행사할 때 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 가지므로그 자산을 환불자산으로 인식하고 해당 금액만큼 매출원가를 조정합니다. 제품을 회수할 권리는 제품의 과거 장부금액에서 제품을 회수하는데 드는 원가를 차감하여 측정합니다.

2.16 리스

(1) 리스이용자

연결회사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 실무적 간편법을 적용하여, 계약에서리스요소와 리스가 아닌 요소(이하 "비리스요소")를 분리하지 않고, 각 리스요소와 관련된 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리합니다.

연결회사는 리스개시일에 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 연결재무상태표에 '유형자산'으로 분류하며, 리스부채는 '유동성장기부채' 또는 '장기차입금'으로 분류합니다.

리스부채는 리스개시일에 그날 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정하며, 연결회사는 현재가치 측정시 연결회사의 증분차입이자율로 리스료를 할인하고 있습니다.

단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하)와 소액자산 리스(기초자산 US$ 5,000 이하)의 경우 실무적 간편법을 적용하여 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.

(2) 리스제공자

리스제공자로서 연결회사는 리스약정일에 리스가 금융리스인지 운용리스인지 판단합니다.

연결회사는 리스약정일에 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류하고, 금융리스 이외의 모든 리스는 운용리스로 분류합니다. 운용리스로부터 발생하는 리스료 수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식하고, 운용리스의 협상 및 계약 단계에서 발생한 리스개설 직접원가는 리스자산의 장부금액에 가산한 후 리스료 수익에 대응하여 리스기간 동안 비용으로 인식합니다.

2.17 정부보조금

수익과 관련된 정부보조금은 이연하여 정부보조금의 교부 목적과 관련된 수익 또는 비용과 대응될 수 있는 기간에 연결손익계산서에 인식하고 있습니다. 한편, 특정 자산의 취득과 관련된 정부보조금은 이연수익으로 처리하고, 관련 자산의 내용연수 동안 상각하여 손익으로 반영하고 있습니다.

2.18 연결재무제표의 승인

연결회사의 연결재무제표는 2025년 1월 31일 이사회에서 승인되었으며, 향후 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.

가. 수익인식

연결회사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대하여 환불부채와 회수할 재화에 대한 권리를 인식하고 있습니다. 판매 시점에 포트폴리오 수준에서 누적된 경험에 기초하여 기대값 방법으로 반품률을 예측하고 있으며, 연결회사의 수익은 예측된 반품률의 변동에 영향을 받습니다.

연결회사는 재화의 판매로 인한 수익을 통제가 이전되는 시점에 계약에 따른 대가에서 특정 매출장려활동을 차감한 금액으로 인식하고 있습니다. 과거의 경험 및 계약에
기초하여 매출차감액을 합리적으로 추정하고 있으며, 연결회사의 수익은 추정된 매출차감에 영향을 받습니다.

나. 판매보증충당부채

연결회사는 판매한 제품에 대하여 품질에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 연결회사는 매 보고기간종료일 미래와 현재의 보증의무를 제공하는데 필요하다고 판단되는 최선의 추정치를 기준으로 판매보증충당부채를 계상하고 있습니다. 이러한 최선의 추정치는 과거 경험에 기초하여 결정하고 있습니다.

다. 금융상품의 공정가치

연결회사는 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치에 대하여 보고기간종료일 현재 주요

한 시장상황을 기초로 다양한 평가기법 및 가정을 사용하여 결정하고 있습니다.
라. 금융자산의 손상

연결회사는 금융자산의 손실충당금을 측정할 때에 채무불이행위험과 기대신용률에 대한 가정에 근거하였습니다. 연결회사는 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간종료일의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다.

마. 리스

연결회사는 리스기간을 산정할 때에 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다.

선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 연결회사가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할 수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이
일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 연결회사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다.

바. 순확정급여부채(자산)

순확정급여부채(자산)는 많은 가정을 사용하는 보험수리적 방식에 의해 결정되는 다양한 요소들에 따라 달라질 수 있습니다. 퇴직연금의 순원가(이익)를 결정하는 데 사용되는 가정은 할인율을 포함하고 있으며, 이러한 가정의 변동은 순확정급여부채(자산)의 장부금액에 영향을 줄 것입니다. 연결회사는 매년 말 우량회사채 이자율을 고려하여 적절한 할인율을 결정하고 있으며, 이러한 할인율은 순확정급여부채(자산)의 정산 시 발생할 것으로 예상되는 미래의 추정 현금 유출액의 현재가치를 결정할 때 사용됩니다. 순확정급여부채(자산)와 관련된 다른 주요한 가정들 중 일부는 현재의 시장 상황에 근거하고 있습니다.
사. 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산의 손상

연결회사는 매년 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산의 손상 여부를 검토하고 있습니다. 현금창출단위 또는 자산의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정하고 있습니다. 이러한 계산은 추정에 근거하여 이루어집니다.

아. 법인세

연결회사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 연결회사는 보고기간종료일 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는
법인세효과를 최선의 추정과정을 거쳐 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다.
하지만 실제 미래 최종 법인세부담은 인식한 관련 자산・부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산・부채에 영향을 줄 수 있습니다.

연결회사는 특정 기간 동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을 때 세법

에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결회사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.

연결회사는 법인세 처리의 불확실성 여부를 검토하고 있으며, 과세당국이 불확실한 법인세 처리를 수용할 가능성이 높지 않다고 결론 내리는 경우에는 불확실한 법인세 처리 각각에 다음 방법 가운데 불확실성의 해소를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 방법을 사용하여 불확실성의 영향을 연결재무제표에 반영하고 있습니다.

(1) 가능성이 가장 높은 금액: 가능한 결과치 범위에서 가능성이 가장 높은 단일금액
(2) 기대값: 가능한 결과치의 범위에 있는 모든 금액에 각 확률을 곱한 금액의 합

4. 범주별 금융상품 (연결)

금융자산의 범주별 공시

당기 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산	금융자산, 범주 합계
금융자산 합계		170,616,210	10,580,932	1,689,020	44,262	182,930,424
금융자산 합계	현금및현금성자산	53,705,579	0	0	0	53,705,579
	단기금융상품	58,909,334	0	0	0	58,909,334
	단기상각후원가금융자산					0
	단기당기손익-공정가치 금융자산	0	0	36,877	0	36,877
	매출채권	43,623,073	0	0	0	43,623,073
	기타포괄손익-공정가치 금융자산	0	10,580,932	0	0	10,580,932
	당기손익-공정가치금융자산	0	0	1,175,749	0	1,175,749
	기타금융자산	14,378,224	0	476,394	44,262	14,898,880

전기 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산	금융자산, 범주 합계
금융자산 합계		143,321,745	7,481,297	1,933,750	70,777	152,807,569
금융자산 합계	현금및현금성자산	69,080,893	0	0	0	69,080,893
	단기금융상품	22,690,924	0	0	0	22,690,924
	단기상각후원가금융자산	608,281	0	0	0	608,281
	단기당기손익-공정가치 금융자산	0	0	27,112	0	27,112
	매출채권	36,647,393	0	0	0	36,647,393
	기타포괄손익-공정가치 금융자산	0	7,481,297	0	0	7,481,297
	당기손익-공정가치금융자산	0	0	1,431,394	0	1,431,394
	기타금융자산	14,294,254	0	475,244	70,777	14,840,275

당기 및 전기 기타금융자산에 대한 각주

기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

금융부채의 범주별 공시

당기 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	기타금융부채	금융부채, 범주 합계
금융부채 합계		49,704,553	36,795	17,922,059	67,663,407
금융부채 합계	매입채무	12,370,177	0	0	12,370,177
	단기차입금	338,058	0	12,834,446	13,172,504
	미지급금	17,390,861	0	0	17,390,861
	유동성장기부채	1,106,764	0	1,100,526	2,207,290
	사채	14,530	0	0	14,530
	장기차입금	6,537	0	3,929,323	3,935,860
	장기미지급금	4,779,141	0	0	4,779,141
	기타금융부채	13,698,485	36,795	57,764	13,793,044

전기 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	기타금융부채	금융부채, 범주 합계
금융부채 합계		42,907,245	49,904	11,366,897	54,324,046
금융부채 합계	매입채무	11,319,824	0	0	11,319,824
	단기차입금	504,552	0	6,610,049	7,114,601
	미지급금	13,996,395	0	0	13,996,395
	유동성장기부채	310,436	0	998,439	1,308,875
	사채	537,618	0	0	537,618
	장기차입금	0	0	3,724,850	3,724,850
	장기미지급금	4,907,875	0	0	4,907,875
	기타금융부채	11,330,545	49,904	33,559	11,414,008

당기 및 전기 기타금융부채에 대한 각주

기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

금융상품의 범주별 손익의 공시

당기 (단위 : 백만원)

	자산과 부채						
	금융자산, 범주				금융부채, 범주		
	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정금융부채	기타금융부채
평가손익(기타포괄손익)	0	2,300,166	0	39,303	0	0	(48,540)
평가·처분손익(당기손익)	(111,124)	0	144,453	(4,524)	0	66,514	5,587
평가손익(손익대체)	0	0	0	(4,590)	0	0	5,669

이자수익(금융수익)	4,818,923	0	205	0			
이자비용(금융원가)					(176,503)	0	(727,415)
외환차익(차손)	1,415,673	0	0	0	(1,169,716)	0	(161,064)
배당금수익(금융수익)	0	133,681	1,271	0			
손상(환입)	(64,352)	0	0	0			
기타금융자산 구성내역에 대한 기술				기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.			
기타금융부채 구성내역에 대한 기술							기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	자산과 부채						
	금융자산, 범주				금융부채, 범주		
	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정금융부채	기타금융부채
평가손익(기타포괄손익)	0	1,481,091	0	58,290	0	0	(16,809)
평가·처분손익(당기손익)	(64,758)	0	213,308	436	0	(116,167)	(126)
평가손익(손익대체)	0	0	0	1,169	0	0	(337)
이자수익(금융수익)	4,357,792	0	230	0			
이자비용(금융원가)					(510,865)	0	(419,388)
외환차익(차손)	(98,522)	0	0	0	162,844	0	61,920
배당금수익(금융수익)	0	161,509	2,694	0			
손상(환입)	(74,594)	0	0	0			
기타금융자산 구성내역에 대한 기술				기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.			
기타금융부채 구성내역에 대한 기술							기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

금융상품의 범주별 손익의 공시,합계

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주	금융부채, 범주

평가손익(기타포괄손익)	2,339,469	(48,540)
평가・처분손익(당기손익)	28,805	72,101
평가손익(손익대체)	(4,590)	5,669
이자수익(금융수익)	4,819,128	
이자비용(금융원가)		(903,918)
외환차익(차손)	1,415,673	(1,330,780)
배당금수익(금융수익)	134,952	
손상(환입)	(64,352)	

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주	금융부채, 범주
평가손익(기타포괄손익)	1,539,381	(16,809)
평가・처분손익(당기손익)	148,986	(116,293)
평가손익(손익대체)	1,169	(337)
이자수익(금융수익)	4,358,022	
이자비용(금융원가)		(930,253)
외환차익(차손)	(98,522)	224,764
배당금수익(금융수익)	164,203	
손상(환입)	(74,594)	

5. 금융자산의 양도 (연결)

전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산

당기 (단위 : 백만원)

	매출채권
기업이 계속하여 인식하는 자산	12,834,446
기업이 계속하여 인식하는 관련 부채	12,834,446
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산과 관련부채와의 관계의 성격에 대한 기술	연결회사는 당기 및 전기 중 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 연결회사가 매출채권 팩토링 거래에서 제공한 매출채권은 채무자의 채무불이행 시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 연결회사가 보유하므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 제거되지 않았습니다. 이러한 거래에서 인식한 금융부채는 연결재무상태표에 '단기차입금'으로 분류되어 있습니다(주석 12 참조).
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산의 성격에 대한 기술	할인된 매출채권에는 연결회사 간의 매출채권이 포함되어 있습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	매출채권

기업이 계속하여 인식하는 자산	6,610,049
기업이 계속하여 인식하는 관련 부채	6,610,049
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산과 관련부채와의 관계의 성격에 대한 기술	연결회사는 당기 및 전기 중 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 연결회사가 매출채권 팩토링 거래에서 제공한 매출채권은 채무자의 채무불이행 시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 연결회사가 보유하므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 제거되지 않았습니다. 이러한 거래에서 인식한 금융부채는 연결재무상태표에 '단기차입금'으로 분류되어 있습니다(주석 12 참조).
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산의 성격에 대한 기술	할인된 매출채권에는 연결회사 간의 매출채권이 포함되어 있습니다.

6. 공정가치금융자산 (연결)

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
비유동금융자산	10,580,932

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
비유동금융자산	7,481,297

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주		금융자산, 범주 합계
	당기손익인식금융자산		
	채무상품	지분상품	
유동 금융자산	36,877		36,877
비유동금융자산	631,375	544,374	1,175,749

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주		금융자산, 범주 합계
	당기손익인식금융자산		

	채무상품	지분상품	
유동 금융자산	27,112		27,112
비유동금융자산	619,036	812,358	1,431,394

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시, 합계

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품 및 지분상품
금융자산	1,212,626

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품 및 지분상품
금융자산	1,458,506

비유동 기타포괄손익-공정가치금융자산 변동내역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주	
	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익인식금융자산
	자산부채변동의 유동비유동 분류	
	비유동으로 분류되는 자산부채	
기초금융자산	7,481,297	1,431,394
발행 또는 매입에 따른 증가, 금융자산	182,655	74,699
제거에 따른 감소, 금융자산	(409,434)	(343,374)
공정가치변동에 따른 증가(감소), 금융자산	3,106,853	(26,515)
기타 변동에 따른 증가(감소), 금융자산	219,561	39,545
기말금융자산	10,580,932	1,175,749

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주	
	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익인식금융자산
	자산부채변동의 유동비유동 분류	

	비유동으로 분류되는 자산부채	
기초금융자산	11,397,012	1,405,468
발행 또는 매입에 따른 증가, 금융자산	124,897	146,392
제거에 따른 감소, 금융자산	(5,918,616)	(81,113)
공정가치변동에 따른 증가(감소), 금융자산	1,548,022	(38,110)
기타 변동에 따른 증가(감소), 금융자산	329,982	(1,243)
기말금융자산	7,481,297	1,431,394

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 변동내역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	자본
	기타자본구성요소
	기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금
기초	249,121
공정가치평가	2,571,076
처분으로 인한 이익잉여금 대체	(49,887)
기말	2,770,310
차감: 자본에 가감되는 법인세효과	(614,995)
계	2,155,315

전기 (단위 : 백만원)

	자본
	기타자본구성요소
	기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금
기초	3,636,478
공정가치평가	1,548,022
처분으로 인한 이익잉여금 대체	(4,935,379)
기말	249,121
차감: 자본에 가감되는 법인세효과	(54,702)
계	194,419

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	측정 전체	
	취득원가	공정가치
	금융자산, 분류	

	공정가치로 측정하는 금융자산															
	상장주식															
	삼성중공업㈜	㈜효성신라	㈜아이마켓코리아	㈜원익홀딩스	㈜원익아이피에스	Wacom Co., Ltd.	Corning Incorporated	기타	삼성중공업㈜	㈜효성신라	㈜아이마켓코리아	㈜원익홀딩스	㈜원익아이피에스	Wacom Co., Ltd.	Corning Incorporated	기타
금융자산	932,158	13,957	324	30,821	32,428	62,013	3,831,362	557,554	1,514,508	73,974	5,179	8,972	82,737	57,021	5,169,226	861,115
보유주식수(주)	134,027,281	2,004,717	647,320	3,518,342	3,701,872	8,398,400	74,000,000									
보유지분율	0.152	0.051	0.019	0.046	0.075	0.058	0.086									
지분율에 대한 설명	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.									

전기 (단위 : 백만원)

	측정 전체															
	취득원가								공정가치							
	금융자산, 분류															
	공정가치로 측정하는 금융자산															
	상장주식															
	삼성중공업㈜	㈜효성신라	㈜아이마켓코리아	㈜원익홀딩스	㈜원익아이피에스	Wacom Co., Ltd.	Corning Incorporated	기타	삼성중공업㈜	㈜효성신라	㈜아이마켓코리아	㈜원익홀딩스	㈜원익아이피에스	Wacom Co., Ltd.	Corning Incorporated	기타
금융자산									1,038,711	131,108	5,560	11,857	125,679	50,358	3,140,978	1,093,963
보유주식수(주)																
보유지분율																
지분율에 대한 설명																

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시, 합계

당기 (단위 : 백만원)

	측정 전체	
	취득원가	공정가치
	금융자산, 분류	
	공정가치로 측정하는 금융자산	
	상장주식	
금융자산	5,460,617	7,772,732

전기 (단위 : 백만원)

	측정 전체	
	취득원가	공정가치
	금융자산, 분류	
	공정가치로 측정하는 금융자산	
	상장주식	
금융자산		5,598,214

7. 매출채권 및 미수금 (연결)

매출채권 및 미수금의 공시

당기 (단위 : 백만원)

		총장부금액	손상차손누계액	장부금액 합계
매출채권		44,071,714	(421,000)	43,650,714

매출채권	유동매출채권			43,623,073
	비유동매출채권			27,641
미수금		10,491,746	(84,945)	10,406,801
미수금	단기미수금, 순액			9,622,974
	장기미수금, 순액			783,827

전기 (단위 : 백만원)

		총장부금액	손상차손누계액	장부금액 합계
매출채권		37,026,738	(355,456)	36,671,282
매출채권	유동매출채권			36,647,393
	비유동매출채권			23,889
미수금		7,474,967	(82,224)	7,392,743
미수금	단기미수금, 순액			6,633,248
	장기미수금, 순액			759,495

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	금융상품	
	매출채권	미수금
	장부금액	
	손상차손누계액	
기초금융자산	(355,456)	(82,224)
대손상각(환입)	(61,705)	(1,413)
제각	9,404	3,458
기타	(13,243)	(4,766)
기말금융자산	(421,000)	(84,945)

전기 (단위 : 백만원)

	금융상품	
	매출채권	미수금
	장부금액	
	손상차손누계액	
기초금융자산	(312,221)	(78,101)
대손상각(환입)	(62,964)	297
제각	18,875	124
기타	854	(4,544)
기말금융자산	(355,456)	(82,224)

연체되거나 손상된 금융자산에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류									
	매출채권					미수금				
	장부금액									
	총장부금액									
	연체상태				연체상태 합계	연체상태				연체상태 합계
	연체되지 않은 채권	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		연체되지 않은 채권	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	
금융자산	40,986,584	2,619,575	124,204	341,351	44,071,714	10,089,887	253,962	24,623	123,274	10,491,746
기업이 신용이 손상된 금융자산인지를 판단하는 방법에 관한 정보		연결회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단하지 않습니다.					연결회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단하지 않습니다.			

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류									
	매출채권					미수금				
	장부금액									
	총장부금액									
	연체상태				연체상태 합계	연체상태				연체상태 합계
	연체되지 않은 채권	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		연체되지 않은 채권	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	
금융자산	33,633,006	2,262,296	478,371	653,065	37,026,738	7,077,413	269,390	15,369	112,795	7,474,967
기업이 신용이 손상된 금융자산인지를 판단하는 방법에 관한 정보		연결회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단하지 않습니다.					연결회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단하지 않습니다.			

연체되거나 손상된 금융자산에 대한 공시, 합계

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류					
	매출채권			미수금		
	장부금액					
	총장부금액					
	연체상태		연체상태 합계	연체상태		연체상태 합계
	연체되지 않은 채권	연체채권		연체되지 않은 채권	연체채권	
금융자산	40,986,584	3,085,130	44,071,714	10,089,887	401,859	10,491,746

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류					
	매출채권			미수금		
	장부금액					
	총장부금액					
	연체상태		연체상태 합계	연체상태		연체상태 합계
	연체되지 않은 채권	연체채권		연체되지 않은 채권	연체채권	
금융자산	33,633,006	3,393,732	37,026,738	7,077,413	397,554	7,474,967

채권의 신용위험 금액에 대한 기술

보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 채권의 장부금액입니다. 연결회사의 주요 채권과 관련하여 보험사와 보험계약을 체결하고 있습니다.

8. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당기 (단위 : 백만원)

		평가전금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
재고자산		56,737,864	(4,982,999)	51,754,865
재고자산	제품 및 상품	15,061,526	(1,219,250)	13,842,276
	반제품 및 재공품	24,808,183	(2,467,701)	22,340,482
	원재료 및 저장품	15,442,327	(1,296,048)	14,146,279
	미착품	1,425,828	0	1,425,828
기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가				181,242,363

전기 (단위 : 백만원)

		평가전금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
재고자산		59,022,026	(7,396,152)	51,625,874
재고자산	제품 및 상품	16,120,367	(1,567,353)	14,553,014
	반제품 및 재공품	26,501,664	(4,303,216)	22,198,448
	원재료 및 저장품	15,222,937	(1,525,583)	13,697,354
	미착품	1,177,058	0	1,177,058
기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가				177,539,372

기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가에 대한 기술

당기 중 비용으로 인식한 재고자산의 금액은 181,242,363백만원(전기: 177,539,372백만원)입니다. 동 비용에는 재고자산평가손실 금액이 포함되어 있습니다.

9. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결)

가. 당기 및 전기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	11,767,444	10,893,869
취득	11,710	78,690
처분	(33,208)	(33,464)
이익 중 지분해당액	751,044	887,550
기타(*)	95,127	(59,201)
기말	12,592,117	11,767,444

(*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기㈜	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스㈜	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합・관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스㈜	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI㈜(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
㈜제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	기타 산업용 유리제품 생산 및 공급	50.0	한국	12월

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성전기㈜	359,237	2,058,412	2,067,669	359,237	1,837,925	1,841,393
삼성에스디에스㈜	147,963	2,108,195	2,120,417	147,963	1,955,699	1,966,206
삼성바이오로직스㈜	1,424,358	3,403,947	3,406,062	1,424,358	3,068,636	3,073,595
삼성SDI㈜	1,242,605	3,979,333	2,923,991	1,242,605	3,726,675	2,912,564
㈜제일기획	506,162	418,029	718,561	506,162	368,875	669,363
기타	674,721	844,623	1,131,648	690,481	844,645	1,093,799
계	4,355,046	12,812,539	12,368,348	4,370,806	11,802,455	11,556,920

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	215,000	143,198	143,178	215,000	138,939	138,938
기타	259,994	74,075	80,591	259,994	72,215	71,586
계	474,994	217,273	223,769	474,994	211,154	210,524

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 당기 및 전기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 백만원)

기 업 명	기초	지분법평가 내역			기말
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기㈜	1,841,393	164,841	81,782	(20,347)	2,067,669
삼성에스디에스㈜	1,966,206	172,708	28,678	(47,175)	2,120,417
삼성바이오로직스㈜	3,073,595	336,256	(3,789)	-	3,406,062
삼성SDI㈜	2,912,564	(37,454)	62,344	(13,463)	2,923,991
㈜제일기획	669,363	59,476	21,954	(32,232)	718,561
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	138,938	4,389	(130)	(19)	143,178
기타	1,165,385	50,828	42,908	(46,882)	1,212,239
계	11,767,444	751,044	233,747	(160,118)	12,592,117

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

기 업 명	기초	지분법평가 내역			기말
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기㈜	1,764,249	106,455	7,844	(37,155)	1,841,393
삼성에스디에스㈜	1,870,338	154,282	(2,503)	(55,911)	1,966,206
삼성바이오로직스㈜	2,808,673	267,614	(2,692)	-	3,073,595
삼성SDI㈜	2,691,223	214,702	20,506	(13,867)	2,912,564
㈜제일기획	649,161	53,690	(94)	(33,394)	669,363
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	137,745	1,336	(124)	(19)	138,938
기타	972,480	89,471	52,175	51,259	1,165,385
계	10,893,869	887,550	75,112	(89,087)	11,767,444

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(1) 주요 관계기업

(단위 : 백만원)

구 분	당기				
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표:					
유동자산	5,891,746	9,003,787	5,518,118	10,334,313	2,754,194
비유동자산	6,900,656	4,234,543	11,818,179	30,263,032	568,459
유동부채	3,056,861	2,495,409	3,853,188	10,855,694	1,594,190
비유동부채	719,688	1,037,472	2,578,432	8,174,413	251,659
비지배지분	226,693	372,330	-	1,800,842	18,806

요약 포괄손익계산서:					
매출	10,294,103	13,828,232	4,547,322	16,592,249	4,344,257
계속영업손익(*1)	640,865	756,997	1,083,316	544,239	207,515
세후중단영업손익(*1)	38,265	-	-	55,051	-
기타포괄손익(*1)	349,340	144,625	(9,132)	722,676	76,571
총포괄손익(*1)	1,028,470	901,622	1,074,184	1,321,966	284,086
Ⅱ. 관계기업 투자의 장부금액으로의 조정 내역					
순자산(a)	8,789,161	9,333,119	10,904,676	19,766,396	1,457,998
연결실체지분율(b)(*2)	23.4%	22.6%	31.2%	20.1%	28.7%
순자산지분금액(a×b)	2,058,412	2,108,195	3,403,947	3,979,333	418,029
영업권	7,081	26,801	3,645	-	298,779
내부거래 등(*3)	2,176	(14,579)	(1,530)	(1,055,342)	1,753
장부금액	2,067,669	2,120,417	3,406,062	2,923,991	718,561
Ⅲ. 배당					
배당	20,347	47,175	-	13,463	32,232

(*1) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(*2) 보통주와 우선주 포함 지분율입니다.

(*3) 미실현손익과 기타차이로 구성되어 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	전기				
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표:					
유동자산	5,208,418	8,160,300	5,521,988	9,187,029	2,372,420
비유동자산	6,449,453	4,160,724	10,524,209	24,851,831	517,085
유동부채	2,900,460	2,391,861	4,157,861	8,518,933	1,375,034
비유동부채	727,087	953,592	2,057,844	5,612,677	216,707
비지배지분	182,613	317,562	-	1,395,877	11,206
요약 포괄손익계산서:					
매출	8,892,412	13,276,844	3,694,589	21,436,788	4,138,275
계속영업손익(*1)	449,857	693,422	857,691	1,921,820	187,302
세후중단영업손익(*1)	(26,900)	-	-	87,387	-
기타포괄손익(*1)	45,053	(11,085)	(11,673)	85,394	3,685
총포괄손익(*1)	468,010	682,337	846,018	2,094,601	190,987
Ⅱ. 관계기업 투자의 장부금액으로의 조정 내역					
순자산(a)	7,847,711	8,658,009	9,830,492	18,511,373	1,286,558
연결실체지분율(b)(*2)	23.4%	22.6%	31.2%	20.1%	28.7%
순자산지분금액(a×b)	1,837,925	1,955,699	3,068,636	3,726,675	368,875

영업권	7,081	26,801	3,645	-	298,779
내부거래 등(*3)	(3,613)	(16,294)	1,314	(814,111)	1,709
장부금액	1,841,393	1,966,206	3,073,595	2,912,564	669,363
Ⅲ. 배당					
배당	37,155	55,911	-	13,867	33,394

(*1) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(*2) 보통주와 우선주 포함 지분율입니다.

(*3) 미실현손익과 기타차이로 구성되어 있습니다.

(2) 주요 공동기업

(단위 : 백만원)

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	
	당기	전기
Ⅰ. 요약 재무정보		
요약 재무상태표:		
유동자산	120,786	116,372
비유동자산	199,017	185,100
유동부채	33,294	22,684
비유동부채	113	911
요약 포괄손익계산서:		
매출	160,202	122,446
계속영업손익(*1)	8,778	2,672
세후중단영업손익(*1)	-	-
기타포괄손익(*1)	-	-
총포괄손익(*1)	8,778	2,672
Ⅱ. 공동기업 투자의 장부금액으로의 조정 내역		
순자산(a)	286,396	277,877
연결실체지분율(b)	50.0%	50.0%
순자산지분금액(a×b)	143,198	138,939
내부거래 등(*2)	(20)	(1)
장부금액	143,178	138,938
Ⅲ. 배당		
배당	-	-

(*1) 공동기업별 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(*2) 미실현손익과 기타차이로 구성되어 있습니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기		전기	
	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
당기순손익	48,408	2,420	87,072	2,399
기타포괄손익	39,152	3,756	50,260	1,915
총포괄손익	87,560	6,176	137,332	4,314

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당기말		전기말

	주식수	시장가치	시장가치
삼성전기㈜	17,693,084	2,190,404	2,710,580
삼성에스디에스㈜	17,472,110	2,232,936	2,970,259
삼성바이오로직스㈜	22,217,309	21,084,226	16,885,155
삼성SDI㈜	13,462,673	3,332,012	6,354,382
㈜제일기획	29,038,075	492,195	552,595

사. 기타사항

(1) 증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스㈜가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스㈜ 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주석 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치(이하 "1차 처분")를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(이하 "2차 처분")를 2018년 11월 14일에의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스㈜는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 위 처분의취소를 구하는 소송(이하 "본안 소송")을 서울행정법원에 제기하였고, 현재 소송을 진행 중입니다. 1차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2020년 9월 24일 증권선물위원회가 부과한 행정 처분을 취소한다고 판결하고, 항소심 판결 선고 시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였으나, 증권선물위원회는 2020년10월 16일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송을 진행 중입니다. 2차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2024년 8월 14일 증권선물위원회가 부과한 행정처분을 취소한다고 판결하였으나, 증권선물위원회는 2024년 8월 28일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송이 진행 중입니다.

또한, 삼성바이오로직스㈜는 위 처분에 대한 효력정지신청서를 서울행정법원에 제출하였으며, 법원은 2019년 1월 22일(2차 처분)과 2019년 2월 19일(1차 처분)에 본안 소송의 판결시까지 처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시 항고하였으며, 서울고등법원은 2019년 5월 13일(2차 처분), 2019년 5월 24일(1차 처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차 처분), 2019년 6월 10일(1차 처분) 재항고 하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차 처분), 2019년 10월 11일(1차 처분) 재항고를 기각하여 효력정지 결정이 확정되었습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스㈜가
삼성바이오에피스㈜ 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년부터 2022년까지 보고기간의 지분법손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스㈜와 증권선물위원회 간의 행정소송에
대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 연결회사의 당기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

(2) 지배회사는 2024년 12월 31일 이사회에서 관계기업인 레인보우로보틱스㈜의 최대주주 등 6인이 보유한 지분 394만주를 인수하는 주식매도청구권(콜옵션)의 행사를의결하였습니다. 인수대가는 267,463백만원이며, 당기말 현재 진행 중인 지분인수 관련 행정절차가 완료되면 지급할 예정입니다.

10. 유형자산 (연결)

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당기 (단위 : 백만원)

	토지	건물 및 구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	유형자산 합계
기초 유형자산	9,999,377	43,238,115	83,309,168	46,720,328	3,989,274	187,256,262
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	244,885	7,057,644	40,219,596	5,073,120	2,346,943	54,942,188
사업결합을 통한 취득, 유형자산	0	49	0	0	131	180
감가상각비, 유형자산	(50,029)	(4,268,335)	(33,744,595)	0	(1,587,023)	(39,649,982)
유형자산의 처분 및 폐기	(27,321)	(293,418)	(44,567)	(21)	(30,537)	(395,864)

당기손익으로 인식된 손상, 유형자산	0	(231,562)	(113,246)	(50,373)	(1,256)	(396,437)
매각예정으로의 분류를 통한 감소, 유형자산						
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	81,316	1,529,452	1,280,217	1,374,201	(76,324)	4,188,862
기말 유형자산	10,248,228	47,031,945	90,906,573	53,117,255	4,641,208	205,945,209

전기 (단위 : 백만원)

	토지	건물 및 구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	유형자산 합계
기초 유형자산	9,892,167	40,706,918	79,714,631	33,607,564	4,124,108	168,045,388
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	172,262	6,498,611	33,641,691	13,141,766	1,462,032	54,916,362
사업결합을 통한 취득, 유형자산	0	18,125	20,140	34,698	165	73,128
감가상각비, 유형자산	(49,367)	(3,884,333)	(30,031,617)	0	(1,567,094)	(35,532,411)
유형자산의 처분 및 폐기	(25,934)	(181,700)	(37,681)	(256)	(30,547)	(276,118)
당기손익으로 인식된 손상, 유형자산	0	(30,864)	(47,044)	0	(7,449)	(85,357)
매각예정으로의 분류를 통한 감소, 유형자산	(6,615)	(54,318)	(37,101)	(6,255)	(14,100)	(118,389)
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	16,864	165,676	86,149	(57,189)	22,159	233,659
기말 유형자산	9,999,377	43,238,115	83,309,168	46,720,328	3,989,274	187,256,262

유형자산에 대한 세부 정보 공시, 총액

당기 (단위 : 백만원)

	유형자산													
	토지			건물 및 구축물			기계장치			건설중인자산			기타유형자산		
	장부금액			장부금액			장부금액			장부금액			장부금액		
	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계
기초 유형자산	10,157,963	(158,586)	9,999,377	73,689,951	(30,451,836)	43,238,115	328,561,492	(245,252,324)	83,309,168	46,720,328	0	46,720,328	14,058,654	(10,069,380)	3,989,274
기말 유형자산	10,435,001	(186,773)	10,248,228	82,415,394	(35,383,449)	47,031,945	373,276,338	(282,369,765)	90,906,573	53,117,255	0	53,117,255	15,852,084	(11,210,876)	4,641,208

전기 (단위 : 백만원)

	유형자산													
	토지			건물 및 구축물			기계장치			건설중인자산			기타유형자산		
	장부금액			장부금액			장부금액			장부금액			장부금액		
	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계
기초 유형자산	10,024,569	(132,402)	9,892,167	67,713,808	(27,006,890)	40,706,918	303,000,627	(223,285,996)	79,714,631	33,607,564	0	33,607,564	13,248,490	(9,124,382)	4,124,108
기말 유형자산	10,157,963	(158,586)	9,999,377	73,689,951	(30,451,836)	43,238,115	328,561,492	(245,252,324)	83,309,168	46,720,328	0	46,720,328	14,058,654	(10,069,380)	3,989,274

유형자산에 대한 세부 정보 공시, 총액합계

당기 (단위 : 백만원)

	자산		
	유형자산		
	장부금액		장부금액 합계
	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	
기초 유형자산	473,188,388	(285,932,126)	187,256,262
기말 유형자산	535,096,072	(329,150,863)	205,945,209

전기 (단위 : 백만원)

	자산		
	유형자산		
	장부금액		장부금액 합계
	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	
기초 유형자산	427,595,058	(259,549,670)	168,045,388
기말 유형자산	473,188,388	(285,932,126)	187,256,262

기타 변동에 대한 각주, 유형자산

기타는 환율변동에 의한 증감액 및 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

적격자산인 유형자산에 대해 자본화된 차입원가

당기 (단위 : 백만원)

	자산		
	유형자산		
	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위	
자본화된 차입원가			515,824
자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율	0.042	0.059	

전기 (단위 : 백만원)

	자산		
	유형자산		
	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위	
자본화된 차입원가			204,814
자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율	0.039	0.058	

일반취득 및 자본적지출에 대한 각주, 유형자산

일반취득 및 자본적지출은 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다.

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당기 (단위 : 백만원)

	자산				
	유형자산				자산 합계

	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타유형자산	
기초 사용권자산	481,610	4,034,052	137,574	795,796	5,449,032
일반취득, 사용권자산	22,407	975,685	89,158	208,838	1,296,088
사용권자산감가상각비	(49,939)	(940,196)	(59,946)	(166,338)	(1,216,419)
계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 사용권자산	(8,816)	(175,484)	(184)	(15,893)	(200,377)
매각예정분류를 통한 감소, 사용권자산					
기타 변동에 따른 증가(감소), 사용권자산	34,785	261,502	11,578	24,696	332,561
기말 사용권자산	480,047	4,155,559	178,180	847,099	5,660,885

전기 (단위 : 백만원)

	자산				자산 합계
	유형자산				
	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타유형자산	
기초 사용권자산	503,203	3,451,596	175,151	787,659	4,917,609
일반취득, 사용권자산	38,677	1,594,886	10,058	158,842	1,802,463
사용권자산감가상각비	(49,367)	(871,275)	(47,174)	(147,178)	(1,114,994)
계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 사용권자산	(12,461)	(174,426)	(279)	(6,904)	(194,070)
매각예정분류를 통한 감소, 사용권자산	(4,305)	(17)	0	(414)	(4,736)
기타 변동에 따른 증가(감소), 사용권자산	5,863	33,288	(182)	3,791	42,760
기말 사용권자산	481,610	4,034,052	137,574	795,796	5,449,032

기타 변동에 대한 각주, 사용권자산

기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

감가상각비의 기능별 배분

당기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	35,084,501	4,565,481	39,649,982

전기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	31,647,926	3,884,485	35,532,411

11. 무형자산 (연결)

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	무형자산 및 영업권					무형자산 및 영업권 합계
	영업권 이외의 무형자산				영업권	
	산업재산권	개발비	회원권	기타		
기초의 무형자산 및 영업권	4,424,566	0	256,859	11,602,818	6,457,619	22,741,862
개별취득, 영업권 이외의 무형자산	357,137	0	16,763	2,262,202	0	2,636,102
사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권	0	0	0	34,572	145,254	179,826
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산	(289,623)	0	0	(2,691,217)	0	(2,980,840)
처분과 폐기, 무형자산 및 영업권	(37,376)	0	(209)	(16,543)	0	(54,128)

당기손익으로 인식된 손상, 무형자산 및 영업권	(25,340)	0	(864)	0	0	(26,204)
당기손익으로 인식된 손상차손환입, 영업권 이외의 무형자산						
매각예정으로의 분류에 따른 감소, 무형자산 및 영업권						
기타변동에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권	360,002	0	349	315,929	565,668	1,241,948
기말 무형자산 및 영업권	4,789,366	0	272,898	11,507,761	7,168,541	23,738,566

전기 (단위 : 백만원)

	무형자산 및 영업권					무형자산 및 영업권 합계
	영업권 이외의 무형자산				영업권	
	산업재산권	개발비	회원권	기타		
기초의 무형자산 및 영업권	4,278,750	85,018	253,554	9,586,010	6,014,422	20,217,754
개별취득, 영업권 이외의 무형자산	401,561	0	6,251	4,608,488	0	5,016,300
사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권	3,944	0	0	37,758	315,136	356,838
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산	(276,781)	(85,018)	0	(2,772,349)	0	(3,134,148)
처분과 폐기, 무형자산 및 영업권	(41,492)	0	(8,656)	(44)	0	(50,192)
당기손익으로 인식된 손상, 무형자산 및 영업권	(6,265)	0		(2,900)	0	(5,427)
당기손익으로 인식된 손상차손환입, 영업권 이외의 무형자산			3,738			
매각예정으로의 분류에 따른 감소, 무형자산 및 영업권	(2)	0	0	(4,405)	(58,455)	(62,862)
기타변동에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권	64,851	0	1,972	150,260	186,516	403,599
기말 무형자산 및 영업권	4,424,566	0	256,859	11,602,818	6,457,619	22,741,862

기타 변동에 대한 각주, 무형자산

기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

현금창출단위의 정보에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	기 타	현금창출단위 합계 합계
영업권	1,463,566	176,885	380,897	5,146,242	951	7,168,541

현금창출단위의 회수가능액이 결정되어진 근거에 대한 기술						연결회사는 매년 영업권의 손상 여부를 검토하고 있으며, 현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년간(단, 신기술 산업 등 중장기 계획이 합리적인 경우 5년 초과)의 재무예산에 근거한 세전현금흐름 추정치를 사용하였습니다. 동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정 성장률의 가정(단, 산업평균 성장률을 초과하지 않음)이 사용되었습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	기 타	현금창출단위 합계 합계
영업권	1,256,815	164,607	343,967	4,691,440	790	6,457,619

현금창출단위의 회수가능액이 결정되어진 근거에 대한 기술						연결회사는 매년 영업권의 손상 여부를 검토하고 있으며, 현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년간(단, 신기술 산업 등 중장기 계획이 합리적인 경우 5년 초과)의 재무예산에 근거한 세전현금흐름 추정치를 사용하였습니다. 동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정 성장률의 가정(단, 산업평균 성장률을 초과하지 않음)이 사용되었습니다.

무형자산상각비의 기능별 배분

당기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	2,019,693	961,147	2,980,840

전기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	2,197,662	936,486	3,134,148

12. 차입금 (연결)

단기차입금에 대한 세부 정보

당기 (단위 : 백만원)

	차입금명칭												
	담보부차입금						무담보차입금						차입금명칭 합계
	거래상대방												
	우리은행 등			씨티은행 등			우리은행 등			씨티은행 등			
	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	
	하위범위	상위범위		하위범위	상위범위		하위범위	상위범위		하위범위	상위범위		
연이자율	0.004	0.149								0.000	0.530		
단기차입금			12,834,446									338,058	13,172,504
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.										

전기 (단위 : 백만원)

	차입금명칭		
	담보부차입금	무담보차입금	차입금명칭 합계

	거래상대방												
	우리은행 등			씨티은행 등			우리은행 등			씨티은행 등			
	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	
	하위범위	상위범위		하위범위	상위범위		하위범위	상위범위		하위범위	상위범위		
연이자율													
단기차입금			6,610,049									504,552	7,114,601
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.										

유동성장기차입금에 대한 세부 정보

당기

(단위 : 백만원)

	차입금명칭																
	은행차입금								리스부채								차입금명칭 합계
	거래상대방																
	BNP 등				CSSD 등				BNP 등				CSSD 등				
	범위			범위 합계	범위			범위 합계	범위			범위 합계	범위			범위 합계	
	하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		
연이자율	0.000		0.553											0.046			
유동성장기차입금				510,756												1,100,526	1,611,282

전기

(단위 : 백만원)

	차입금명칭																
	은행차입금								리스부채								차입금명칭 합계
	거래상대방																
	BNP 등				CSSD 등				BNP 등				CSSD 등				
	범위			범위 합계	범위			범위 합계	범위			범위 합계	범위			범위 합계	
	하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		
연이자율																	
유동성장기차입금				304,082												998,439	1,302,521

장기차입금에 대한 세부 정보

당기

(단위 : 백만원)

	차입금명칭																
	은행차입금								리스부채								차입금명칭 합계
	거래상대방																
	BNP 등				CSSD 등				BNP 등				CSSD 등				
	범위			범위 합계	범위			범위 합계	범위			범위 합계	범위			범위 합계	
	하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		
연이자율	0.000		0.074											0.046			
장기차입금				6,537												3,929,323	3,935,860

전기

(단위 : 백만원)

	차입금명칭																
	은행차입금								리스부채								차입금명칭 합계
	거래상대방																
	BNP 등				CSSD 등				BNP 등				CSSD 등				
	범위			범위 합계	범위			범위 합계	범위			범위 합계	범위			범위 합계	
	하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		
연이자율																	
장기차입금				0												3,724,850	3,724,850

리스부채 이자비용에 대한 공시

당기

(단위 : 백만원)

	공시금액

리스부채에 대한 이자비용	223,938
리스부채 측정에 포함되지 않은 변동리스료에 관련되는 비용	159,262
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며 당기 중 발생한 이자비용은 223,938백만원(전기: 197,202백만원)입니다. 한편, 당기 중 리스부채 측정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액자산 리스료 등은 159,262백만원(전기:158,395백만원)입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 이자비용	197,202
리스부채 측정에 포함되지 않은 변동리스료에 관련되는 비용	158,395
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며 당기 중 발생한 이자비용은 223,938백만원(전기: 197,202백만원)입니다. 한편, 당기 중 리스부채 측정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액자산 리스료 등은 159,262백만원(전기:158,395백만원)입니다.

차입금의 만기분석에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년 이후	합계 구간 합계
장기차입금, 미할인 현금흐름	510,756	1,770	1,953	1,106	1,708	517,293
총 리스부채	1,304,227	1,047,520	828,443	642,638	1,969,015	5,791,843

13. 사채 (연결)

사채에 대한 세부 정보 공시

당기 (단위 : 백만원)

	US$ denominated Straight Bonds	US$ denominated Debenture Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	2015-05-11	
만기상환일	2027-10-01	2025-05-15	
연이자율	0.077	0.042	
명목금액	22,050	588,000	610,050
명목금액, 기초통화금액 (USD) [USD, 천]	15,000	400,000	
사채할인발행차금			(255)
사채할증발행차금			743
사채			610,538

차감: 유동성사채			(596,008)
비유동성사채			14,530
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	

전기 (단위 : 백만원)

	US$ denominated Straight Bonds	US$ denominated Debenture Bonds	차입금명칭 합계
발행일			
만기상환일			
연이자율			
명목금액	25,788	515,760	541,548
명목금액, 기초통화금액(USD) [USD, 천]	20,000	400,000	
사채할인발행차금			(370)
사채할증발행차금			2,794
사채			543,972
차감: 유동성사채			(6,354)
비유동성사채			537,618
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	

사채의 만기분석에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	2025년	2026년	2027년	합계 구간 합계
사채, 미할인현금흐름	595,350	7,350	7,350	610,050

14. 순확정급여부채(자산) (연결)

확정급여제도에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적립약정 합계

확정급여채무, 현재가치	16,965,629	379,155	17,344,784
사외적립자산의 공정가치			(19,912,945)
순확정급여부채(자산) 계			(2,568,161)

전기 (단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	15,403,976	319,689	15,723,665
사외적립자산의 공정가치			(20,172,327)
순확정급여부채(자산) 계			(4,448,662)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여제도			1,400,834
순이자비용(수익), 확정급여제도			(259,108)
과거근무원가, 확정급여제도			(676)
기타 비용, 확정급여제도			47,897
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	462,180	726,767	1,188,947

전기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여제도			1,294,308
순이자비용(수익), 확정급여제도			(354,220)
과거근무원가, 확정급여제도			4,839
기타 비용, 확정급여제도			9,491
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	378,104	576,314	954,418

확정기여제도 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
퇴직급여비용, 확정기여제도	382,391

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
퇴직급여비용, 확정기여제도	203,004

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산	순확정급여부채(자산) 합계
기초	15,723,665	(20,172,327)	(4,448,662)
당기근무원가, 순확정급여부채(자산)	1,400,834		1,400,834
이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)	840,271	(1,099,379)	(259,108)
과거근무원가, 순확정급여부채(자산)	(676)		(676)
재측정요소		213,636	213,636
- 인구통계적가정의 변동	76,762		76,762
- 재무적가정의 변동	595,095		595,095
기타사항에 의한 효과	141,212		141,212
사용자의 기여금		(114,173)	(114,173)
급여지급액	(1,466,188)	1,267,778	(198,410)
기타	33,809	(8,480)	25,329
기말	17,344,784	(19,912,945)	(2,568,161)
다음 연차보고기간 동안에 납부할 것으로 예상되는 기여금에 대한 추정치		2,081,723	

전기 (단위 : 백만원)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산	순확정급여부채(자산) 합계
기초	14,010,308	(19,593,910)	(5,583,602)
당기근무원가, 순확정급여부채(자산)	1,294,308		1,294,308
이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)	805,084	(1,159,304)	(354,220)
과거근무원가, 순확정급여부채(자산)	4,839		4,839
재측정요소		654,005	654,005
- 인구통계적가정의 변동	62,291		62,291
- 재무적가정의 변동	266,505		266,505
기타사항에 의한 효과	123,165		123,165
사용자의 기여금		(746,068)	(746,068)
급여지급액	(846,457)	687,125	(159,332)
기타	3,622	(14,175)	(10,553)
기말	15,723,665	(20,172,327)	(4,448,662)
다음 연차보고기간 동안에 납부할 것으로 예상되는 기여금에 대한 추정치			

기타 변동에 의한 증가(감소), 순확정급여부채(자산)에 대한 기술

기타는 환율변동에 의한 증감액 및 매각예정으로 인한 재분류를 포함하고 있습니다.

사외적립자산의 공정가치에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
원금보장형 고정수익 상품 등	(15,685,547)
간접투자상품	(4,128,450)
그 밖의 자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액	(98,948)
사외적립자산, 공정가치	(19,912,945)

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
원금보장형 고정수익 상품 등	(18,178,623)
간접투자상품	(1,908,087)
그 밖의 자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액	(85,617)
사외적립자산, 공정가치	(20,172,327)

보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	보험수리적 가정					
	할인율에 대한 보험수리적 가정			미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정		
	범위		범위 합계	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위		하위범위	상위범위	
할인율에 대한 보험수리적 가정	0.040	0.051				
미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정				0.020	0.059	
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율			0.01			0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소)			15,743,077			19,173,312
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율			0.01			0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소)			19,203,081			15,736,900

전기 (단위 : 백만원)

	보험수리적 가정					
	할인율에 대한 보험수리적 가정			미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정		
	범위		범위 합계	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위		하위범위	상위범위	
할인율에 대한 보험수리적 가정	0.039	0.059				
미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정				0.030	0.063	

보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율			0.01			0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소)			14,291,442			17,365,127
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율			0.01			0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소)			17,385,125			14,280,988

확정급여채무의 만기구성에 대한 정보의 공시

	가중범위
확정급여채무의 가중평균만기	9년11개월23일

15. 충당부채 (연결)

충당부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	충당부채 합계
기초	2,540,212	1,838,052	993,751	4,031,311	9,403,326
순전입	2,090,900	1,315,779	265,696	2,461,978	6,134,353
사용	(2,035,240)	(532,481)	(458,731)	(1,603,945)	(4,630,397)
기타	138,629	172,551	12,295	105,756	429,231
기말	2,734,501	2,793,901	813,011	4,995,100	11,336,513

충당부채의 성격에 대한 기술	연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.	연결회사는 협상 진행중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.	연결회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.	연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.	

기타충당부채에 대한 기술

기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

무상할당배출권과 배출량 추정치에 대한 공시

	2024년(당기 이행연도)	2025년(잔여 계획기간)
무상할당 배출권(단위: 만톤(tCO2-eq))	1,795만톤	1,629만톤
배출량 추정치(단위: 만톤(tCO2-eq))	1,807만톤	

배출권 변동내역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	3,137
증가	0
사용	0
기말	3,137

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	19,567
증가	1,272
사용	(17,702)
기말	3,137

배출권 수량에 대한 공시

	공시금액
무상할당배출권 수량(단위: 만톤(tCO2-eq))	3,423만톤
담보로 제공된 배출권 수량(단위: 만톤(tCO2-eq))	0

배출부채 변동내역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	137
순전입(환입)	37
사용	0
기말	174

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	32,838
순전입(환입)	(15,210)
사용	(17,491)
기말	137

16. 우발부채와 약정사항 (연결)

법적소송우발부채에 대한 공시

	법적소송우발부채
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채	보고기간종료일 현재 연결회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다.
유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채	소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등에 따른 자원의 유출금액및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	무역금융, 상업어음할인 및 외상매출채권담보대출 등의 약정	무역금융 약정	외상매출채권담보대출, 일반대출 등의 약정	발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정
약정처	우리은행 외 27개 은행	신한은행 외 22개 은행	우리은행 외 12개 은행	
약정 금액	23,536,721	18,172,601	2,204,609	8,596,696
약정에 대한 설명	보고기간종료일 현재 연결회사는 우리은행 외 27개 은행과 무역금융, 상업어음할인 및 외상매출채권담보대출 등의 약정을 맺고 있으며 동 약정에 대한 통합한도액은 23,536,721백만원입니다.	연결회사는 신한은행 외 22개 은행과 한도액 18,172,601백만원의 무역금융 약정을 체결하고 있습니다.	우리은행 외 12개 은행과 한도액 2,204,609백만원의 외상매출채권담보대출, 일반대출 등의 약정을 맺고 있습니다.	보고기간종료일 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정액은 8,596,696백만원입니다.

17. 계약부채 (연결)

계약부채에 대한 공시

당기

(단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	13,523,368
기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익	1,314,325

전기

(단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	13,327,724
기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익	

계약부채에 대한 기술

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

18. 자본금 (연결)

주식의 분류에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식 합계

회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수(주)			25,000,000,000
주당 액면가액(원)			100
발행주식 액면 총액(백만원)	596,978	82,289	679,267
납입자본금(백만원)			897,514
자본금에 대한 설명			보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다. 보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주이며, 유통주식수는 자기주식 취득으로 인하여 발행주식의 총수와 차이가 있습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

각 종류별 주식에 부여된 권리, 우선권 및 제한사항			보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다.

주식에 대한 공시

당기

	보통주	우선주
기초 유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700
자기주식 취득주식수(주)	(29,700,000)	(4,050,000)
기말 유통주식수(주)	5,940,082,550	818,836,700

전기

	보통주	우선주
기초 유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700
자기주식 취득주식수(주)	0	0
기말 유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700

19. 연결이익잉여금 (연결)

이익잉여금에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		370,513,188
이익잉여금	임의적립금 등	224,424,501
	연결미처분이익잉여금	146,088,687

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		346,652,238
이익잉여금	임의적립금 등	208,198,003
	연결미처분이익잉여금	138,454,235

배당금에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	배당의 구분											
	분기배당									기말배당		
	1분기			2분기			3분기					
	주식		주식 합계	주식		주식 합계	주식		주식 합계	주식		주식 합계
	보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주	
배당기준일			2024-03-31			2024-06-30			2024-09-30			2024-12-31
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,940,082,550	818,836,700	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)			3.61			3.61			3.61			3.63
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)			3.61			3.61			3.61			3.64
지급된 배당금	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154			
지급될 배당금										2,156,250	298,057	2,454,307

전기 (단위 : 백만원)

	배당의 구분											
	분기배당									기말배당		
	1분기			2분기			3분기					
	주식		주식 합계	주식		주식 합계	주식		주식 합계	주식		주식 합계
	보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주	
배당기준일			2023-03-31			2023-06-30			2023-09-30			2023-12-31
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)			3.61			3.61			3.61			3.61
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)			3.61			3.61			3.61			3.62
지급된 배당금	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154			
지급될 배당금										2,155,092	297,884	2,452,976

20. 기타자본항목 (연결)

기타자본구성요소

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		15,873,008
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	2,155,315
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	424,575
	해외사업장환산외환차이	18,614,960
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	(3,596,943)
	자기주식	(1,811,775)
	기타	86,876

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		1,280,130
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	194,419
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	185,144
	해외사업장환산외환차이	3,651,112
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	(2,849,526)
	자기주식	0
	기타	98,981

자기주식에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 자기주식수(주)	29,700,000	4,050,000
자기주식 취득가액	1,625,252	186,523

전기 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 자기주식수(주)	0	0
자기주식 취득가액	0	0

21. 비용의 성격별 분류 (연결)

비용의 성격별 분류 공시

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
매출원가와 판매관리비 합계		268,144,942
매출원가와 판매관리비 합계	제품 및 재공품 등의 변동	571,892
	원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	93,861,545
	급여	32,877,167
	퇴직급여	1,571,338
	감가상각비	39,649,982
	무형자산상각비	2,980,840
	복리후생비	6,823,800
	유틸리티비	8,403,851
	외주용역비	7,822,607
	광고선전비	5,428,555
	판매촉진비	7,300,311
	기타 비용	60,853,054

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
매출원가와 판매관리비 합계		252,368,518
매출원가와 판매관리비 합계	제품 및 재공품 등의 변동	(644,905)
	원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	96,219,181
	급여	30,405,245

	퇴직급여	1,157,422
	감가상각비	35,532,411
	무형자산상각비	3,134,148
	복리후생비	6,472,979
	유틸리티비	7,502,408
	외주용역비	7,058,833
	광고선전비	5,213,896
	판매촉진비	6,894,395
	기타 비용	53,422,505

성격별 비용에 대한 기술

연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

22. 판매비와관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

			공시금액
판매비와관리비 합계			81,582,674
판매비와관리비 합계	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계		46,584,532
	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계	급여	8,647,408
		퇴직급여	453,164
		지급수수료	8,807,740
		감가상각비	1,689,079
		무형자산상각비	716,646
		광고선전비	5,428,555
		판매촉진비	7,300,311
		운반비	2,960,237
		서비스비	3,843,980
		기타판매비와관리비	6,737,412
	경상연구개발비-연구개발 총지출액		34,998,142

전기 (단위 : 백만원)

			공시금액
판매비와관리비 합계			71,979,938
판매비와관리비 합계	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계		43,640,214
	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계	급여	8,324,562
		퇴직급여	299,369
		지급수수료	8,753,442
		감가상각비	1,649,335
		무형자산상각비	688,786

		광고선전비	5,213,896
		판매촉진비	6,894,395
		운반비	1,721,614
		서비스비	3,968,816
		기타판매비와관리비	6,125,999
	경상연구개발비-연구개발 총지출액		28,339,724

23. 기타수익 및 기타비용 (연결)

기타수익 및 기타비용

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타수익		1,960,338
기타수익	배당금수익	134,952
	임대료수익	155,928
	유형자산처분이익	81,647
	기타	1,587,811
기타비용		1,625,229
기타비용	유형자산처분손실	124,018
	기부금	216,219
	기타	1,284,992

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타수익		1,180,448
기타수익	배당금수익	164,203
	임대료수익	150,273
	유형자산처분이익	104,663
	기타	761,309
기타비용		1,083,327
기타비용	유형자산처분손실	85,799
	기부금	243,377
	기타	754,151

24. 금융수익 및 금융비용 (연결)

금융수익 및 금융비용

당기 (단위 : 백만원)

			공시금액
금융수익 합계			16,703,304
금융수익 합계	이자수익(금융수익)		4,819,128
	이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는	4,818,923

		금융자산의 이자수익	
		당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이자수익	205
	외환차이		10,997,621
	파생상품관련이익		886,555
금융비용 합계			12,985,684
금융비용 합계	이자비용		903,918
	이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자비용	176,503
		기타 금융부채 이자비용	727,415
	외환차이		11,360,618
	파생상품관련손실		721,148

전기 (단위 : 백만원)

			공시금액
금융수익 합계			16,100,148
금융수익 합계	이자수익(금융수익)		4,358,022
	이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	4,357,792
		당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이자수익	230
	외환차이		10,608,661
	파생상품관련이익		1,133,465
금융비용 합계			12,645,530
금융비용 합계	이자비용		930,253
	이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자비용	510,865
		기타 금융부채 이자비용	419,388
	외환차이		10,711,058
	파생상품관련손실		1,004,219

금융수익 및 금융비용에 대한 기술

연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다
.

25. 법인세비용 (연결)

법인세비용(수익)의 주요 구성요소

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
당기법인세 소계		7,373,860
당기법인세 소계	기간손익에 대한 당기법인세	6,302,022
	글로벌최저한세	429,824
	당기에 인식한 조정사항	642,014
이연법인세 소계		(4,295,477)
이연법인세 소계	세액공제의 이월로 인한 이연법인세변동액	(5,228,946)
	일시적차이로 인한 이연법인세변동액	(196,702)
	이월결손금으로 인한 이연법인세 변동액	1,023,962
	기타변동액	106,209
법인세비용 계		3,078,383

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
당기법인세 소계		4,934,981
당기법인세 소계	기간손익에 대한 당기법인세	5,660,505
	글로벌최저한세	0
	당기에 인식한 조정사항	(725,524)
이연법인세 소계		(9,415,816)
이연법인세 소계	세액공제의 이월로 인한 이연법인세변동액	(5,346,657)
	일시적차이로 인한 이연법인세변동액	(3,061,001)
	이월결손금으로 인한 이연법인세 변동액	(1,041,996)
	기타변동액	33,838
법인세비용 계		(4,480,835)

회계이익에 적용세율을 곱하여 산출한 금액에 대한 조정

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
법인세비용차감전순이익	37,529,734
가중평균 적용세율에 따른 법인세비용	8,629,708
영구적차이에 의한 법인세효과	(220,405)
실현가능성이 없는 이연법인세 자산의 변동에 대한 법인세효과	(14,079)
세액공제 및 감면에 대한 법인세 효과	(6,566,360)
종속기업 손익 등에 대한 법인세 효과	759,731
세율변동효과	(12,943)
글로벌최저한세	429,824
기타	72,907
법인세비용 계	3,078,383

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
법인세비용차감전순이익	11,006,265
가중평균 적용세율에 따른 법인세비용	1,901,195
영구적차이에 의한 법인세효과	219,374
실현가능성이 없는 이연법인세 자산의 변동에 대한 법인세효과	(12,588)
세액공제 및 감면에 대한 법인세 효과	(6,706,820)
종속기업 손익 등에 대한 법인세 효과	(389,305)
세율변동효과	(3,926)
글로벌최저한세	0
기타	511,235
법인세비용 계	(4,480,835)

적용세율에 대한 기술

보고기간종료일 현재 연결회사의 이익에 대해서 과세관청별로 다르게 적용되는 법정세율을 가중평균하여 산정하였습니다.

일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제												일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 합계
	일시적차이								미사용 세무상 결손금	미사용 세액공제	자본에 직접 가감하는 이연법인세		
	토지재평가	종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	감가상각누계액 등	미수수익	충당부채 및 미지급비용 등	외화평가조정	손상차손누계액	기타			기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 등	순확정급여부채(자산) 재측정요소	
기초 이연법인세부채 (자산)	898,687	4,902,607	1,883,690	(67,722)	(7,142,616)	(172,903)	(235,745)	588,545	(1,318,354)	(8,093,087)	206,835	(1,041,185)	(9,591,248)
이연법인세부채(자산)의 증가(감소)	(1,998)	975,243	(741,224)	29,641	(249,150)	(72,746)	(839)	(135,629)	1,023,962	(5,228,946)	563,985	(279,288)	(4,116,989)
기말 이연법인세부채 (자산)	896,689	5,877,850	1,142,466	(38,081)	(7,391,766)	(245,649)	(236,584)	452,916	(294,392)	(13,322,033)	770,820	(1,320,473)	(13,708,237)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이에 대한 설명		종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이 중 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 경우 이연법인세 자산을 인식하지 않았습니다.											

전기 (단위 : 백만원)

	일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제												일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 합계
	일시적차이								미사용 세무상 결손금	미사용 세액공제	자본에 직접 가감하는 이연법인세		
	토지재평가	종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	감가상각누계액 등	미수수익	충당부채 및 미지급비용 등	외화평가조정	손상차손누계액	기타			기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 등	순확정급여부채(자산) 재측정요소	
기초 이연법인세부채 (자산)	898,505	4,960,247	2,566,535	(39,680)	(5,219,130)	(185,900)	(234,734)	969,702	(276,358)	(2,746,430)	50,392	(733,135)	10,014
이연법인세부채(자산)의 증가(감소)	182	(57,640)	(682,845)	(28,042)	(1,923,486)	12,997	(1,011)	(381,157)	(1,041,996)	(5,346,657)	156,443	(306,050)	(9,601,262)

기말 이연법인세부채(자산)	898,687	4,902,607	1,883,690	(67,722)	(7,142,616)	(172,903)	(235,745)	588,545	(1,318,354)	(8,093,087)	206,835	(1,041,185)	(9,591,248)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이에 대한 설명		종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적차이 중 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 경우 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.											

일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제에 대한 공시, 합계

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 이연법인세자산	10,211,797
이연법인세자산의 증가(감소)	4,024,671
기말 이연법인세자산	14,236,468
기초 이연법인세부채	620,549
이연법인세부채의 증가(감소)	(92,318)
기말 이연법인세부채	528,231

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 이연법인세자산	5,101,318
이연법인세자산의 증가(감소)	5,110,479
기말 이연법인세자산	10,211,797
기초 이연법인세부채	5,111,332
이연법인세부채의 증가(감소)	(4,490,783)
기말 이연법인세부채	620,549

이연법인세자산(부채)으로 인식하지 않은 차감(가산)할 일시적차이

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
이월결손금이월액	583,820
세액공제이월액	75,679

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
이월결손금이월액	597,176
세액공제이월액	118,694

이연법인세자산으로 인식되지 않은 미사용 세무상결손금과 세액공제의 소멸일

(단위 : 백만원)

	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과 3년 이내	3년초과
이월결손금이월액	82,248	5,675	5,675	490,222
세액공제이월액	3,088	1,115	54,628	16,848

이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제 시기

당기

(단위 : 백만원)

	12개월 이내에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	12개월 이후에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채
이연법인세자산	219,670	14,016,798
이연법인세부채		(528,231)

전기

(단위 : 백만원)

	12개월 이내에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	12개월 이후에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채
이연법인세자산	9,392,311	819,485
이연법인세부채		(620,549)

이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제 시기, 합계

당기

(단위 : 백만원)

	공시금액
이연법인세자산	14,236,468
이연법인세부채	528,231
이연법인세부채(자산)	(13,708,237)

전기

(단위 : 백만원)

	공시금액
이연법인세자산	10,211,797
이연법인세부채	620,549
이연법인세부채(자산)	(9,591,247)

글로벌 최저한세 도입 영향에 대한 기술

필라2 법률에 따라 연결회사는 각 구성기업이 속해 있는 관할국별 GloBE 유효세율과 최저한세율 15%의 차액에 대해 추가 세액을 납부해야 합니다. 베트남의 GloBE 유효세율이 15% 미만으로 현지에서 적격소재지국추가세액(QDMTT) 도입에 따라 필라2 법인세를 당기법인세비용으로 인식하고 있으며, 그외의 연결실체 내의 구성기업에 대해서는 필라2 규정에 따른 영향금액이 없거나 미미할 것으로 예상됩니다. 관련된 이연법인세자산(부채)의 인식 및 공시에 대해서는 예외규정을 적용하였습니다.

26. 주당이익 (연결)

주당이익

당기 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
지배회사지분 당기순이익	33,621,363	33,621,363
지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)	29,547,625	
가중평균유통보통주식수(주)	5,969,671,673	
기본 보통주 주당이익(원)	4,950	
지배기업의 우선주에 귀속되는 당기순이익(손실)		4,073,738
가중평균유통우선주식수(주)		822,871,378
기본 우선주 주당이익(원)		4,951

전기 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
지배회사지분 당기순이익	14,473,401	14,473,401
지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)	12,719,321	
가중평균유통보통주식수(주)	5,969,782,550	
기본 보통주 주당이익(원)	2,131	
지배기업의 우선주에 귀속되는 당기순이익(손실)		1,754,080
가중평균유통우선주식수(주)		822,886,700
기본 우선주 주당이익(원)		2,132

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당기 및 전기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

27. 현금흐름표 (연결)

현금흐름의 회계정책에 대한 기술

연결회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당기 및 전기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

영업활동현금흐름

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		42,947,079
조정내역 계	법인세비용 조정	3,078,383
	금융수익	(7,412,419)
	금융비용	3,879,286
	퇴직급여	1,571,338
	감가상각비	39,649,982
	무형자산상각비	2,980,840
	대손상각비	61,705
	배당금수익	(134,952)
	지분법이익	(751,044)
	유형자산처분이익	(81,647)
	유형자산처분손실	124,018
	재고자산평가손실환입	(527,092)
	재고자산평가손실	
	기타	508,681
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(1,567,557)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(2,496,105)
	미수금의 감소(증가)	(642,629)
	장단기선급비용의 감소(증가)	(369,269)
	재고자산의 감소(증가)	2,541,364
	매입채무의 증가(감소)	(2,573,560)
	장단기미지급금의 증가(감소)	1,035,043
	선수금의 증가(감소)	235,827
	예수금의 증가(감소)	65,954
	미지급비용의 증가(감소)	(156,596)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,503,956
	퇴직금의 지급	(1,697,139)
	사외적립자산의 감소(증가)	1,153,605
	기타	(168,008)

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		36,519,534
조정내역 계	법인세비용 조정	(4,480,835)
	금융수익	(6,156,093)
	금융비용	3,076,837
	퇴직급여	1,157,422
	감가상각비	35,532,411

	무형자산상각비	3,134,148
	대손상각비	62,964
	배당금수익	(164,203)
	지분법이익	(887,550)
	유형자산처분이익	(104,663)
	유형자산처분손실	85,799
	재고자산평가손실환입	
	재고자산평가손실	5,037,579
	기타	225,718
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(5,458,745)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(90,243)
	미수금의 감소(증가)	325,894
	장단기선급비용의 감소(증가)	(390,636)
	재고자산의 감소(증가)	(3,206,615)
	매입채무의 증가(감소)	318,432
	장단기미지급금의 증가(감소)	785,534
	선수금의 증가(감소)	138,188
	예수금의 증가(감소)	(411,028)
	미지급비용의 증가(감소)	(3,704,020)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,566,904
	퇴직금의 지급	(938,691)
	사외적립자산의 감소(증가)	100,384
	기타	47,152

현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요 투자활동과 재무활동 거래

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가	3,106,853
관계기업 및 공동기업 투자의 평가	233,746
유형자산의 본계정 대체	48,452,108
사용권자산의 취득(리스부채의 신규계약)	1,296,088
사채의 유동성 대체	2,207,290

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가	1,548,022
관계기업 및 공동기업 투자의 평가	75,112
유형자산의 본계정 대체	39,749,735
사용권자산의 취득(리스부채의 신규계약)	1,802,463

사채의 유동성 대체	1,308,875

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	단기차입금	사채 및 장기차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계
기초	7,114,601	5,571,343	12,685,944
재무현금흐름	5,871,346	(959,554)	4,911,792
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가	0	1,296,088	1,296,088
그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)	186,557	249,803	436,360
기말	13,172,504	6,157,680	19,330,184

전기 (단위 : 백만원)

	단기차입금	사채 및 장기차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계
기초	5,147,315	5,185,927	10,333,242
재무현금흐름	2,145,400	(864,867)	1,280,533
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가	0	1,497,058	1,497,058
그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)	(178,114)	(246,775)	(424,889)
기말	7,114,601	5,571,343	12,685,944

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)에 대한 기술

상각, 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

리스 현금유출

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	1,184,788
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	223,938

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	1,098,944
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	197,202

기업이 보유한 현금및현금성자산에 대한 경영진의 기술

연결회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기금융상품, 단기차입금등으로 인한 현금의 유입과 유출항목을 순증감액으로 작성하였습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결회사의 현금및현금성자산은 대부분 예금 등으로 구성되어 있습니다.

28. 재무위험관리 (연결)

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

	위험					위험 합계
	시장위험			신용위험	유동성위험	
	환위험	이자율위험	지분가격위험			
위험에 대한 노출정도에 대한 기술	연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.	이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다.	연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다.	신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.	유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 연결회사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다.	

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술	연결회사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 연결회사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 연결회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.	연결회사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.	연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.	신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제	연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다. 연결회사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별 회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다. 또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.	연결회사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다. 재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다. 한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다. 연결회사의 재무위험 관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

				약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.		

보고기간 말 현재 노출된 시장위험의 각 유형별 민감도 분석

당기 (단위 : 백만원)

	위험	
	시장위험	
	환위험	
	기능통화 또는 표시통화	
	USD	EUR
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향	기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향
시장변수 상승 시 당기손익 증가	365,273	88,649
시장변수 하락 시 당기손익 감소	365,273	88,649

전기 (단위 : 백만원)

	위험	
	시장위험	
	환위험	
	기능통화 또는 표시통화	
	USD	EUR
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향	기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향
시장변수 상승 시 당기손익 증가	418,776	151,740
시장변수 하락 시 당기손익 감소	418,776	151,740

보고기간 말 현재 노출된 이자율위험의 민감도 분석

당기 (단위 : 백만원)

	위험	위험 합계
	시장위험	

	이자율위험		
	자산과 부채		
	금융자산	금융부채	
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	변동금리부 금융자산 및 금융부채에 대하여 이자율이 1%p 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향	변동금리부 금융자산 및 금융부채에 대하여 이자율이 1%p 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향	
시장변수 상승 시 당기손익 증가	141,671		135,969
시장변수 상승 시 당기손익 감소	141,671		135,969
시장변수 하락 시 당기손익 증가		5,702	
시장변수 하락 시 당기손익 감소		5,702	

전기 (단위 : 백만원)

	위험		위험 합계
	시장위험		
	이자율위험		
	자산과 부채		
	금융자산	금융부채	
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	변동금리부 금융자산 및 금융부채에 대하여 이자율이 1%p 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향	변동금리부 금융자산 및 금융부채에 대하여 이자율이 1%p 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향	
시장변수 상승 시 당기손익 증가	210,617		204,420
시장변수 상승 시 당기손익 감소	210,617		204,420
시장변수 하락 시 당기손익 증가		6,197	
시장변수 하락 시 당기손익 감소		6,197	

보고기간 말 현재 노출된 주가변동의 각 유형별 민감도 분석

당기 (단위 : 백만원)

	위험
	시장위험

	지분가격위험
	금융자산, 분류
	기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향
시장변수 상승 시 당기손익 증가	76,865
시장변수 상승 시 기타포괄손익 증가	862

전기 (단위 : 백만원)

	위험
	시장위험
	지분가격위험
	금융자산, 분류
	기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향
시장변수 상승 시 당기손익 증가	52,510
시장변수 상승 시 기타포괄손익 증가	3,472

금융부채의 만기분석에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과	합계 구간 합계
금융부채	55,955,211	1,369,038	1,890,467	7,659,645	1,993,483	
종속기업 지급보증 및 이행보증 등으로 노출된 유동성위험의 최대금액	36,795					
금융부채의 만기분석 금액에 대한 설명						위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과	합계 구간 합계

금융부채	43,302,421	589,743	1,529,785	7,811,246	2,337,792	
종속기업 지급보증 및 이행보증 등으로 노출된 유동성위험의 최대금액	44,252					
금융부채의 만기분석 금액에 대한 설명						위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

회사가 금융기관과 체결한 공급자금융약정에 대한 기술

연결회사가 금융기관과 체결한 공급자금융약정에 근거하여, 연결회사에 재화 및 용역을 공급한 업체가 대금 지급기한 내에 매출채권을 금융기관에 양도할 경우, 연결회사는 그 대금을 금융기관에 지급합니다. 이 약정은 대금 지급과정을 효율화하고, 공급자에게 조기 결제 조건을 제공하기 위한 목적이며, 원채무의 책임이 면제되거나 대금지급 조건에 실질적인 변경이 없으므로 매입채무 또는 미지급금으로 인식된 원채무는 제거하지 않습니다.

위험회피수단에 대한 세부 정보 공시

당기 (단위 : 백만원)

	위험회피
	현금흐름위험회피
	파생상품 계약 유형
	통화 관련
	파생상품 유형
	선도계약
	장부금액
	총장부금액
비유동파생상품자산	13,944
유동 파생상품 금융자산	30,318
파생상품 금융자산	44,262
비유동 파생상품 금융부채	27,612
유동 파생상품 금융부채	30,152
파생상품 금융부채	57,764

위험회피수단이 포함된 재무상태표 항목에 대한 기술	연결회사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	위험회피
	현금흐름위험회피
	파생상품 계약 유형
	통화 관련
	파생상품 유형
	선도계약
	장부금액
	총장부금액
비유동파생상품자산	19,853
유동 파생상품 금융자산	50,018
파생상품 금융자산	69,871
비유동 파생상품 금융부채	18,099
유동 파생상품 금융부채	15,031
파생상품 금융부채	33,130
위험회피수단이 포함된 재무상태표 항목에 대한 기술	연결회사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다.

위험회피회계처리의 결과로 포괄손익계산서에 영향을 미친 금액에 대한 정보의 공시

당기 (단위 : 백만원)

	현금흐름위험회피
기타포괄손익으로 인식하는 위험회피에 효과적인 부분의 세후 평가손익	(38,946)
당기손익으로 인식하는 위험회피에 비효과적인 부분의 세전 평가손익	1,063
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	6,642
재고자산으로 재분류되는 세후기타포괄손익	35,333

전기 (단위 : 백만원)

	현금흐름위험회피
기타포괄손익으로 인식하는 위험회피에 효과적인 부분의 세후 평가손익	927
당기손익으로 인식하는 위험회피에 비효과적인 부분의 세전 평가손익	1,304
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	6,692
재고자산으로 재분류되는 세후기타포괄손익	51,614

부채비율에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
부채	112,339,878
자본	402,192,070
부채비율	0.279
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
부채	92,228,115
자본	363,677,865
부채비율	0.254
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

금융상품의 장부금액에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

			공시금액
금융자산 합계			182,930,424
금융자산 합계	현금및현금성자산		53,705,579
	단기금융상품		58,909,334
	단기상각후원가금융자산		0
	단기당기손익-공정가치금융자산		36,877
	매출채권		43,623,073
	기타포괄손익-공정가치금융자산		10,580,932
	당기손익-공정가치금융자산		1,175,749
	기타금융자산		14,898,880
금융부채 합계			67,663,407
금융부채 합계	매입채무		12,370,177
	단기차입금		13,172,504
	미지급금		17,390,861

	유동성장기부채		2,207,290
	유동성장기부채	유동성장기차입금	1,611,282
		유동성사채	596,008
	사채		14,530
	장기차입금		3,935,860
	장기미지급금		4,779,141
	기타금융부채		13,793,044

전기 (단위 : 백만원)

			공시금액
금융자산 합계			152,807,569
금융자산 합계	현금및현금성자산		69,080,893
	단기금융상품		22,690,924
	단기상각후원가금융자산		608,281
	단기당기손익-공정가치금융자산		27,112
	매출채권		36,647,393
	기타포괄손익-공정가치금융자산		7,481,297
	당기손익-공정가치금융자산		1,431,394
	기타금융자산		14,840,275
금융부채 합계			54,324,046
금융부채 합계	매입채무		11,319,824
	단기차입금		7,114,601
	미지급금		13,996,395
	유동성장기부채		1,308,875
	유동성장기부채	유동성장기차입금	1,302,521
		유동성사채	6,354
	사채		537,618
	장기차입금		3,724,850
	장기미지급금		4,907,875
	기타금융부채		11,414,008

금융상품의 공정가치에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

		공정가치
단기당기손익-공정가치금융자산		10,580,932
기타포괄손익-공정가치금융자산		36,877
당기손익-공정가치금융자산		1,175,749
기타금융자산		520,656
유동성장기부채		594,010

유동성장기부채	유동성사채	594,010
사채		16,427
기타금융부채		94,559
기타금융자산 금액 중 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금액		14,378,224
기타금융부채 금액 중 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금액		13,698,485

전기 (단위 : 백만원)

		공정가치
단기당기손익-공정가치금융자산		7,481,297
기타포괄손익-공정가치금융자산		27,112
당기손익-공정가치금융자산		1,431,394
기타금융자산		546,021
유동성장기부채		6,757
유동성장기부채	유동성사채	6,757
사채		529,254
기타금융부채		83,463
기타금융자산 금액 중 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금액		14,294,254
기타금융부채 금액 중 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금액		11,330,545

금융상품의 공정가치에 대한 공시 표상 일부 금융상품에 대하여 공정가치 공시를 제외한 사유

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

금융상품의 공정가치에 대한 공시 표상 기타금융자산 및 기타금융부채 금액에 대한 기술

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 14,378,224백만원(전기말: 14,294,254백만원)
및 금융부채 13,698,485백만원(전기말: 11,330,545백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

금융상품의 공정가치에 대한 공시 표상 유동성장기차입금, 장기차입금에 대하여 리스부채를 공정가치 공시대상에서 제외한 사유

리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	측정 전체
	공정가치
	자산

	단기당기손익-공정가치금융자산				공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산				당기손익-공정가치금융자산				기타금융자산			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계
	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계
자산	0	36,877	0	36,877	7,686,545	0	2,894,387	10,580,932	86,187	0	1,089,562	1,175,749	0	98,159	422,497	520,656

전기

(단위 : 백만원)

	측정 전체															
	공정가치															
	자산															
	단기당기손익-공정가치금융자산				공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산				당기손익-공정가치금융자산				기타금융자산			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계
	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계
자산	0	27,112	0	27,112	5,250,993	0	2,230,304	7,481,297	347,221	0	1,084,173	1,431,394	0	130,364	415,657	546,021

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당기

(단위 : 백만원)

	측정 전체											
	공정가치											
	부채											
	유동성사채				사채				기타금융부채			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계
	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계
부채	0	594,010	0	594,010	0	16,427	0	16,427	0	94,559	0	94,559

전기

(단위 : 백만원)

	측정 전체											
	공정가치											
	부채											
	유동성사채				사채				기타금융부채			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계
	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계
부채	0	6,757	0	6,757	0	529,254	0	529,254	0	83,463	0	83,463

금융상품의 공정가치측정에 대한 공시

	수준 1	수준 2	수준 3
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	동일한 자산에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채	동일한 부채에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

평가기법 및 투입변수에 대한 기술

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다. 연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. 연결회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

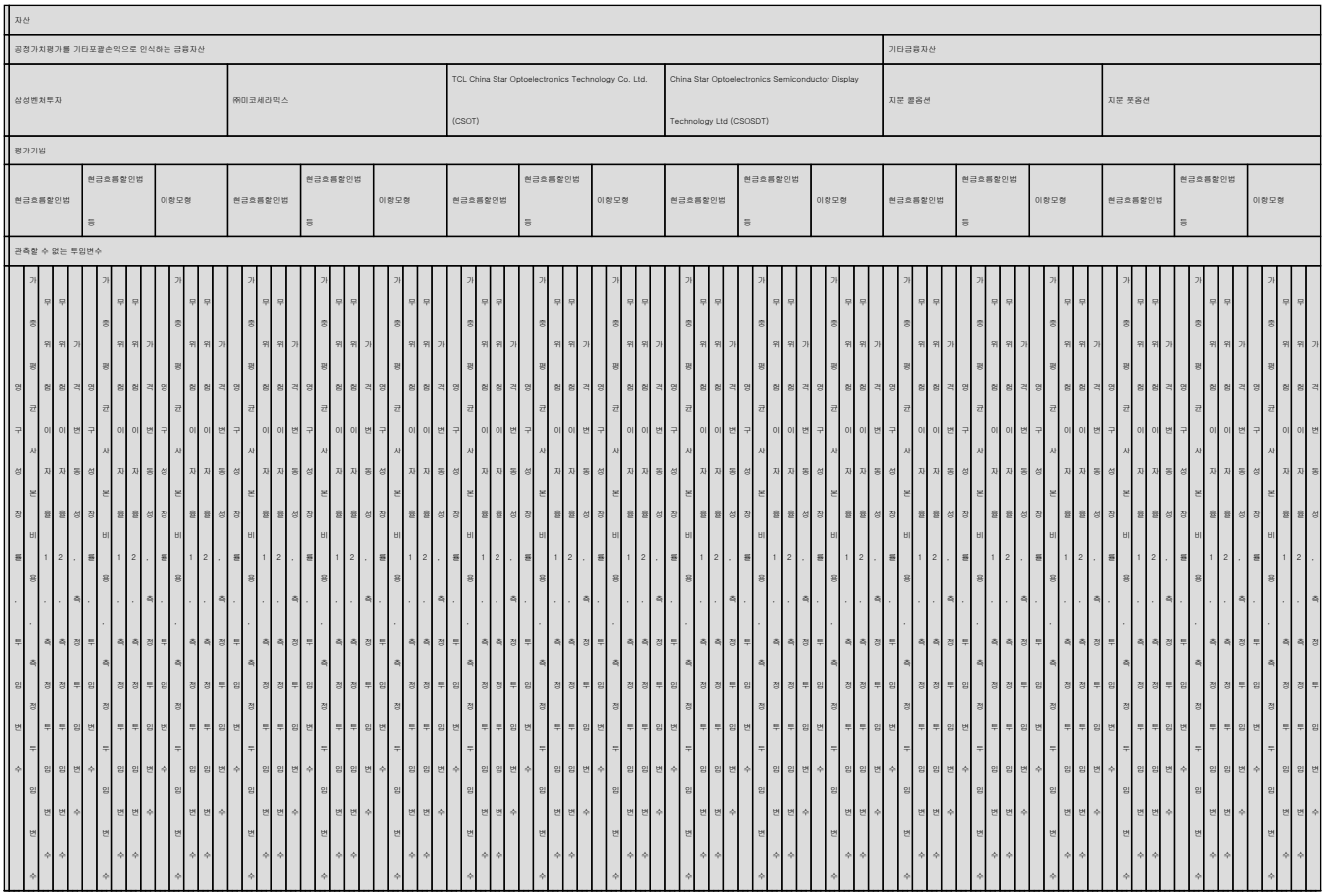
자산의 가치평가기법 및 투입변수에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	측정 전체					
	공정가치					
	자산					
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산				기타금융자산	
	삼성벤처투자	㈜미코세라믹스	TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	지분 콜옵션	지분 풋옵션
	공정가치 서열체계의 모든 수준					
	공정가치 서열체계 수준 3					
자산	36,253	49,794	1,518,963	314,942	373,681	48,816
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산	현금흐름할인법	현금흐름할인법 등	현금흐름할인법	현금흐름할인법	이항모형	이항모형
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	영구성장률, 가중평균자본비용	영구성장률, 가중평균자본비용	영구성장률, 가중평균자본비용	영구성장률, 가중평균자본비용	무위험 이자율, 가격변동성	무위험 이자율, 가격변동성

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

측정 전체
공정가치



자산의 공정가치측정에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 모든 수준
	수준 3
	자산
	금융자산, 범주
기초금융자산	3,730,134
매입	250,695
매도	(133,546)
당기손익으로 인식된 손익	23,415
기타포괄손익으로 인식된 손익	322,885
기타	212,863
기말금융자산	4,406,446

전기 (단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 모든 수준
	수준 3
	자산
	금융자산, 범주
기초금융자산	3,303,227

매입	207,023
매도	(124,477)
당기손익으로 인식된 손익	297,680
기타포괄손익으로 인식된 손익	46,725
기타	(44)
기말금융자산	3,730,134

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 모든 수준
	공정가치 서열체계 수준 3
	부채
	금융부채, 범주
기초금융부채	0
당기손익으로 인식된 손익	0
기타	0
기말금융부채	0

전기 (단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 모든 수준
	공정가치 서열체계 수준 3
	부채
	금융부채, 범주
기초금융부채	7,404
당기손익으로 인식된 손익	619
기타	(8,023)
기말금융부채	0

관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정의 민감도분석 공시, 자산

(단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 모든 수준									
	공정가치 서열체계 수준 3									
	자산									
	기타포괄손익-공정가치금융자산					기타				
	관측할 수 없는 투입변수				관측할 수 없는 투입변수 합계	관측할 수 없는 투입변수				관측할 수 없는 투입변수 합계
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	기초 자산 가격, 측정 투입변수	가격 변동성		영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	기초 자산 가격, 측정 투입변수	가격 변동성	
관측가능하지 않은 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정치의 민감도에 대한 기술, 자산	주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률 및 가중평균자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치	주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률 및 가중평균자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치						주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였	주요 관측불가능한 투입변수인 가격 변동성(10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습	

	변동을 산출하였습니다.	변동을 산출하였습니다.						습니다.	니다.	
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산	0.01	0.01						0.20	0.10	
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산	0.01	0.01						0.20	0.10	
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산					0					144,566
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산					0					(131,073)
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산					207,262					0
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산					(134,940)					0

29. 부문별 보고 (연결)

보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.
매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문 사이의 거래에 대한 회계처리 방법에 대한 기술

당기와 전기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	기업 전체 총계					
	영업부문				내부거래 조정 등	기업 전체 총계 합계
	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman		
매출액	174,887,683	111,065,950	29,157,820	14,274,930	(28,515,480)	300,870,903
감가상각비	2,576,351	34,097,568	2,432,338	342,627	0	39,649,982
무형자산상각비	1,634,046	674,945	233,604	207,607	0	2,980,840
영업이익	12,439,897	15,094,486	3,733,429	1,307,580	0	32,725,961
보고부문에 대한 기술						기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	기업 전체 총계					
	영업부문				내부거래 조정 등	기업 전체 총계 합계
	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman		
매출액	169,992,337	66,594,471	30,975,373	14,388,454	(23,015,141)	258,935,494
감가상각비	2,524,199	29,371,056	3,108,935	327,572	0	35,532,411
무형자산상각비	1,721,938	754,901	222,045	200,896	0	3,134,148
영업이익	14,384,705	(14,879,458)	5,566,478	1,173,702	0	6,566,976
보고부문에 대한 기술						기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

제품과 용역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	TV, 모니터 등	스마트폰 등	메모리	디스플레이 패널	제품과 용역 합계
매출액	30,931,628	114,424,862	84,463,005	29,157,820	300,870,903
주요 제품별 매출액에 대한 기술					기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	TV, 모니터 등	스마트폰 등	메모리	디스플레이 패널	제품과 용역 합계

매출액	30,375,193	108,632,515	44,125,386	30,975,373	258,935,494
주요 제품별 매출액에 대한 기술					기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

지역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	지역						
	본사 소재지 국가	외국				연결실체 내 내부거래조정	지역 합계
		미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국		
순매출액	39,826,088	118,828,546	50,118,754	48,171,377	43,926,138	0	300,870,903
비유동자산	177,190,869	28,361,758	6,736,899	9,681,791	10,007,583	(2,295,125)	229,683,775
지역에 대한 공시 표 비유동자산에 대한 기술							금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	지역						
	본사 소재지 국가	외국				연결실체 내 내부거래조정	지역 합계
		미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국		
순매출액	45,599,419	92,136,669	48,108,965	44,814,355	28,276,086	0	258,935,494
비유동자산	163,312,301	20,346,775	6,288,864	8,737,541	12,191,879	(879,236)	209,998,124
지역에 대한 공시 표 비유동자산에 대한 기술							금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

30. 특수관계자와의 거래 (연결)

특수관계자거래에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자									
	특수관계자									
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공동기업	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관계자	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사
매출 등, 특수관계자거래	104,837	46,773	107,474	35,535	1,167,252	23,472	757,640	2,464	12,320	247,997
비유동자산 처분, 특수관계자거래	21,504	0	0	0	122	0	0	0	0	0
매입 등, 특수관계자거래	2,130,399	1,196,979	664,368	1,004,792	12,656,359	262,652	1,395,795	72,000	541,532	562,134
비유동자산 매입, 특수관계자거래	286,135	0	20,514	19,193	198,411	6,797,619	4,124,354	4,305,202	43,906	1,174,427
특수관계자거래에 대한 기술	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자									
	특수관계자									
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공동기업	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관계자	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사
매출 등, 특수관계자거래	202,810	69,782	110,025	38,930	1,023,702	49,366	582,978	1,358	9,720	239,223
비유동자산 처분, 특수관계자거래	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
매입 등, 특수관계자거래	1,984,263	1,113,058	754,792	948,677	12,540,601	270,079	1,675,564	35,482	527,232	1,251,775
비유동자산 매입, 특수관계자거래	291,120	60	31,750	4,900	168,977	6,149,229	4,686,787	2,837,309	40,327	612,481
특수관계자거래에 대한 기술	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

특수관계자거래에 대한 공시, 합계

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	1,461,871	781,112	262,781
비유동자산 처분, 특수관계자거래	21,626	0	0
매입 등, 특수관계자거래	17,652,897	1,658,447	1,175,666
비유동자산 매입, 특수관계자거래	524,253	10,921,973	5,523,535

특수관계자거래에 대한 기술	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	1,445,249	632,344	250,301
비유동자산 처분, 특수관계자거래	0	70	0
매입 등, 특수관계자거래	17,341,391	1,945,643	1,814,489
비유동자산 매입, 특수관계자거래	496,807	10,836,016	3,490,117
특수관계자거래에 대한 기술	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자									
	특수관계자									
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공동기업	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관계자	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사
채권 등, 특수관계자거래	23,493	5,704	123,940	206	311,560	205,420	19,784	513	2,660	16,848
채무 등, 특수관계자거래	617,140	113,971	50,278	436,315	1,380,625	1,868,959	743,167	1,919,798	66,988	626,382

특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자									
	특수관계자									
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공동기업	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관계자	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사
채권 등, 특수관계자거래	84,747	1,894	117,690	137	310,708	213,538	23,155	305	1,289	16,096
채무 등, 특수관계자거래	458,723	138,405	92,854	440,414	1,268,131	1,955,976	318,355	807,098	49,955	390,073
특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

특수관계자에 대한 채권 채무에 대한 공시, 합계

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	464,903	225,204	20,021
채무 등, 특수관계자거래	2,598,329	2,612,126	2,613,168

특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	515,176	236,693	17,690
채무 등, 특수관계자거래	2,398,527	2,274,331	1,247,126
특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

특수관계자 자금거래에 관한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	관계기업 및 공동기업	대규모기업집단
현금출자, 출자금 납입	11,710	
현금출자, 출자금 회수	33,178	
지급결의한 배당금, 특수관계자거래		128,232

전기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	관계기업 및 공동기업	대규모기업집단
현금출자, 출자금 납입	78,690	
현금출자, 출자금 회수	33,457	
지급결의한 배당금, 특수관계자거래		128,232

특수관계자 자금거래에 관한 공시_2

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자
지급결의한 배당금, 특수관계자거래	1,610,832
배당과 관련한 미지급금에 대한 기술	배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.
리스 이용 계약, 특수관계자거래	31,076
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	41,800

전기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자
지급결의한 배당금, 특수관계자거래	1,650,995
배당과 관련한 미지급금에 대한 기술	배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.
리스 이용 계약, 특수관계자거래	3,791
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	25,443

주요 경영진(등기임원)에 대한 보상에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	9,991
퇴직급여	600
기타 장기급여	8,078

전기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	14,073
퇴직급여	557
기타 장기급여	7,834

31. 비지배지분 (연결)

보고기간종료일 현재 종속기업에 대한 비지배지분이 연결회사에게 중요한 종속기업의 정보는 다음과 같습니다.

가. 비지배지분이 보유한 소유지분율 및 누적 비지배지분의 변동

(단위 : %, 백만원)

구 분	삼성디스플레이㈜와 그 종속기업	
	당기	전기
비지배지분율	15.2%	15.2%
기초	9,727,674	8,853,712
당기순이익	779,506	941,786
배당금	(1,022,540)	(43,646)
기타	345,013	(24,178)
기말	9,829,653	9,727,674

나. 종속기업의 요약 재무정보(내부거래 제거 전)

(1) 요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	삼성디스플레이㈜와 그 종속기업	
	당기말	전기말
유동자산	22,421,643	24,721,411
비유동자산	50,635,008	46,413,723
유동부채	6,667,092	5,821,885
비유동부채	1,501,348	1,485,250
자본	64,888,211	63,827,999
- 지배기업 소유주지분	64,849,566	63,769,776
- 비지배지분	38,645	58,223

(2) 요약 연결포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	삼성디스플레이㈜와 그 종속기업	
	당기	전기

매출	29,135,660	30,950,579
당기순이익	5,087,437	6,331,238
기타포괄손익	2,652,443	(108,689)
총포괄손익	7,739,880	6,222,549
- 지배기업 소유주지분	7,730,156	6,217,248
- 비지배지분	9,724	5,301

(3) 요약 연결현금흐름표

(단위 : 백만원)

구 분	삼성디스플레이㈜와 그 종속기업	
	당기	전기
영업활동 현금흐름	6,570,627	9,244,331
투자활동 현금흐름	(5,907,733)	(3,931,091)
재무활동 현금흐름	(5,975,290)	(277,515)
매각예정분류	-	(14,153)
외화환산으로 인한 현금의 변동	183,925	(1,534)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,128,471)	5,020,038
기초의 현금및현금성자산	7,329,248	2,309,210
기말의 현금및현금성자산	2,200,777	7,329,248

32. 매각예정분류(처분자산집단) (연결)

처분자산집단에 대한 공시

전기

	매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단
처분 또는 재분류된 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단에 대한 기술	전기 중 연결회사의 경영진은 ㈜도우인시스 지분 56.8%를 ㈜뉴파워프라즈마 등 3개사에게 매각하기로 결정하였습니다. 2023년 12월 7일 계약이 체결되었으며, 2024년 1월 31일 매각이 완료되었습니다.
매각지분율	0.568
매각계약체결일자	2023-12-07
매각완료일자	2024-01-31

매각예정으로 분류한 자산 및 부채에 대한 공시

전기 (단위 : 백만원)

		매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단

매각예정분류자산		217,864
매각예정분류자산	현금및현금성자산	14,153
	매출채권	1,316
	유동재고자산	4,697
	기타유동자산	13,134
	유형자산 및 무형자산	181,251
	기타비유동자산	3,313
매각예정분류부채		61,654
매각예정분류부채	유동부채	27,608
	비유동부채	34,046

매각예정으로 분류한 기타자본항목에 대한 공시

전기 (단위 : 백만원)

	자본
	기타자본구성요소
	매각예정으로 분류된 비유동자산 또는 처분자산 집단과 관련하여 기타포괄손익으로 인식되어 자본에 누적된 금액
해외사업장환산외환차이	(217)

33. 보고기간 후 사건 (연결)

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

	수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건		수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건 합계
	주요한 보통주 거래		
	주식		
	보통주	우선주	
수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술	지배회사는 2024년 11월 15일 이사회 결의에 의거하여 자기주식을 매입 중이며, 보고기간일 이후 총 2,330만주(보통주 2,044만주, 우선주 286만주)를 취득하였습니다.	지배회사는 2024년 11월 15일 이사회 결의에 의거하여 자기주식을 매입 중이며, 보고기간일 이후 총 2,330만주(보통주 2,044만주, 우선주 286만주)를 취득하였습니다.	
자기주식 매입에 대한 이사회결의일	2024-11-15	2024-11-15	2024-11-15

보고기간일 이후 감사보고서일까지 취득한 자기주식수(만주)	2,044	286	2,330

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 56 기 2024.12.31 현재

제 55 기 2023.12.31 현재

제 54 기 2022.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 56 기	제 55 기	제 54 기
자산			
유동자산	82,320,322	68,548,442	59,062,658
현금및현금성자산 (주4,28)	1,653,766	6,061,451	3,921,593
단기금융상품 (주4,28)	10,187,991	50,071	137
매출채권 (주4,5,7,28)	33,840,357	27,363,016	20,503,223
미수금 (주4,7,28)	3,249,731	1,910,054	2,925,006
선급비용	1,381,781	1,349,755	1,047,900
재고자산 (주8)	29,154,115	29,338,151	27,990,007
기타유동자산 (주4,28)	2,852,581	2,475,944	2,674,792
비유동자산	242,645,805	228,308,847	201,021,092
기타포괄손익-공정가치금융자산 (주4,6,28)	2,176,346	1,854,503	1,364,325
당기손익-공정가치금융자산 (주4,6,28)	0	1	283
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 (주9)	57,427,196	57,392,438	57,397,249
유형자산 (주10)	151,446,870	140,579,161	123,266,986
무형자산 (주11)	10,496,956	10,440,211	8,561,424
순확정급여자산 (주14)	2,249,792	3,745,697	4,410,223
이연법인세자산 (주25)	14,333,432	9,931,358	2,142,512
기타비유동자산 (주4,7,28)	4,515,213	4,365,478	3,878,090
자산총계	324,966,127	296,857,289	260,083,750
부채			
유동부채	80,157,976	41,775,101	46,086,047
매입채무 (주4,28)	10,287,967	7,943,834	8,729,315
단기차입금 (주4,5,12,28)	11,110,972	5,625,163	2,381,512
미지급금 (주4,28)	18,591,524	15,256,046	18,554,543
선수금 (주17)	350,448	302,589	320,689
예수금 (주4,28)	516,454	445,470	523,354
미지급비용 (주4,17,28)	9,039,886	6,931,991	8,359,296

당기법인세부채	1,380,469	0	2,533,481
유동성장기부채 (주4,12,13,28)	22,264,226	228,491	135,753
충당부채 (주15)	6,257,389	4,540,702	4,059,491
기타유동부채 (주17)	358,641	500,815	488,613
비유동부채	8,411,494	30,294,414	4,581,512
사채 (주4,13,28)	14,530	19,064	24,912
장기차입금 (주4,13,28)	795,703	22,902,035	654,979
장기미지급금 (주4,28)	4,965,481	4,942,826	2,439,232
장기충당부채 (주15)	2,602,575	2,413,133	1,423,165
기타비유동부채	33,205	17,356	39,224
부채총계	88,569,470	72,069,515	50,667,559
자본			
자본금 (주18)	897,514	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주19)	233,734,316	219,963,351	204,388,016
기타자본항목 (주20)	(2,639,066)	(476,984)	(273,232)
자본총계	236,396,657	224,787,774	209,416,191
부채와자본총계	324,966,127	296,857,289	260,083,750

4-2. 손익계산서

손익계산서

제 56 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 56 기	제 55 기	제 54 기
매출액 (주29)	209,052,241	170,374,090	211,867,483
매출원가 (주21)	152,061,472	144,023,552	152,589,393
매출총이익	56,990,769	26,350,538	59,278,090
판매비와관리비 (주21,22)	44,629,735	37,876,835	33,958,761
영업이익(손실) (주29)	12,361,034	(11,526,297)	25,319,329
기타수익 (주23)	10,351,185	29,643,315	4,576,378
기타비용 (주23)	540,542	375,723	296,344
금융수익 (주24)	7,717,689	7,388,664	9,734,299
금융비용 (주24)	8,139,788	7,598,459	9,641,742
법인세비용차감전순이익	21,749,578	17,531,500	29,691,920

법인세비용(수익) (주25)	(1,832,987)	(7,865,599)	4,273,142
당기순이익	23,582,565	25,397,099	25,418,778
주당이익 (주26)			
기본주당이익 (단위 : 원)	3,472	3,739	3,742
희석주당이익 (단위 : 원)	3,472	3,739	3,742

4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 56 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 56 기	제 55 기	제 54 기
당기순이익	23,582,565	25,397,099	25,418,778
기타포괄손익	(352,470)	(216,079)	613,118
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(352,470)	(216,079)	613,118
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)	239,784	356,472	(208,883)
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)	(592,254)	(572,551)	822,001
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0
총포괄손익	23,230,095	25,181,020	26,031,896

4-4. 자본변동표

자본변동표

제 56 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본				
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2022.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	188,774,335	(882,010)	193,193,732
당기순이익	0	0	25,418,778	0	25,418,778
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)	0	0	4,340	(213,223)	(208,883)
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)	0	0	0	822,001	822,001
배당 (주19)	0	0	(9,809,437)	0	(9,809,437)
자기주식의 취득 (주20)					0
2022.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	204,388,016	(273,232)	209,416,191
2023.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	204,388,016	(273,232)	209,416,191

당기순이익	0	0	25,397,099	0	25,397,099
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)	0	0	(12,327)	368,799	356,472
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)	0	0	0	(572,551)	(572,551)
배당 (주19)	0	0	(9,809,437)	0	(9,809,437)
자기주식의 취득 (주20)	0	0	0	0	0
2023.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	219,963,351	(476,984)	224,787,774
2024.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	219,963,351	(476,984)	224,787,774
당기순이익	0	0	23,582,565	0	23,582,565
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,20)	0	0	(2,163)	241,947	239,784
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주14,20)	0	0	0	(592,254)	(592,254)
배당 (주19)	0	0	(9,809,437)	0	(9,809,437)
자기주식의 취득 (주20)	0	0	0	(1,811,775)	(1,811,775)
2024.12.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	233,734,316	(2,639,066)	236,396,657

4-5. 현금흐름표

현금흐름표

제 56 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 55 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 54 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 56 기	제 55 기	제 54 기
영업활동현금흐름	52,491,497	34,455,084	44,788,749
영업에서 창출된 현금흐름	44,315,608	8,088,628	49,589,897
당기순이익	23,582,565	25,397,099	25,418,778
조정 (주27)	21,493,129	(4,092,924)	31,039,388
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주27)	(760,086)	(13,215,547)	(6,868,269)
이자의 수취	277,362	332,111	339,560
이자의 지급	(674,010)	(798,649)	(287,488)
배당금 수입	9,635,502	29,497,803	3,551,435
법인세 납부액	(1,062,965)	(2,664,809)	(8,404,655)
투자활동현금흐름	(50,377,644)	(47,571,537)	(28,123,886)
단기금융상품의 순감소(증가)	(10,122,673)	(49,934)	15,000,439
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	2,942	15,538	10,976
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(15,515)	0
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1	243	1,744
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	319,965	144,292	165,089
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(336,648)	(108,300)	(1,001,723)
유형자산의 처분	130,956	164,415	288,684
유형자산의 취득	(38,246,765)	(45,026,206)	(39,160,176)

무형자산의 처분	13,327	12,002	6,242
무형자산의 취득	(2,069,083)	(2,639,614)	(3,298,378)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(69,666)	(68,458)	(136,783)
재무활동현금흐름	(6,520,814)	15,268,902	(16,665,064)
단기차입금의 순증가(감소) (주27)	5,316,919	3,274,337	(6,700,826)
장기차입금의 차입 (주27)	0	21,990,000	0
사채 및 장기차입금의 상환 (주27)	(217,305)	(185,316)	(155,264)
배당금의 지급	(9,808,653)	(9,810,119)	(9,808,974)
자기주식의 취득	(1,811,775)	0	0
외화환산으로 인한 현금의 변동	(724)	(12,591)	2,922
현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,407,685)	2,139,858	2,721
기초현금및현금성자산	6,061,451	3,921,593	3,918,872
기말현금및현금성자산	1,653,766	6,061,451	3,921,593

5. 재무제표 주석

1. 일반적 사항

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 DX 부문, DS 부문으로 구성되어있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 네트워크시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry,
System LSI 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침

다음은 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

2.2 회계정책과 공시의 변경

가. 회사가 채택한 제・개정 기준서

회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

동 개정사항은 부채의 유동 및 비유동 분류에 영향을 미치며, 이는 보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되도록 요구합니다. 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

동 개정사항은 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다.
리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를
산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정

동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표 이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정의 주요 조건, 잔액, 결제기간 및 관련된 현금흐름 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제・개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 회사가 조기 적용하지 않은 주요 제・개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정

동 개정사항은 외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고와 해외사업장의 기능통화를 지배기업의 표시통화로 환산하는 규정을 명확히 하기 위해, 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다.

2.3 종속기업, 관계기업 및 공동기업

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 별도재무제표에서 종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 투자를 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따라 원가법으로 처리하고 있습니다. 또한 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 객관적인 손상의 징후가 있는 경우, 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 회수가능액과 장부금액과의 차이는 손상차손으로 인식됩니다.

2.4 외화환산

가. 기능통화와 표시통화

회사는 재무제표에 포함되는 항목들을 회사의 영업활동이 이루어지는 주된 경제 환경에서의 통화("기능통화")인 대한민국 원화(KRW)를 적용하여 측정하고 있으며, 재무제표는 대한민국 원화(KRW)로 표시되어 있습니다.

2.5 현금및현금성자산

현금및현금성자산은 보유중인 현금, 요구불예금 및 취득일 현재 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고, 가치변동의 위험이 경미한 매우 유동적인 단기투자자산으로 구성되어 있습니다.

2.6 금융자산

가. 분류

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다. 계약상 현금흐름이 원금과 이자에 대한 지급만으로 이루어져 있는지를 평가할 때, 회사는 해당 상품의 계약조건을 고려합니다.

나. 손상

회사는 미래 전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 단, 매출채권에 대해 회사는 채권의 최초 인식 시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

2.7 매출채권

매출채권은 유의적인 금융요소를 포함하는 경우를 제외하고는 최초에 거래가격으로 인식하며, 유효이자율을 적용한 상각후원가에서 손실충당금을 차감하여 측정하고 있습니다.

2.8 재고자산

회사는 미착품을 제외하고는 재고자산의 단위원가를 평균법에 따라 결정하고 있습니다. 제품과 재공품의 원가는 원재료비, 직접노무비 및 기타 직접원가와 정상조업도에 근거한 관련 제조간접비로 이루어지며, 유휴 생산설비 원가나 폐기비용은 제외하고 있습니다.

회사는 재고자산을 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다.순실현가능가치는 정상적인 영업과정에서의 추정 판매가격에서 적용 가능한 변동 판매비용을 차감한 금액으로,

판가의 하락 또는 완성시까지의 원가 상승을 반영하는 저가법 평가와 재고의 과잉 또는 진부화로 인한 가치의 하락을 반영하는 과잉/진부화평가의 두 가지 평가방법을 적용합니다.

2.9 유형자산

회사는 제품의 생산 등 자산을 경영진이 의도한 목적으로 사용할 수 있게 되었다고 판단된 시점을 기준으로 감가상각을 개시하고 있습니다.

회사의 유형자산은 취득원가에서 잔존가액을 차감한 금액이 회사가 추정한 추정내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다. 토지는 상각되지 않으며, 자본화차입금이자를 포함한 장기건설자산의 취득에 사용된 원가는 관련 자산의 추정내용연수 동안 상각됩니다.

자산별로 회사가 사용하고 있는 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

구 분	대표추정내용연수
건물 및 구축물	15, 30 년
기계장치	5 년
기타	5 년

2.10 무형자산

영업권은 사업의 취득시점에 회사가 식별가능 순자산에 대해 공정가치를 초과하여 지급한 대가에 해당하며, 무형자산으로 계상하고 있습니다.

영업권을 제외한 무형자산은 역사적 원가로 최초 인식되고, 원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시됩니다.

회원권은 이용 가능 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 한정되지 않아 상각되지 않습니다. 하지만 회원권의 시장가치 하락 등 손상 징후 발견 시 합리적으로 추정하여 손상을 반영합니다. 특허권, 상표권 및 기타무형자산 등 한정된 내용연수를 가지는 무형자산은 추정내용연수 동안 정액법에 따라 상각하고 있습니다.
자산별 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

구 분	대표추정내용연수
특허권, 상표권 및 기타무형자산	5년 ~ 10년

2.11 금융부채

회사는 계약상 내용의 실질과 금융부채의 정의에 따라 금융부채를 당기손익인식금융부채와 기타금융부채로 분류하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고
있습니다.

2.12 종업원급여

회사는 확정급여제도와 확정기여제도를 포함하는 다양한 형태의 퇴직연금제도를 운영하고 있습니

다. 확정급여제도와 관련하여 재무상태표에 계상된 부채(자산)는 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 현재가치에 사외적립자산의 공정가치를 차감한 과소적립액(자산인식상한을 한도로 하는 초과적립액)이며, 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정됩니다.

2.13 법인세비용

필라 2 법률에 따라 납부하는 글로벌 최저한세는 기업회계기준서 제1012호 '법인세'의 적용대상 입니다. 회사는 글로벌 최저한세 납부액이 발생하는 시점에 당기법인세로 회계처리하고 있으며, 글로벌 최저한세와 관련된 이연법인세의 인식과 공시에 대한 예외규정을 적용하고 있습니다.

회사는 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여 소멸 시점을 통제할 수 있고 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한 이러한 자산으로부터 발생하는 차감할 일시적차이에 대하여 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높고 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.

2.14 파생상품

회사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피 금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

2.15 수익인식

회사의 수익은 재화의 판매에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가액에서 부가가치세, 반품, 판매장려금 및 가격 할인액 등을 차감한 순액으로 표시하고 있습니다.

(1) 수행의무의 식별

회사는 고객과의 계약에 따라 재화 및 용역에 대한 통제를 이전할 의무가 있습니다. 회사가 Incoterms Group C조건(무역조건 CIF 등)에 따라 제품 및 상품을 수출하는 경우, 고객에게 재화의 통제가 이전된 이후 제공하는 운송서비스(보험 포함)를 별도의 수행의무로 인식합니다.

(2) 한시점에 이행하는 수행의무

회사의 수익은 주로 재화의 판매에서 발생하고 있으며, 재화의 통제가 고객에게 이전되는 시점에 수익을 인식하고 있습니다.

(3) 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

용역 수행 경과에 따른 결과물을 고객이 직접 통제하게 되는 소프트웨어 판매, 운송용역, 설치용역 등의 경우, 기간에 걸쳐 수익을 인식하고 있습니다.

(4) 변동대가

회사는 인센티브, 판매장려금, 매출에누리 등 다양한 판매촉진 정책을 운영하고 있습니다. 이러한 판매촉진 정책으로 인해 고객과 약속한 대가에 변동가능성이 있는 경우, 고객으로부터 이미 받았거나 받을 대가 중 권리를 갖지 않을 것으로 예상하는 금액(변동대가)을 기대값 또는 가능성이 가장 높은 금액 중 보다 신뢰성 있는 방법으로 추정하고 있습니다. 변동대가의 추정치는 관련 불확실성이 해소될 때 이미 인식한누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 거래가격에 포함하며, 관련 매출이 발생한 시점과 고객에게 변동대가를 지급하기로 결정한 시점 중 늦은 시점에 수익 및 계약부채를 인식합니다.

회사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대해 경험률에 기초한 기대값 방법으로 반품율을 예측하여 계약부채(환불부채)를 인식하고 있습니다. 고객이 반품권리를 행사할 때 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 가지므로 그 자산을 환불자산으로 인식하고 해당 금액만큼 매출원가를 조정합니다. 제품을 회수할 권리는 제품의 과거 장부금액에서 제품을 회수하는데 드는 원가를 차감하여 측정합니다.

2.16 리스

(1) 리스이용자

회사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 실무적 간편법을 적용하여, 계약에서 리스요소와 리스가 아닌 요소(이하 "비리스요소")를 분리하지 않고, 각 리스요소와 관련된 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리합니다.

회사는 리스개시일에 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 재무상태표에 '유형자산'으로 분류하며, 리스부채는 '유동성장기부채' 또는 '장기차입금'으로 분류합니다.

리스부채는 리스개시일에 그날 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정하며, 회사는 현재가치 측정 시 회사의 증분차입이자율로 리스료를 할인하고 있습니다.

단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하)와 소액자산 리스(기초자산 US$ 5,000 이하)의 경우 실무적 간편법을 적용하여 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.

(2) 리스제공자

리스제공자로서 회사는 리스약정일에 리스가 금융리스인지 운용리스인지 판단합니다.

회사는 리스약정일에 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류하고, 금융리스 이외의 모든 리스는 운용리스로 분류합니다. 운용리스로부터 발생하는 리스료 수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식하고, 운용리스의 협상 및 계약 단계에서 발생한 리스개설 직접원가는 리스자산의 장부금액에 가산한 후 리스료 수익에 대응하여 리스기간 동안 비용으로 인식합니다.

2.17 정부보조금

수익과 관련된 정부보조금은 이연하여 정부보조금의 교부 목적과 관련된 수익 또는 비용과 대응될 수 있는 기간에 손익계산서에 인식하고 있습니다. 한편, 특정 자산의 취득과 관련된 정부보조금은

이연수익으로 처리하고, 관련 자산의 내용연수 동안 상각하여 손익으로 반영하고 있습니다.

2.18 재무제표의 승인

회사의 재무제표는 2025년 1월 31일 이사회에서 승인되었으며, 향후 정기주주총회에서 수정 승인 될 수 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.

가. 수익인식

회사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대하여 환불부채와 회수할 재화에 대한 권리를 인식하고 있습니다. 판매 시점에 포트폴리오 수준에서 누적된 경험에 기초하여 기대값 방법으로 반품률을 예측하고 있으며, 회사의 수익은 예측된 반품률의 변동에 영향을 받습니다.

회사는 재화의 판매로 인한 수익을 통제가 이전되는 시점에 계약에 따른 대가에서 특정 매출장려활동을 차감한 금액으로 인식하고 있습니다. 과거의 경험 및 계약에 기초하여 매출차감액을 합리적으로 추정하고 있으며, 회사의 수익은 추정된 매출차감에 영향을 받습니다.

나. 판매보증충당부채

회사는 판매한 제품에 대하여 품질에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 회사는 매
보고기간종료일 미래와 현재의 보증의무를 제공하는데 필요하다고 판단되는 최선의 추정치를 기준으로 판매보증충당부채를 계상하고 있습니다. 이러한 최선의 추정치는과거 경험에 기초하여 결정하고 있습니다.

다. 금융상품의 공정가치

회사는 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치에 대하여 보고기간종료일 현재 주요한 시장상황을 기초로 다양한 평가기법 및 가정을 사용하여 결정하고 있습니다.
라. 금융자산의 손상

회사는 금융자산의 손실충당금을 측정할 때에 채무불이행위험과 기대신용률에 대한 가정에 근거하였습니다. 회사는 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간종료일의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다.

마. 리스

회사는 리스기간을 산정할 때에 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다.

선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 회사가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 회사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다.

바. 순확정급여부채(자산)

순확정급여부채(자산)는 많은 가정을 사용하는 보험수리적 방식에 의해 결정되는 다양한 요소들에 따라 달라질 수 있습니다. 퇴직연금의 순원가(이익)를 결정하는 데 사용되는 가정은 할인율을 포함하고 있으며, 이러한 가정의 변동은 순확정급여부채(자산)의 장부금액에 영향을 줄 것입니다. 회사는 매년 말 우량회사채 이자율을 고려하여 적절한 할인율을 결정하고 있으며, 이러한 할인율은 순확정급여부채(자산)의 정산시 발생할 것으로 예상되는 미래의 추정 현금 유출액의 현재가치를 결정할 때 사용됩니다. 순확정급여부채(자산)와 관련된 다른 주요한 가정들 중 일부는 현재의 시장 상황에 근거하고 있습니다.

사. 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산의 손상

회사는 매년 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산의 손상 여부를 검토하고 있습니다. 현금창출단위 또는 자산의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정하고 있습니다. 이러한 계산은 추정에 근거하여 이루어집니다.

아. 법인세

회사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 회사는 보고기간종료일 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 최선의 추정과정을 거쳐 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 하지만 실제 미래 최종 법인세부담은 인식한 관련 자산・부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산・부채에 영향을 줄 수 있습니다.

회사는 특정 기간 동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을 때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 회사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.

회사는 법인세 처리의 불확실성 여부를 검토하고 있으며, 과세당국이 불확실한 법인세 처리를 수용할 가능성이 높지 않다고 결론을 내리는 경우에는 불확실한 법인세 처리 각각에 다음 방법 가운데 불확실성의 해소를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 방법을 사용하여 불확실성의 영향을 재무제표에 반영하고 있습니다.

(1) 가능성이 가장 높은 금액: 가능한 결과치 범위에서 가능성이 가장 높은 단일 금액
(2) 기대값: 가능한 결과치의 범위에 있는 모든 금액에 각 확률을 곱한 금액의 합

4. 범주별 금융상품

금융자산의 범주별 공시

당기 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	금융자산, 범주 합계
금융자산 합계		50,947,761	2,176,346	373,681	53,497,788
금융자산 합계	현금및현금성자산	1,653,766	0	0	1,653,766
	단기금융상품	10,187,991	0	0	10,187,991
	매출채권	33,840,357	0	0	33,840,357
	기타포괄손익-공정가치금융자산	0	2,176,346	0	2,176,346
	당기손익-공정가치금융자산				0
	기타금융자산	5,265,647	0	373,681	5,639,328

전기 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	금융자산, 범주 합계
금융자산 합계		38,446,822	1,854,503	393,236	40,694,561
금융자산 합계	현금및현금성자산	6,061,451	0	0	6,061,451
	단기금융상품	50,071	0	0	50,071
	매출채권	27,363,016	0	0	27,363,016
	기타포괄손익-공정가치금융자산	0	1,854,503	0	1,854,503
	당기손익-공정가치금융자산	0	0	1	1
	기타금융자산	4,972,284	0	393,235	5,365,519

금융부채의 범주별 공시

당기 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채	금융부채, 범주 합계
금융부채 합계		59,909,108	12,173,636	72,082,744
금융부채 합계	매입채무	10,287,967	0	10,287,967
	단기차입금	0	11,110,972	11,110,972
	미지급금	18,331,728	0	18,331,728
	유동성장기부채	21,997,265	266,961	22,264,226
	사채	14,530	0	14,530
	장기차입금	0	795,703	795,703
	장기미지급금	4,383,749	0	4,383,749
	기타금융부채	4,893,869	0	4,893,869

전기 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채	금융부채, 범주 합계
금융부채 합계		53,114,189	6,759,335	59,873,524
금융부채 합계	매입채무	7,943,834	0	7,943,834
	단기차입금	0	5,625,163	5,625,163

	미지급금	15,015,578	0	15,015,578
	유동성장기부채	6,354	222,137	228,491
	사채	19,064	0	19,064
	장기차입금	21,990,000	912,035	22,902,035
	장기미지급금	4,486,390	0	4,486,390
	기타금융부채	3,652,969	0	3,652,969

당기 및 전기 기타금융부채에 대한 각주

기타금융부채는 담보부차입금과 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

금융상품의 범주별 손익의 공시

당기 (단위 : 백만원)

	자산과 부채				
	금융자산, 범주			금융부채, 범주	
	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채
평가손익(기타포괄손익)	0	239,784	0		
평가・처분손익(당기손익)	0	0	(14,895)		
이자수익(금융수익)	396,089	0	0		
이자비용(금융원가)				(330,514)	(509,097)
외환차익(차손)	1,326,139	0	0	(657,439)	(165,169)
배당금수익(금융수익)	0	3,962	0		
손상(환입)	(67,644)	0	0		
기타금융부채 구성내역에 대한 기술					기타금융부채는 담보부차입금과 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	자산과 부채				
	금융자산, 범주			금융부채, 범주	
	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채
평가손익(기타포괄손익)	0	356,472	0		
평가・처분손익(당기손익)	0	0	365,387		
이자수익(금융수익)	371,106	0	0		
이자비용(금융원가)				(310,267)	(285,498)
외환차익(차손)	(216,145)	0	0	5,103	31,557
배당금수익(금융수익)	0	4,081	637		
손상(환입)	(2,113)	0	0		

기타금융부채 구성내역에 대한 기술					기타금융부채는 담보부차입금과 기업회계기준서 제 1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

금융상품의 범주별 손익의 공시,합계

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주	금융부채, 범주
평가손익(기타포괄손익)	239,784	
평가・처분손익(당기손익)	(14,895)	
이자수익(금융수익)	396,089	
이자비용(금융원가)		(839,611)
외환차익(차손)	1,326,139	(822,608)
배당금수익(금융수익)	3,962	
손상(환입)	(67,644)	

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주	금융부채, 범주
평가손익(기타포괄손익)	356,472	
평가・처분손익(당기손익)	365,387	
이자수익(금융수익)	371,106	
이자비용(금융원가)		(595,765)
외환차익(차손)	(216,145)	36,660
배당금수익(금융수익)	4,718	
손상(환입)	(2,113)	

5. 금융자산의 양도

전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산

당기 (단위 : 백만원)

	매출채권
기업이 계속하여 인식하는 자산	11,110,972
기업이 계속하여 인식하는 관련 부채	11,110,972

전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산과 관련부채와의 관계의 성격에 대한 기술	회사는 당기 및 전기 중 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 회사가 매출채권 팩토링 거래에서 제공한 매출채권은 채무자의 채무불이행 시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 회사가 보유하므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 제거되지 않았습니다. 이러한 거래에서 인식한 금융부채는 재무상태표에 '단기차입금'으로 분류되어 있습니다(주석 12 참조).

전기 (단위 : 백만원)

	매출채권
기업이 계속하여 인식하는 자산	5,625,163
기업이 계속하여 인식하는 관련 부채	5,625,163
전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산과 관련부채와의 관계의 성격에 대한 기술	회사는 당기 및 전기 중 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 회사가 매출채권 팩토링 거래에서 제공한 매출채권은 채무자의 채무불이행 시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 회사가 보유하므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 제거되지 않았습니다. 이러한 거래에서 인식한 금융부채는 재무상태표에 '단기차입금'으로 분류되어 있습니다(주석 12 참조).

6. 공정가치금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
금융자산	2,176,346

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
금융자산	1,854,503

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품
금융자산	0

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품
금융자산	1

비유동 기타포괄손익-공정가치금융자산 변동내역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주	
	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익인식금융자산
	지분상품	채무상품
기초금융자산	1,854,503	1
발행 또는 매입에 따른 증가, 금융자산	0	
제거에 따른 감소, 금융자산	(2,942)	0
공정가치변동에 따른 증가(감소), 금융자산	324,785	
기타 변동에 따른 증가(감소), 금융자산		(1)
기말금융자산	2,176,346	0

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 범주	
	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익인식금융자산
	지분상품	채무상품
기초금융자산	1,364,325	283
발행 또는 매입에 따른 증가, 금융자산	15,515	
제거에 따른 감소, 금융자산	(15,577)	(282)
공정가치변동에 따른 증가(감소), 금융자산	490,240	
기타 변동에 따른 증가(감소), 금융자산		0
기말금융자산	1,854,503	1

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 변동내역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	자본
	기타자본구성요소

	기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금
기초	340,232
공정가치평가	324,785
처분으로 인한 이익잉여금 대체	2,939
기말	667,956
차감: 자본에 가감되는 법인세효과	(179,854)
계	488,102

전기 (단위 : 백만원)

	자본
	기타자본구성요소
	기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금
기초	(166,635)
공정가치평가	490,240
처분으로 인한 이익잉여금 대체	16,627
기말	340,232
차감: 자본에 가감되는 법인세효과	(94,077)
계	246,155

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

| | 측정 전체 | | |

| | | |

	상장주식	
금융자산		1,757,336

7. 매출채권 및 미수금

매출채권 및 미수금의 공시

당기 (단위 : 백만원)

		총장부금액	손상차손누계액	장부금액 합계
매출채권		33,967,334	(126,977)	33,840,357
매출채권	유동매출채권			33,840,357
	비유동매출채권			0
미수금		3,263,714	(4,303)	3,259,411
미수금	단기미수금, 순액			3,249,731
	장기미수금, 순액			9,680

전기 (단위 : 백만원)

		총장부금액	손상차손누계액	장부금액 합계
매출채권		27,421,756	(58,740)	27,363,016
매출채권	유동매출채권			27,363,016
	비유동매출채권			0
미수금		1,927,564	(6,230)	1,921,334
미수금	단기미수금, 순액			1,910,054
	장기미수금, 순액			11,280

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	금융상품	
	매출채권	미수금
	장부금액	
	손상차손누계액	
기초금융자산	(58,740)	(6,230)
대손상각(환입)	(68,237)	330
제각	0	1,597
기말금융자산	(126,977)	(4,303)

전기 (단위 : 백만원)

	금융상품	
	매출채권	미수금
	장부금액	
	손상차손누계액	
기초금융자산	(56,432)	(6,387)

대손상각(환입)	(2,308)	145
제각	0	12
기말금융자산	(58,740)	(6,230)

연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류									
	매출채권					미수금				
	장부금액									
	총장부금액									
	연체상태				연체상태 합계	연체상태				연체상태 합계
	연체되지 않은 채권	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		연체되지 않은 채권	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	
금융자산	33,374,582	404,847	71,780	116,125	33,967,334	3,141,782	77,956	13,019	30,957	3,263,714
기업이 신용이 손상된 금융자산인지를 판단하는 방법에 관한 정보		회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용위험이 유의적으로 증가하였다고판단하지 않습니다.					회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용위험이 유의적으로 증가하였다고판단하지 않습니다.			

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류									
	매출채권					미수금				
	장부금액									
	총장부금액									
	연체상태				연체상태 합계	연체상태				연체상태 합계
	연체되지 않은 채권	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과		연체되지 않은 채권	31일 이하	31일 초과 90일 이하	90일 초과	
금융자산	26,584,115	430,299	252,998	154,344	27,421,756	1,747,904	142,166	7,893	29,601	1,927,564
기업이 신용이 손상된 금융자산인지를 판단하는 방법에 관한 정보		회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용위험이 유의적으로 증가하였다고판단하지 않습니다.					회사는 31일 이하 연체된 매출채권 및 미수금은 신용위험이 유의적으로 증가하였다고판단하지 않습니다.			

연체되거나 손상된 금융자산에 대한 공시, 합계

당기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류					
	매출채권			미수금		
	장부금액					
	총장부금액					
	연체상태		연체상태 합계	연체상태		연체상태 합계
	연체되지 않은 채권	연체채권		연체되지 않은 채권	연체채권	
금융자산	33,374,582	592,752	33,967,334	3,141,782	121,932	3,263,714

전기 (단위 : 백만원)

	금융자산, 분류					
	매출채권			미수금		
	장부금액					
	총장부금액					
	연체상태		연체상태 합계	연체상태		연체상태 합계
	연체되지 않은 채권	연체채권		연체되지 않은 채권	연체채권	

금융자산	26,584,115	837,641	27,421,756	1,747,904	179,660	1,927,564

채권의 신용위험 금액에 대한 기술

보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 채권의 장부금액입니다. 회사의 주요 채권과 관련하여 보험사와 보험계약을 체결하고 있습니다.

8. 재고자산

재고자산 세부내역

당기 (단위 : 백만원)

		평가전금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
재고자산		32,283,948	(3,129,833)	29,154,115
재고자산	제품 및 상품	6,374,009	(774,903)	5,599,106
	반제품 및 재공품	20,944,352	(1,802,857)	19,141,495
	원재료 및 저장품	4,561,944	(552,073)	4,009,871
	미착품	403,643	0	403,643
기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가				150,032,902

전기 (단위 : 백만원)

		평가전금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
재고자산		35,267,515	(5,929,364)	29,338,151
재고자산	제품 및 상품	7,914,117	(1,203,662)	6,710,455
	반제품 및 재공품	21,866,523	(3,863,881)	18,002,642
	원재료 및 저장품	4,910,170	(861,821)	4,048,349
	미착품	576,705	0	576,705
기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가				142,735,272

기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가에 대한 기술

당기 중 비용으로 인식한 재고자산의 금액은 150,032,902백만원(전기: 142,735,272백만원)입니다. 동 비용에는 재고자산평가손실 금액이 포함되어 있습니다.

9. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자

가. 당기 및 전기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기
기초	57,392,438	57,397,249
취득	336,648	108,300
처분	(315,306)	(144,317)
손상환입	13,416	31,206
기말	57,427,196	57,392,438

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(종속기업 현황은 주석 30 참조)

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기㈜	수동소자, 회로부품, 모듈 등	23.7	한국	12월

	전자부품의 생산 및 공급			
삼성에스디에스㈜	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합・관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스㈜	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI㈜(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
㈜제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

다. 보고기간종료일 현재 주요 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 주요 종속기업

(단위 : 백만원)

기업명(*)	당기			
	자산	부채	매출액	당기순이익(손실)
삼성디스플레이㈜	67,541,382	8,305,660	25,401,419	5,989,037
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	50,777,503	18,653,435	40,650,074	1,628,652
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	31,226,978	353,722	-	5,326,248
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	18,796,411	900,205	11,180,211	1,195,361
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	16,111,528	15,246,946	2,754,791	300,719
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	9,561,708	3,226,735	17,048,976	1,408,392
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,093,393	3,452,430	-	195,012
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	6,467,878	5,635,634	30,068,460	468,408
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,679,383	1,486,272	7,935,236	208,102
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	3,267,763	2,042,914	6,158,787	181,457
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	2,637,138	502,266	4,513,870	166,928
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	2,411,145	1,642,510	5,744,458	62,255
세메스㈜	2,365,712	705,818	2,432,656	144,665
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,017,910	845,480	4,086,721	125,857
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	1,928,760	1,710,124	15,682,546	(12,249)

(*) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(단위 : 백만원)

기업명(*)	전기			
	자산	부채	매출액	당기순이익(손실)
삼성디스플레이㈜	65,328,568	7,266,213	27,083,336	8,268,314
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	41,926,899	15,322,780	39,551,809	477,338

Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	22,234,942	282,614	-	14,140,195
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	15,808,283	870,453	8,693,788	877,892
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	10,222,557	8,797,991	3,148,858	189,887
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,660,481	4,585,806	-	103,387
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	7,738,259	3,373,730	15,216,331	1,153,256
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	5,542,627	1,587,911	7,222,304	333,812
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	5,262,086	4,552,030	15,649,307	244,210
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,039,379	640,512	4,213,492	150,510
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,902,722	1,976,067	5,859,133	185,113
세메스㈜	2,187,919	659,607	2,502,143	58,754
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,153,032	1,038,115	3,638,080	148,873
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	1,797,627	1,139,056	4,108,479	56,467
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	1,794,552	639,120	2,833,717	140,313

(*) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(2) 주요 관계기업

(단위 : 백만원)

구 분	당기				
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
요약 재무상태표:					
유동자산	5,891,746	9,003,787	5,518,118	10,334,313	2,754,194
비유동자산	6,900,656	4,234,543	11,818,179	30,263,032	568,459
유동부채	3,056,861	2,495,409	3,853,188	10,855,694	1,594,190
비유동부채	719,688	1,037,472	2,578,432	8,174,413	251,659
요약 포괄손익계산서:					
매출	10,294,103	13,828,232	4,547,322	16,592,249	4,344,257
계속영업손익(*)	640,865	756,997	1,083,316	544,239	207,515
세후중단영업손익(*)	38,265	-	-	55,051	-
기타포괄손익(*)	349,340	144,625	(9,132)	722,676	76,571
총포괄손익(*)	1,028,470	901,622	1,074,184	1,321,966	284,086

(*) 관계기업별 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	전기				
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
요약 재무상태표:					
유동자산	5,208,418	8,160,300	5,521,988	9,187,029	2,372,420

비유동자산	6,449,453	4,160,724	10,524,209	24,851,831	517,085
유동부채	2,900,460	2,391,861	4,157,861	8,518,933	1,375,034
비유동부채	727,087	953,592	2,057,844	5,612,677	216,707
요약 포괄손익계산서:					
매출	8,892,412	13,276,844	3,694,589	21,436,788	4,138,275
계속영업손익(*)	449,857	693,422	857,691	1,921,820	187,302
세후중단영업손익(*)	(26,900)	-	-	87,387	-
기타포괄손익(*)	45,053	(11,085)	(11,673)	85,394	3,685
총포괄손익(*)	468,010	682,337	846,018	2,094,601	190,987

(*) 관계기업별 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

라. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당기말			전기말	
	주식수(주)	시장가치	장부금액	시장가치	장부금액
삼성전기㈜	17,693,084	2,190,404	445,244	2,710,580	445,244
삼성에스디에스㈜	17,472,110	2,232,936	560,827	2,970,259	560,827
삼성바이오로직스㈜	22,217,309	21,084,226	1,595,892	16,885,155	1,595,892
삼성SDI㈜	13,462,673	3,332,012	1,242,605	6,354,382	1,242,605
㈜제일기획	29,038,075	492,195	491,599	552,595	491,599

마. 기타사항

당사는 2024년 12월 31일 이사회에서 관계기업인 레인보우로보틱스㈜의 최대주주 등 6인이 보유한 지분 394만주를 인수하는 주식매도청구권(콜옵션)의 행사를 의결하였습니다. 인수대가는 267,463백만원이며, 당기말 현재 진행 중인 지분인수 관련 행정절차가 완료되면 지급할 예정입니다.

10. 유형자산

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당기

(단위 : 백만원)

	토지	건물 및 구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	유형자산 합계
기초 유형자산	7,881,222	26,564,296	69,492,787	34,675,331	1,965,525	140,579,161
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	181,295	4,756,975	38,411,587	(3,208,214)	1,228,769	41,370,412
감가상각비, 유형자산	(2,340)	(2,464,085)	(27,213,533)	0	(605,340)	(30,285,298)
유형자산의 처분 및 폐기	(17,239)	(114,033)	(26,089)	0	(7,971)	(165,332)
당기손익으로 인식된 손상, 유형자산	0	(199)	(3,624)	0	(942)	(4,765)
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	915	(12,620)	165,845	(205)	(201,243)	(47,308)
기말 유형자산	8,043,853	28,730,334	80,826,973	31,466,912	2,378,798	151,446,870

전기

(단위 : 백만원)

	토지	건물 및 구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	유형자산 합계
기초 유형자산	7,752,989	23,246,622	61,426,540	28,768,364	2,072,471	123,266,986
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	131,535	5,509,158	31,107,219	5,907,608	461,345	43,116,865
감가상각비, 유형자산	(1,003)	(2,135,709)	(22,908,637)	0	(574,245)	(25,619,594)
유형자산의 처분 및 폐기	(2,277)	(25,652)	(95,125)	0	(5,330)	(128,384)

당기손익으로 인식된 손상, 유형자산	0	(27,715)	(24,920)	0	(1,547)	(54,182)
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	(22)	(2,408)	(12,290)	(641)	12,831	(2,530)
기말 유형자산	7,881,222	26,564,296	69,492,787	34,675,331	1,965,525	140,579,161

유형자산에 대한 세부 정보 공시, 총액

당기 (단위 : 백만원)

	유형자산													
	토지			건물 및 구축물			기계장치			건설중인자산			기타유형자산		
	장부금액			장부금액			장부금액			장부금액			장부금액		
	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계
기초 유형자산	7,883,620	(2,398)	7,881,222	41,814,348	(15,250,052)	26,564,296	228,287,817	(158,795,030)	69,492,787	34,675,331	0	34,675,331	5,182,709	(3,217,184)	1,965,525
기말 유형자산	8,048,086	(4,233)	8,043,853	46,332,683	(17,602,349)	28,730,334	264,285,218	(183,458,245)	80,826,973	31,466,912	0	31,466,912	5,691,097	(3,312,299)	2,378,798

전기 (단위 : 백만원)

	유형자산													
	토지			건물 및 구축물			기계장치			건설중인자산			기타유형자산		
	장부금액			장부금액			장부금액			장부금액			장부금액		
	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	장부금액 합계
기초 유형자산	7,754,559	(1,570)	7,752,989	36,449,026	(13,202,404)	23,246,622	199,823,339	(138,396,799)	61,426,540	28,768,364	0	28,768,364	4,886,059	(2,813,588)	2,072,471
기말 유형자산	7,883,620	(2,398)	7,881,222	41,814,348	(15,250,052)	26,564,296	228,287,817	(158,795,030)	69,492,787	34,675,331	0	34,675,331	5,182,709	(3,217,184)	1,965,525

유형자산에 대한 세부 정보 공시, 총액합계

당기 (단위 : 백만원)

	자산		
	유형자산		
	장부금액		장부금액 합계
	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	
기초 유형자산	317,843,825	(177,264,664)	140,579,161
기말 유형자산	355,823,996	(204,377,126)	151,446,870

전기 (단위 : 백만원)

	자산		
	유형자산		
	장부금액		장부금액 합계
	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	
기초 유형자산	277,681,347	(154,414,361)	123,266,986
기말 유형자산	317,843,825	(177,264,664)	140,579,161

적격자산인 유형자산에 대해 자본화된 차입원가

당기 (단위 : 백만원)

	유형자산
자본화된 차입원가	849,378
자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율	0.046

전기 (단위 : 백만원)

	유형자산
자본화된 차입원가	646,471
자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율	0.046

일반취득 및 자본적지출에 대한 각주, 유형자산

일반취득 및 자본적지출은 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다.

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당기 (단위 : 백만원)

	자산				
	유형자산				자산 합계
	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타유형자산	
기초 사용권자산	4,575	1,295,293	8,142	532,903	1,840,913
일반취득, 사용권자산	193	74,707	77,272	46,870	199,042
사용권자산감가상각비	(2,340)	(231,116)	(29,075)	(46,160)	(308,691)
계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 사용권자산	(328)	(3,083)	0	(145)	(3,556)
기타 변동에 따른 증가(감소), 사용권자산	914	0	(283)	1,805	2,436
기말 사용권자산	3,014	1,135,801	56,056	535,273	1,730,144

전기 (단위 : 백만원)

	자산				
	유형자산				자산 합계
	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타유형자산	
기초 사용권자산	1,866	642,700	22,135	569,312	1,236,013
일반취득, 사용권자산	3,712	863,062	1,728	4,554	873,056
사용권자산감가상각비	(1,003)	(189,855)	(16,057)	(40,749)	(247,664)
계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 사용권자산	0	(20,500)	0	(234)	(20,734)
기타 변동에 따른 증가(감소), 사용권자산	0	(114)	336	20	242
기말 사용권자산	4,575	1,295,293	8,142	532,903	1,840,913

감가상각비의 기능별 배분

당기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	27,673,746	2,611,552	30,285,298

전기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	23,618,150	2,001,444	25,619,594

11. 무형자산

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당기 (단위 : 백만원)

	산업재산권	개발비	회원권	기타	영업권 이외의 무형자산 합계
기초 영업권 이외의 무형자산	1,287,798	0	196,827	8,955,586	10,440,211
개별취득, 영업권 이외의 무형자산	270,328	0	13,531	2,213,977	2,497,836
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산	(236,511)	0	0	(2,195,761)	(2,432,272)
처분과 폐기, 영업권 이외의 무형자산	(33,661)	0	0	(16,040)	(49,701)
당기손익으로 인식된 손상차손, 영업권 이외의 무형자산	0	0	(826)	0	(826)
당기손익으로 인식된 손상차손환입, 영업권 이외의 무형자산					
기타변동에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산	(741)	0	0	42,449	41,708
기말 영업권 이외의 무형자산	1,287,213	0	209,532	9,000,211	10,496,956

전기 (단위 : 백만원)

	산업재산권	개발비	회원권	기타	영업권 이외의 무형자산 합계
기초 영업권 이외의 무형자산	1,193,286	85,018	199,870	7,083,250	8,561,424
개별취득, 영업권 이외의 무형자산	371,570	0	1,069	4,174,044	4,546,683
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산	(229,849)	(85,018)	0	(2,299,322)	(2,614,189)
처분과 폐기, 영업권 이외의 무형자산	(40,944)	0	(7,850)	(560)	(49,354)
당기손익으로 인식된 손상차손, 영업권 이외의 무형자산	(6,265)	0		(3,114)	(5,641)
당기손익으로 인식된 손상차손환입, 영업권 이외의 무형자산			3,738		
기타변동에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산	0	0	0	1,288	1,288
기말 영업권 이외의 무형자산	1,287,798	0	196,827	8,955,586	10,440,211

무형자산상각비의 기능별 배분

당기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	1,836,827	595,445	2,432,272

전기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	2,016,938	597,251	2,614,189

12. 차입금

단기차입금에 대한 세부 정보

당기 (단위 : 백만원)

	차입금명칭	
	담보부차입금	
	거래상대방	
	우리은행 등	
	범위	범위 합계

	하위범위	상위범위	
연이자율	0.004	0.149	
단기차입금			11,110,972
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	차입금명칭		
	담보부차입금		
	거래상대방		
	우리은행 등		
	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위	
연이자율			
단기차입금			5,625,163
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

유동성장기차입금에 대한 세부 정보

당기 (단위 : 백만원)

	리스 부채	무담보차입금	차입금명칭 합계
연이자율	0.030	0.046	
만기일	-	2025-08-16	
유동성장기차입금	266,961	21,990,000	22,256,961
차입처		삼성디스플레이㈜	

전기 (단위 : 백만원)

	리스 부채	무담보차입금	차입금명칭 합계
연이자율			
만기일			
유동성장기차입금	222,137	0	222,137
차입처			

장기차입금에 대한 세부 정보

당기 (단위 : 백만원)

	리스 부채	무담보차입금	차입금명칭 합계
연이자율	0.030	0.000	

장기차입금	795,703	0	795,703

전기 (단위 : 백만원)

	리스 부채	무담보차입금	차입금명칭 합계
연이자율			
장기차입금	912,035	21,990,000	22,902,035

리스부채 이자비용에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 이자비용	32,567
리스부채 측정에 포함되지 않은 변동리스료에 관련되는 비용	47,328
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 당기 중 발생한 이자비용은 32,567백만원(전기: 28,282백만원)입니다. 한편, 당기 중 리스부채 측정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액 자산 리스료 등은 47,328백만원(전기: 51,569백만원)입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 이자비용	28,282
리스부채 측정에 포함되지 않은 변동리스료에 관련되는 비용	51,569
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 당기 중 발생한 이자비용은 16,518백만원(전기: 28,282백만원)입니다. 한편, 당기 중 리스부채 측정치에 포함되지 않은 단기리스료, 소액 자산 리스료 등은 47,328백만원(전기: 51,569백만원)입니다.

차입금의 만기분석에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년 이후	합계 구간 합계
장기차입금, 미할인현금흐름	22,619,095					22,619,095
총 리스부채	299,447	241,390	168,208	129,598	333,846	1,172,489

13. 사채

사채에 대한 세부 정보 공시

당기 (단위 : 백만원)

	US$ denominated Straight Bonds

발행일	1997-10-02
만기상환일	2027-10-01
연이자율	0.077
명목금액	22,050
명목금액, 기초통화금액(USD) [USD, 천]	15,000
사채할인발행차금	(255)
사채	21,795
차감: 유동성사채	(7,265)
비유동성사채	14,530
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

전기 (단위 : 백만원)

	US$ denominated Straight Bonds
발행일	
만기상환일	
연이자율	
명목금액	25,788
명목금액, 기초통화금액(USD) [USD, 천]	20,000
사채할인발행차금	(370)
사채	25,418
차감: 유동성사채	(6,354)
비유동성사채	19,064
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

사채의 만기분석에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	2025년	2026년	2027년	합계 구간 합계
사채, 미할인현금흐름	7,350	7,350	7,350	22,050

14. 순확정급여부채(자산)

확정급여제도에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	13,152,202	25,500	13,177,702
사외적립자산의 공정가치			(15,427,494)
순확정급여부채(자산) 계			(2,249,792)

전기 (단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	11,959,655	22,672	11,982,327
사외적립자산의 공정가치			(15,728,024)
순확정급여부채(자산) 계			(3,745,697)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여제도			1,053,582
순이자비용(수익), 확정급여제도			(215,644)
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	336,493	501,445	837,938

전기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여제도			962,366
순이자비용(수익), 확정급여제도			(275,246)
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	271,113	416,007	687,120

확정기여제도 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
퇴직급여비용, 확정기여제도	77,360

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
퇴직급여비용, 확정기여제도	48,884

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산	순확정급여부채(자산) 합계
기초	11,982,327	(15,728,024)	(3,745,697)
당기근무원가, 순확정급여부채(자산)	1,053,582		1,053,582
이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)	642,716	(858,360)	(215,644)
재측정요소		141,532	141,532
- 인구통계적가정의 변동	0		0
- 재무적가정의 변동	538,347		538,347
기타사항에 의한 효과	124,814		124,814

사용자의 기여금		0	0
급여지급액	(1,178,887)	1,021,978	(156,909)
기타	14,803	(4,620)	10,183
기말	13,177,702	(15,427,494)	(2,249,792)
다음 연차보고기간 동안에 납부할 것으로 예상되는 기여금에 대한 추정치		1,674,416	

전기 (단위 : 백만원)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산	순확정급여부채(자산) 합계
기초	10,758,672	(15,168,895)	(4,410,223)
당기근무원가, 순확정급여부채(자산)	962,366		962,366
이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)	613,363	(888,609)	(275,246)
재측정요소		494,687	494,687
- 인구통계적가정의 변동	(61,559)		(61,559)
- 재무적가정의 변동	226,995		226,995
기타사항에 의한 효과	117,800		117,800
사용자의 기여금		(694,100)	(694,100)
급여지급액	(653,343)	537,855	(115,488)
기타	18,033	(8,962)	9,071
기말	11,982,327	(15,728,024)	(3,745,697)
다음 연차보고기간 동안에 납부할 것으로 예상되는 기여금에 대한 추정치			

사외적립자산의 공정가치에 대한 공시

보고기간종료일 현재 사외적립자산은 원금보장형 고정수익 상품 등에 투자되어 있습니다.

보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	할인율에 대한 보험수리적 가정	미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정
할인율에 대한 보험수리적 가정	0.051	
미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정		0.055
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율	0.01	0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소)	11,947,468	14,591,538
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율	0.01	0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소)	14,615,589	11,943,514

전기 (단위 : 백만원)

	할인율에 대한 보험수리적 가정	미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정

할인율에 대한 보험수리적 가정	0.056	
미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정		0.056
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율	0.01	0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소)	10,888,509	13,242,324
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율	0.01	0.01
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소)	13,258,187	10,880,916

확정급여채무의 만기구성에 대한 정보의 공시

	가중범위
확정급여채무의 가중평균만기	10년1개월13일

15. 충당부채

기타충당부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	기타충당부채 합계
기초	673,951	1,815,938	713,719	3,750,227	6,953,835
순전입(환입)	801,454	1,337,893	202,630	2,384,980	4,726,957
사용	(718,775)	(532,481)	(262,023)	(1,575,488)	(3,088,767)
기타	0	172,551	0	95,388	267,939
기말	756,630	2,793,901	654,326	4,655,107	8,859,964

충당부채의 성격에 대한 기술	회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.	회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.	회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.	회사는 생산 및 판매를 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.	

무상할당배출권과 배출량 추정치에 대한 공시

	2024년(당기 이행연도)	2025년(잔여 계획기간)
무상할당 배출권(단위: 만톤(tCO2-eq))	1,282만톤	1,116만톤
배출량 추정치(단위: 만톤(tCO2-eq))	1,396만톤	

배출권 변동내역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	3,137
증가	0
사용	0
기말	3,137

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	19,567
증가	1,265
사용	(17,695)
기말	3,137

배출권 수량에 대한 공시

	공시금액
무상할당배출권 수량(단위: 만톤(tCO2-eq))	2,748만톤
담보로 제공된 배출권 수량(단위: 만톤(tCO2-eq))	0

배출부채 변동내역에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	0
순전입(환입)	0
사용	0
기말	0

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초	32,825
순전입(환입)	(15,348)
사용	(17,477)
기말	0

16. 우발부채와 약정사항

법적소송우발부채에 대한 공시

	법적소송우발부채
유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채	보고기간종료일 현재 회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	지급보증의 구분				
	제공한 지급보증				제공받은 지급보증
	해외종속기업(SETK) 자금조달 등을 위한 채무보증	해외종속기업(기타) 자금조달 등을 위한 채무보증	해외종속기업 자금조달 등을 위한 채무보증 합계	해외종속기업 계약이행을 위한 지급보증	해외종속기업 계약이행을 위한 지급보증
피보증처명	SETK	기타	SETK 및 기타		

보증처	BNP 외	기타	BNP 외 기타		
특수관계 여부	Y	Y	Y	Y	Y
기업의(으로의) 보증한도 (비 PF)	1,392,090	10,518,247	11,910,337	532,893	
차입금(사채 포함)	675,675	0	675,675		
지급보증에 대한 비고 (설명)				회사가 해외종속기업의 계약이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증 한도액은 532,893백만원입니다.	회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시, 외화금액

	지급보증의 구분
	제공한 지급보증
	해외종속기업 자금조달 등을 위한 채무보증 합계
기업의(으로의) 보증한도 (비 PF), (USD) [USD, 천]	8,102,270
차입금(USD) [USD, 천]	495,321

우발부채에 대한 공시

	분할과 관련된 연대채무
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채	회사와 삼성디스플레이㈜ 등은 분할된 삼성디스플레이㈜ 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	무역금융, 상업어음할인 및 외상매출채권담보대출 등의 약정	무역금융 약정	외상매출채권담보대출 약정	유·무형자산의 취득 약정
약정처	우리은행 외 4개 은행	신한은행 외 18개 은행	기업은행 외 4개 은행	
약정 금액	10,677,500		506,249	7,335,536

약정잔액, 기초통화금액(USD) [USD, 백만]		8,898		
약정에 대한 설명	보고기간종료일 현재 회사는 우리은행 외 4개 은행과 무역금융, 상업어음할인 및 외상매출채권담보대출 등의 약정을 맺고 있으며 동 약정에 대한 통합한도액은 10,677,500백만원입니다.	회사는 신한은행 외 18개 은행과 한도액 US$ 8,898백만의 무역금융 약정을 체결하고 있습니다.	기업은행 외 4개 은행과 한도액 506,249백만원의 외상매출채권담보대출 약정 등을 맺고 있습니다.	보고기간종료일 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정액은 7,335,536백만원입니다.

17. 계약부채

계약부채에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	1,559,287
기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익	281,451

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	1,491,085
기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익	

계약부채에 대한 기술

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

18. 자본금

주식의 분류에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식 합계
회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수(주)			25,000,000,000
주당 액면가액(원)			100
발행주식 액면 총액(백만원)	596,978	82,289	679,267
납입자본금(백만원)			897,514

자본금에 대한 설명			보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다. 보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주이며, 유통주식수는 자기주식 취득으로 인하여 발행주식의 총수와 차이가 있습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.
각 종류별 주식에 부여된 권리, 우선권 및 제한사항			보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다.

주식에 대한 공시

당기

	보통주	우선주
기초 유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700
자기주식 취득주식수(주)	(29,700,000)	(4,050,000)
기말 유통주식수(주)	5,940,082,550	818,836,700

전기

	보통주	우선주
기초 유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700
자기주식 취득주식수(주)	0	0
기말 유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700

19. 이익잉여금

이익잉여금에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

			공시금액
이익잉여금			233,734,316
이익잉여금	법정적립금		450,789
	법정적립금	이익준비금	450,789
	임의적립금		217,059,556
	미처분이익잉여금		16,223,971
자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술			회사는 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으나, 보고기간종료일 현재 회사의 이익준비금이 납입자본의 50%에 달하였으므로 추가 적립할 의무는 없습니다.

전기 (단위 : 백만원)

			공시금액
이익잉여금			219,963,351
이익잉여금	법정적립금		450,789
	법정적립금	이익준비금	450,789
	임의적립금		201,484,221
	미처분이익잉여금		18,028,341

자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술	회사는 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으나, 보고기간종료일 현재 회사의 이익준비금이 납입자본의 50%에 달하였으므로 추가 적립할 의무는 없습니다.

이익잉여금 처분계산서

당기 (단위 : 백만원)

			공시금액
미처분이익잉여금			16,223,971
미처분이익잉여금	전기이월이익잉여금		30
	분기배당		(7,356,461)
	분기배당	주당 배당금, 분기배당	1,083
		주당 배당률, 분기배당	10.83
	당기순이익		23,582,565
	기타포괄손익-공정가치금융자산 처분		(2,163)
임의적립금 등의 이입액			0
이익잉여금 처분액			16,223,941
이익잉여금 처분액	배당금		2,454,307
	배당금	보통주에 지급될 주당배당금	363
		우선주에 지급될 주당배당금	364
		보통주에 지급된 주당배당금	
		우선주에 지급된 주당배당금	
		보통주 주당 배당률	3.63
		우선주 주당 배당률	3.64
	연구및인력개발준비금		13,769,634
차기이월 미처분이익잉여금			30
이익잉여금 처분예정일			2025-03-19
이익잉여금 처분확정일			

전기 (단위 : 백만원)

			공시금액
미처분이익잉여금			18,028,341
미처분이익잉여금	전기이월이익잉여금		30
	분기배당		(7,356,461)

	분기배당	주당 배당금, 분기배당	1,083
		주당 배당률, 분기배당	10.83
	당기순이익		25,397,099
	기타포괄손익-공정가치금융자산 처분		(12,327)
임의적립금 등의 이입액			0
이익잉여금 처분액			18,028,311
이익잉여금 처분액	배당금		2,452,976
	배당금	보통주에 지급될 주당배당금	
		우선주에 지급될 주당배당금	
		보통주에 지급된 주당배당금	361
		우선주에 지급된 주당배당금	362
		보통주 주당 배당률	3.61
		우선주 주당 배당률	3.62
	연구및인력개발준비금		15,575,335
차기이월 미처분이익잉여금			30
이익잉여금 처분예정일			
이익잉여금 처분확정일			2024-03-20

배당금에 대한 공시

당기

(단위 : 백만원)

	배당의 구분											
	분기배당									기말배당		
	1분기			2분기			3분기					
	주식		주식 합계	주식		주식 합계	주식		주식 합계	주식		주식 합계
	보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주	
배당기준일			2024-03-31			2024-06-30			2024-09-30			2024-12-31
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,940,082,550	818,836,700	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)			3.61			3.61			3.61			3.63
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)			3.61			3.61			3.61			3.64
지급된 배당금	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154			
지급될 배당금										2,156,250	298,057	2,454,307

전기

(단위 : 백만원)

	배당의 구분											
	분기배당									기말배당		
	1분기			2분기			3분기					
	주식		주식 합계	주식		주식 합계	주식		주식 합계	주식		주식 합계
	보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주	
배당기준일			2023-03-31			2023-06-30			2023-09-30			2023-12-31
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)			3.61			3.61			3.61			3.61
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)			3.61			3.61			3.61			3.62
지급된 배당금	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154			
지급될 배당금										2,155,092	297,884	2,452,976

20. 기타자본항목

기타자본구성요소

당기

(단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		(2,639,066)
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	488,102
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	(3,075,801)
	자기주식	(1,811,775)
	기타	1,760,408

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		(476,984)
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	246,155
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	(2,483,547)
	자기주식	0
	기타	1,760,408

자기주식에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 자기주식수(주)	29,700,000	4,050,000
자기주식 취득가액	1,625,252	186,523

전기 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 자기주식수(주)	0	0
자기주식 취득가액	0	0

21. 비용의 성격별 분류

비용의 성격별 분류 공시

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
매출원가와 판매관리비 합계		196,691,207
매출원가와 판매관리비 합계	제품 및 재공품 등의 변동	(27,504)
	원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	87,478,581
	급여	15,247,579
	퇴직급여	915,298
	감가상각비	30,285,298
	무형자산상각비	2,432,272
	복리후생비	3,414,856

	유틸리티비	5,759,175
	외주용역비	4,505,891
	광고선전비	1,634,516
	판매촉진비	1,385,627
	기타 비용	43,659,618

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
매출원가와 판매관리비 합계		181,900,387
매출원가와 판매관리비 합계	제품 및 재공품 등의 변동	(1,557,583)
	원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	89,350,845
	급여	13,941,832
	퇴직급여	736,004
	감가상각비	25,619,594
	무형자산상각비	2,614,189
	복리후생비	3,307,047
	유틸리티비	5,051,847
	외주용역비	3,791,485
	광고선전비	1,747,480
	판매촉진비	1,298,806
	기타 비용	35,998,841

성격별 비용에 대한 기술

손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

22. 판매비와관리비

판매비와관리비에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

			공시금액
판매비와관리비 합계			44,629,735
판매비와관리비 합계	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계		14,471,718
	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계	급여	2,521,337
		퇴직급여	163,548
		지급수수료	3,091,188
		감가상각비	477,811
		무형자산상각비	398,113
		광고선전비	1,634,516
		판매촉진비	1,385,627
		운반비	865,698
		서비스비	1,292,125
		기타판매비와관리비	2,641,755

	경상연구개발비-연구개발 총지출액	30,158,017

전기 (단위 : 백만원)

			공시금액
판매비와관리비 합계			37,876,835
판매비와관리비 합계	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계		14,023,986
	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계	급여	2,541,935
		퇴직급여	133,881
		지급수수료	3,566,826
		감가상각비	468,454
		무형자산상각비	390,581
		광고선전비	1,747,480
		판매촉진비	1,298,806
		운반비	541,902
		서비스비	981,945
		기타판매비와관리비	2,352,176
	경상연구개발비-연구개발 총지출액		23,852,849

23. 기타수익 및 기타비용

기타수익 및 기타비용

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타수익		10,351,185
기타수익	배당금수익	9,736,333
	임대료수익	184,855
	유형자산처분이익	64,356
	기타	365,641
기타비용		540,542
기타비용	유형자산처분손실	99,941
	기부금	150,377
	기타	290,224

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타수익		29,643,315
기타수익	배당금수익	29,096,899
	임대료수익	183,234
	유형자산처분이익	105,553
	기타	257,629
기타비용		375,723
기타비용	유형자산처분손실	49,044

	기부금	176,171
	기타	150,508

24. 금융수익 및 금융비용

금융수익 및 금융비용

당기 (단위 : 백만원)

			공시금액
금융수익 합계			7,717,689
금융수익 합계	이자수익(금융수익)		396,089
	이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	396,089
	외환차이		7,321,600
	파생상품관련이익		0
금융비용 합계			8,139,788
금융비용 합계	이자비용		839,611
	이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자비용	330,514
		기타 금융부채 이자비용	509,097
	외환차이		7,280,623
	파생상품관련손실		19,554

전기 (단위 : 백만원)

			공시금액
금융수익 합계			7,388,664
금융수익 합계	이자수익(금융수익)		371,106
	이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	371,106
	외환차이		6,652,107
	파생상품관련이익		365,451
금융비용 합계			7,598,459
금융비용 합계	이자비용		595,765
	이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자비용	310,267
		기타 금융부채 이자비용	285,498
	외환차이		7,002,694
	파생상품관련손실		0

금융수익 및 금융비용에 대한 기술

회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

25. 법인세비용

법인세비용(수익)의 주요 구성요소

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
당기법인세 소계		2,443,434
당기법인세 소계	기간손익에 대한 당기법인세	1,689,123
	당기에 인식한 조정사항	754,311
이연법인세 소계		(4,276,421)
이연법인세 소계	세액공제의 이월로 인한 이연법인세변동액	(4,658,032)
	일시적차이로 인한 이연법인세변동액	(547,094)
	이월결손금으로 인한 이연법인세 변동액	928,705
법인세비용 계		(1,832,987)

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
당기법인세 소계		(149,839)
당기법인세 소계	기간손익에 대한 당기법인세	337,983
	당기에 인식한 조정사항	(487,822)
이연법인세 소계		(7,715,760)
이연법인세 소계	세액공제의 이월로 인한 이연법인세변동액	(4,713,725)
	일시적차이로 인한 이연법인세변동액	(2,073,330)
	이월결손금으로 인한 이연법인세 변동액	(928,705)
법인세비용 계		(7,865,599)

회계이익에 적용세율을 곱하여 산출한 금액에 대한 조정

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
법인세비용차감전순이익	21,749,578
가중평균 적용세율에 따른 법인세비용	5,741,889
세무상 과세되지 않는 수익	(2,696,812)
세무상 차감되지 않는 비용	10,691
세액공제	(4,936,294)
기타	47,539
법인세비용 계	(1,832,987)

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
법인세비용차감전순이익	17,531,500
가중평균 적용세율에 따른 법인세비용	4,628,316
세무상 과세되지 않는 수익	(7,340,802)
세무상 차감되지 않는 비용	6,256
세액공제	(5,082,791)

기타	(76,578)
법인세비용 계	(7,865,599)

적용세율에 대한 기술

보고기간종료일 현재 제정된 세법에서 규정한 법정세율을 적용하여 산정하였습니다.

일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제에 대한 공시

당기

(단위 : 백만원)

	일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제													
	일시적차이로 인한 이연법인세									미사용 세무상 결손금	미사용 세액공제	자본에 직접 가감하는 이연법인세		일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 합계
	토지재평가	종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	감가상각누계액 등	미수수익	충당부채 및 미지급비용 등	외화평가조정	손상차손누계액	퇴직급여	기타			기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 등	순확정급여부채(자산) 재측정요소	
기초 이연법인세부채(자산)	898,687	228,304	1,408,682	3,564	(5,433,027)	(124,852)	(181,641)	1,879,227	(539,804)	(928,705)	(6,339,250)	88,295	(890,838)	(9,931,358)
이연법인세부채(자산)의 증가(감소)	(1,998)	(6,902)	(324,105)	28,996	(153,938)	(41,321)	(3,687)	(182,161)	138,022	928,705	(4,658,032)	86,785	(212,438)	(4,402,074)
기말 이연법인세부채(자산)	896,689	221,402	1,084,577	32,560	(5,586,965)	(166,173)	(185,328)	1,697,066	(401,782)	0	(10,997,282)	175,080	(1,103,276)	(14,333,432)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적 차이에 대한 설명		종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적 차이 중 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 경우 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.												

전기

(단위 : 백만원)

	일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제													
	일시적차이로 인한 이연법인세									미사용 세무상 결손금	미사용 세액공제	자본에 직접 가감하는 이연법인세		일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 합계
	토지재평가	종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	감가상각누계액 등	미수수익	충당부채 및 미지급비용 등	외화평가조정	손상차손누계액	퇴직급여	기타			기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 등	순확정급여부채(자산) 재측정요소	
기초 이연법인세부채(자산)	898,505	819,038	1,634,038	2,487	(3,613,572)	(147,194)	(184,282)	1,427,630	(624,180)	0	(1,625,525)	(43,991)	(685,466)	(2,142,512)
이연법인세부채(자산)의 증가(감소)	182	(590,734)	(225,356)	1,077	(1,819,455)	22,342	2,641	451,597	84,376	(928,705)	(4,713,725)	132,286	(205,372)	(7,788,846)
기말 이연법인세부채(자산)	898,687	228,304	1,408,682	3,564	(5,433,027)	(124,852)	(181,641)	1,879,227	(539,804)	(928,705)	(6,339,250)	88,295	(890,838)	(9,931,358)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적 차이에 대한 설명		종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자와 관련된 차감할 일시적 차이 중 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높지 않을 경우 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.												

이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제 시기

당기 (단위 : 백만원)

	12개월 이내에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	12개월 이후에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	합계 구간 합계
이연법인세부채(자산) 순액	(3,776,380)	(10,557,052)	(14,333,432)

전기 (단위 : 백만원)

	12개월 이내에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	12개월 이후에 결제될 이연법인세자산 및 이연법인세부채	합계 구간 합계
이연법인세부채(자산) 순액	(5,055,283)	(4,876,075)	(9,931,358)

26. 주당이익

주당이익

당기 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
지배회사지분 당기순이익	23,582,565	23,582,565
지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)	20,724,961	
가중평균유통보통주식수(주)	5,969,671,673	
기본 보통주 주당이익(원)	3,472	
지배기업의 우선주에 귀속되는 당기순이익(손실)		2,857,604
가중평균유통우선주식수(주)		822,871,378
기본 우선주 주당이익(원)		3,473

전기 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
지배회사지분 당기순이익	25,397,099	25,397,099
지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)	22,319,686	
가중평균유통보통주식수(주)	5,969,782,550	
기본 보통주 주당이익(원)	3,739	
지배기업의 우선주에 귀속되는 당기순이익(손실)		3,077,413
가중평균유통우선주식수(주)		822,886,700
기본 우선주 주당이익(원)		3,740

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당기 및 전기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

27. 현금흐름표

현금흐름의 회계정책에 대한 기술

회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다.

영업활동현금흐름

당기 (단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		21,493,129
조정내역 계	법인세비용 조정	(1,832,987)
	금융수익	(1,566,938)
	금융비용	2,545,209
	퇴직급여	915,298
	감가상각비	30,285,298
	무형자산상각비	2,432,272
	대손상각비	67,958
	배당금수익	(9,736,333)
	유형자산처분이익	(64,356)
	유형자산처분손실	99,941
	재고자산평가손실환입	(1,691,973)
	재고자산평가손실	
	기타	39,740
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(760,086)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(5,566,775)
	미수금의 감소(증가)	(1,213,085)
	장단기선급비용의 감소(증가)	(286,511)
	재고자산의 감소(증가)	1,929,763
	매입채무의 증가(감소)	2,028,901
	장단기미지급금의 증가(감소)	1,304,136
	선수금의 증가(감소)	47,859
	예수금의 증가(감소)	70,984
	미지급비용의 증가(감소)	(50,071)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,638,190
	퇴직금의 지급	(1,256,247)
	사외적립자산의 감소(증가)	1,021,978
	기타	(429,208)

전기 (단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		(4,092,924)
조정내역 계	법인세비용 조정	(7,865,599)
	금융수익	(995,482)

	금융비용	1,316,292
	퇴직급여	736,004
	감가상각비	25,619,594
	무형자산상각비	2,614,189
	대손상각비	2,308
	배당금수익	(29,096,899)
	유형자산처분이익	(105,553)
	유형자산처분손실	49,044
	재고자산평가손실환입	
	재고자산평가손실	3,558,358
	기타	74,820
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(13,215,547)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(6,883,154)
	미수금의 감소(증가)	612,652
	장단기선급비용의 감소(증가)	(339,588)
	재고자산의 감소(증가)	(4,399,456)
	매입채무의 증가(감소)	(701,579)
	장단기미지급금의 증가(감소)	(335,900)
	선수금의 증가(감소)	(18,100)
	예수금의 증가(감소)	(77,884)
	미지급비용의 증가(감소)	(1,677,917)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,076,981
	퇴직금의 지급	(702,328)
	사외적립자산의 감소(증가)	(156,245)
	기타	386,971

현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요 투자활동과 재무활동 거래

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가	324,785
유형자산의 본계정 대체	43,491,326
사용권자산의 취득(리스부채의 신규계약)	199,042
사채 및 장기차입금의 유동성 대체	22,264,226

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가	490,240
유형자산의 본계정 대체	38,188,436
사용권자산의 취득(리스부채의 신규계약)	873,056

사채 및 장기차입금의 유동성 대체	228,492

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	단기차입금	사채 및 장기차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계
기초	5,625,163	23,149,590	28,774,753
재무현금흐름	5,316,919	(217,305)	5,099,614
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가	0	199,042	199,042
그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)	168,890	(56,868)	112,022
기말	11,110,972	23,074,459	34,185,431

전기 (단위 : 백만원)

	단기차입금	사채 및 장기차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계
기초	2,381,512	815,644	3,197,156
재무현금흐름	3,274,337	21,804,684	25,079,021
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가	0	567,652	567,652
그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)	(30,686)	(38,390)	(69,076)
기말	5,625,163	23,149,590	28,774,753

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)에 대한 기술

상각, 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

리스 현금유출

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	210,858
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는 현금유출	32,567

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	178,979
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는 현금유출	28,282

기업이 보유한 현금및현금성자산에 대한 경영진의 기술

회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기금융상품,단기차입금 등으로 인한 현금의 유입과 유출항목을 순증감액으로 작성하였습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 회사의 현금및현금성자산은 대부분 예금 등으로 구성되어 있습니다.

28. 재무위험관리

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

	위험					
	시장위험			신용위험	유동성위험	위험 합계
	환위험	이자율위험	지분가격위험			
위험에 대한 노출정도에 대한 기술		이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다.	회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다.	신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대 노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.	유동성위험이란 회사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다.	회사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로구성되어 있습니다.

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술	회사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 회사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한 회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.	회사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.	회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.	신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없	대규모 투자가 많은 회사 사업 특성상적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다. 회사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성 위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하고 자금운용부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다. 또한 대규모 유동성이 필요한 경우에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.	회사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다. 재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다. 한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.

				는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.		

보고기간 말 현재 노출된 시장위험의 각 유형별 민감도 분석

당기 (단위 : 백만원)

	위험	
	시장위험	
	환위험	
	기능통화 또는 표시통화	
	USD	EUR
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.	기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
시장변수 상승 시 당기손익 증가	132,956	
시장변수 하락 시 당기손익 감소	132,956	
시장변수 상승 시 당기손익 감소		92,620
시장변수 하락 시 당기손익 증가		92,620

전기 (단위 : 백만원)

	위험	
	시장위험	
	환위험	
	기능통화 또는 표시통화	
	USD	EUR
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.	기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
시장변수 상승 시 당기손익 증가	201,224	
시장변수 하락 시 당기손익 감소	201,224	
시장변수 상승 시 당기손익 감소		25,356
시장변수 하락 시 당기손익 증가		25,356

보고기간 말 현재 노출된 주가변동의 각 유형별 민감도 분석

당기 (단위 : 백만원)

	위험
	시장위험
	지분가격위험
	금융자산, 분류
	기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향
시장변수 상승 시 기타포괄손익 증가	20,722

전기 (단위 : 백만원)

	위험
	시장위험
	지분가격위험
	금융자산, 분류
	기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향
시장변수 상승 시 기타포괄손익 증가	17,573

금융부채의 만기분석에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과	합계 구간 합계
금융부채	43,847,890	556,915	22,667,554	4,894,826	728,620	
종속기업 지급보증 및 이행보증 등으로 노출된 유동성위험의 최대금액						12,443,230
금융부채의 만기분석 금액에 대한 설명						위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	3개월 이내	~6개월	~1년	1~5년	5년 초과	합계 구간 합계
금융부채	32,311,019	374,370	980,835	27,454,095	1,378,061	
종속기업 지급보증 및 이행보증 등으로 노출된 유동성위험의 최대금액						10,960,748
금융부채의 만기분석 금액에 대한 설명						위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

회사가 금융기관과 체결한 공급자금융약정에 대한 기술

회사가 금융기관과 체결한 공급자금융약정에 근거하여, 회사에 재화 및 용역을 공급한 업체가 대금 지급기한 내에 매출채권을 금융기관에 양도할 경우, 회사는 그 대금을 금융기관에 지급합니다. 이 약정은 대금 지급과정을 효율화하고, 공급자에게 조기결제 조건을 제공하기 위한 목적이며, 원채무의 책임이 면제되거나 대금지급 조건에 실질적인 변경이 없으므로 매입채무 또는 미지급금으로 인식된 원채무는 제거하지 않습니다.

부채비율에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공시금액
부채	88,569,470
자본	236,396,657
부채비율	0.375
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	공시금액
부채	72,069,515
자본	224,787,774
부채비율	0.321

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

금융상품의 장부금액에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

			공시금액
금융자산 합계			53,497,788
금융자산 합계	현금및현금성자산		1,653,766
	단기금융상품		10,187,991
	매출채권		33,840,357
	기타포괄손익-공정가치금융자산		2,176,346
	당기손익-공정가치금융자산		0
	기타금융자산		5,639,328
금융부채 합계			72,082,744
금융부채 합계	매입채무		10,287,967
	단기차입금		11,110,972
	미지급금		18,331,728
	유동성장기부채		22,264,226
	유동성장기부채	유동성장기차입금	22,256,961
		유동성사채	7,265
	사채		14,530
	장기차입금		795,703
	장기미지급금		4,383,749
	기타금융부채		4,893,869

전기 (단위 : 백만원)

			공시금액
금융자산 합계			40,694,561
금융자산 합계	현금및현금성자산		6,061,451
	단기금융상품		50,071
	매출채권		27,363,016
	기타포괄손익-공정가치금융자산		1,854,503
	당기손익-공정가치금융자산		1
	기타금융자산		5,365,519
금융부채 합계			59,873,524
금융부채 합계	매입채무		7,943,834

	단기차입금		5,625,163
	미지급금		15,015,578
	유동성장기부채		228,491
	유동성장기부채	유동성장기차입금	222,137
		유동성사채	6,354
	사채		19,064
	장기차입금		22,902,035
	장기미지급금		4,486,390
	기타금융부채		3,652,969

금융상품의 공정가치에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

		공정가치
기타포괄손익-공정가치금융자산		2,176,346
당기손익-공정가치금융자산		0
기타금융자산		373,681
유동성장기부채		7,737
유동성장기부채	유동성사채	7,737
사채		16,427
기타금융자산 금액 중 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금액		5,265,647

전기 (단위 : 백만원)

		공정가치
기타포괄손익-공정가치금융자산		1,854,503
당기손익-공정가치금융자산		1
기타금융자산		393,235
유동성장기부채		6,757
유동성장기부채	유동성사채	6,757
사채		21,695
기타금융자산 금액 중 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금액		4,972,284

금융상품의 공정가치에 대한 공시 표상 일부 금융상품에 대하여 공정가치 공시를 제외한 사유

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

금융상품의 공정가치에 대한 공시 표상 기타금융자산 및 기타금융부채 금액에 대한 기술

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금융자산 5,265,647백만원 (전기말: 4,972,284백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

금융상품의 공정가치에 대한 공시 표상 유동성장기차입금, 장기차입금에 대하여 리스부채를 공정가치 공시대상에서 제외한 사유

리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	측정 전체											
	공정가치											
	자산											
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산				당기손익-공정가치금융자산				기타금융자산			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계
	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계
자산	2,072,180	0	104,166	2,176,346	0	0	0	0	0	0	373,681	373,681

전기 (단위 : 백만원)

	측정 전체											
	공정가치											
	자산											
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산				당기손익-공정가치금융자산				기타금융자산			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계
	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계
자산	1,757,336	0	97,167	1,854,503	0	0	1	1	0	0	393,235	393,235

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	측정 전체							
	공정가치							
	부채							
	유동성사채				사채			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의
	수준 1	수준 2	수준 3	모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	모든 수준 합계
부채	0	7,737	0	7,737	0	16,427	0	16,427

전기 (단위 : 백만원)

	측정 전체							
	공정가치							
	부채							
	유동성사채				사채			
	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의
	수준 1	수준 2	수준 3	모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	모든 수준 합계
부채	0	6,757	0	6,757	0	21,695	0	21,695

금융상품의 공정가치측정에 대한 공시

	수준 1	수준 2	수준 3

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채	동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

평가기법 및 투입변수에 대한 기술

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다. 회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. 회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

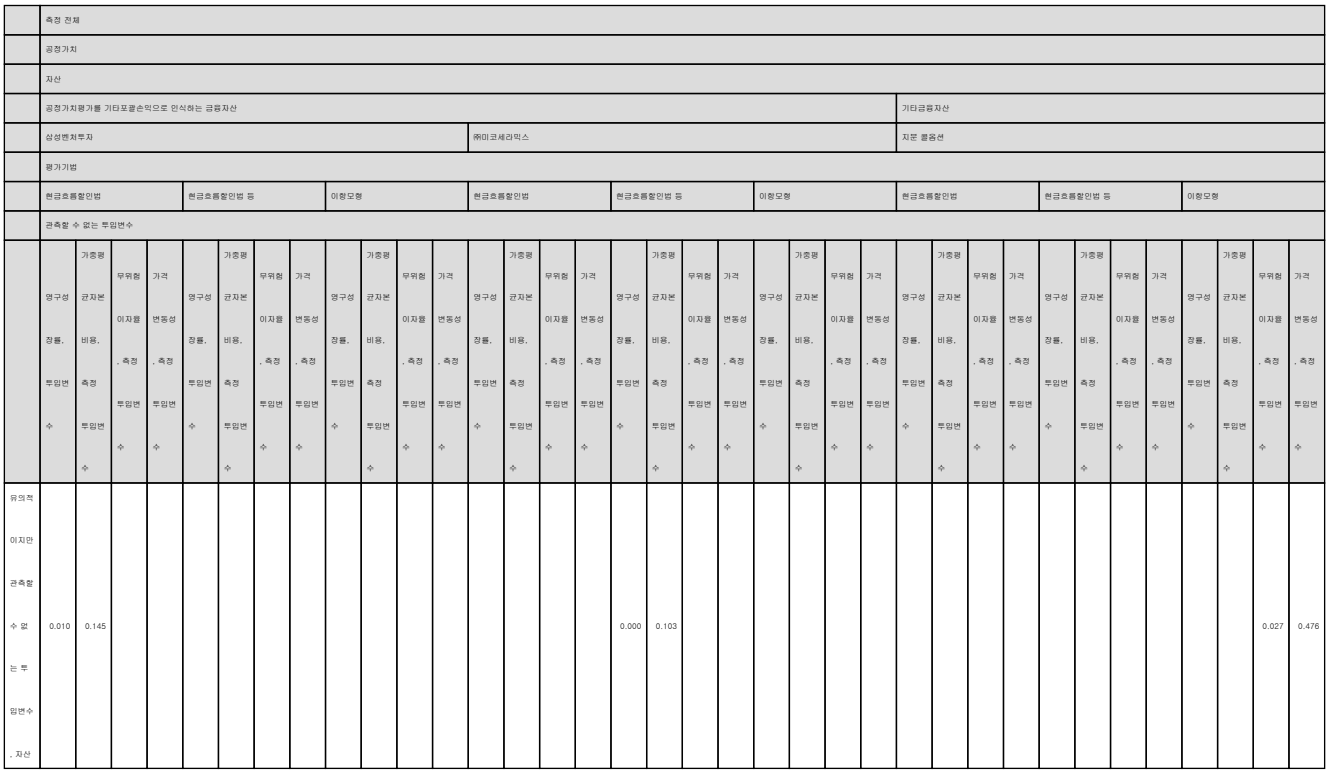
자산의 가치평가기법 및 투입변수에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	측정 전체		
	공정가치		
	자산		
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산		기타금융자산
	삼성벤처투자	㈜미코세라믹스	지분 콜옵션
	공정가치 서열체계의 모든 수준		
	공정가치 서열체계 수준 3		
자산	36,253	49,794	373,681

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산	현금흐름할인법	현금흐름할인법 등	이항모형
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	영구성장률, 가중평균자본비용	영구성장률, 가중평균자본비용	무위험 이자율, 가격 변동성

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시



자산의 공정가치측정에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 모든 수준
	수준 3
	자산
	금융자산, 범주
기초금융자산	490,403
매입	0
매도	(2,942)
당기손익으로 인식된 손익	(19,555)
기타포괄손익으로 인식된 손익	9,941
기말금융자산	477,847

전기 (단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 모든 수준
	수준 3
	자산
	금융자산, 범주
기초금융자산	116,726
매입	27,784
매도	(343)
당기손익으로 인식된 손익	365,451
기타포괄손익으로 인식된 손익	(19,215)
기말금융자산	490,403

관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정의 민감도분석 공시, 자산

(단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 모든 수준									
	공정가치 서열체계 수준 3									
	자산									
	기타포괄손익-공정가치금융자산					기타				
	관측할 수 없는 투입변수				관측할 수 없는 투입변수 합계	관측할 수 없는 투입변수				관측할 수 없는 투입변수 합계
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	기초 자산 가격, 측정 투입변수	가격 변동성		영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	기초 자산 가격, 측정 투입변수	가격 변동성	
관측가능하지 않은 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정치의 민감도에 대한 기술, 자산	주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률 및 가중평균자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.	주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률 및 가중평균자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.						주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.	주요 관측불가능한 투입변수인 가격 변동성(10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.	
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산	0.01	0.01						0.20	0.10	
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산	0.01	0.01						0.20	0.10	
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산					0					127,996

당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산					0					(127,995)
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산					6,327					0
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산					(4,182)					0

29. 부문별 보고

영업부문에 통합기준을 적용하면서 이루어진 경영진의 판단에 대한 설명

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.
매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문 등으로 구성되어 있습니다. 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	기업 전체 총계		기업 전체 총계 합계
	영업부문		
	DX 부문	DS부문	
매출액	109,294,016	108,861,352	209,052,241

감가상각비	565,540	29,518,534	30,285,298
무형자산상각비	1,595,847	605,793	2,432,272
영업이익	1,474,559	10,886,378	12,361,034
보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술			기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전기 (단위 : 백만원)

	기업 전체 총계		기업 전체 총계 합계
	영업부문		
	DX 부문	DS부문	
매출액	106,661,889	65,438,933	170,374,090
감가상각비	534,813	24,882,772	25,619,594
무형자산상각비	1,682,132	696,457	2,614,189
영업이익	5,256,921	(16,788,154)	(11,526,297)
보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술			기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

30. 특수관계자와의 거래

가. 보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung Lennox HVAC North America, LLC	에어컨공조 판매	50.1
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0

	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	해외자회사 관리	100.0
	eMagin Corporation	디스플레이 패널 개발 및 생산	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0
	Sonio Corporation	소프트웨어 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0

	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Roon Labs, LLC.	오디오제품 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽・CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV・모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0

	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Oxford Semantic Technologies Limited (OST)	R&D	100.0
	Sonio SAS	소프트웨어 판매, R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽・CIS	AKG Acoustics Gmbh	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0

	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding Gmbh & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Management Gmbh	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
중동・아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co., Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Middle East and North Africa (SEMENA)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	전자제품 판매	100.0

	(SSA)		
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV・모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
아시아(중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	R&D	100.0

	(SRI-Bangalore)		
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0

	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체·FPD 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
국내	삼성디스플레이㈜	디스플레이 패널 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스㈜	디스플레이 패널 부품 생산	50.0
	스테코㈜	반도체 부품 생산	70.0
	세메스㈜	반도체·FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스㈜	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스㈜	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5
	㈜희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	㈜미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0

	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 62호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 67호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5
	반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

특수관계자거래에 대한 공시

당기

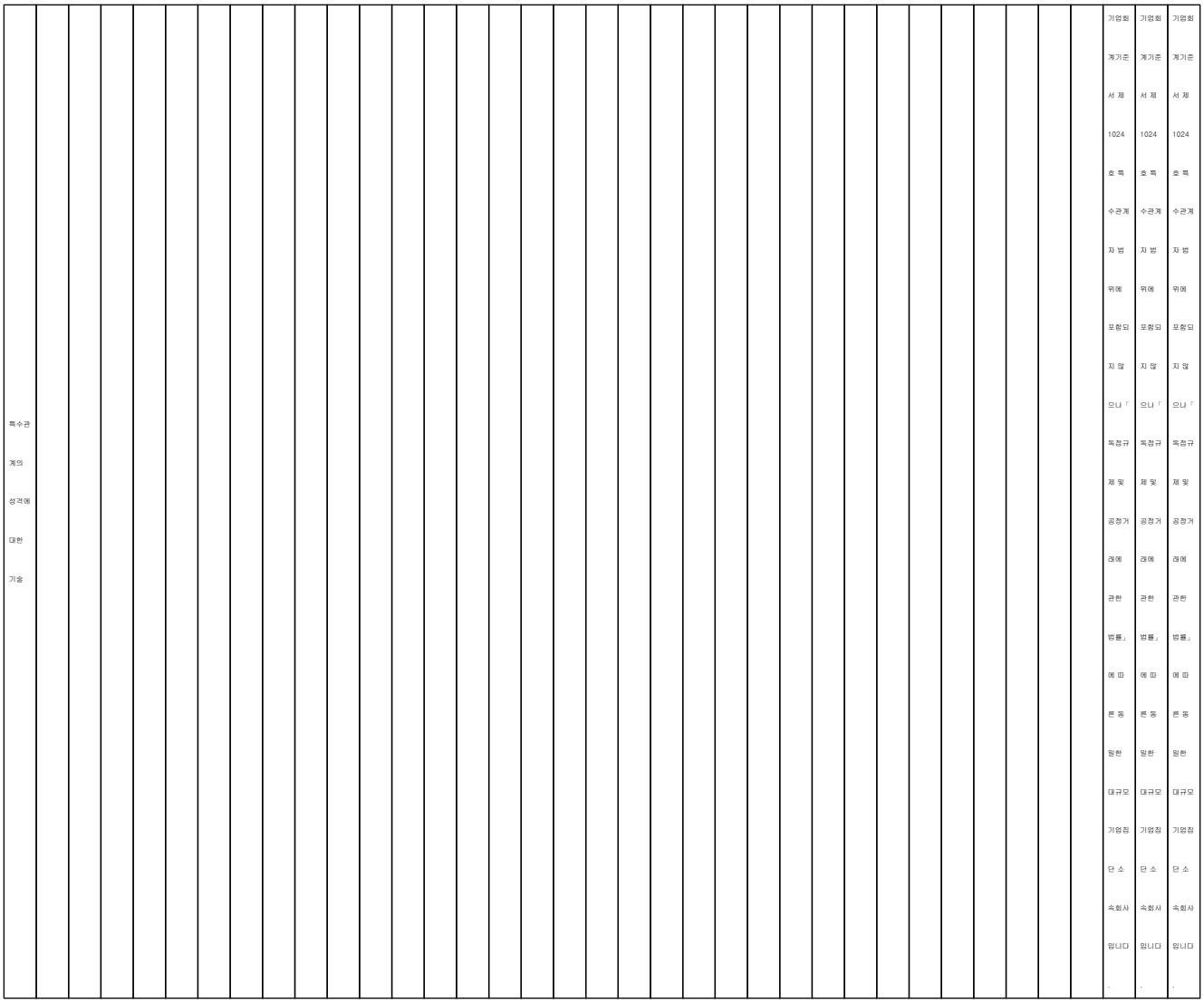
(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자																																		
	특수관계자																																				
	종속기업																									관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성디스플레이㈜	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Harman 그 종속기업	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Samsung Electronics Vietnam THAI NGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	Samsung Electronics Europe Holding Coopératief U.A. (SEEH)	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Samsung International, Inc. (SII)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	세메스㈜	Samsung Electronics GmbH (SEG)	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	기타 종속기업	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공동기업	삼성물산㈜	그 밖의 특수관계자, 기타	삼성에버랜드㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사
매출 등, 특수관계자거래	6,081,548	29,191,890	45	92	42,993,409	1,691	305,793	2,623,756	2,822,390	3,382,049	0	1,715,000	1,567,614	28,414,204	508,390	2,470,490	1,921,656	2,283,763	259,766	4,652,560	6,286	3,367,756	2,982,398	6,291,992	931,126	50,898,717	103,524	37,521	70,196	34,803	641,033	12,795	629,744	2,244	8,812	207,490

비유동자산 처분, 특수관계자거래	0	49	0	0	0	0	13,573	0	461	0	0	0	0	0	272	149	0	20	1,753	0	0	0	0	0	0	22,109	21,504	0	0	0	122	0	0	0	0	0
매입 등, 특수관계자거래	1,978,814	239,434	19,630	4,998,728	952,847	86,182	11,179,941	14,749	22,021,129	6,247,023	0	14,392,955	0	0	6,049,850	6,434	116,400	2,158,606	7,316,100	1,490	1,973,123	7,298	10,331	3,153	937	13,541,160	1,960,668	793,001	326,467	934,551	982,206	119,056	642,110	57,371	452,836	251,877
비유동자산 매입, 특수관계자거래	0	0	0	0	0	0	4,579	0	4,070	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,969	271,717	0	20,515	7,125	8,264	5,658,238	161,448	4,209,500	38,931	894,163
특수관계자거래에 대한 기술	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다. Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사의 거래 금액입니다.

| | | |

| | | |



특수관계자거래에 대한 공시, 합계

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자			
	특수관계자			
	종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	195,674,381	887,077	642,539	218,546
비유동자산 처분, 특수관계자거래	38,386	21,626	0	0
매입 등, 특수관계자거래	93,316,314	4,996,893	761,166	762,084
비유동자산 매입, 특수관계자거래	16,750	307,621	5,819,686	5,142,594
특수관계자거래에 대한 기술	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자			
	특수관계자			
	종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	175,047,007	973,319	491,975	206,530
비유동자산 처분, 특수관계자거래	51,051	0	70	0
매입 등, 특수관계자거래	82,847,307	4,837,793	820,296	758,281
비유동자산 매입, 특수관계자거래	29,552	325,409	5,778,675	3,283,656
특수관계자거래에 대한 기술	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자			
	특수관계자			
	종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단

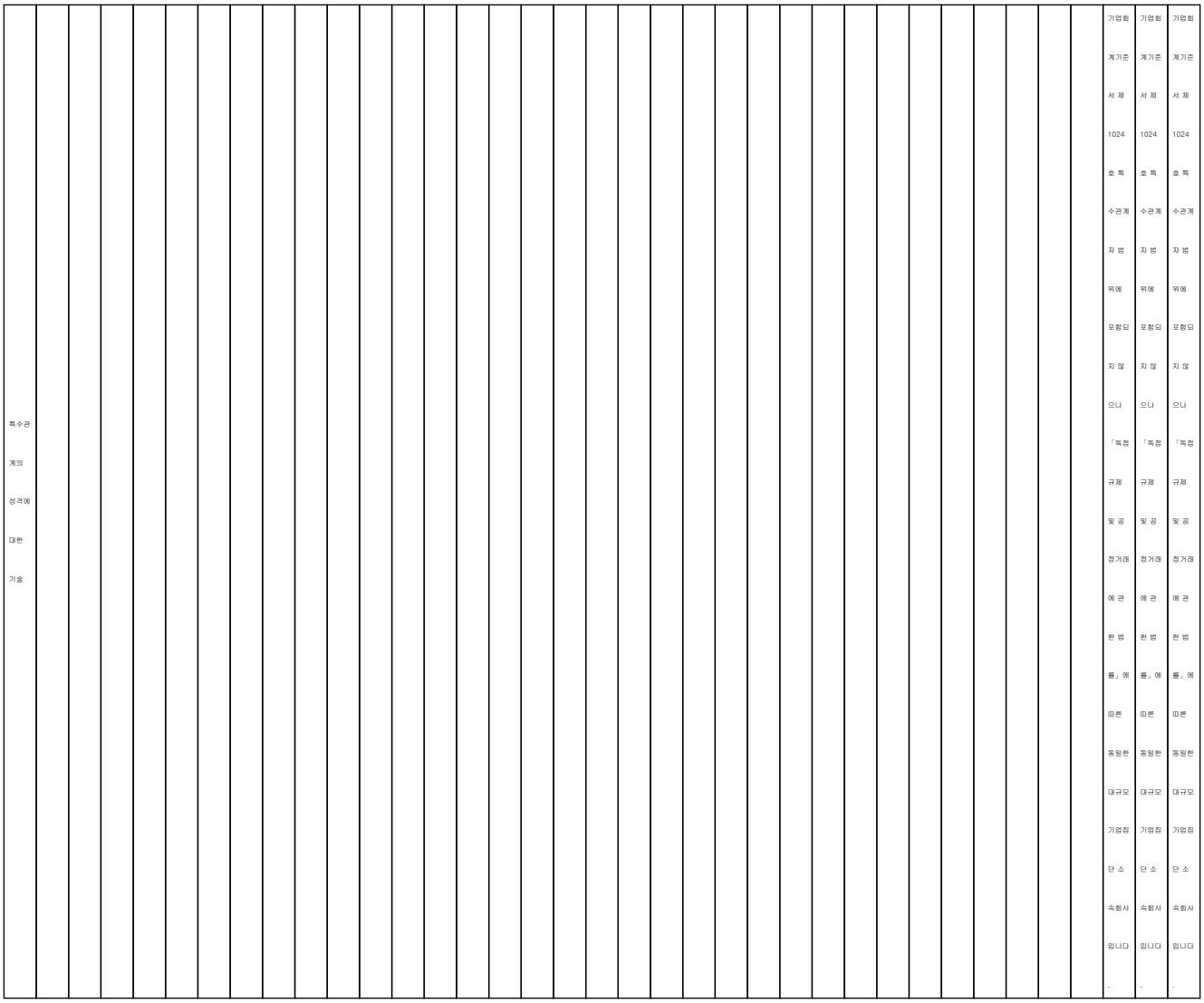
	삼성디스플레이㈜	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Harman 그 종속기업	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Samsung International, Inc. (SII)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	세메스㈜	Samsung Electronics GmbH (SEG)	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	기타 종속기업	삼성메디스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공동기업	삼성물산㈜	그 밖의 특수관계자, 기타	삼성아㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사
채권 등, 특수관계자거래	64,853	4,440,842	1,817	7,277	11,910,574	8,749	59,706	190,954	833,617	696,280	3,256	513,163	97,479	4,859,048	137,456	271,048	93,808	98,027	167,656	388,807	81,448	16,599	88,572	424,204	23,398	6,759,498	23,133	4,039	114,061	69	156,624	181,822	14,747	475	2,330	3,489
채무 등, 특수관계자거래	218,158	637,861	1,301	584,322	340,273	20,906	970,717	363,362	2,620,106	430,196	0	2,010,992	362	82	620,008	9,157	30,843	262,109	212,535	69,362	699,286	95,727	2,064	244,987	7,495	3,156,728	569,158	66,901	33,653	425,271	197,504	1,781,431	179,533	1,870,246	50,798	599,373

특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명
회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무증권 스부채가 포함된 금액입니다.

| | | |

채무보증, 특수관계자거래	196,686	1,119,907	1,147	303,203	209,789	9,659	687,410	201,966	2,324,691	297,628	0	1,377,493	46	281	367,007	1,226	40,118	267,659	54,694	87,718	917,707	4,448	2,021	415	6,266	2,607,878	418,787	86,166	50,149	429,435	183,813	1,876,745	149,585	766,329	39,223	265,721

| 특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명 | 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무증권 리스부채가 포함된 금액입니다.



특수관계자에 대한 채권 채무에 대한 공시, 합계

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자			
	특수관계자			
	종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	32,238,136	297,926	196,569	6,294
채무 등, 특수관계자거래	13,608,939	1,292,487	1,960,964	2,520,417

특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자			
	특수관계자			
	종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	24,463,048	364,610	204,278	5,209
채무 등, 특수관계자거래	11,087,063	1,168,350	2,026,330	1,071,273
특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

특수관계자 자금거래에 관한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	종속기업	관계기업 및 공동기업	대규모기업집단
대여거래, 대여	0	0	
차입거래, 차입	0	0	
현금출자, 출자금 납입	336,648	0	
현금출자, 출자금 회수	319,943	0	
지급결의한 배당금, 특수관계자거래			128,232
차입금	21,990,000		

전기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	종속기업	관계기업 및 공동기업	대규모기업집단
대여거래, 대여	0	0	
차입거래, 차입	21,990,000	0	
현금출자, 출자금 납입	49,318	58,982	
현금출자, 출자금 회수	143,799	518	
지급결의한 배당금, 특수관계자거래			128,232
차입금	21,990,000		

특수관계자 자금거래에 관한 공시_2

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자

	종속기업, 관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자
지급결의한 배당금, 특수관계자거래	1,610,832
배당과 관련한 미지급금에 대한 기술	배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.
리스 이용 계약, 특수관계자거래	23,571
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	60,211
채무보증에 대한 설명	회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 16 참조).

전기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	종속기업, 관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자
지급결의한 배당금, 특수관계자거래	1,650,995
배당과 관련한 미지급금에 대한 기술	배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.
리스 이용 계약, 특수관계자거래	182,860
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	59,287
채무보증에 대한 설명	회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 16 참조).

주요 경영진(등기임원)에 대한 보상에 대한 공시

당기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	9,991
퇴직급여	600
기타 장기급여	8,078

전기 (단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	14,073
퇴직급여	557
기타 장기급여	7,834

31. 보고기간 후 사건

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

	수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건		수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건 합계
	주요한 보통주 거래		
	주식		
	보통주	우선주	
수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술	회사는 2024년 11월 15일 이사회 결의에 의거하여 자기주식 매입을 진행중이며, 보고기간일 이후 감사보고서일까지 총 2,330만주(보통주 2,044만주, 우선주 286만주)를 취득하였습니다.	회사는 2024년 11월 15일 이사회 결의에 의거하여 자기주식 매입을 진행중이며, 보고기간일 이후 감사보고서일까지 총 2,330만주(보통주 2,044만주, 우선주 286만주)를 취득하였습니다.	
자기주식 매입에 대한 이사회결의일	2024-11-15	2024-11-15	2024-11-15
보고기간일 이후 감사보고서일까지 취득한 자기주식수(만주)	2,044	286	2,330

6. 배당에 관한 사항

6-1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 2021~2023년의 주주환원 정책에 따라 3년간 잉여현금흐름(Free Cash Flow)의 50%를 재원으로 활용하여 정규 배당을 연간 총 9.8조원 수준으로 실시하였습니다. 2024~2026년의 주주환원 정책은 2024년 1월에 발표하였으며, 이에 따라 당사는 2024년부터 2026년까지 3년간 발생하는 잉여현금흐름의 50%를 재원으로 활용하여 연간 9.8조원 수준의 정규배당을 유지하되, 정규배당 이후에도 잔여 재원이 발생하는 경우에 추가로 환원할 계획입니다. 또한, 당사는 2024년부터 2026년까지의 주주환원 정책 대상 기간 종료 이전이라도 M&A 추진, 현금규모 등을 감안하여 탄력적으로 새로운 주주환원 정책을 발표하고 시행할 수 있습니다.

한편, 당사는 2024년 11월 향후 1년간 총 10조원 규모의 자사주 분할 매입 계획을 발표하고, 이 중 3조원은 주주가치 제고를 목적으로 매입 후 2025년 2월에 소각하였습니다. 또한 2025년 2월에 주주가치 제고 및 임직원 보상 등 목적으로 잔여 7조원 중 약 3조원 규모의 자사주 취득을 결정하였습니다.

6-2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획
정관상 배당액 결정 기관	- 분기배당은 이사회, 기말배당은 주주총회에서 결정
정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	- 불가
배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	- 검토 중

나. 기말 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액 확정일	배당기준일	배당 예측가능성 제공여부	비고
기말배당	2023년 12월	O	2024년 03월 20일	2023년 12월 31일	X	-
기말배당	2022년 12월	O	2023년 03월 15일	2022년 12월 31일	X	-
기말배당	2021년 12월	O	2022년 03월 16일	2021년 12월 31일	X	-

※ 당사는 3년 단위(2024~2026년)의 주주환원 정책을 발표하고 매년 분기 단위로 동일한 금액(약 9.8조원)의
정규배당을 실시하여 실질적인 예측가능성을 제공하고 있음

6-3. 기타 참고사항

[주요 배당지표]

(단위 : 원, 백만원, %, 주)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제56기	제55기	제54기
주당액면가액(원)		100	100	100
(연결)당기순이익(백만원)		33,621,363	14,473,401	54,730,018
(별도)당기순이익(백만원)		23,582,565	25,397,099	25,418,778
(연결)주당순이익(원)		4,950	2,131	8,057
현금배당금총액(백만원)		9,810,767	9,809,438	9,809,438
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		29.2	67.8	17.9
현금배당수익률(%)	보통주	2.7	1.9	2.5
	우선주	3.3	2.4	2.7
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	1,446	1,444	1,444
	우선주	1,447	1,445	1,445
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 현금배당금총액의 자세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '연결이익잉여금' 항목을 참고하시기 바랍니다. 분기 배당금은

제56기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원),3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이며,

제55기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이고,

제54기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)입니다.

[배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
42	44	2.4	2.6

※ 연속 배당횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.

※ 중간배당은 1999년(제31기)부터 연속 배당 시작하였고, 분기배당은 2017년(제49기)부터 연속 배당중이며, 결산배당은 1981년(제13기)부터 연속 배당 중입니다.

※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다.우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 2.8%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 2.9%입니다.

※ 최근 3년간은 2021년(제53기)부터 2023년(제55기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2019년(제51기)부터 2023년(제55기)까지 기간입니다.2024년(제56기) 배당수익률은 상기 '주요 배당지표'를 참고하시기 바랍니다(보통주 2.7%, 우선주 3.3%).

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자㈜	회사채	공모	1997.10.02	147,000	7.7%	Aa2 (Moody's), AA- (S&P)	2027.10.01	일부상환	Goldman Sachs 등
Harman International Industries, Inc	회사채	공모	2015.05.11	588,000	4.2%	A (S&P)	2025.05.15	미상환	J.P. Morgan 등
합 계	-	-	-	735,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 전자단기사채 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	595,350	7,350	7,350	-	-	-	-	610,050
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	595,350	7,350	7,350	-	-	-	-	610,050

- 삼성전자㈜

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	7,350	7,350	7,350	-	-	-	-	22,050
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	7,350	7,350	7,350	-	-	-	-	22,050

- Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	588,000	-	-	-	-	-	-	588,000
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	588,000	-	-	-	-	-	-	588,000

※ 미상환잔액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

마. 신종자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	147,000	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만
	이행현황	계약내용 이행 중 (해당 자산에 대해 담보권 설정 없음)
자산처분 제한현황	계약내용	(보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 중 (2024년 중 처분 자산은 전체의 0.0%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

※ 발행액은 기준일 환율을 적용하였습니다.
※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.는
Fiscal Agent의 지위에 있습니다.
※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.
※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근 재무제표의 작성기준일입니다.
※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

해당사항 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

(eMagin Corporation 지분인수)

종속기업 Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)는 Micro Display 기술 경쟁력을 확보를 위해 2023년 10월 18일자로 eMagin Corporation (대표자: AndrewSculley, 소재지: New York, USA) 지분 100%를 인수하였습니다.

(㈜도우인시스 지분매각)

종속기업 삼성디스플레이㈜는 OLED 산업 내 경쟁구도가 갈수록 심화되고 있는 상황에서 본연의 사업과 R&D에 집중하기 위해 2024년 1월 31일자로 SVIC 29호 신기술투자조합 및 SVIC 48호 신기술투자조합이 보유한 ㈜도우인시스 지분 56.8%를 ㈜뉴파워프라즈마 등 3개사에 매각하였습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

(자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리)

해당사항 없습니다.

(중요한 소송사건)

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(채무보증 내역)

1) 국내채무보증

해당사항 없습니다.

2) 해외채무보증

(단위 : 천US$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2024.04.20	2025.11.08	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2024.03.28	2025.12.16	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2024.10.01	2025.12.16	329,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	62,000	64,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2024.06.01	2025.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.12.16	96,000	46,000	8,065	△8,065	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	917,000	947,000	320,893	174,428	495,321	47.5%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.12.16	70,000	70,000	-	-	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	114,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2024.04.28	2025.12.16	835,508	808,270	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	125,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	537,000	537,000	-	-	-	
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	888,400	906,400	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	15,600	15,600	-	-	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	270,000	270,000	-	-	-	
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	30,000	30,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	10,000	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증 시작일	보증 종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2023.02.17	2027.11.24	601,149	584,785	510,977	△13,910	497,067	8.36%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무소멸시	340,000	340,000	-	-	-	
SEA	계열회사	US Government	지급보증	보조금	2024.12.20	채무소멸시	-	6,435,000	-	-	-	
합 계							9,070,657	15,462,055	839,935	152,453	992,388	

※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA가 각각 채무보증인입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를 수취하고 있습니다.당사는 2024년 중 US$2,215천의 수수료를 청구하였으며, 2024년말 현재 미수취하였습니다.

한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2024년 중 $2,982천 수수료를 청구하였으며, 2024년말 현재 미수취하였습니다.

※ SEA의 US Government 채무는 SAS가 반도체 보조금 계약 불이행시 미 상무부에 반환해야하는 금액에 대한 모법인의 지급보증 계약입니다.

☞ 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항)

구 분	강조사항 등	핵심감사사항
제56기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성 (별도재무제표) 1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제55기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성 (별도재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제54기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

나. 대손충당금(손실충당금) 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금 (손실충당금)	대손충당 설정률
제56기말	매출채권	44,044,074	421,001	1.0%
	단기대여금	119,558	94,051	78.7%
	미수금	9,707,716	84,742	0.9%
	선급금	1,366,329	4,573	0.3%
	장기매출채권	27,641	-	0.0%
	장기미수금	784,030	203	0.0%
	장기선급금	5,997,761	6,802	0.1%
	장기대여금	141,149	911	0.6%
	합 계	62,188,258	612,285	1.0%
제55기말	매출채권	37,002,849	355,456	1.0%
	단기대여금	21,279	204	1.0%
	미수금	6,715,263	82,015	1.2%
	선급금	994,525	3,316	0.3%
	장기매출채권	23,889	-	0.0%
	장기미수금	759,704	209	0.0%
	장기선급금	4,964,481	9,255	0.2%
	장기대여금	239,149	77,608	32.5%
	합 계	50,721,139	528,063	1.0%
제54기말	매출채권	36,033,784	312,221	0.9%
	단기대여금	22,403	215	1.0%
	미수금	6,227,068	77,859	1.3%
	선급금	1,741,031	3,965	0.2%
	장기매출채권	204,248	-	0.0%
	장기미수금	824,468	242	0.0%
	장기선급금	2,382,711	10,969	0.5%
	장기대여금	225,983	1,206	0.5%
	합 계	47,661,696	406,677	0.9%

※ 연결 기준입니다.

※ 채권 금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

(2) 대손충당금(손실충당금) 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제56기	제55기	제54기
기초 대손충당금(손실충당금)	528,063	406,677	397,525
순대손처리액(①-②+③)	△22,558	14,647	16,658
① 대손처리액(상각채권액) 등	10,834	19,179	9,711
② 상각채권회수액	-	4	-
③ 기타증감액	△33,392	△4,528	6,947
대손상각비 계상(환입)액	61,664	136,033	25,810
기말 대손충당금(손실충당금)	612,285	528,063	406,677

※ 연결 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

(3) 매출채권 관련 대손충당금(손실충당금) 설정 방침

(설정방침)

- 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하는 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금(손실충당금) 설정

(대손경험률 및 대손예상액 산정근거)

- 대손경험률: 과거 3개년 평균 채권잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 합리적인 대손예상액 설정

[대손 설정 기준]

상 황	설정률
분 쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소 송	75 %
부 도	100 %

(대손 처리 기준)

매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생 시 실대손처리
- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	43,821,805	28,084	111,835	109,991	44,071,715
구성비율	99.4%	0.1%	0.3%	0.2%	100.0%

※ 연결 기준입니다.

※ 매출채권 잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

다. 재고자산 현황

(1) 사업부문별 재고자산의 보유 현황

(단위 : 백만원, %, 회)

부문	계정과목	제56기말	제55기말	제54기말
DX 부문	제품 및 상품	7,198,304	7,229,898	7,712,885
	반제품 및 재공품	1,130,657	967,513	1,013,606
	원재료 및 저장품	10,352,671	9,608,619	10,520,293
	미착품	1,231,092	1,014,420	943,322
	소 계	19,912,724	18,820,450	20,190,106
DS 부문	제품 및 상품	5,394,407	6,476,768	6,601,087
	반제품 및 재공품	21,091,920	20,961,730	18,756,104
	원재료 및 저장품	3,134,003	3,484,046	3,639,061
	미착품	68,244	76,226	61,352
	소 계	29,688,574	30,998,770	29,057,604
SDC	제품 및 상품	458,697	284,394	811,518
	반제품 및 재공품	151,553	296,788	542,473
	원재료 및 저장품	575,119	564,573	788,521
	미착품	15,672	6,509	23,626
	소 계	1,201,041	1,152,264	2,166,138
Harman	제품 및 상품	916,269	725,484	799,919
	반제품 및 재공품	108,241	104,514	119,890
	원재료 및 저장품	680,564	700,011	913,085
	미착품	401,238	319,785	269,715
	소 계	2,106,312	1,849,794	2,102,609
총 계	제품 및 상품	13,842,276	14,553,014	16,032,226
	반제품 및 재공품	22,340,482	22,198,448	20,077,519
	원재료 및 저장품	14,146,279	13,697,354	14,979,280
	미착품	1,425,828	1,177,058	1,098,841
	소 계	51,754,865	51,625,874	52,187,866
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		10.1%	11.3%	11.6%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		3.6회	3.5회	4.1회

※ 당사 연결 기준입니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등

(실사내역)

・5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
・재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역을 확인하여 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인

(실사방법)

・사내보관재고: 폐창식 전수조사 실시
※ 반도체 및 디스플레이 패널 라인 재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
・사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고는 전수로 물품보유확인서 또는 장치보관확인서 징구 및 표본조사 병행
・외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회・확인하고 일부 항목은 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인

※ 당사는 2024년 11월 30일부터 12월 3일까지 하반기 재고실사를 실시하였으며, 종속기업들도 동일기준(11월말)으로 하반기 재고실사를 진행하였습니다.

(장기체화재고 등 내역)

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우 저가법 등을 사용하여 재고자산의 장부금액을 결정하고 있으며, 2024년말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	기말잔액
제품 및 상품	15,061,526	15,061,526	△1,219,250	13,842,276
반제품 및 재공품	24,808,183	24,808,183	△2,467,701	22,340,482
원재료 및 저장품	15,442,327	15,442,327	△1,296,048	14,146,279
미착품	1,425,828	1,425,828	-	1,425,828
합 계	56,737,864	56,737,864	△4,982,999	51,754,865

※ 당사 연결 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

라. 수주계약 현황

2024년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

마. 공정가치평가 내역

(1) 금융상품의 공정가치평가 방법

[금융자산]

(분류)

당사는 금융자산을 공정가치 측정 금융자산(기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치변동 인식), 상각후원가 측정 금융자산으로 분류합니다.

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(측정)

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상현금흐름 특성에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산
사업모형이 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
사업모형이 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산
상기 상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에
'기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로, 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

(손상)

당사는 미래전망정보에 근거하여, 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(인식과 제거)

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

(금융상품의 상계)

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

[금융부채]

(분류 및 측정)

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채
   파생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채
   이러한 금융부채는 상기 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
3) 금융보증계약
   최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
   - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
   - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정
   최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
   - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
   - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가
   이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

(제거)

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

[파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품 내역

1) 제56기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	53,705,579	-	-	-	53,705,579
단기금융상품	58,909,334	-	-	-	58,909,334
단기상각후원가금융자산	-	-	-	-	-
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	36,877	-	36,877
매출채권	43,623,073	-	-	-	43,623,073
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	10,580,932	-	-	10,580,932
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,175,749	-	1,175,749
기타	14,378,224	-	476,394	44,262	14,898,880
계	170,616,210	10,580,932	1,689,020	44,262	182,930,424

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	12,370,177	-	-	12,370,177
단기차입금	338,058	-	12,834,446	13,172,504
미지급금	17,390,861	-	-	17,390,861
유동성장기부채	1,106,764	-	1,100,526	2,207,290
사채	14,530	-	-	14,530
장기차입금	6,537	-	3,929,323	3,935,860
장기미지급금	4,779,141	-	-	4,779,141
기타	13,698,485	36,795	57,764	13,793,044
계	49,704,553	36,795	17,922,059	67,663,407

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로

분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

2) 제55기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	69,080,893	-	-	-	69,080,893
단기금융상품	22,690,924	-	-	-	22,690,924
단기상각후원가금융자산	608,281	-	-	-	608,281
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	27,112	-	27,112
매출채권	36,647,393	-	-	-	36,647,393
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	7,481,297	-	-	7,481,297
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,431,394	-	1,431,394
기타	14,294,254	-	475,244	70,777	14,840,275
계	143,321,745	7,481,297	1,933,750	70,777	152,807,569

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	12,861,787	-	-	12,861,787
단기차입금	271,753	-	10,763,366	11,035,119
미지급금	14,107,676	-	-	14,107,676
유동성장기부채	1,060,156	-	1,051,626	2,111,782
사채	19,537	-	-	19,537
장기차입금	6,829	-	3,758,608	3,765,437
장기미지급금	4,728,755	-	-	4,728,755
기타	13,197,743	50,873	43,788	13,292,404
계	46,254,236	50,873	15,617,388	61,922,497

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로

분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치 측정내역

(금융상품의 장부금액과 공정가치)

(단위 : 백만원)

구 분	제56기말		제55기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	53,705,579	(*1)	69,080,893	(*1)
단기금융상품	58,909,334	(*1)	22,690,924	(*1)
단기상각후원가금융자산	-	-	608,281	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	36,877	36,877	27,112	27,112
매출채권	43,623,073	(*1)	36,647,393	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	10,580,932	10,580,932	7,481,297	7,481,297
당기손익-공정가치금융자산	1,175,749	1,175,749	1,431,394	1,431,394
기타(*2)	14,898,880	520,656	14,840,275	546,021
계	182,930,424		152,807,569	
금융부채:				
매입채무	12,370,177	(*1)	11,319,824	(*1)
단기차입금	13,172,504	(*1)	7,114,601	(*1)
미지급금	17,390,861	(*1)	13,996,395	(*1)
유동성장기부채	2,207,290	594,010	1,308,875	6,757
- 유동성장기차입금	1,611,282	(*1)(*3)	1,302,521	(*1)(*3)
- 유동성사채	596,008	594,010	6,354	6,757
사채	14,530	16,427	537,618	529,254
장기차입금	3,935,860	(*1)(*3)	3,724,850	(*1)(*3)
장기미지급금	4,779,141	(*1)	4,907,875	(*1)
기타(*2)	13,793,044	94,559	11,414,008	83,463
계	67,663,407		54,324,046	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 14,378,224백만원(전기말: 14,294,254백만원)

및 금융부채 13,698,485백만원(전기말: 11,330,545백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계)

(단위 : 백만원)

구 분	제56기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	36,877	-	36,877
기타포괄손익-공정가치금융자산	7,686,545	-	2,894,387	10,580,932
당기손익-공정가치금융자산	86,187	-	1,089,562	1,175,749
기타	-	98,159	422,497	520,656
금융부채:				
유동성사채	-	594,010	-	594,010
사채	-	16,427	-	16,427
기타	-	94,559	-	94,559

(단위 : 백만원)

구 분	제55기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	27,112	-	27,112
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,250,993	-	2,230,304	7,481,297
당기손익-공정가치금융자산	347,221	-	1,084,173	1,431,394
기타	-	130,364	415,657	546,021
금융부채:				
유동성사채	-	6,757	-	6,757
사채	-	529,254	-	529,254
기타	-	83,463	-	83,463

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.
- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
  (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

당사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여
  해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(가치평가기법 및 투입변수)

당사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2024년말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자㈜	36,253	현금흐름할인법	영구성장률	1.0%
			가중평균자본비용	14.5%
㈜미코세라믹스	49,794	현금흐름할인법 등	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	10.3%
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,518,963	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	9.3%
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	314,942	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	9.3%
기타:				
지분 콜옵션	373,681	이항모형	무위험 이자율	2.7%
			가격 변동성	47.6%
지분 풋옵션	48,816	이항모형	무위험 이자율	3.5%~4.6%, 1.4%
			가격 변동성	26.4%, 40.6%

[△는 부(-)의 값임]

('수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역)

(단위 : 백만원)

금융자산	제56기	제55기
기초	3,730,134	3,303,227
매입	250,695	207,023
매도	△133,546	△124,477
당기손익으로 인식된 손익	23,415	297,680
기타포괄손익으로 인식된 손익	322,885	46,725
기타	212,863	△44
기말	4,406,446	3,730,134

[△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

금융부채	제56기	제55기
기초	-	7,404
당기손익으로 인식된 손익	-	619
기타	-	(8,023)
기말	-	-

[△는 부(-)의 값임]

('수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석)

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

2024년말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동 효과		불리한 변동 효과	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	207,262	-	△134,940
기타	144,566	-	△131,073	-

※ 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률 및 가중평균자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

※ 기타는 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및가격 변동성(10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

[△는 부(-)의 값임]

(4) 유형자산 재평가내역

당사는 공시대상기간 중 유형자산 재평가내역이 없습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.
이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.

'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.

- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융 시장의 동향
- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정
- DX부문, DS부문, SDC, Harman 등 회사가 영위하는 주요 사업의 예상치 못한 급격한 여건변화
- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 개요

2024년 세계 경제는 소비 침체, 지정학적 긴장 지속, 환율 변동 등 순조롭지 않은 경영 여건이 조성되었습니다. 이러한 상황에서 당사는 2024년 연결기준 매출 301조원,영업이익 33조원, 별도기준 매출 209조원, 영업이익 12조원을 기록하였습니다.

재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 27.9%, 자기자본비율 78.2%, ROE 9.0%, 별도기준 부채비율 37.5%, 자기자본비율 72.7%, ROE 10.2% 등 견실한 재무구조를
유지하였으며, 2024년 브랜드 가치는 1,008억달러로 전년대비 10% 증가하여 세계 전체 기업 중 5위(2024년 10월 인터브랜드 발표 기준)를 유지하였습니다.

사업 측면에서는 다양한 제품 라인업에 AI 기술을 접목하여 Galaxy S24 시리즈, Galaxy Z 폴드6와 Galaxy Z 플립6을 출시하였으며, '비전 AI'를 통해 개인화된 디스플레이 경험을 제공하며 업계 리더십을 더욱 강화하고 있습니다. 또한 반도체 사업은 HBM과 DDR5 등 고부가가치 제품 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다.

2025년은 관세 중심의 보호무역 기조 확산과 환율 리스크 등 경제적 불확실성이 예고되고 있으며, AI를 중심으로 한 기술 업계의 주도권 경쟁 및 급변하는 산업 환경은 당사에게 기회인 동시에 위기가 될 것으로 보입니다. 당사는 끊임없는 기술 혁신과 철저한 준비를 바탕으로 실적 개선과 미래 성장 동력 확보에 매진하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준)

가. 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제56기	제55기	증 감	증감률
[유동자산]	227,062,266	195,936,557	31,125,709	15.9%
· 현금및현금성자산	53,705,579	69,080,893	△15,375,314	△22.3%
· 단기금융상품	58,909,334	22,690,924	36,218,410	159.6%
· 기타유동금융자산	36,877	635,393	△598,516	△94.2%
· 매출채권	43,623,073	36,647,393	6,975,680	19.0%
· 재고자산	51,754,865	51,625,874	128,991	0.2%
· 기타	19,032,538	15,256,080	3,776,458	24.8%
[비유동자산]	287,469,682	259,969,423	27,500,259	10.6%
· 기타비유동금융자산	11,756,681	8,912,691	2,843,990	31.9%
· 관계기업 및 공동기업 투자	12,592,117	11,767,444	824,673	7.0%
· 유형자산	205,945,209	187,256,262	18,688,947	10.0%
· 무형자산	23,738,566	22,741,862	996,704	4.4%
· 기타	33,437,109	29,291,164	4,145,945	14.2%
자산총계	514,531,948	455,905,980	58,625,968	12.9%
[유동부채]	93,326,299	75,719,452	17,606,847	23.3%
[비유동부채]	19,013,579	16,508,663	2,504,916	15.2%
부채총계	112,339,878	92,228,115	20,111,763	21.8%
[지배기업 소유주지분]	391,687,603	353,233,775	38,453,828	10.9%
[비지배지분]	10,504,467	10,444,090	60,377	0.6%
자본총계	402,192,070	363,677,865	38,514,205	10.6%
부채와 자본총계	514,531,948	455,905,980	58,625,968	12.9%
자기자본비율	78.2%	79.8%	△1.6%p	
부채비율	27.9%	25.4%	2.5%p	
재고자산회전율	3.6회	4.1회	△0.5회	

※ 제56기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. [△는 부(-)의 값임]

향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우
정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

제56기 당사 자산은 전년 대비 58조 6,260억원(12.9%) 증가한 514조 5,319억원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 단기금융상품 등의 유동자산의 증가 31조 1,257억원 및반도체・디스플레이 패널 사업의 대규모 시설투자에 따른 유형자산의 증가 18조 6,889억원 등입니다.

부채는 전년 대비 20조 1,118억원(21.8%) 증가한 112조 3,399억원으로, 유동부채가17조 6,068억원(23.3%), 비유동부채가 2조 5,049억원(15.2%) 증가하였습니다. 자본은 전년 대비 38조 5,142억원(10.6%) 증가한 402조 1,921억원입니다.

재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년 대비 1.6%p 감소한 78.2%, 부채비율이 전년 대비 2.5%p 증가한 27.9%로 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다.

나. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분	제56기	제55기	증 감	증감률
매출액	300,870,903	258,935,494	41,935,409	16.2%
매출원가	186,562,268	180,388,580	6,173,688	3.4%
매출총이익	114,308,635	78,546,914	35,761,721	45.5%
판매비와관리비	81,582,674	71,979,938	9,602,736	13.3%
영업이익	32,725,961	6,566,976	26,158,985	398.3%
기타수익	1,960,338	1,180,448	779,890	66.1%
기타비용	1,625,229	1,083,327	541,902	50.0%
지분법이익	751,044	887,550	△136,506	△15.4%
금융수익	16,703,304	16,100,148	603,156	3.7%
금융비용	12,985,684	12,645,530	340,154	2.7%
법인세비용차감전순이익	37,529,734	11,006,265	26,523,469	241.0%
법인세비용	3,078,383	△4,480,835	7,559,218	△168.7%
당기순이익	34,451,351	15,487,100	18,964,251	122.5%
・지배기업 소유주지분	33,621,363	14,473,401	19,147,962	132.3%
・비지배지분	829,988	1,013,699	△183,711	△18.1%

※ 제56기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. [△는 부(-)의 값임]

향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

제56기 당사 매출액은 전년 대비 41조 9,354억원(16.2%) 증가한 300조 8,709억원을기록하였으며, 영업이익은 전년 대비 26조 1,590억원(398.3%) 증가한 32조 7,260억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전순이익은 전년 대비 26조 5,235억원(241%) 증가한 37조 5,297억원, 당기순이익은 전년 대비 18조 9,643억원(122.5%) 증가한 34조 4,514억원을 기록하였습니다.

수익성 지표 측면에서는 ROE가 전년 대비 4.4%p 증가 9.0%, 매출액순이익률이 전년 대비 5.5%p 증가한 11.5%로, 지속적으로 견실한 재무구조를 유지할 수 있도록 노력하고 있습니다.

[부문별 영업실적 분석]

[단위 : 백만원]

구분	부문	제56기		제55기		증감(률)	
		금액	비중	금액	비중	금액	(%)
매출	DX 부문	174,887,683	58.1%	169,992,337	65.7%	4,895,346	2.9%
	DS 부문	111,065,950	36.9%	66,594,471	25.7%	44,471,479	66.8%
	SDC	29,157,820	9.7%	30,975,373	12.0%	△1,817,553	△5.9%
	Harman	14,274,930	4.7%	14,388,454	5.6%	△113,524	△0.8%
	전사 매출	300,870,903	100.0%	258,935,494	100.0%	41,935,409	16.2%
영업이익	DX 부문	12,439,897	38.0%	14,384,705	219.0%	△1,944,808	△13.5%
	DS 부문	15,094,486	46.1%	△14,879,458	△226.6%	29,973,944	(흑자전환)
	SDC	3,733,429	11.4%	5,566,478	84.8%	△1,833,049	△32.9%
	Harman	1,307,580	4.0%	1,173,702	17.9%	133,878	11.4%
	전사 영업이익	32,725,961	100.0%	6,566,976	100.0%	26,158,985	398.3%

※ 각 부문별 매출 및 영업이익은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

(DX 부문)

DX 부문의 제57기 매출은 174조 8,877억원으로 전년 대비 4조 8,953억원(2.9%) 증가하였으나, 영업이익은 12조 4,399억원으로 전년 대비 1조 9,448억원(13.5%) 감소하였습니다.

DX 부문의 영상디스플레이/생활가전 사업은 AI 기술을 접목한 Neo QLED와 마이크로 LED 제품 등 프리미엄 TV와 차별화된 사용 경험을 제공하는 AI 가전제품을 중심으로 발전하고 있습니다.

영상디스플레이 사업에서 초대형 제품을 중심으로 프리미엄 시장 점유율을 늘려가고있으며, 개인화된 경험까지 제공할 수 있도록 기술을 발전시키고 있습니다.

Neo QLED 제품 라인업을 98인치에 이어 100인치와 115인치대로 확대하고, OLED 제품은 77인치와 83인치 판매를 강화하는 한편 마이크로 LED 역시 101, 114, 144 인치대로 라인업을 확대하여 소비자 선택권을 넓히고 있습니다.

또한, '비전 AI'를 프리미엄 신제품에 적용하여 기존 TV의 역할을 확대해 사용자의 니즈와 취향, 의도까지 미리 파악하여 개인화된 경험을 제공합니다. 콘텐츠 시청 중에도 한 번의 클릭으로 사용자가 원하는 정보를 찾아 알려주는 '클릭 투 서치', 외국어 콘텐츠의 자막을 실시간으로 우리말로 바꿔주는 '실시간 번역', 사용자가 원하는 이미지를 만들어주는 '생성형 배경화면'기능 등이 상용화되기 시작했습니다.

신제품에 대한 긍정적인 반응과 안정적인 공급망 관리를 바탕으로 글로벌 TV 시장에서는 2006년부터 2024년까지 19년 연속 세계 1위를 고수하고 있습니다.

생활가전 사업은 친환경·고효율 기술을 통해 제품의 기본 성능의 우위는 물론이고, 변화하는 라이프스타일에 대한 깊은 이해를 바탕으로 소비자의 삶을 편리하게 하는 제품과 서비스를 지속 출시하고 있습니다. 또한 Bixby와 SmartThings를 중심으로 다양한 제품 및 서비스와 연동하는 AI 가전을 통해 고객에게 차별화된 사용경험을 제공하고 있습니다.

2025년에도 시장과 고객에 대한 연구를 강화하고 혁신 제품을 출시하여 시장을 선도하며 AI 기능 고도화를 통해 고객에게 새로운 경험을 제공하겠습니다. 특히, 고부가사업인 HVAC 사업은 고효율 제품을 바탕으로 전문 채널을 공략하여 성장세를 이어가겠습니다.

MX(Mobile eXperience) 사업에서 Galaxy AI 도입을 통해 모바일 AI 분야의 리더십을 확보하고 플래그십 제품의 판매를 확대하여 전년 대비 매출이 성장하였고, 특히, Galaxy AI가 처음 적용된 Galaxy S24 시리즈는 판매량과 매출 모두 두자릿수 성장을기록하며 플래그십 스마트폰 부문의 견조한 성장을 이끌었습니다. 또한, 태블릿과 웨어러블 제품군도 프리미엄 신제품 중심으로 판매량과 매출이 성장했습니다.

Galaxy AI는 제스처를 통한 검색, 창의적인 사진 편집, 실시간 통·번역, 편리한 텍스트 요약 등 새로운 AI 경험을 제공합니다. 또한 Galaxy Z 폴드6 및 Galaxy Z 플립6는폴더블 폼팩터에 특화된 Galaxy AI를 탑재하였으며, 성능, 내구성 등 제품 완성도를 대폭 향상시켰습니다. 스마트폰 외에도 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 워치, 편안한 착용감으로 맞춤형 건강정보를 제공하는 스마트링, 풍부한 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰 등 다양한 Galaxy Ecosystem 제품을 통해 고객에게 풍부한 모바

일 경험을 제공하고 있습니다.

이와 함께 Samsung Wallet, Samsung Health, Bixby 등의 서비스가 제공되고 있으며, 고객이 어느 기기를 사용하더라도 일관되고 자연스러운 연결을 체감할 수 있는 Multi Device Experience를 제공하고 있으며, Ecosystem 확장을 위한 전략적 파트너십을 강화하고 있으며, 글로벌 인스톨드 베이스(Installed-base) 기반 서비스 사업을 통해 수익 구조를 다변화하고 있습니다.

2025년에도 당사는 Galaxy S25 시리즈를 통해 모바일 시장을 선도할 계획입니다. Galaxy S25는 AI 통합 플랫폼인 One UI 7.0을 기반으로 더욱 확장되고 개인화된 AI 사용성과 멀티 모달 인터랙션을 제공합니다. 이러한 경험은 폴더블 기기를 포함한 다양한 폼팩터에도 적용될 계획이며, Galaxy AI의 확장과 고도화를 위해 연구개발 및 투자와 업계 최고의 R&D 역량을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 제공하겠습니다.

(DS 부문)

DS 부문의 제56기 매출은 111조 660억원으로 전년 대비 44조 4,715억원(66.8%) 증가하였으며, 영업이익은 15조 945억원으로 전년 대비 29조 9,740억원 증가하여 흑자로 전환하였습니다.

메모리 사업은 PC・모바일 수요는 감소하고 서버향 고사양 제품의 수요는 강세를 보이는 수요의 양극화 상황에서 시장 수요에 적기 대응하며 사업 경쟁력 강화에 집중하였습니다. 2025년 메모리 업황은 단기적으로 약세가 전망되며, 2분기부터는 회복세를 보이기 시작할 것으로 예상됩니다. 다만, 반도체 수출 통제와 거시경제 추이 등 메모리 시장에 광범위하게 영향을 주는 변수들에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다. 당사는 미래 고부가가치 제품 수요에 적극 대응하기 위해
DRAM・NAND 선단 공정 생산 능력을 확대하는 데에 주력할 예정입니다.

DRAM의 경우 HBM3E 개선제품 판매를 확대하고 하반기 내 HBM4를 개발 및 양산하여 AI 시장 내 경쟁력을 강화할 계획입니다. 또한 서버향 DDR5 공급 확대에 주력하면서 AI 서버에 필요한 128GB, 256GB 등 시장의 고용량화 추세를 주도할 것이며,1b나노 기반 LPDDR5x를 모바일뿐 아니라 PC・서버향으로 확산하여 고부가가치 제품 비중을 적극적으로 늘려 나가겠습니다.

NAND의 경우 QLC를 포함한 고용량 SSD 수요에 적극 대응하면서 서버 시장 내 리더십을 강화하고, V8・V9으로의 공정 전환을 본격화하여 제품 경쟁력을 제고하겠습니다.

Foundry사업은 수요 약세 및 반등 지연으로 어려운 여건이 지속될 것으로 전망되나, 시장 변화에 맞춰 사업의 전 영역에서 대책을 준비하여 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. Advanced 노드는 중장기 수요 확보가 중요한 만큼 기존 양산 공정의 안정적인 수율 확보와 함께 신규 공정의 적기 개발 및 양산 성공으로 다양한 고객을 유치하는데 집중하고 있습니다. Mature 노드는 공정·제품 포트폴리오 강화를 통해 응용처를 확대하고 사업 다변화를 지속하고 있으며, 고수익 제품 확대와 믹스 최적화로 원가 경쟁력을 강화할 예정입니다.

System LSI 사업은 대내외 거시 경제 불확실성 확대 및 주요 고객사들의 재고 건전화에 따른 수요 감소가 예상되나, 차세대 제품 적기 개발, 고객과의 협력 강화, 원가 경쟁력 개선 등을 통해 시장 변화에 대비하도록 하겠습니다.

(SDC)

SDC의 제56기 매출은 29조 1,578억원으로전년 대비 1조 8,176억원(5.9%) 감소하였으며, 영업이익은 전년 대비 1조 8,330억원(32.9%) 감소한 3조 7,334억원입니다.

중소형 디스플레이 사업은 다양한 제품 포트폴리오를 구축하여 고도화되는 소비자 니즈에 대응하고 있으며, 차별화된 기술과 성능으로 스마트폰 패널 시장 내 리더십을공고히 하였습니다. 또한 IT, Auto 등 응용처 다변화를 지속적으로 추진하여 고객과 제품 기반을 강화하였습니다.

대형 디스플레이 사업은 자발광 제품의 시장 침투율이 지속 확대되어 QD-OLED

TV의 안정적 판매기반을 유지하였으며, 모니터는 고성능 제품 라인업을 추가하여 게이밍 시장을 중심으로 판매를 확대하였습니다.

(Harman)

Harman의 제56기 매출은 14조 2,749억원으로 전년 대비 1,135억원(0.8%) 감소하였으며, 영업이익은 1조 3,076억원으로 전년 대비 1,339억원(11.4%) 증가하였습니다.

Harman은 전장부품 및 소비자오디오에서 견조한 성장세를 유지하고 있으며, 다른 부문의 모바일・IT・디스플레이・반도체 기술과의 융합을 통해 사업역량을 확대하고 있습니다.

당사는 전장부품 시장의 선도업체로서 완성차 업체들에게 혁신 기술을 적용한 제품을 공급하는 한편 프리미엄 브랜드에 부합하는 품질수준을 유지하고 있습니다. 특히,인포테인먼트 분야에서는 IVI(InVehicle Infotainment)에서 디지털콕핏으로의 본격 전환에 선행 대응함으로써 시장을 선점하였으며, TCU(Telematics Control Unit)에서는 5G업계 최초 수주로 기술개발을 선도하여 수주 확대 및 차별화된 기술 개발에 주력하고 있습니다. 카오디오는 글로벌 1위의 입지를 강화하고, 기술 차별화를 통해 소비자들에게 자동차에서도 몰입감 있는 경험을 제공하고 있습니다. 또한, 향후 전개될 자율주행차 시대의 운전 환경 변화에 대비하여 차량용 디스플레이, HUD(Head Up
Display), S/W서비스 솔루션 등 공급을 확대하여 차량내 사용자 경험을 확장하고 차별화된 경험을 제공하는데 사업 역량을 집중하겠습니다.

Harman의 소비자오디오 브랜드는 오디오 시장에서 기술혁신을 통해 일반 소비자들과 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 특히, JBL 브랜드는 2015년부터 글로벌 블루투스 스피커에서 시장 1위를 유지하고 있으며, 헤드폰 및 무선 이어폰 시장에서도 괄목할만한 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 전략적으로 인수한 Roon의 다양한 기술을 활용하여 다른 사업 분야와의 시너지를 창출하고 업계를 지속적으로 선도하고자 합니다.

다. 신규 사업 및 중단 사업

해당사항 없습니다.

라. 조직의 변경

당사는 2021년 12월 중 기존의 CE부문과 IM부문을 DX부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience)사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS부문과 별도로 구분하였습니다.

[2021년 12월]

<table>
<tr><th></th><th>변경전</th><th>변경후</th></tr>
<tr><td rowspan="4">사업
조직</td><td>CE 부문
(영상디스플레이,
생활가전, 의료기기)</td><td rowspan="2">DX 부문
(영상디스플레이,
생활가전, 의료기기,
Mobile eXperience, 네트워크)</td></tr>
<tr><td>IM 부문
(무선, 네트워크)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DS 부문
(메모리, System LSI, Foundry,
디스플레이 패널)</td><td>DS 부문
(메모리, System LSI, Foundry)</td></tr>
<tr><td>SDC
(디스플레이 패널)</td></tr>
<tr><td>Harman 부문</td><td>Harman</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지역
총괄</td><td>한국, 북미, 중남미, 구주,
CIS, 서남아, 동남아, 중국,
중동, 아프리카</td><td>한국, 북미, 중남미, 구주,
CIS, 서남아, 동남아, 중국,
중동, 아프리카</td></tr>
<tr><td>미주(DS), 구주(DS),
중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)</td><td>미주(DS), 구주(DS),
중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)</td></tr>
</table>

마. 환율변동 영향

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.

[각 통화별 기말환율] (단위 : 원)

구 분	제56기	제55기	변동	변동률
USD	1,470.00	1,289.40	180.60	14.0%
EUR	1,528.73	1,426.59	102.14	7.2%

[△는 부(-)의 값임]

기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제56기		제55기	
	환율 상승시	환율 하락시	환율 상승시	환율 하락시
USD	365,273	△365,273	418,776	△418,776
EUR	88,649	△88,649	151,740	△151,740

[△는 부(-)의 값임]

당사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 당사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다.

또한, 당사는 효과적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

바. 자산 손상 인식

당사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다.

현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년간(단, 신기술 산업 등 중장기 계획이 합리적인 경우 5년 초과)의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다.
동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정성장률의 가정(단, 산업평균성장률을 초과하지 않음)이 사용되었습니다.

개별자산에 대한 손상차손은 회수가능가액을 초과하는 장부금액만큼 인식하며, 회수가능가액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다.

당기의 계정과목별 손상차손(환입) 인식액은 유형자산 3,964억원, 무형자산 262억원등입니다.

☞ 자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과
'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'의 '2. 타법인출자 현황'(별도 기준)을
참고하시기 바랍니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 당사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지・관리하고 있습니다.

당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 당기말 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.

가. 유동성 현황

당기말 현재 당사의 유동성은 상당히 양호하며, Cash Coverage(유동자금÷차입금)는 583%입니다.

구 분	제56기	제55기
Cash Coverage(유동자금÷차입금)	583%	728%

(단위 : 백만원)

구 분	제56기	제55기	증감
유동자금:			
현금및현금성자산	53,705,579	69,080,893	△15,375,314
단기금융상품	58,909,334	22,690,924	36,218,410
단기상각후원가금융자산	-	608,281	△608,281
단기당기손익-공정가치금융자산	36,877	27,112	9,765
소 계	112,651,790	92,407,210	20,244,580
차입금:			
단기차입금	13,172,504	7,114,601	6,057,903
유동성장기부채	2,207,290	1,308,875	898,415
사채	14,530	537,618	△523,088
장기차입금	3,935,860	3,724,850	211,010
소 계	19,330,184	12,685,944	6,644,240
Net Cash(유동자금-차입금)	93,321,606	79,721,266	13,600,340

※ 유동성장기부채는 유동성장기차입금과 유동성사채입니다. [△는 부(-)의 값임]

당사는 당기말 현재 112조 6,518억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ① 현금및현금성자산, ② 단기금융상품, ③ 단기상각후원가금융자산, ④ 단기당기손익-공정가치금융자산을 모두 포함한 금액이며,전기말 유동자금 92조 4,072억원대비 20조 2,446억원 증가하였습니다.

당기말 현재 당사 차입금(사채 포함)은 19조 3302억원으로 전기말 12조 6,859억원 대비 6조 6,442억원 증가하였습니다.

당사의 유동성은 당기 영업활동 현금흐름으로 72조 9,826억원이 유입되었고, 유·무형자산의 취득 53조 7,416억원, 배당금 지급 10조 8,887억원 등이 유출되었으며,
Net Cash(유동자금-차입금)는 93조 3,216억원으로 전기말 79조 7,213억원 대비 13조 6,003억원 증가하였습니다.

나. 자금 조달과 지출

(차입금 내역)

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	제56기	제55기
단기차입금:				
담보부차입금	우리은행 등	0.4~14.9	12,840,396	6,610,049
무담보차입금	씨티은행 등	0.0~53.0	332,108	504,552
계			13,172,504	7,114,601
유동성장기차입금:				
은행차입금	BNP 등	0.0~55.3	510,756	304,082
리스부채	CSSD 등	4.6	1,100,526	998,439
계			1,611,282	1,302,521
장기차입금:				
은행차입금	-	0.0~7.4	6,537	-
리스부채	CSSD 등	4.6	3,929,323	3,724,850
계			3,935,860	3,724,850

(단위 : 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	제56기	제55기
US$ denominated Straight Bonds	1997.10.02	2027.10.01	7.7	22,050 (US$ 15,000천)	25,788 (US$ 20,000천)
US$ denominated Debenture Bonds	2015.05.11	2025.05.15	4.2	588,000 (US$ 400,000천)	515,760 (US$ 400,000천)
소 계				610,050	541,548
사채할증발행차금(사채할인발행차금)				488	2,424
계				610,538	543,972
차감: 유동성사채				△596,008	△6,354
비유동사채				14,530	537,618

[△는 부(-)의 값임]

(차입금의 차입 및 상환)

당사의 단기차입금은 주로 매출채권할인 규모에 따라 증가 또는 감소하고 있습니다.
당사는 당기 중 단기차입금은 6조 579억원이 증가하였으며, 사채 및 장기차입금(유동성 포함)은 5,198억원 증가하였습니다.

(차입금의 상환계획)

(단위 : 백만원)

상환연도	금액
2025년	15,582,837
2026년	1,054,870
2027년	835,793
2028년	642,638
2029년 이후	1,969,015
계	20,085,153

※ 상환계획 금액은 사채의 할증발행차금과 할인발행차금, 리스부채의 현재가치할인차금을 고려하기 전 금액입니다.

(사채관리계약 이행현황)

당사가 발행한 공모사채는 투자자 보호를 위하여 담보권설정 제한, 자산처분 제한 등의 이행조건이 부과되어 있으며, 당사는 이행조건을 준수하고 있습니다.

5. 부외거래

당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정
동 개정사항은 부채의 유동 및 비유동 분류에 영향을 미치며, 이는 보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되도록 요구합니다. 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정
동 개정사항은 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를 산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정
동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표 이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정의 주요 조건, 잔액, 결제기간 및 관련된 현금흐름 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항

환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.

당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 종업원 관련 유의한 변동사항은 없습니다.

다. 법규상의 규제에 관한 사항

당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항

환율 변동 리스크 관리를 위하여 해외법인은 기능통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다.

당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등

삼정회계법인은 당사의 제55기 및 제56기 감사를 수행하였고, 감사의견은 모두적정입니다.
또한, 안진회계법인은 당사의 제54기 감사를 수행하였고 감사의견은 적정입니다.

한편, 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

[회계감사인의 명칭 및 감사의견]

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련 중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항
제56기 (당기)	감사보고서	삼정회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
	연결감사 보고서	삼정회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제55기 (전기)	감사보고서	삼정회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
	연결감사 보고서	삼정회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제54기 (전전기)	감사보고서	안진회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
	연결감사 보고서	안진회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제56기 (당기)	삼정회계법인	분・반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사	7,800	78,000	7,800	76,830
제55기 (당기)	삼정회계법인	분・반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사	7,800	85,700	7,800	85,036
제54기 (전기)	안진회계법인	분・반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	8,424	78,000	8,424	78,146

(제56기 일정)

구 분		일 정
제56기 1분기	사전검토	2024.03.11 ~ 2024.03.29
	본검토	2024.04.08 ~ 2024.05.14
제56기 2분기	사전검토	2024.06.10 ~ 2024.06.27
	본검토	2024.07.08 ~ 2024.08.13
제56기 3분기	사전검토	2024.09.09 ~ 2024.09.27
	본검토	2024.10.08 ~ 2024.11.13
시스템 및 자동 내부통제 감사		2024.04.03 ~ 2025.01.31
조기입증감사(연중감사)		2024.03.06 ~ 2024.12.29
내부회계관리제도 감사		2024.04.03 ~ 2025.01.31
조기입증감사 절차 업데이트 및 재무제표 감사		2025.01.02 ~ 2025.02.18

※ 별도・연결 재무제표 검토 및 감사와 내부회계관리제도 감사에 대한 일정입니다.

[비감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제56기(당기)	2017.02	세무자문업무(해외종속기업)	2024.01~2024.06	43	삼정회계법인
	2018.09	세무자문업무(해외종속기업)	2024.01~2024.05	-	삼정회계법인
	2019.05	세무자문업무(해외종속기업)	2024.01~2024.06	73	삼정회계법인
제55기(전기)	2017.02	세무자문업무(해외종속기업)	2023.01~2023.12	202	삼정회계법인
	2018.09	세무자문업무(해외종속기업)	2023.01~2023.12	27	삼정회계법인
	2019.05	세무자문업무(해외종속기업)	2023.01~2023.12	79	삼정회계법인
	2023.05	ESG인증업무(국내종속기업)	2023.05~2023.07	25	삼정회계법인
제54기(전전기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2024.01.29	・감사위원회: 위원 3명 ・회사: 감사팀장 ・감사인: 업무수행이사 외 5명	대면회의	・연간 회계감사 진행 상황 ・핵심 감사사항 등 중점 감사사항 ・내부회계관리제도 감사 진행 상황 ・기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항
2	2024.04.26	・감사위원회: 위원 3명 ・회사: 감사팀장 ・감사인: 업무수행이사 외 5명	대면회의	・분기 검토 경과 보고 ・연간 회계감사 계획 ・기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항
3	2024.07.29	・감사위원회: 위원 3명 ・회사: 감사팀장 ・감사인: 업무수행이사 외 5명	대면회의	・연간 회계감사 진행 상황 ・핵심 감사사항 선정 계획 ・내부회계관리제도 감사 진행 상황 ・분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항

4	2024.10.25	・감사위원회: 위원 3명 ・회사: 감사팀장 ・감사인: 업무수행이사 외 5명	대면회의	・연간 회계감사 진행 상황 ・핵심 감사사항 선정 계획 ・내부회계관리제도 감사 진행 상황 ・분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항
5	2024.11.27	・감사위원회: 위원 3명 ・회사: 감사팀장 ・감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	・연간 회계감사 진행 상황 ・핵심 감사사항 선정 계획
6	2025.01.24	・감사위원회: 위원 3명 ・회사: 감사팀장 ・감사인: 업무수행이사 외 5명	대면회의	・연간 회계감사 진행 상황 ・핵심 감사사항 등 중점 감사사항 ・내부회계관리제도 감사 진행 상황 ・기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항

[조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보]

해당사항 없습니다.

나. 회계감사인의 변경

제56기말 현재 당사의 종속기업은 228개이며, 당기 중 해외 종속기업 중 Harman International Industires, Inc. 외 16개 종속기업은 PwC에서 KPMG로 회계감사인을 변경하였으며, 국내 종속기업 중 ㈜하만인터내셔널코리아는 삼일회계법인(PwC)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 회계감사인을 변경하였습니다. 당기 중 설립된 SVIC 67호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을, Samsung Electronics Middle east and North Africa는 KPMG를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 또한, 전기 중 신규 인수한 eMagin Corporation은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였고, 전기 중 설립된 종속기업 Samsung Federal Inc.는 KPMG를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 종속기업의 회계감사인 변경 및 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제56기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
㈜하만인터내셔널코리아	삼일회계법인(PwC)	삼정회계법인(KPMG)
Harman International Industires, Inc.	PwC	KPMG
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Holding Limited	PwC	KPMG
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Becker Automotive Systems GmbH	PwC	KPMG
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	PwC	KPMG
Harman Connected Services GmbH	PwC	KPMG
Harman Consumer Nederland B.V.	PwC	KPMG
Harman Deutschland GmbH	PwC	KPMG
Harman Holding Gmbh & Co. KG	PwC	KPMG
Harman Hungary Financing Ltd.	PwC	KPMG
Harman Professional Kft	PwC	KPMG

당사는 제55기(전기)부터 회계감사인을 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 변경하였습니다. 이는 지정감사인이었던 안진회계법인(Deloitte)과의 계약이 2022년말 기간 만료로 종료됨에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 제1항 및 제3항, 제4항에 의거하여 감사위원회가 선정한 결과로, 삼정회계법인(KPMG)을 2023년부터 2025년까지 3개년의 회계감사인으로 신규 선임하였습니다.

제55기말(전기말) 현재 당사의 종속기업은 232개이며, 전기 중 국내 종속기업 가운데 삼성디스플레이㈜ 등 8개는 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)으로, 에스유머티리얼스㈜는 한영회계법인(E&Y)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 회계감사인을 변경하였습니다. 또한, 해외 종속기업 중 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 30개사는 Deloitte에서 KPMG로, Samsung Japan Corporation (SJC)등 65개사는 PwC에서 KPMG로, Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA) 등 6개사는 E&Y에서 KPMG로, Laos Samsung Electronics Sole Co.,Ltd (LSE)는 KPP Co., Ltd에서 KPMG로 회계감사인을 변경하였습니다. 한편, 전기 중 설립된 종속기업SVIC 62호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을 신규 선임하였고, 전전기 중 설립된 종속기업 ㈜희망별숲은 삼정회계법인(KPMG)을, Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC (SEUZ), DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED는 KPMG를회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 해당 종속기업들은 당사(지배회사)의 회계감사인 변경에 따라 연결감사 업무 효율화 등을 위해 회계감사인을 변경 및 신규 선임하였으며, 이는 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제55기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
삼성디스플레이㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자서비스㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자서비스씨에스㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자판매㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자로지텍㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
㈜도우인시스	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
지에프㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
㈜미래로시스템	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
에스유머티리얼스㈜	한영회계법인(E&Y)	삼정회계법인(KPMG)
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Deloitte	KPMG
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	Deloitte	KPMG
Samsung International, Inc. (SII)	Deloitte	KPMG
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics GmbH (SEG)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	Deloitte	KPMG
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	Deloitte	KPMG

Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	Deloitte	KPMG
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Deloitte	KPMG
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Deloitte	KPMG
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Deloitte	KPMG
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Deloitte	KPMG
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Deloitte	KPMG
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Turkiye (SETK)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	Deloitte	KPMG
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Deloitte	KPMG
Samsung Japan Corporation (SJC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	PwC	KPMG
Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	PwC	KPMG
Samsung Research America, Inc (SRA)	PwC	KPMG
SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	PwC	KPMG
SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	PwC	KPMG
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	PwC	KPMG

Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	PwC	KPMG
Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	PwC	KPMG
Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	PwC	KPMG
Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	PwC	KPMG
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	PwC	KPMG
PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	PwC	KPMG
PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	PwC	KPMG
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	PwC	KPMG
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	PwC	KPMG
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	PwC	KPMG
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	PwC	KPMG
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	PwC	KPMG
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	PwC	KPMG
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	PwC	KPMG
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	PwC	KPMG
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	PwC	KPMG
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	PwC	KPMG
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	PwC	KPMG
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	PwC	KPMG
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	PwC	KPMG
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	PwC	KPMG

Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	E&Y	KPMG
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	KPP Co., Ltd	KPMG

또한, 제54기말(전전기) 현재 당사의 종속기업은 232개이며, 종속기업 Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)이 PwC를, SVIC 52호 신기술투자조합과 SVIC 55호 신기술투자조합, SVIC 56호 신기술투자조합, SVIC 57호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 종속기업의 회계감사인 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

2. 내부통제에 관한 사항

[경영진의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과]

사업연도	구분	운영실태 보고서 보고일자	평가 결론	중요한 취약점	시정조치 계획 등
제56기 (당기)	내부회계 관리제도	2025.01.24	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음
	연결내부회계 관리제도	2025.01.24	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음
제55기 (전기)	내부회계 관리제도	2024.01.29	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음
	연결내부회계 관리제도	2024.01.29	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음
제54기 (전전기)	내부회계 관리제도	2023.01.27	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음
	연결내부회계 관리제도	-	-	-	-

[감사위원회의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과]

사업연도	구분	평가보고서 보고일자	평가 결론	중요한 취약점	시정조치 계획 등
제56기 (당기)	내부회계 관리제도	2025.02.18	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음
	연결내부회계 관리제도	2025.02.18	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음
제55기 (전기)	내부회계 관리제도	2024.01.31	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음
	연결내부회계 관리제도	2024.01.31	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음
제54기 (전전기)	내부회계 관리제도	2023.01.31	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음
	연결내부회계 관리제도	-	-	-	-

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견]

사업연도	구분	감사인	유형 (감사/검토)	감사의견 또는 검토결론	지적사항	회사의 대응조치
제56기 (당기)	내부회계 관리제도	삼정회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음
	연결내부회계 관리제도	삼정회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음
제55기 (전기)	내부회계 관리제도	삼정회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음
	연결내부회계 관리제도	삼정회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음
제54기 (전전기)	내부회계 관리제도	안진회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음
	연결내부회계 관리제도	-	-	-	-	-

[내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황]

소속기관 또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증 보유비율			내부회계담당 인력의 평균경력월수
		내부회계 담당인력수(A)	공인회계사자격증 소지자수(B)	비율 (B/A*100)	
감사위원회	3	3	-	-	35
이사회	9	9	-	-	34
내부회계관리총괄	1	1	-	-	284
회계처리부서	43	36	5	13.9	150
자금운영부서	22	20	1	5.0	153
전산운영부서	128	29	-	-	277
공시관련부서	21	11	-	-	111
인사관리부서	95	45	-	-	163
내부회계관리부서	18	18	2	11.1	161
내부회계평가지원부서	5	5	2	40.0	145

[회계담당자의 경력 및 교육실적]

직책 (직위)	성명	회계담당자 등록여부	경력 (단위:년, 개월)		교육실적 (단위:시간)	
			근무연수	회계관련경력	당기	누적
내부회계관리자	박순철	O	32년, 10개월	23년, 8개월	1	1
회계담당임원	김동욱	O	31년, 1개월	31년, 1개월	1	6
회계담당직원	전형석	O	20년 2개월	15년, 9개월	2	6

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 2024년말 현재 사내이사 3인(한종희, 노태문, 이정배)과 사외이사 6인(김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사회의 독립성과 투명성 제고를 위하여 이사회 의장을 대표이사와 분리하여, 김한조 사외이사를 이사 간 의견 조율과 이사회 활동을 총괄하는 적임자로 판단해 의장으로 선임하였습니다. 이사회내 위원회로는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	의장・위원장	주요 역할
이사회	사내이사 3명, 사외이사 6명	한종희, 노태문, 이정배, 김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	김한조 (사외이사)	・법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 ・경영진의 업무집행 감독
경영위원회	사내이사 3명	한종희, 노태문, 이정배	한종희 (사내이사)	・경영 일반, 재무 관련 사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의・결의
감사위원회	사외이사 3명	김한조, 유명희, 조혜경	김한조 (사외이사)	・재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사
사외이사 후보추천위원회	사외이사 3명	신제윤, 허은녕, 유명희	신제윤 (사외이사)	・사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천
내부거래위원회	사외이사 3명	허은녕, 김한조, 유명희	허은녕 (사외이사)	・자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고
보상위원회	사외이사 3명	김한조, 김준성, 신제윤	-	・이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보
지속가능경영위원회	사외이사 6명	김한조, 김준성, 허은녕,유 명희, 신제윤, 조혜경	김한조 (사외이사)	・환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고

☞ 이사회 구성원별 선임에 대한 자세한 사항은 'Ⅰ. 회사의 개요'의 '2. 회사의 연혁'을 참고하시기 바랍니다.

※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 김한조 사외이사가 이사회 의장, 보상위원회 위원으로 선임되었고,
김준성 이사는 보상위원회 위원, 지속가능경영위원회 위원으로, 사내이사 전원이 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2022년 4월 26일 김한조 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 4월 28일 김한조 사외이사가 지속가능경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 11월 3일 임시주주총회에서 신규 사외이사로 선임된 허은녕, 유명희 사외이사가 당일 개최된 이사회를 통해
지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2023년 3월 15일 이사회를 통해 한종희 사내이사가 경영위원회 위원으로,
허은녕, 유명희 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2023년 4월 27일 한종희 사내이사가 경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2024년 3월 20일 주주총회에서 신제윤 사외이사, 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 조혜경 사외이사가 신규 선임되었으며,
유명희 사외이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
당일 개최된 이사회를 통해 허은녕 사외이사와 유명희 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었고,
신제윤 이사는 사외이사 후보추천위원회 위원, 보상위원회 위원, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며,
조혜경 사외이사는 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2024년 4월 26일 허은녕 사외이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2024년 5월 21일 경계현 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2024년 7월 29일 신제윤 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2024년 12월 26일 박학규 사내이사가 사임하였습니다.

※ 작성기준일 이후 2025년 1월 31일 제1차 이사회에서 김한조 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었으며
2025년 2월 14일 보상위원회 위원장으로 선임되었습니다.

[사외이사 및 그 변동 현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
9	6	2	-	1

나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명											
			사내이사					사외이사						
			한종희 (출석률 :100%)	경계현 (출석률 :100%)	노태문 (출석률 :100%)	박학규 (출석률 :100%)	이정배 (출석률 :100%)	김한조 (출석률 :100%)	김선욱 (출석률 :100%)	김종훈 (출석률 :100%)	김준성 (출석률 :100%)	허은녕 (출석률 :100%)	유명희 (출석률 :100%)	신제윤 (출석률 :100%)	조혜경 (출석률 :100%)
			찬 반 여 부											
'24.01.31 (1차)	1. 2023년(제55기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성											
	2. '24~'26 주주환원 정책 승인의 건													
	3. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
	4. 삼성메디슨㈜ 삼성CI 상표 사용료 수취의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	찬성	찬성	
	※ 보고사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
	① 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
	② 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건													
'24.02.20 (2차)	1. 제55기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 사항 없음 (신규선임)
	2. 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
	□ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고													
	□ 제1호: 제55기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인의 건													
	□ 제2호: 사외이사 신제윤 선임의 건													
	□ 제3호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건													
	□ 제4호: 감사위원회 위원 유명희 선임의 건													
	□ 제5호: 이사 보수한도 승인의 건													
	□ 제6호: 정관 일부 변경의 건													
	3. 학교법인 충남삼성학원 후원금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
	4. 2024년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
	5. 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
'24.03.20	1. 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3차)	2. 이사 보수 책정의 건 3. 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성
'24.04.30 (4차)	1. 2024년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 2. 삼성바이오로직스㈜/에피스㈜ 삼성CI 상표 사용계약 체결의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성			찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
'24.07.31 (5차)	1. 2024년 반기 보고서 및 분기배당 승인의 건 2. 사회공헌 기부금 출연의 건 3. 국내사업장 패키지 보험 가입의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성			찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
'24.10.31 (6차)	1. 2024년 3분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 2. 주식예탁증서 우선주 이전상장의 건 3. 한국경제인협회 연회비 납부의 건 4. DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건 ※ 보고사항 ① 최고경영자 승계 후보군 보고의 건	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성			찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성
'24.11.15 (7차)	1. 자기주식 취득계획 및 취득의 건 1-1호 : 자기주식 취득 계획의 건 1-2호 : 자기주식 취득의 건	가결 가결	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	사항 없음 (사임)	해당사항 없음 (임기만료)	찬성 찬성	찬성 기권	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
'24.11.26 (8차)	※ 보고사항 ① 2025 삼성전자 사장단 인사(안) 보고의 건	-	-	해당 사항 없음 (사임)	-	-	-	-			-	-	-	-	-
'24.11.29 (9차)	1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 2. 퇴직연금 불입의 건 3. 내부회계관리규정 개정의 건 4. 2025년 경영계획 승인의 건 5. 희망 2025 나눔 캠페인 기부금 출연의 건 6. Samsung Global Goals 기부금 출연의 건 7. 구미 1사업장 부지 분할 매각의 건 ※ 보고사항 ① 준법통제활동 보고의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성			찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
'24.12.19 (10차)	1. 유전자 및 임상 종합 DB 구축 공동연구 참여의 건 ※ 보고사항 ① 2025년 정기조직개편 내역 보고의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'24.12.31 (11차)	※ 보고사항 ① 레인보우로보틱스社1차 매수청구권 실행의 건	-	-		-	해당 사항 없음 (사임)	-	-			-	-	-	-	-

※ 김준성 사외이사는 '24년 제1차 이사회에서 부의된 '24~'26년 주주환원 정책 승인의 건에 대하여 고정적 배당은 유연성이 부족할 수 있다는 점을 근거로 반대의견을 제시하였습니다.

※ 허은녕 사외이사는 '24년 제7차 이사회에서 자사주 취득 계획에는 동의하나, 주주가치 제고에 가장 적절한 시점을 재고 하자는 취지에서 즉시 취득하는 안건에 대해 기권 의견을 제시하였습니다.

※ 신제윤 사외이사는 2024년 3월 29일에 사외이사 임기가 시작되어 4차 이사회부터 의결에 참여하였습니다.

다. 이사회내의 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	사내이사 3명	한종희(위원장), 노태문, 이정배	하단 기재내용 참조	· 한종희 사내이사 위원장 선임('23.04.27)
내부거래위원회	사외이사 3명	허은녕(위원장), 김한조, 유명희	하단 기재내용 참조	· 허은녕 사외이사 위원장 선임('24.04.26)
보상위원회	사외이사 3명	김한조, 김준성, 신제윤	하단 기재내용 참조	-
지속가능경영위원회	사외이사 6명	김한조(위원장), 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	하단 기재내용 참조	· 김한조 사외이사 위원장 선임('22.04.28)

※ 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

※ 경영위원회 등 이사회내 위원회의 위원장은 해당 이사회내 위원회에서 선임합니다.

※ 작성기준일 이후 2025년 2월 14일 김한조 사외이사가 보상위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(경영위원회)

- 설치목적: 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며,
그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.
경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항: 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함

1. 경영일반에 관한 사항
1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
2) 주요 경영전략
3) 사업계획·사업구조 조정 추진
4) 해외 지점·법인의 설치, 이전 및 철수
5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)
7) 기타 주요 경영현황
8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지
9) 지배인의 선임 또는 해임
10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술 관련 특허권 취득, 양수, 양도계약
13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기
14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는
공급계약 체결 또는 해지
16) 조직의 운영에 관한 기본원칙
17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경
18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항
 1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분
 2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자
 3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는
    신규 채무보증(기간 연장은 제외함)
   - 담보: 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함
   - 채무보증: 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외
 4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)
 5) 내부거래의 승인
    내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 특수관계인을
    상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상
    독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 대규모 내부거래 기준 금액 미만
    상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는
    자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위 (기존 계약을
    중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)
 6) 사채발행
 7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로
    인한 경우에 한함
 8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중
   이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과
   다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

(내부거래위원회)

- 설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항
  · 내부거래 보고 청취권: 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음
  ※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 대규모 내부거래를 하고자 하는 경우에는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음
  · 내부거래 직권조사 명령권
  · 내부거래 시정조치 건의권

(보상위원회)

- 설치목적: 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함
- 권한사항
  · 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
  · 등기이사에 대한 보상체계
  · 기타 이사회에서 위임한 사항

(지속가능경영위원회)

- 설치목적: 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고하기 위함
- 권한사항
  - 회사의 지속가능경영과 관련된 사항
    1) 주요 지속가능경영 전략 및 정책
    2) 환경, 사회, 지배구조 등 지속가능경영 관련 주요 활동 보고
    3) 지속가능경영보고서 발간 계획
  - 주주가치 제고와 관련된 사항
    1) 주주환원 정책 사전 심의
    2) 주주권익 관련 주요 사안 보고
  - 기타 지속가능경영 및 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로 위원회가 부의가 필요하다고 판단한 사항
  - 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항
  - 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명				
				한종희 (출석률: 100%)	경계현 (출석률: 75%)	노태문 (출석률: 92%)	박학규 (출석률: 100%)	이정배 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부				
경영위원회	'24.02.06	1. 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'24.03.07	1. 메모리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. Foundry(평택) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. Foundry(화성) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 온양캠퍼스 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'24.03.19	1. GPU 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'24.04.12	1. 메모리 투자의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		2. 삼성 SDI와 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		3. 생산물 배상책임 보험 가입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		4. 상표 사용 계약 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		5. 서초 전자사옥 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
	'24.05.30	1. 메모리 투자의 건	가결	찬성	해당 사항 없음 (사임)	찬성	찬성	찬성
		2. 메모리(평택) 기존 FAB 마감 공사의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
		3. 메모리(평택) 신규 FAB 기초 공사의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
		4. AVP 투자의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
		5. 해외법인 설립의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
	'24.06.26	1. 해외법인 청산의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
	'24.07.05	1. 반도체 연구소 투자의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
	'24.08.28	1. 메모리 투자의 건	가결	찬성		불참	찬성	찬성
		2. 메모리 투자의 건	가결	찬성		불참	찬성	찬성
		3. 메모리 투자의 건	가결	찬성		불참	찬성	찬성
		4. 삼성디스플레이와 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성		불참	찬성	찬성
	'24.09.20	1. 메모리 투자의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
	'24.10.15	1. 메모리 투자의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
		2. 메모리 투자의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
	'24.11.12	1. 기흥 캠퍼스 투자의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
		2. 평택 캠퍼스 투자의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
	'24.12.31	1. 매수청구권 실행의 건	가결	찬성		찬성	해당사항 없음(사임)	찬성

(내부거래위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명				
				김선욱 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)	허은녕 (출석률: 100%)	유명희 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부				
내부거래 위원회	'24.01.29	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 삼성메디슨㈜ 삼성 CI 상표 사용료 수취 건 2. 2023년 4분기 내부거래 현황 보고	- -	- -	- -	- -	해당 사항 없음 (신규선임)	해당 사항 없음 (신규선임)
	'24.03.18	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건	-	-	-	-		
	'24.04.26	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 2. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 삼성바이오로직스㈜/에피스㈜ 삼성 CI 상표 사용 계약 체결의 건 3. 2024년 1분기 내부거래 현황 보고	가결 - -		찬성 - -		찬성 - -	찬성 - -
	'24.07.29	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 사회공헌 기부금 출연의 건 ② 국내 사업장 패키지 보험 가입의 건 2. '24.2/4분기 내부거래 현황 보고	-	해당 사항 없음 (사임)	-	해당 사항 없음 (임기만료)	-	-
	'24.10.29	1. '24.3/4분기 내부거래 현황 보고	-		-		-	-
	'24.11.27	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 퇴직연금 불입의 건 ② 구미 1사업장 부지 일부 매각의 건 ③ 2025년도 대규모 상품용역거래 승인의 건	-		-		-	-

(보상위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명			
				김종훈 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: 100%)	김준성 (출석률: 100%)	신제윤 (출석률: -%)
				찬 반 여 부			
보상 위원회	'24.02.19	1. 2024년 사내이사 개별 보수체계 및 고정연봉 심의의 건 2. 2024년 이사보수 한도 심의의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	해당사항 없음 (신규선임)

(지속가능경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명							
				김한조 (출석률: 100%)	김선욱 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)	김준성 (출석률: 100%)	허은녕 (출석률: 100%)	유명희 (출석률: 100%)	신제윤 (출석률: 100%)	조혜경 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부							
지속가능 경영위원회	'24.1.29 (1차)	① ESG 이해관계자 대응 고도화 방안 ② '24년 지속가능경영보고서 발간 계획 ③ IR동향 ④ '24~'26년 주주환원정책 사전심의	- - - 가결	- - - 찬성	- - - 찬성	- - - 찬성	- - - 반대	- - - 찬성	- - - 찬성	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)
	'24.4.26 (2차)	① IR동향 ② '24년 중대성 평가 결과 ③ EU 이해관계자 인게이지먼트 결과 ④ 자회사형 장애인 표준사업장(희망별숲) 사업 확대 계획	- - - -	- - - -	해당 사항 없음 (사임)	해당 사항 없음 (임기 만료)	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	'24.7.29 (3차)	① IR동향 ② EU 기업 지속가능성 보고 지침 대응 방안 ③ EU 공급망실사지침 대응 경과 ④ 산업안전보건 관리 현황	- - - -	- - - -			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	'24.10.29 (4차)	① IR동향 ② 주식예탁증서 우선주 상장 이전 ③ 신환경경영전략 추진 경과 ④ 안전보건 주요 현안	- - - -	- - - -			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보 중 사내이사는 이사회에서 추천하고 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회에서 추천하여, 이사회가 이를 검토해서 주주총회의 회의목적 사항으로 확정합니다.

이사 선임에 있어서는 관련 법령과 정관에 정한 요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 재무, 법률, IT(로봇, AI), ESG, 금융, 투자, 환경, 에너지, 국제통상, Risk 관리 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

직 명	성 명	임 기 (연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계
사내이사 (대표이사)	한종희	'20.03~'26.03 (1회)	디스플레이 제품 분야의 최고 개발 전문가로서 당사가 글로벌 TV 1위를 지속 달성하는데 주도적인 역할을 하였으며, DX부문장으로서 탁월한 경영역량을 발휘하여 경쟁이 심화되고 있는 시장을 주도하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단	이사회	DX부문 경영전반 총괄	해당사항없음	특수관계인
사내이사	노태문	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	MX사업부의 주요 핵심보직을 두루 경험하였고, '21년에는 Galaxy S21, 폴더블 등을 통해 매출 104조원을 달성하여 '14년 이후 최고 실적을 창출하였음. 또한, 사업운영 개선을 통해 수익성을 강화하고 사업체질을 공고화하는 등 기업체질 변화에 크게 기여할 것으로 판단	이사회	MX사업부 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	이정배	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	메모리사업부의 개발, 품질, 전략 등 주요 보직들을 두루 경험한 전문가로 제품 경쟁력 확보를 통해 DRAM 30년 연속 매출 1위를 달성하였고, '21년에는 세계 반도체 매출 1위를 재탈환하는 등 DS부문 사업에 대한 풍부한 경험과 뛰어난 역량을 보유한 것으로 판단	이사회	메모리사업부 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사외이사	김한조	'19.03~'25.03 (1회)	은행장을 역임한 재무전문가이자 전문 경영인이며사회공헌 재단을 맡은바 있어 경영 전반에 대한 조언 외에 재무 전문성 및 상생·나눔경영 역량을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	김준성	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	글로벌 선진 금융시장에서 주식시장 분석과 투자 경험을 쌓은 국제경제 및 투자 전문가로서, 해외시장과 외국 투자자들의 입장을 잘 대변하고, 글로벌 네크워킹을 활용하여 트렌디한 투자 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	허은녕	'22.11~'25.11 (해당사항 없음)	에너지·자원·환경 관련 경제 및 정책 분야 전문가이자 세계적으로도 손꼽히는 석학으로 당사 해당 분야의 경영 강화에 기여하는 한편, 이사회에 실질적인 조언을 해줄 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	유명희	'22.11~'25.11 (해당사항 없음)	통상교섭본부장을 역임한 국제 통상전문가로 외교적 소통 노하우, 글로벌 인적 네트워크를 바탕으로 회사의 주요 투자자 및 이해 관계자들과 긴밀히 소통할 수 있을 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	신제윤	'24.03~'27.03 (해당사항 없음)	제4대 금융위원회 위원장을 역임한 금융·재정 전문가로서 회사의 자금 운용 및 글로벌 전략 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	조혜경	'24.03~'27.03 (해당사항 없음)	한국로봇학회 19대 회장을 역임한 로봇공학 및 로봇 소프트웨어 분야의 전문가이며 국내 로봇 연계 교육에도 앞장서 왔음. 당사의 관련 사업에 대해 실질적 조언을 해줄 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회

주주총회에서 선임하는 사외이사의 후보자를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 위원회는 사외이사 3인(신제윤, 허은녕, 유명희)으로 구성되어 있어 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있습니다. 작성기준일 이후 2025년 제1차 이사회에서 김한조 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.

사외이사 후보추천위원회는 사외이사 후보군(사외이사 추천인, 대외기관 추천인 등 포함) 중에서 이사회 구성, 임기만료 예정인 사외이사의 경력과 이사회내 위원회 활동 등 제반 사항을 종합적으로 살펴 적임자를 선정해 최종 사외이사 후보로 추천하고
있습니다.

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명			
				김선욱 (출석률:100%)	허은녕 (출석률: 100%)	유명희 (출석률: 100%)	신제윤 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부			
사외이사 후보추천위원회	'24.01.29 (1차)	① 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규 선임)
		② 사외이사 후보추천일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	
	'24.02.19 (2차)	① 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	
		② 사외이사 후보추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	
	'24.07.29 (3차)	① 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음 (사임)	찬성 -	찬성 -	찬성 -
		② 사외이사 후보군 선정 경과 보고					

(3) 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수 / 지원업무 담당기간)	주요 활동내역
이사회 사무국	4	・부사장 1명(19년 11개월 / 2년 1개월), ・직원(Principal Professional) 2명 (평균 18년 1개월 / 평균 3년 4개월) ・직원(Professional) 1명 (7년 11개월 / 1년 10개월)	・주주총회, 이사회, 이사회내 위원회 운영 지원 ・사외이사 교육 및 직무수행 지원 ・이사 후보군 데이터베이스 구축 ・각 이사에게 안건에 관련된 정보 제공 ・회의 진행을 위한 실무 지원 ・이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실시 현황

① 국내외 경영현장 점검

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022.04.28	MX사업부	김한조, 김선욱, 박병국, 김종훈, 김준성	해당사항 없음	・사업부 경영현황 및 전략제품 소개 등
2022.07.28	Memory 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성	해당사항 없음	・사업부 경영현황 및 생산라인 소개 등
2022.08	SEUK, SRUK, SEF, SENA, SEH	김한조, 김선욱, 김종훈	코로나19 감염 (김준성 이사)	・경영현황 보고 및 주요 현안 질의 ・TV 생산라인 및 영업 현장 방문 등
2022.11.30	Foundry 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	・사업부 경영현황 파악 및 현장 답사
2023.01.31	Samsung Research, 디자인경영센터	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	・DX부문 R&D 현황 보고 및 CTO 간담회 등
2023.04.27	생활가전 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희	겸직 업무 (김준성 이사)	・광주사업장 운영 현황 보고 및 현장 답사
2023.07.27	S.LSI 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	・사업부 경영현황 및 중장기 사업전략 보고 등
2023.08	SEDA, SECH, SELA, SEM	김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희	겸직 업무 (김준성 이사)	・경영현황 보고 및 주요 현안 질의, 내부통제활동 평가 ・생산라인 및 마케팅 현장 방문, 임직원 간담회
2023.10.31	VD 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희	겸직 업무 (김준성 이사)	・사업부 경영현황 및 사업전략 보고 등
2024.01.31	MX 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	・사업부 미래 준비현황 및 전략제품 소개 등
2024.04.30	Memory 사업부	김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	해당사항 없음	・사업부 경영현황 및 평택사업장 현장 방문
2024.05	인력개발원	김한조, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	겸직 업무 (김준성 이사)	・대구삼성창조캠퍼스 및 영덕연수원 방문
2024.07.29	한국총괄	김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	해당사항 없음	・국내 영업조직 소개 및 삼성스토어 방문

2024.07.31	Samsung Research, 디자인경영센터	김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	해당사항 없음	· DX부문 R&D, 디자인 현황 보고 및 CTO 간담회 등
2024.08	SESP, SEHC, SEVT, SRV, SEAU, TSE	김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	해당사항 없음	· 경영현황 보고 및 주요 현안 질의, 내부통제활동 평가 · 생산라인 및 마케팅 현장 방문, 임직원 간담회
2024.10.31	삼성디스플레이	김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	해당사항 없음	· 자회사 경영현황 및 기흥사업장 현장 방문
2024.11.29	MX사업부	김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	해당사항 없음	· 사업부 경영현황 및 최신 전략제품 소개 등

※ 사외이사의 현업 일정 등으로 회사가 준비한 사업부나 법인 방문, 교육 등의 프로그램에 현장 참석이 어려운 경우 교육자료 등을 제공하고 있습니다.

② 신임 사외이사 오리엔테이션

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022.04.27	경영지원실	김준성	해당사항 없음	· 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
2022.11.28	경영지원실	허은녕, 유명희	해당사항 없음	· 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
2024.03.20	경영지원실	신제윤, 조혜경	해당사항 없음	· 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
2024.04.26	인력개발원	신제윤, 조혜경	해당사항 없음	· 삼성 역사와 경영철학

※ 교육 참석 대상은 신임 사외이사입니다.

③ 사외이사 공통 교육

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2023.03.15	인력개발원	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	· 회사 역사, 경영철학 등 회사경영 관련 주요사항
2023.04.25	글로벌마케팅실 글로벌EHS센터	김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희	겸직 업무 (김준성 이사)	· 마케팅 활동의 이해 · EHS 관리 현황 및 환경 경영의 이해
2023.10.27	사회공헌단 청년S/W아카데미 창의개발센터	김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희	겸직 업무 (김준성 이사)	· 희망디딤돌 등 CSR 활동의 이해 · SSAFY 프로그램 소개 · C-Lab 소개 및 활동 소개
2024.05.23	경영지원실	김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	해당사항 없음	· 이사회 워크샵 실시, 주요 현안 이슈 논의
2024.07.29	DS부문 글로벌인프라총괄	김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	해당사항 없음	· 반도체 FAB 인프라 이해
2024.10.31	경영지원실	김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	해당사항 없음	· 로봇 및 메드텍 사업전략 보고

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2024년말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 김한조 위원이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

성명	사외이사 여부	경력	회계・재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
김한조	예	・하나금융나눔재단 이사장('22~'24) ・하나금융공익재단 이사장('19~'21) ・하나금융나눔재단 이사장('15~'19) ・㈜하나금융지주 부회장('15~'16) ・㈜한국외환은행 은행장('14~'15) ・외환캐피탈㈜ 사장('13~'14)	예	4호 유형 (금융기관・정부・ 증권유관기관 등 경력자)	・㈜하나금융지주 부회장('15~'16) ・㈜한국외환은행 은행장('14~'15) ・외환캐피탈㈜ 사장('13~'14) ・㈜한국외환은행 - 기업사업그룹장('12~'13) - 지점장('99~'02, '04~'05)
유명희	예	・서울대 국제대학원 객원교수('22~현재) ・외교부 경제통상대사('21~'22) ・산업통상자원부 통상교섭본부 본부장, Minister of Trade (차관급)('19~'21) ・산업통상자원부 통상교섭실 실장('18~'19) ・산업통상자원부 통상정책국 국장('17~'18) ・산업통상자원부 자유무역협정교섭관 겸 자유무역협정추진 기획단장('15~'17) ・대통령비서실 홍보수석실 외신대변인('14~'15)	-	-	-
조혜경	예	・한국공학한림원 정회원('23~현재) ・한국로봇학회 회장('22) ・국가과학기술자문회의(심의회의) 기계소재전문위원회 위원('21~'22) ・제어로봇시스템학회 부회장('20~'21) ・대한전기학회 이사('14~'17) ・한국로봇산업진흥원 이사(의장)('12~'15) ・한성대학교 AI응용학과 교수('96~현재)	-	-	-

※ 전문가 유형은 기업공시서식 작성기준 및「상법 시행령」제37조 제2항에 따른 회계・재무전문가 유형입니다.

・4호 유형: 금융기관・정부・증권유관기관 등에서 회계・재무 관련 업무 또는 이에 대한 감독업무를 수행한 경력이 모두 5년 이상인지 여부

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한・책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원 전원은 이사회 및 사외이사 후보추천위원회의 추천을 받고 주주총회의 결의를 통해 선임한 재무전문가(김한조 위원)와 미국 변호사 자격 소지자(유명희 위원), 타 상장법인의 감사위원(조혜경 위원)으로 구성되어 있습니다. 동 위원회 위원은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등
3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」 제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제2조
사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김한조 위원)	「상법」 제542조의11 제2항, 당사 감사위원회 규정 제3조
감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김한조 위원)	
그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」 제542조의11 제3항

(기준일 : 2024년 12월 31일)

성 명	감사위원회 위원 임기 (연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	타회사 겸직 현황
김한조	'19.03~'25.03 (연임/1회)	재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	-
유명희	'24.03~'25.11 (신규선임)	산업통상자원부 통상교섭본부장을 역임한 국제 통상 전문가로 외교적 소통 노하우, 글로벌 인적 네트워크를 바탕으로, 독립적이고 객관적인 시각에서 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	-
조혜경	'24.03~'27.03 (신규선임)	AI응용학과 교수와 한국로봇학회 회장을 역임한 공학전문가로서 이해관계자들의 다양성 확대 및 ESG 경영에 대한 요구에 대응하여 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-

※ 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

감사위원회는 회계감사를 위해서 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는
신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명				
				김한조 (출석률: 100%)	김선욱 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)	유명희 (출석률: 100%)	조혜경 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부				
감사 위원회	'24.01.29	1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-		
		2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-		
		3. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-	-	-		
		4. 2023년(제55기) 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	-	-	-	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)
		5. 2023년 4분기 비감사업무 수행 검토 보고의 건(*)	-	-	-	-		
		6. 2023년 4분기 대외후원금 현황 보고의 건	-	-	-	-		
		7. 2023년 감사실적 보고의 건	-	-	-	-		
	'24.02.19	1. 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건	-	-	-	-		
		2. 2023년 내부감시장치 가동현황 보고의 건	-	-	-	-		
	'24.04.26	1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-	해당사항 없음 (사임)	해당사항 없음 (임기만료)	-	-
		2. 2023년 외부감사 이행 평가 보고의 건	-	-			-	-
		3. 2024년 1분기 보고서 보고의 건	-	-			-	-
		4. 2024년 1분기 비감사업무 수행 검토 보고의 건(*)	-	-			-	-
		5. 외부감사인과의 감사계약조건 결정의 건	가결	찬성			찬성	찬성
		6. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건	-	-			-	-
		7. 2024년 1분기 대외 후원금 현황 보고의 건	-	-			-	-
		8. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고의 건	-	-			-	-
	'24.07.29	1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-			-	-
		2. 2024년 반기 보고서 보고의 건	-	-			-	-
		3. 2024년 2분기 비감사업무 수행 검토 보고의 건(*)	-	-			-	-
		4. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 건	-	-			-	-
		5. 2024년 2분기 대외 후원금 현황 보고의 건	-	-			-	-
		6. 2024년 상반기 감사실적 보고의 건	-	-			-	-
	'24.08.05	1. 동남아총괄 '24년 내부회계관리제도 운영현황 보고	-	-			-	-
		2. 동남아총괄 부정 제보채널 운영, 부정감사 현황 보고	-	-			-	-
	'24.10.25	1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-			-	-
		2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 중간보고	-	-			-	-
	'24.10.29	1. 2024년 3분기 보고서 보고	-	-			-	-
		2. 2024년 3분기 비감사업무 수행 검토 보고(*)	-	-			-	-
		3. 2024년 3분기 대외후원금 현황 보고	-	-			-	-
	'24.11.27	1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-			-	-
		2. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성			찬성	찬성

※ 당사 외부감사인이 감사위원회 승인 대상 비감사용역을 수행하지 않았음을 검토하여 보고한 안건으로,
감사위원회는 감사위원 간 논의를 거쳐 승인 대상 비감사용역을 수행하지 않았음을 최종 확인하였습니다.

라. 감사위원회 교육 실시 계획

당사는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 연 1회 이상 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가, 재경팀 및 감사팀 등이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다.

마. 감사위원회 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2021.07.27	외부전문가	박재완 김선욱 김한조	해당사항 없음	연결 내부회계관리제도 도입
2022.05.25	재경팀, 외부전문가	김종훈	해당사항 없음	내부회계관리제도와 감사위원회의 역할
2022.07.26	외부전문가	김한조 김선욱 김종훈	해당사항 없음	내부회계관리제도 조직운영 관련 해외 선진 사례
2023.10.27	외부전문가	김한조 김선욱 김종훈	해당사항 없음	내부회계관리제도 생성형 AI 활용 등 고도화 방안
2024.04.23	외부전문가, 감사팀, 내부회계평가지원그룹	유명희 조혜경	해당사항 없음	감사위원회 기본 개요, 역할과 책임 등
2024.05.21	외부전문가	조혜경	해당사항 없음	기업지배구조 및 감사위원회 제도, 운영, 활동방안 등
2024.07.04	외부전문가	유명희 조혜경	해당사항 없음	IT통제와 디지털 감사, 준법 감독, 감사위원회 역할 등
2024.07.08	내부회계평가지원그룹	유명희 조혜경	해당사항 없음	핵심감사사항
2024.11.20	외부전문가	김한조 유명희 조혜경	해당사항 없음	내부회계관리제도

바. 감사위원회 지원조직 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
감사팀	3	부사장 1명(1개월) 직원(Principal Professional) 1명(7년) 직원(Senior Professional) 1명(3년)	감사위원회 지원
내부회계 평가지원그룹	4	부사장 1명(6년) 변호사 1명(3년 9개월) 직원(Principal Professional) 1명(1년 7개월) 직원(Senior Professional) 2명(평균 11개월)	내부회계관리제도 운영실태 평가 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

사. 준법지원인에 관한 사항

(기준일 : 2024년 12월 31일)

구 분		내 용
1. 인적사항 및 주요경력	성명	박정호
	출생연월	1971.09
	성별	남
	담당업무	삼성전자㈜ Compliance팀장('22.12～현재)
	주요경력	'04.05 : 삼성전자㈜ 경영지원실 인사팀 변호사 '14.12 : 삼성전자㈜ 법무실 법무팀 상무 '18.03 : 삼성전자㈜ DS부문 법무지원팀 상무 '20.01 : 삼성전자㈜ Compliance팀 상무 '22.12 : 삼성전자㈜ Compliance팀장 부사장
	학력	서울대 법학(학사) 미시간주립대 대학원 노사관계학(석사)
2. 이사회 결의일		2022.12.20
3. 결격요건		해당사항 없음
4. 기타		해당사항 없음

※ 준법지원인은 관련 법령「상법」제542조의13 제5항의 요건(변호사 자격)을 충족하고 있습니다.

아. 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과

당사는 국내외 사업장에서 정기・비정기적으로 준법 점검 활동을 수행하고 있으며, 점검 결과를 바탕으로 개선이 필요한 사안은 경영 활동에 반영하여 회사 및 임직원이제반 법규를 준수할 수 있도록 효과적인 준법 지원 활동을 하고 있습니다.

점검일시		점검내용	점검분야	점검 및 처리 결과
'24.1분기	'24.03	특허출원 프로세스 점검	영업비밀, 기술유용 등	전반적으로 양호하며, 일부 개선 필요사항은 사내 정책 등에 따라 보완함
		국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
'24.2분기	'24.04	온라인 판매 사이트 준법 점검	소비자보호, 다크패턴	
	'24.05	국내 영업조직 준법 점검	공정거래, 영업비밀 등	
	'24.06	해외법인 자율 준법 점검	컴플라이언스 프로그램 운영 현황	
		국내 개발조직 준법 점검	영업비밀	
		해외 판매법인 준법 점검	공정거래, 영업비밀 등	
		온라인 판매 사이트 준법 점검	소비자보호, 그린워싱	
		국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
'24.3분기	'24.07	특허출원 프로세스 점검	기술유용, 영업비밀 등	
		해외 생산법인 준법 점검	기술유용, 반부패 등	
	'24.09	국내 영업조직 준법 점검	공정거래, 영업비밀등	
		대외 기술소싱 채널 준법 점검	영업비밀, 기술유용 등	
		국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
'24.4분기	'24.10	국내 영업조직 준법 점검	공정거래	
		온라인 판매 사이트 준법 점검	소비자보호, 그린워싱	
	'24.11	대외후원금 리스크 점검	반부패, 공정거래	
	'24.12	자회사 준법 점검	영업비밀, 개인정보 등	
		국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	

※ 점검시기는 각 분기별 종료월 기준입니다.

※ 각 점검은 일부 점검대상 조직을 선정하여 실시하였습니다.

자. 준법지원인 지원 조직 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
Compliance팀 등	60	상무 1명(1개월), 직원(Principal Professional) 20명(평균 9년 5개월), 변호사 10명(평균 5년 6개월), 직원(Senior Professional) 25명(평균 6년 3개월), 직원(Professional) 4명(평균 2년 1개월)	준법지원인 주요 활동 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 2024년말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 2024년 3월 20일 제55기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 당사 이사회는 2020년 1월 30일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2020년 3월 18일에 개최한 제51기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다.
당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	-	-	제55기('23년도) 정기주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

2024년말 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주입니다. 이 중 우선주는 의결권이 없으며, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(603,783,175주)을 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 5,336,299,375주입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	5,969,782,550	-
	우선주	822,886,700	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	29,700,000	자기주식
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	822,886,700	우선주인 자기주식 4,050,000주 포함
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	603,325,350	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 제한 (삼성생명보험㈜ 508,157,148주, 삼성화재해상보험㈜ 88,802,052주, 삼성복지재단 4,484,150주, 삼성문화재단 1,880,750주, 삼성생명공익재단 1,250주)
	보통주	457,825	「보험업법」에 의한 제한 (삼성생명보험㈜ 특별계정 일부)
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	5,336,299,375	-
	우선주	-	-

※ 단, '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에서,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 제한된 주식(603,325,350주) 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사가 가능합니다.

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	1. 이 회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 제8조 6항에서 정하는 바에 따라 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생 하였을 경우에는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 이를 처리한다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 ③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ④ 제11조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ⑤ 제11조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입 등을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. ☞ (주) 제8조 6항 이 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다. ☞ (주) 제11조의 3 (일반공모증자) 1. 이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제1항 제3호의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행할 수 있다. 2. 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. ☞ (주) 제11조의 4 (주식매수선택권) 1. 이 회사는 임・직원(「상법」 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의

	임・직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게「상법」이 허용하는 한도내에서 「상법」제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. 다만, 관련 법령이 정하는 한도까지 임・직원(이 회사의 이사를 제외한다)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립・경영・해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임・직원으로 하되 관련 법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임・직원은 제외한다. 3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다. 4. 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관련 법령에서 허용하는 한도까지로 한다. 5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년이내에서 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회의 결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다. 단, 이 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 관련 법령이 정하는 경우를 제외하고는 본문의 규정에 의한 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다. 6. 주식매수선택권의 내용, 행사가격 등 주식매수선택권의 조건은 관련 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의로 정하되, 관련 법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 규정하지 않은 사항은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다. 7. 다음 각호에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. ① 임・직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 ② 임・직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 ③ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우
결 산 일	12월 31일
정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내
명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500): 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동)
주주의 특전	없음
공고 방법	중앙일보

※ 2019년 9월 16일「주식・사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법")시행으로,주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

※ 당사는 정관에 의거 중앙일보에 공고하고 있으며, 당사 홈페이지(https://www.samsung.com/sec/ir)에도 게재하고 있습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2024년 12월 31일)

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용
제55기 정기주주총회 (2024.03.20)	제1호 의안 : 제55기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건	가결	· 55기 영업성과 및 배당 관련 설명 · 주주가치 제고 방안 질의응답 · 사업경쟁력 관련 질의응답
	제2호 의안 : 사외이사 신제윤 선임의 건	가결	· 금융/재정 전문가 등 후보 추천사유 설명
	제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건	가결	· 다양한 조직에서의 감사경력 등 후보 추천사유 설명 · 감사위원이 되는 사외이사 후보의 IT 전문성 및 회계/재무 전문성 관련 의견 등 후보선정에 관한 질의응답
	제4호 의안 : 감사위원회 위원 유명희 선임의 건	가결	· 국제통상 및 법률전문가 등 후보 추천사유 설명 · 감사위원 후보의 회계/재무 전문성 및 감사위원회의 다양성 측면 의견 등 후보선정에 관한 질의응답
	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	· 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명
	제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	· 관계법령 및 이사회 산하 위원회 활동 반영 등 정관변경 배경 및 내용 설명
제54기 정기주주총회 (2023.03.15)	제1호 의안 : 제54기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건	가결	· 54기 영업성과 및 배당 관련 설명 · 주주가치 제고 방안 질의응답 · 사업경쟁력 관련 질의응답
	제2호 의안 : 사내이사 한종희 선임의 건	가결	· 완제품 사업 전반에 대한 리더십 등 후보 추천사유 설명
	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	· 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명
제54기 임시주주총회 (2022.11.03)	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 1-1호: 사외이사 허은녕 선임의 건 1-2호: 사외이사 유명희 선임의 건	 가결 가결	· 임시주총 개최 사유 관련 질의응답 · 에너지/환경 분야 및 통상분야 전문성 등 후보 추천사유 설명
제53기 정기주주총회 (2022.03.16)	제1호 의안 : 제53기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건	가결	· 53기 영업성과 및 배당 관련 설명 · 주주가치 제고 방안 질의응답 · 사업경쟁력 관련 질의응답
	제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호: 사외이사 선임의 건 2-1-1호: 사외이사 김한조 선임의 건 2-1-2호: 사외이사 한화진 선임의 건 2-1-3호: 사외이사 김준성 선임의 건 2-2호: 사내이사 선임의 건 2-2-1호: 사내이사 경계현 선임의 건 2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건 2-2-3호: 사내이사 박학규 선임의 건 2-2-4호: 사내이사 이정배 선임의 건 2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건	 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 	 · 금융 및 회계/재무 전문가 등 후보 추천사유 설명 · 비즈니스 리더십 및 사업/재무 전문성 등 후보 추천사유 설명 · 글로벌 경영능력 등 후보 추천사유 설명

	2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건 2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건	가결 가결	
	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	· 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
삼성생명보험㈜	최대주주 본인	보통주	508,157,148	8.51	508,157,148	8.51	-
삼성생명보험㈜	최대주주 본인	우선주	43,950	0.01	43,950	0.01	-
삼성생명보험㈜ (특별계정)	최대주주 본인	보통주	8,097,938	0.14	5,378,652	0.09	장내 매매
삼성생명보험㈜ (특별계정)	최대주주 본인	우선주	417,085	0.06	329,788	0.04	장내 매매
삼성물산㈜	계열회사	보통주	298,818,100	5.01	298,818,100	5.01	-
삼성화재해상보험㈜	계열회사	보통주	88,802,052	1.49	88,802,052	1.49	-
삼성복지재단	출연 재단	보통주	4,484,150	0.08	4,484,150	0.08	-
삼성문화재단	출연 재단	보통주	1,880,750	0.03	1,880,750	0.03	-
삼성생명공익재단	출연 재단	보통주	0	0.00	1,250	0.00	특수관계없는 일반인의 기부
홍라희	최대주주의 특수관계인	보통주	117,302,806	1.96	97,978,700	1.64	시간외 매매
홍라희	최대주주의 특수관계인	우선주	206,633	0.03	206,633	0.03	-
이재용	최대주주의 특수관계인	보통주	97,414,196	1.63	97,414,196	1.63	-
이재용	최대주주의 특수관계인	우선주	137,757	0.02	137,757	0.02	-
이부진	계열회사 임원	보통주	55,394,044	0.93	47,745,681	0.80	시간외 매매
이부진	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
이서현	계열회사 임원	보통주	55,394,044	0.93	47,290,190	0.79	시간외 매매
이서현	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
한종희	계열회사 임원	보통주	15,000	0.00	25,000	0.00	장내 매매
경계현	계열회사 임원	보통주	21,050	0.00	0	0.00	이사 사임
노태문	계열회사 임원	보통주	13,000	0.00	28,000	0.00	장내 매매
박학규	계열회사 임원	보통주	22,500	0.00	0	0.00	이사 사임
이정배	계열회사 임원	보통주	15,000	0.00	21,800	0.00	장내 매매
김한조	계열회사 임원	보통주	3,655	0.00	6,985	0.00	장내 매매
조혜경	계열회사 임원	보통주	0	0.00	500	0.00	신규 선임
계		보통주	1,235,835,433	20.70	1,198,033,154	20.07	-
		우선주	1,080,935	0.13	993,638	0.12	-

※ 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.
(단, 보통주 일부는 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한되어 있습니다. 자세한 현황은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '3. 주주총회 등에 관한 사항'의 '라. 의결권 현황'을 참고하시기 바랍니다.)

※ 2024년 12월 31일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '주식등의대량보유상황보고서(일반)' 등을 참고하시기 바랍니다.

2. 최대주주 관련 사항

가. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 기본정보

1) 법적・상업적 명칭: 삼성생명보험㈜ (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)

2) 설립일자: 1957년 4월 24일

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
전화번호: 1588-3114
홈페이지: www.samsunglife.com

4) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주

(단위 : 명, %)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성생명보험㈜	64,322	홍원학	0.00	-	-	삼성물산㈜	19.34
		-	-	-	-	-	-

※ 2024년 12월 31일 보통주 기준입니다.

5) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2024.03.21	홍원학	0.00	-	-	-	-

※ 2024년 3월 21일 전영묵 대표이사가 사임하고, 홍원학 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

(2) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성생명보험㈜
자산총계	312,218,844
부채총계	279,480,913
자본총계	32,737,931
매출액	33,786,029
영업이익	2,499,751
당기순이익	2,260,255

※ 재무현황은2024년 12월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 사업현황 등

삼성생명보험㈜은 인보험 및 그와 관련된 재보험계약 등을 주요 영업목적으로 하는 생명보험회사로, 보험업법 및 기타 법령 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.
또한, 주요 종속기업인 삼성카드㈜는 여신전문금융업(신용카드업・시설대여업・할부금융업 등)을 영위하는 여신전문금융회사로, 여신전문금융업법 및 기타 관계법령에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

☞ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 삼성생명보험㈜의 사업(분・반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 기본정보

1) 법적・상업적 명칭: 삼성물산㈜ (Samsung C&T Corporation)

2) 설립일자 및 존속기간
1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)
전화번호: 02-2145-5114
홈페이지: www.samsungcnt.com

4) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주

(단위 : 명, %)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성물산㈜	114,158	오세철	0.00	-	-	이재용	19.06
		정해린	0.00	-	-	-	-
		이재언	0.00	-	-	-	-

※ 2024년 12월 31일, 보통주 기준입니다.

5) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역

(단위 : %)

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2023.03.17	한승환	-	-	-	-	-
2023.03.17	정해린	0.00	-	-	-	-
2023.04.21	-	-	-	-	이재용	18.26
2024.03.15	고정석	-	-	-	-	-
2024.03.15	이재언	0.00	-	-	-	-
2024.04.19	-	-	-	-	이재용	19.06

※ 2023년 3월 17일 한승환 대표이사가 사임하고, 정해린 대표이사가 선임되었습니다.

※ 2023년 4월 21일 자기주식 소각(보통주 1,295,411)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(18.13%→18.26%)되었습니다.

※ 2024년 3월 15일 고정석 대표이사가 사임하고, 이재언 대표이사가 선임되었습니다.

※ 2024년 4월 19일 자기주식 소각(보통주 7,807,563)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(18.26%→19.06%)되었습니다

(2) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성물산㈜
자산총계	61,990,427
부채총계	24,731,887
자본총계	37,258,540
매출액	42,103,238
영업이익	2,983,397
당기순이익	2,772,012

※ 재무현황은 2024년 12월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 사업현황 등

삼성물산㈜은 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다.

☞ 최대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 삼성물산㈜의 사업(분・반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 최대주주 변동현황

공시대상기간 중 최대주주의 변동 사항은 없습니다.

4. 주식의 분포 현황

가. 주식 소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	삼성생명보험㈜	513,535,800	8.60	특별계정 포함
	국민연금공단	433,041,739	7.25	-
	BlackRock Fund Advisors	300,391,061	5.03	2019년 1월 28일 기준
	삼성물산㈜	298,818,100	5.01	-
우리사주조합		-	-	-

※ 5% 이상 주주는 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.
자세한 현황은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '3. 주주총회 등에 관한 사항'의 '라. 의결권 현황'을
참고하시기 바랍니다.
※ BlackRock Fund Advisors의 소유주식수 및 지분율은 2019년 2월 7일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에
공시된 '주식등의 대량보유상황보고서' 기준입니다.

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	
소액주주	5,160,210	5,160,297	99.99	4,073,349,914	5,969,782,550	68.23	-

※ 소유주식은 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.
※ 소액주주는 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다.

5. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류			'24.07월	'24.08월	'24.09월	'24.10월	'24.11월	'24.12월
보통주	주가	최 고	87,800	83,100	74,400	61,300	58,700	56,100
		최 저	80,400	71,400	61,500	55,900	49,900	53,000
		평 균	84,383	76,500	66,033	59,295	55,776	54,035
	거래량	최고(일)	45,791,193	54,608,790	49,402,713	45,262,214	52,527,995	33,476,698
		최저(일)	11,317,202	7,805,598	12,641,376	14,420,260	13,877,396	10,517,075
		월 간	477,159,149	402,010,176	516,679,519	537,302,984	581,402,427	387,381,948
우선주	주가	최 고	69,800	64,800	60,000	51,400	49,050	46,600
		최 저	63,000	56,100	50,900	47,650	42,650	43,050
		평 균	66,248	61,267	54,322	49,568	47,098	45,153
	거래량	최고(일)	3,661,034	2,892,408	4,075,148	5,977,382	5,717,164	2,906,785
		최저(일)	754,676	519,390	1,085,368	1,266,982	672,154	570,379
		월 간	39,489,781	29,613,234	38,893,609	45,501,469	39,042,600	27,930,917

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 런던 증권거래소(보통주)] (단위 : US$, 원, DR)

종 류				'24.07월	'24.08월	'24.09월	'24.10월	'24.11월	'24.12월
보통주	주가	최고	US$	1,612.00	1,499.00	1,395.00	1,164.00	1,068.00	971.50
			₩환산	2,230,041	2,068,770	1,862,046	1,521,232	1,473,092	1,390,605
		최저	US$	1,449.00	1,328.00	1,169.00	1,014.00	898.00	904.50
			₩환산	2,007,010	1,806,877	1,542,612	1,399,827	1,263,755	1,333,323
		평균	US$	1,526.09	1,420.33	1,235.86	1,091.48	995.74	935.93
			₩환산	2,111,162	1,925,384	1,650,487	1,480,282	1,387,438	1,341,616
	거래량	최고(일)		27,882	59,610	34,961	31,302	46,338	74,174
		최저(일)		3,832	5,455	7,597	9,128	4,956	2,189
		월 간		281,497	348,482	371,268	390,246	450,652	373,507

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

※ 최고・최저 주가의 원화 환산은 해당 일자의 종가 원/달러 환율 기준이며, 평균 주가의 원화 환산은 월평균 원/달러 환율 기준입니다.

※ DR 1주당 원주 25주입니다.

[증권거래소명 : 룩셈부르크 증권거래소(우선주)] (단위 : US$, 원, DR)

종 류				'24.07월	'24.08월	'24.09월	'24.10월	'24.11월	'24.12월
우선주	주가	최고	US$	1,266.00	1,184.00	1,128.00	976.00	882.00	815.00
			₩환산	1,751,384	1,610,358	1,505,654	1,275,534	1,233,212	1,166,591
		최저	US$	1,138.00	1,064.00	983.00	865.00	770.00	750.00
			₩환산	1,572,716	1,447,678	1,297,167	1,194,133	1,078,847	1,087,275
		평균	US$	1,196.96	1,136.38	1,018.05	916.65	845.95	786.55
			₩환산	1,655,849	1,540,462	1,359,603	1,243,180	1,178,730	1,127,492
	거래량	최고(일)		2,900	3,035	3,916	5,272	5,882	6,966
		최저(일)		303	220	459	342	258	282
		월 간		24,777	22,224	33,421	50,799	34,361	43,713

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

※ 최고・최저 주가의 원화 환산은 해당 일자의 종가 원/달러 환율 기준이며, 평균 주가의 원화 환산은 월평균 원/달러 환율 기준입니다.

※ DR 1주당 원주 25주입니다.

※ 2025년 2월 13일 당사는 룩셈부르크 거래소에 상장되어 있는 DR우선주를 상장폐지하고, 동일 날짜에 DR 우선주를 런던거래소에 상장하였습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
한종희	남	1962.03	부회장	사내이사	상근	대표이사 (DX부문 경영전반 총괄)	· 인하대 전자공학 학사 · 삼성전자 DX부문장	25,000	-	계열회사 임원	58개월	2026.03.17
노태문	남	1968.09	사장	사내이사	상근	MX사업부장	· 포항공대 전자전기공학 박사 · 삼성전자 MX사업부장	28,000	-	계열회사 임원	34개월	2025.03.15
이정배	남	1967.02	상담역	사내이사	상근	상담역	· 서울대 전자공학 박사 · 삼성전자 메모리사업부장	21,800	-	계열회사 임원	34개월	2025.03.15
김한조	남	1956.07	이사	사외이사	비상근	이사회 의장 감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원 보상위원회 위원 지속가능경영위원회 위원장	· 연세대 불어불문학 학사 · 하나금융지주 부회장	6,985	-	계열회사 임원	70개월	2025.03.19
김준성	남	1967.10	이사	사외이사	비상근	보상위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· Carnegie Mellon대 경제학/산업공학 학사 · 싱가포르 투자청 토탈리턴그룹 이사	-	-	계열회사 임원	34개월	2025.03.15
허은녕	남	1964.08	이사	사외이사	비상근	내부거래위원회 위원장 사외이사 후보추천위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· Pennsylvania State대 자원경제학 박사 · 서울대 공과대학 교수	-	-	계열회사 임원	26개월	2025.11.02
유명희	여	1967.06	이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원 내부거래위원회 위원 사외이사 후보추천위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· Vanderbilt대 법학 박사 · 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장	-	-	계열회사 임원	26개월	2025.11.02
신제윤	남	1958.03	이사	사외이사	비상근	사외이사 후보추천위원회 위원장 보상위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· 서울대 경제학 학사 · 금융위원회 위원장	-	-	계열회사 임원	10개월	2027.03.28
조혜경	여	1964.07	이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· 서울대 로봇공학 박사 · 한성대 AI응용학과 교수	500	-	계열회사 임원	10개월	2027.03.19

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 기준이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하시기 바랍니다.

※ 2024년 3월 20일 정기주주총회에서 신제윤 사외이사, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 이사가 신규 선임되었으며, 유명희 사외이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. 당일 개최된 이사회를 통해 허은녕 사외이사와 유명희 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었고,

신제윤 이사는 사외이사 후보추천위원회 위원, 보상위원회 위원, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며,

조혜경 사외이사는 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2024년 3월 20일 김선욱 사외이사가 퇴임하였습니다.

※ 2024년 3월 22일 김종훈 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2024년 4월 26일 허은녕 사외이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2024년 5월 21일 경계현 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2024년 7월 29일 신제윤 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2024년 12월 26일 박학규 사내이사가 사임하였습니다.

※ 작성기준일 이후 2025년 1월 31일 제1차 이사회에서 김한조 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었으며 2025년 2월 14일 보상위원회 위원장으로

선임되었습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일)

구분	성명	성별	출생년월	사외이사 후보자 해당여부	주요경력	선·해임 예정일	최대주주와의 관계
선임	전영현	남	1960.12	사내이사	· KAIST 전자공학 박사 · 삼성SDI대표이사('17~'22) · 삼성전자 DS부문장 겸)메모리사업부장, SAIT 원장('24~현재)	2025.03.19	계열회사 임원
선임	노태문	남	1968.09	사내이사	· 포항공대 전자전기공학 박사 · 삼성전자 무선사업부 개발실장('17~'20) · 삼성전자 MX사업부장('20~현재)	2025.03.19	계열회사 임원
선임	송재혁	남	1967.08	사내이사	· 서울대학교 반도체공학 박사 · 삼성전자 반도체연구소장('22) · 삼성전자 DS부문 CTO 겸)반도체연구소장('22~현재)	2025.03.19	계열회사 임원
선임	김준성	남	1967.10	사외이사	· 美 Carnegie Mellon 대학교 경제학, 산업공학 학사 · 싱가포르 투자청(GIC) Managing Director('13~'20) · 싱가포르 국립대 Endowment Fund CIO('22~현재)	2025.03.19	계열회사 임원
선임	허은녕	남	1964.08	사외이사	· 美 Purdue대학교 전자컴퓨터공학 박사 · 세계에너지경제학회 부회장('17~'19) · 서울대학교 공과대학 교수('96~현재)	2025.03.19	계열회사 임원
선임	유명희	여	1967.06	사외이사	· 美Vanderbilt대 법학 박사 · 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장('19~'21) · 서울대학교 국제대학원 객원 교수('22~현재)	2025.03.19	계열회사 임원
선임	이혁재	남	1965.02	사외이사	· 美 Purdue대학교 전자컴퓨터공학 박사 · 서울대학교 반도체공동연구소 소장('24~현재) · 서울대학교 인공지능반도체 대학원 사업단장 ('21~현재) · 서울대학교 전기정보공학부 교수('01~현재)	2025.03.19	-

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제56기 정기주주총회의 안건으로,

향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

다. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일)

겸 직 자		겸 직 회 사		
성 명	직 위	기업명	직 위	재임 기간
유명희	사외이사	HD현대건설기계	사외이사	2022년~현재
조혜경	사외이사	현대건설	사외이사	2021년~현재

라. 미등기임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 개월)

성명	성별	출생 연월	직위	상근 여부	담당업무	주요경력	학력	최대주주 와의 관계	재직 기간
이재용	남	1968.06	회장	상근	회장	COO	Harvard Univ.(박사수료)	최대주주의 특수관계인	
전영현	남	1960.12	부회장	상근	DS부문장	미래사업기획단장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
정현호	남	1960.03	부회장	상근	사업지원T/F장	디지털이미징사업부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
고크리스 토퍼한승	남	1963.04	사장	상근	미래사업기획단장	삼성바이오에피스 대표이사	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	2
김수목	남	1964.05	사장	상근	법무실장	법무실 송무팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	52
김용관	남	1963.12	사장	상근	경영전략담당	사업지원T/F 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김우준	남	1968.05	사장	상근	네트워크사업부장	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김원경	남	1967.08	사장	상근	Global Public Affairs실장	북미총괄 대외협력팀장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	
남석우	남	1966.03	사장	상근	Foundry CTO	제조&기술담당	연세대(박사)	계열회사 임원	
박승희	남	1964.08	사장	상근	Corporate Relations담당	삼성물산, 건설부문 커뮤니케이션팀장	건국대(석사)	계열회사 임원	25
박용인	남	1964.04	사장	상근	System LSI사업부장	System LSI 전략마케팅실장	연세대(석사)	계열회사 임원	
박학규	남	1964.11	사장	상근	사업지원T/F 담당임원	경영지원실장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
백수현	남	1963.01	사장	상근	커뮤니케이션실장	커뮤니케이션팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	
송재혁	남	1967.08	사장	상근	DS부문 CTO	메모리 Flash개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
안중현	남	1963.03	사장	상근	경영지원실 담당임원	SGR, 미래산업연구본부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	9
양걸	남	1962.10	사장	상근	중국삼성전략협력실장	DS부문 중국총괄	서강대(석사)	계열회사 임원	
엄대현	남	1966.03	사장	상근	법무실 담당임원	법무실 송무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
용석우	남	1970.09	사장	상근	영상디스플레이사업부장	영상디스플레이 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(석사)	계열회사 임원	
이영희	여	1964.11	사장	상근	브랜드전략위원	글로벌마케팅실장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
이원진	남	1967.08	사장	상근	글로벌마케팅실장	Mobile eXperience 서비스 Biz팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경훈	남	1962.12	사장	상근	DX부문 CTO	네트워크사업부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor (박사)	계열회사 임원	
한승환	남	1964.07	사장	상근	의료사업일류화추진단장	삼성물산, 리조트부문 대표이사	서울대(학사)	계열회사 임원	25
한진만	남	1966.10	사장	상근	Foundry사업부장	DS부문 DSA총괄	서울대(학사)	계열회사 임원	
강동구	남	1976.12	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
강동훈	남	1970.12	부사장	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
강문수	남	1969.08	부사장	상근	Foundry사업부 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	
강석채	남	1971.06	부사장	상근	Foundry 전략마케팅실장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
강성철	남	1967.08	부사장	상근	생산기술연구소 담당임원	Samsung Research Robot센터장	서울대(박사)	계열회사 임원	
강신봉	남	1970.01	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C 센터장	위대한상상, CEO	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	24
강태우	남	1973.10	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	

강희성	남	1970.08	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
계종욱	남	1966.10	부사장	상근	Foundry Design Platform 개발실장	Foundry Design Platform 개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
고대곤	남	1965.03	부사장	상근	SEPM법인장	SIEL-P(C)법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
고봉준	남	1972.01	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	58
고재윤	남	1973.01	부사장	상근	구주총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
고재필	남	1970.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry 제조기술센터 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
곽연봉	남	1967.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터장	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
구본영	남	1967.05	부사장	상근	SAS법인장	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
구자흠	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실장	Foundry 기술개발실 담당임원	North Carolina State Univ.(박사)	계열회사 임원	
권상덕	남	1967.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 담당임원	반도체연구소 Logic TD실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
권오겸	남	1977.08	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	제조&기술담당 Foundry 제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
권태훈	남	1968.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	
권혁준	남	1971.06	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당Master	성균관대(석사)	계열회사 임원	2
김강태	남	1972.10	부사장	상근	Samsung Research 기술전략팀장	Samsung Research SE팀장	중앙대(박사)	계열회사 임원	
김경환	남	1970.06	부사장	상근	법무실 송무팀장	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
김경희	여	1969.07	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Yale Univ.(석사)	계열회사 임원	
김기환	남	1975.03	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	NVIDIA, Principal Research Scientist	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	57
김기훈	남	1968.05	부사장	상근	한국총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	Univ. of Baltimore(석사)	계열회사 임원	
김대주	남	1969.10	부사장	상근	영상디스플레이 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.06	부사장	상근	Samsung Research AI 센터장	Samsung Research Global AI 센터장	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
김동관	남	1969.10	부사장	상근	DS부문 정보보호센터장	삼성SDS 정보보호센터장	한양대(학사)	계열회사 임원	37
김동욱	남	1969.06	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Test&Package센터 담당임원	Univ. of California, Irvine(박사)	계열회사 임원	
김동욱	남	1968.10	부사장	상근	재경팀장	재경팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김두일	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research Platform 팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
김만영	남	1969.07	부사장	상근	SEG법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Boston Univ.(학사)	계열회사 임원	
김명철	남	1968.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	

김민구	남	1964.08	부사장	상근	System LSI 담당임원	System LSI SOC사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김병도	남	1967.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김보현	남	1973.02	부사장	상근	Foundry People팀장	DS부문 People팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김상우	남	1971.01	부사장	상근	DS부문 법무지원팀장	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	11
김성욱	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 D2C팀장	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김성윤	남	1966.10	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 책임변호사	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
김성은	남	1970.05	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	경북대(학사)	계열회사 임원	
김성한	남	1970.05	부사장	상근	Foundry Global 운영팀장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김세윤	남	1973.06	부사장	상근	TSE-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김수진	여	1969.08	부사장	상근	지속가능경영추진센터장	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(박사)	계열회사 임원	
김연정	남	1975.12	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김용국	남	1968.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성바이오에피스, 생산본부 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	42
김용성	남	1973.09	부사장	상근	SAIT Device Research Center장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김용수	남	1971.07	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀장	Google, VP	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	13
김용재	남	1972.03	부사장	상근	영상디스플레이 Next Product팀장	영상디스플레이 개발팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
김우평	남	1970.05	부사장	상근	DSRA-PKG 연구소장	TSP총괄 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	30
김유석	남	1965.04	부사장	상근	법무실 IP센터장	법무실 IP센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김윤호	남	1974.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	11
김은중	남	1965.06	부사장	상근	System LSI Global운영팀장	S.LSI Global Operation실 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김이수	남	1973.03	부사장	상근	SEVT법인장	SIEL-P(N)공장장	아주대(학사)	계열회사 임원	
김인식	남	1967.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성SDS, 전략기획담당 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor (석사)	계열회사 임원	
김일룡	남	1974.02	부사장	상근	System LSI 제품기술팀장	S.LSI Global Operation실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김장경	남	1973.05	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
김재열	남	1965.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김재준	남	1968.01	부사장	상근	메모리 전략마케팅실장	DS부문 미주총괄 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김재훈	남	1967.01	부사장	상근	SEIB법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김정식	남	1970.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
김정현	남	1975.06	부사장	상근	Mobile eXperience CX실장	Mobile eXperience CX실 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
김종훈	남	1969.12	부사장	상근	메모리 품질실장	메모리 품질실 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	

김주년	남	1969.12	부사장	상근	Mobile eXperience Galaxy Value Innovation팀장	Mobile eXperience 품질혁신센터장	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김준석	남	1972.10	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI Project Management팀장	연세대(박사)	계열회사 임원	
김준석	남	1969.04	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김중정	남	1973.11	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터장	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	
김지윤	여	1975.02	부사장	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	
김진수	남	1971.10	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	국민대(학사)	계열회사 임원	
김창업	남	1969.08	부사장	상근	동남아총괄	SEDA-S판매부문장	한양대(학사)	계열회사 임원	
김창태	남	1972.01	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	금오공대(학사)	계열회사 임원	
김철기	남	1968.03	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1969.04	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 설비기술연구소장	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김평진	남	1973.12	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	연세대(학사)	계열회사 임원	
김학상	남	1966.09	부사장	상근	Global CS센터장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Univ. of Massachusetts, Lowell (박사)	계열회사 임원	
김한석	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김현우	남	1970.02	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 기술기획팀장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김형로	남	1973.01	부사장	상근	영상디스플레이 People팀장	인사팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	37
김형재	남	1970.12	부사장	상근	SELA법인장	SEM-S법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김홍경	남	1965.11	부사장	상근	DS부문 경영지원실장	DS부문 경영지원실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김홍식	남	1969.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
나기홍	남	1966.03	부사장	상근	People팀 담당임원	People팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
노경래	남	1976.12	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEM-S 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	
노원일	남	1967.08	부사장	상근	SRA연구소장	네트워크 상품전략팀장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
다니엘오	남	1974.03	부사장	상근	IR팀장	IR팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	35
데이브다스	남	1975.06	부사장	상근	SEA 담당임원	SEIB법인장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
데이빗리	남	1969.07	부사장	상근	Samsung NEXT장	Refactor Capital, Co-founder	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	47
류경동	남	1970.01	부사장	상근	AI센터 담당임원	SAIT System Research Center장	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	16
린준청	남	1970.07	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구실 담당임원	Skytech, CEO	NTUST(박사)	계열회사 임원	24
마크리퍼트	남	1973.02	부사장	상근	북미총괄 대외협력팀장	YouTube, APAC 대외협력총괄	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	34
메노	남	1968.06	부사장	상근	SEF법인장	SEBN법인장	Haarlem Business School(학사)	계열회사 임원	

명호석	남	1967.04	부사장	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
문성우	남	1971.12	부사장	상근	경영혁신센터장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
문성훈	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	경북대(박사)	계열회사 임원	
문종승	남	1971.08	부사장	상근	생활가전 개발팀장	생산기술연구소장	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
문준	남	1974.06	부사장	상근	네트워크 개발팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문희동	남	1971.07	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	종합기술원 인사팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
바우만	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEUK법인장	Univ. of Bath(석사)	계열회사 임원	
박건태	남	1969.09	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀장	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	Univ. of Colorado, Boulder (석사)	계열회사 임원	
박문호	남	1965.01	부사장	상근	People팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상권	남	1971.07	부사장	상근	DS부문 커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	46
박성욱	남	1972.04	부사장	상근	SCS법인장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박성호	남	1968.09	부사장	상근	생활가전 Global제조팀장	SEVT법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	
박세근	남	1974.01	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
박수남	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	Univ. of Minnesota, Minneapolis(박사)	계열회사 임원	
박순철	남	1966.07	부사장	상근	경영지원실장	지원팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
박재성	남	1971.02	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
박정미	여	1968.07	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박정민	남	1972.03	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀장	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	48
박정호	남	1971.09	부사장	상근	Compliance팀장	Compliance팀 담당임원	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	
박정호	남	1974.11	부사장	상근	Samsung Research 차세대 통신연구센터장	Samsung Research 차세대 통신연구센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
박정훈	남	1969.10	부사장	상근	Samsung Research Visual Technology팀장	Samsung Research Media Research팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
박제민	남	1971.12	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실장	Univ. of California, Berkeley (박사)	계열회사 임원	
박중범	남	1969.02	부사장	상근	서남아총괄	SIEL-S 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박지선	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	SRA 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
박진영	여	1971.11	부사장	상근	DS부문 구매팀장	DS부문 구매팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
박찬우	남	1973.05	부사장	상근	한국총괄 B2B통합오퍼링센터 담당임원	생활가전 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박찬홍	남	1972.10	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	Qualcomm, Sr.Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	1
박철우	남	1971.10	부사장	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
박태상	남	1975.01	부사장	상근	SEVT 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박현정	남	1969.12	부사장	상근	DS부문 기획팀 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	

반효동	남	1967.06	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
발라지	남	1969.09	부사장	상근	SSIR연구소장	SSIR VP	Birla Institute of Technology andScience, Pilani(석사)	계열회사 임원	
배광진	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
배승준	남	1976.03	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
배일환	남	1970.07	부사장	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
백종수	남	1971.01	부사장	상근	신사업팀장	신사업T/F장	서울대(석사)	계열회사 임원	
부민혁	남	1973.06	부사장	상근	생활가전 디자인팀장	Mobile eXperience사업부 CX실 담당임원	제주대(학사)	계열회사 임원	
서보철	남	1972.01	부사장	상근	SIEL-P(N)법인장	Mobile eXperience Global운영팀장	동국대(학사)	계열회사 임원	
서원주	남	1976.07	부사장	상근	DS부문 IP팀장	DS부문 미주총괄 VP	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	49
서정아	여	1971.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
서한석	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
서형석	남	1968.02	부사장	상근	DS부문 DSC총괄	메모리 전략마케팅실 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	
성덕용	남	1973.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 설비기술연구소 담당임원	제조&기술담당 설비기술연구소 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
손성원	남	1969.02	부사장	상근	Mobile eXperience 지원팀장	북미총괄 지원팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
손영수	남	1974.02	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
손태용	남	1972.08	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
송기환	남	1970.07	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	
송두근	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터장	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌환경안전/인프라센터장	아주대(박사)	계열회사 임원	
송명주	여	1970.02	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	TSE-S법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
송방영	남	1974.10	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
송병무	남	1973.08	부사장	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
송승엽	남	1968.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 S.PKG제조기술센터장	TSP총괄 TP센터장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
송용호	남	1967.04	부사장	상근	AI센터장	메모리 Solution개발실장	Univ. of Southern California (박사)	계열회사 임원	
송철섭	남	1967.12	부사장	상근	DS부문 DSC 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
송호건	남	1966.01	부사장	상근	TSP총괄 C.PKG개발팀장	TSP총괄 Package개발실 담당임원	Univ. of California, Berkeley (박사)	계열회사 임원	
신경섭	남	1968.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터장	제조&기술담당 메모리제조기술센터장	Univ. of California, Berkeley (박사)	계열회사 임원	
신명훈	남	1965.01	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	

신승원	남	1974.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	48
신승철	남	1973.04	부사장	상근	DS부문 DSSEA총괄	Foundry Corporate Planning실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
신승혁	남	1968.01	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Polytechnic Univ. of NY(박사)	계열회사 임원	
신영주	남	1969.09	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
신정규	남	1969.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS/인프라기술연구소장	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	Technical Univ. of Munich(박사)	계열회사 임원	16
신종신	남	1973.12	부사장	상근	Foundry Design Platform 개발실장	Foundry Design Platform개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
신현진	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience People팀장	영상디스플레이 People팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
심재현	남	1972.01	부사장	상근	생활가전 지원팀장	지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
안길준	남	1969.01	부사장	상근	Mobile eXperience 담당임원	무선 개발실 담당임원	George Mason Univ.(박사)	계열회사 임원	
안수진	여	1969.12	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구실장	포항공대(박사)	계열회사 임원	
안유정	여	1974.08	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	Waymo, Head of Design	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	14
안재용	남	1968.08	부사장	상근	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
안정착	남	1970.12	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
양병덕	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
양세영	남	1975.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양익준	남	1969.11	부사장	상근	경영혁신센터 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
양준철	남	1972.06	부사장	상근	생활가전 구매팀장	생활가전 구매팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
양혜순	여	1968.02	부사장	상근	생활가전 MDE전략팀장	생활가전 Global CS팀장	Michigan State Univ.(박사)	계열회사 임원	
엄재훈	남	1966.06	부사장	상근	상생협력센터장	DS부문 DS대외협력팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
여명구	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	조직문화개선T/F 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
여태정	남	1970.06	부사장	상근	하만협력팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
오문욱	남	1974.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	혁신센터장	서울대(석사)	계열회사 임원	
오재균	남	1972.02	부사장	상근	DS부문 지원팀장	System LSI 지원팀장	Univ. of Iowa(석사)	계열회사 임원	
오정석	남	1970.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	TSP총괄 지원팀장	清華大(석사)	계열회사 임원	
오종훈	남	1969.10	부사장	상근	System LSI 지원팀장	메모리 지원팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
오치오	남	1967.01	부사장	상근	한국총괄 B2B팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	건국대(석사)	계열회사 임원	
오태영	남	1974.10	부사장	상근	DSRA-Memory 연구소장	메모리 DRAM개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
오화석	남	1972.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
우영돈	남	1974.01	부사장	상근	법무실 개인정보보호팀장	법무실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
원성근	남	1968.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	충북대(석사)	계열회사 임원	

원순재	남	1972.01	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
위훈	남	1970.04	부사장	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	생활가전 선행개발팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
유규태	남	1975.02	부사장	상근	의료기기사업부장	의료기기 전략마케팅팀장	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	25
유미영	여	1968.07	부사장	상근	생활가전 Global CS팀장	생활가전 S/W개발팀장	포항공대(석사)	계열회사 임원	
유병길	남	1970.09	부사장	상근	SEDA-S법인장	SEA 담당임원	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	
유상민	남	1973.09	부사장	상근	System LSI IP개발팀장	System LSI SOC사업팀 담당임원	Univ. of Washington(박사)	계열회사 임원	49
유창식	남	1969.12	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	한양대, 교수	서울대(박사)	계열회사 임원	50
윤석민	남	1971.02	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	33
윤세승	남	1965.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Qualcomm, Senior Director	연세대(학사)	계열회사 임원	32
윤영조	남	1975.02	부사장	상근	Global Public Affairs실 담당임원	IR팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	57
윤인수	남	1974.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
윤종덕	남	1969.04	부사장	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤주한	남	1970.05	부사장	상근	중동총괄 지원팀장	재경팀 담당임원	Univ. of California, Berkeley (석사)	계열회사 임원	
윤준오	남	1967.06	부사장	상근	하만협력팀장	전장사업팀장	건국대(학사)	계열회사 임원	
윤태양	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄, CSO	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터장	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤하룡	남	1971.12	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이경우	남	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 Principal Engineer	한양대(박사)	계열회사 임원	
이계성	남	1967.11	부사장	상근	법무실 해외법무팀장	구주총괄 대외협력팀장	St. Louis Univ.(석사)	계열회사 임원	
이귀호	여	1975.05	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 Principal Professional	이화여대(학사)	계열회사 임원	
이규열	남	1966.05	부사장	상근	TSP총괄	TSP총괄 TP센터장	항공대(학사)	계열회사 임원	
이근호	남	1970.02	부사장	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이금주	여	1971.09	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	중앙대(석사)	계열회사 임원	
이대성	남	1970.09	부사장	상근	중국총괄	SCIC 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	49
이동근	남	1971.08	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	한양대(박사)	계열회사 임원	
이무형	남	1970.02	부사장	상근	Global CS센터 담당임원	생활가전 CX팀장	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
이병국	남	1965.11	부사장	상근	Mobile eXperience Global제조센터장	SEVT법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	
이병원	남	1972.05	부사장	상근	IR팀 담당임원	기획재정부, 부이사관	Indiana Univ., Bloomington (석사)	계열회사 임원	14
이상우	남	1972.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
이상욱	남	1973.04	부사장	상근	영상디스플레이 CX팀장	BT Group, CDO	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	2
이상원	남	1971.07	부사장	상근	감사팀장	서남아총괄 지원팀장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상주	남	1970.09	부사장	상근	구주총괄 대외협력팀장	법무실 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	

이상직	남	1970.06	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SELA법인장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	
이상현	남	1970.09	부사장	상근	DSRJ 담당임원	SCS 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이상훈	남	1973.04	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	29
이석원	남	1970.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 설비기술연구소 담당임원	제조&기술담당 설비기술연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이승구	남	1969.08	부사장	상근	People팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
이승엽	남	1968.08	부사장	상근	아프리카총괄	SEIN-S법인장	서울대(학사)	계열회사 임원	
이승재	남	1974.08	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이시영	남	1972.04	부사장	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Univ. of Sussex(석사)	계열회사 임원	
이양우	남	1972.02	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	KNOWCK, 공동대표	Univ. of Colorado, Boulder (석사)	계열회사 임원	46
이영수	남	1972.01	부사장	상근	생산기술연구소장	SEVT 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이영웅	남	1969.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	21
이왕익	남	1963.07	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성생명, 지원팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이원준	남	1970.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	중동총괄 지원팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
이일환	남	1973.09	부사장	상근	Mobile eXperience 디자인팀장	Mobile eXperience CX실 담당임원	Art Center College Of Design (학사)	계열회사 임원	25
이재범	남	1970.10	부사장	상근	생활가전 기획팀장	영상디스플레이 기획팀장	홍익대(학사)	계열회사 임원	
이재열	남	1970.01	부사장	상근	System LSI LSI사업팀장	System LSI LSI개발실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이정삼	남	1967.06	부사장	상근	SESS법인장	TSP총괄 Global운영팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정원	남	1977.04	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	48
이정환	남	1971.05	부사장	상근	DS부문 법무실장	DS부문 법무지원팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	24
이제석	남	1969.01	부사장	상근	System LSI Sensor 사업팀장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	15
이제현	남	1970.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 경영지원실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
이종명	남	1970.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종민	남	1971.09	부사장	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터장	디바이스플랫폼센터 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	
이종열	남	1970.02	부사장	상근	AI센터 담당임원	System LSI SOC사업팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종호	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 품질팀장	Foundry 기술개발실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
이주형	남	1972.08	부사장	상근	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
이준현	남	1965.05	부사장	상근	Samsung Research Life Solution팀장	Samsung Research 차세대 가전연구팀장	Univ. of Cincinnati(박사)	계열회사 임원	
이준화	남	1972.03	부사장	상근	Global EHS실장	생활가전 CX팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이지별	남	1971.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	Meta, Creative Director	Parsons School of Design(학사)	계열회사 임원	29
이진엽	남	1970.02	부사장	상근	DS부문 감사팀장	메모리 Flash개발실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	

이창수	남	1971.07	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이충순	남	1967.09	부사장	상근	CIS총괄	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
이태관	남	1971.12	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성물산, 법무팀 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
이학민	남	1972.04	부사장	상근	지원팀장	사업지원T/F 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이한관	남	1971.09	부사장	상근	SRA 담당임원	TSP총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이해창	남	1975.10	부사장	상근	System LSI 전략마케팅실장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	51
이헌	남	1969.02	부사장	상근	SEIN-S법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
이헌	남	1971.01	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
이형우	남	1970.03	부사장	상근	북미총괄 담당임원	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	
이화성	남	1970.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
임건	남	1970.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	58
임병일	남	1970.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성증권, 기업금융1본부장	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	37
임석환	남	1974.11	부사장	상근	DSRA-S.LSI 연구소장	System LSI 기반설계실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
임성수	남	1978.11	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
임성택	남	1966.06	부사장	상근	한국총괄	중동총괄	연세대(학사)	계열회사 임원	
임성택	남	1970.10	부사장	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 C&M사업팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
임용식	남	1971.01	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장상익	남	1968.07	부사장	상근	영상디스플레이 구매팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장성환	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Interpublic Group, EVP	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	7
장세명	남	1968.01	부사장	상근	기획팀장	기획팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(박사)	계열회사 임원	25
장소연	여	1971.06	부사장	상근	한국총괄 마케팅팀장	한국총괄 마케팅팀 담당임원	이화여대(학사)	계열회사 임원	
장우승	남	1970.02	부사장	상근	글로벌마케팅실 담당임원	Big Data센터장	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
장재훈	남	1969.07	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장호영	남	1968.01	부사장	상근	네트워크 구매팀장	네트워크 Global운영팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장호진	남	1970.09	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
전상욱	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience Samsung Care+팀장	Mobile eXperience 전략기획팀장	Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	25
전신애	여	1973.08	부사장	상근	SAIT Material Research Center장	SAIT Material Research Center 담당Master	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13

전필규	남	1968.11	부사장	상근	창의개발센터장	삼성경제연구소, 리더십팀장	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	13
정기봉	남	1970.01	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	49
정성택	남	1976.09	부사장	상근	DS부문 기획팀 담당임원	미래사업기획단 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	29
정승목	남	1969.05	부사장	상근	중국삼성전략협력실 담당임원	중국전략협력실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
정윤	남	1967.05	부사장	상근	북미총괄	Mobile eXperience 전략마케팅실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
정재연	여	1974.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
정재욱	남	1976.07	부사장	상근	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Univ. of Waterloo(박사)	계열회사 임원	26
정진국	남	1975.10	부사장	상근	Samsung Research 차세대 통신연구센터 담당임원	Samsung Research 차세대 통신연구센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	
정진민	남	1972.12	부사장	상근	Samsung Research S/W혁신센터장	Samsung Research Platform팀장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정혁준	남	1972.05	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Univ. of Southern California (박사)	계열회사 임원	49
정혜순	여	1975.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 Principal Engineer	부산대(학사)	계열회사 임원	
정호진	남	1971.05	부사장	상근	한국총괄 MX팀장	한국총괄 CE영업팀장	Rutgers Univ.(석사)	계열회사 임원	
정훈	남	1969.01	부사장	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
조기열	남	1971.03	부사장	상근	법무실 법무팀장	삼성디스플레이, 법무실장	경찰대(학사)	계열회사 임원	13
조기재	남	1967.01	부사장	상근	메모리 지원팀장	DS부문 지원팀장	Babson College(석사)	계열회사 임원	
조명호	남	1969.05	부사장	상근	영상디스플레이 Global CS팀장	영상디스플레이 기획팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
조상연	남	1971.12	부사장	상근	DS부문 DSA총괄	DS부문 DSA 담당임원	Univ. of Minnesota, Twin Cities (박사)	계열회사 임원	
조성대	남	1969.06	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	
조성혁	남	1970.05	부사장	상근	구주총괄	중동총괄	Univ. of California, Berkeley (석사)	계열회사 임원	
조성훈	남	1970.11	부사장	상근	SEA 담당임원	경영혁신센터 담당임원	건국대(박사)	계열회사 임원	
조시정	남	1969.11	부사장	상근	People팀장	People팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
조영준	남	1971.05	부사장	상근	수원지원센터장	북미총괄 People팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
조웅	남	1972.08	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성SDI, 법무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	33
조인하	여	1974.02	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEUK법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
조필주	남	1971.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 지원팀장	종합기술원 기획지원팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
조홍상	남	1966.06	부사장	상근	중남미총괄	SEF법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	
주영수	남	1965.08	부사장	상근	성균관대(파견)	삼성생명서비스, 고객지원실 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
주창훈	남	1970.10	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
지현기	남	1968.01	부사장	상근	DS부문 상생협력센터장	메모리 기획팀장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
지혜령	여	1972.04	부사장	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	

짐엘리엇	남	1970.11	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.(석사)	계열회사 임원	
차경환	남	1972.04	부사장	상근	중동총괄	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
차병석	남	1968.11	부사장	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	40
채원철	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience Digital Wallet팀장	Mobile eXperience CX실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
최광보	남	1971.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	북미총괄 지원팀장	부산대(학사)	계열회사 임원	
최권영	남	1971.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이, 중소형 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	1
최동준	남	1972.05	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	Univ. of Southern California (석사)	계열회사 임원	
최병희	남	1970.05	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	49
최성현	남	1970.05	부사장	상근	네트워크 선행개발팀장	Samsung Research 차세대 통신연구센터장	Univ. of Michigan, Ann Arbor (박사)	계열회사 임원	
최순	남	1970.10	부사장	상근	SIEL-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
최승범	남	1964.12	부사장	상근	디바이스플랫폼센터장	Samsung Research 기술전략팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
최승은	여	1969.07	부사장	상근	Mobile eXperience 마케팅팀장	무선 GDC센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
최승훈	남	1970.10	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	삼성생명, 기획팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	25
최완우	남	1965.02	부사장	상근	DS부문 People팀장	메모리 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
최용원	남	1968.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라설비자동화T/F장	고려대(석사)	계열회사 임원	
최용훈	남	1969.07	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
최원준	남	1970.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
최주호	남	1963.03	부사장	상근	베트남삼성전략협력실장	베트남복합단지장	아주대(석사)	계열회사 임원	
최진원	남	1966.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	
최진한	남	1973.05	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실 담당임원	AMAT, Managing Director	Univ. of Arizona(박사수료)	계열회사 임원	26
최진혁	남	1967.02	부사장	상근	System LSI SOC사업팀장	DSRA-Memory 연구소장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최창규	남	1970.03	부사장	상근	AI센터 담당임원	SAIT AI Research Center장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
패트릭쇼메	남	1964.05	부사장	상근	Mobile eXperience 담당임원	Mobile eXperience CX실장	Institut d administration des entreprises(석사)	계열회사 임원	
편정우	남	1970.10	부사장	상근	TSP총괄 품질팀장	메모리 품질실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
한상숙	여	1966.07	부사장	상근	Mobile eXperience 서비스Biz팀장	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
함선규	남	1970.01	부사장	상근	지원팀 담당임원	중남미총괄 지원팀장	Washington Univ. in St. Louis (석사)	계열회사 임원	
허길영	남	1965.08	부사장	상근	DS부문 재경팀장	DS부문 재경팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
허성회	남	1969.01	부사장	상근	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
현상진	남	1972.02	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	

홍경선	남	1970.08	부사장	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
홍기채	남	1969.06	부사장	상근	법무실 담당임원	법무법인 다전, 변호사	한양대(학사)	계열회사 임원	42
홍범석	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 B2B통합오퍼링센터장	아프리카총괄	중앙대(학사)	계열회사 임원	
홍석준	남	1970.07	부사장	상근	CSS사업팀장	CSS사업팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	19
홍성희	남	1966.02	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	
홍승완	남	1971.06	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
홍영기	남	1970.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터장	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	
홍유진	여	1972.05	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	
홍주선	남	1971.10	부사장	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	경희대(석사)	계열회사 임원	
황경순	남	1968.08	부사장	상근	SAIT Air Science Research Center장	UT Austin, 교수	Caltech(박사)	계열회사 임원	19
황상준	남	1972.01	부사장	상근	메모리 DRAM개발실장	메모리 전략마케팅실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
황완구	남	1972.02	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	37
황인철	남	1977.11	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
황태환	남	1968.04	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀장	한국총괄 CE팀장	경희대(학사)	계열회사 임원	
황희돈	남	1974.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
더못라이언	남	1962.09	부사장	상근	DS부문 DSE 담당임원	DS부문 구주총괄 담당임원	Limerick Regional Technical Coll.(학사)	계열회사 임원	
강건혁	남	1978.11	상무	상근	DSRA-S.LSI 담당임원	System LSI Design Platform개발실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	40
강도희	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
강동우	남	1971.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 S.PKG제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 AVP제조기술센터장	한양대(석사)	계열회사 임원	
강명진	남	1977.02	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	25
강민석	남	1976.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 CX실 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	37
강상용	남	1972.09	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
강성욱	남	1971.05	상무	상근	지원팀 담당임원	SEUK Principal Professional	Univ. of Southern California (석사)	계열회사 임원	
강신광	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	45
강연호	남	1979.11	상무	상근	재경팀 담당임원	관세청, 부이사관	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	18
강윤경	여	1968.12	상무	상근	People팀 담당임원	Samsung Research 창의개발센터 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor (석사)	계열회사 임원	
강은경	여	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	37
강정대	남	1970.09	상무	상근	육상연맹(파견)	재경팀 담당임원	한국방송통신대(학사)	계열회사 임원	

강종호	남	1974.12	상무	상근	SELV법인장	SEAD법인장	인하대(석사)	계열회사 임원	2
강진선	남	1975.09	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 Principal Professional	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	37
강태형	남	1976.05	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	Dell, Director	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	17
강혁	남	1984.10	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	25
고경민	남	1975.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
고광현	남	1968.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
고상도	남	1975.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	2
고상원	남	1979.11	상무	상근	영상디스플레이 기획팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	25
고얄시드	남	1977.12	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Accenture, Mng. Director	Univ. of Sydney(석사)	계열회사 임원	53
고의중	남	1972.02	상무	상근	법무실 담당임원	Compliance팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	37
고정욱	남	1976.02	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국총괄 MX팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
고종현	남	1981.01	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 CIS TD팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 CIS TD팀 Principal Engineer	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	2
고주현	남	1974.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
고택균	남	1971.05	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	49
고현목	남	1980.02	상무	상근	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	13
공병진	남	1971.09	상무	상근	SEM-P법인장	SIEL-P(C)공장장	항공대(학사)	계열회사 임원	49
곽원근	남	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	13
구관본	남	1975.01	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	42
구윤본	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 연구라인기술팀장	제조&기술담당 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
구자천	남	1981.04	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 기획팀장	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	
권기덕	남	1972.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
권기덕	남	1977.10	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 Principal Legal Counsel	서울대(학사)	계열회사 임원	49
권기덕	여	1974.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략기획팀장	기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	49
권기록	남	1974.07	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	성균관대(박사)	계열회사 임원	14
권기성	남	1975.01	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	인하대(학사)	계열회사 임원	14

권민호	남	1975.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	2
권영재	남	1972.05	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	49
권영호	남	1973.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	2
권영훈	남	1972.02	상무	상근	SEA 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	42
권욱	남	1978.07	상무	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	31
권정현	남	1980.03	상무	상근	Samsung Research Robot센터 담당임원	NVIDIA, Senior S/W Engineering Manager	서울대(박사)	계열회사 임원	23
권춘기	남	1969.04	상무	상근	SEHC법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	포항공대(학사)	계열회사 임원	49
권혁만	남	1973.06	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI SOC사업팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
권혁우	남	1973.07	상무	상근	DX부문 Global Public Affair실 담당임원	산업통상자원부 과장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	30
권형석	남	1973.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	System LSI 전략마케팅실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
권호범	남	1975.12	상무	상근	Samsung Research Platform팀장	Samsung Research Platform팀 담당임원	New York Univ., Tandon School of Engineering(석사)	계열회사 임원	49
김건우	남	1976.01	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	SESK 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	37
김경륜	남	1983.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 상품기획실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	37
김경태	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	49
김경태	남	1973.07	상무	상근	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 IMC팀 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	25
김경택	남	1975.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 Principal Designer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	13
김광익	남	1974.09	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	37
김광훈	남	1975.02	상무	상근	SEDA-P(C)법인장	SEDA-P(C)공장장	인하대(학사)	계열회사 임원	25
김기수	남	1976.05	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	25
김기언	남	1972.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	25
김길섭	남	1979.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	사업지원T/F Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	2
김대신	남	1970.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 CSE팀장	혁신센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
김대우	남	1970.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구팀 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SME법인장	경북대(학사)	계열회사 임원	25
김덕헌	남	1975.06	상무	상근	상생협력센터 담당임원	메타볼라이트, Co-Founder	고려대(학사)	계열회사 임원	59

김덕호	남	1970.11	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 S/W개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김도기	남	1975.05	상무	상근	People팀 담당임원	DS부문 CTO People팀장	숭실대(학사)	계열회사 임원	25
김도형	남	1977.05	상무	상근	SAIT People팀장	SCS Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	2
김동근	남	1976.07	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	37
김동수	남	1975.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 People팀장	DS부문 People팀 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	37
김동수	남	1976.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	2
김동준	남	1973.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	제조&기술담당 담당임원	광주과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김두현	남	1976.10	상무	상근	SEROM법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	2
김래훈	남	1975.07	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	45
김륭	남	1971.12	상무	상근	생활가전 People팀장	People팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	49
김명오	남	1972.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	49
김무성	남	1975.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	포항공대(석사)	계열회사 임원	37
김문수	남	1977.12	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	SRI-Delhi연구소장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	49
김민성	남	1975.02	상무	상근	미래사업기획단 담당임원	삼성SDI, 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	1
김민우	남	1978.06	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	TSE-S 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	49
김범준	남	1977.03	상무	상근	동남아총괄 지원팀장	사업지원T/F Principal Professional	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	13
김범진	남	1975.02	상무	상근	Mobile eXperience Galaxy Value Innovation팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
김병승	남	1976.11	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	14
김보성	남	1974.04	상무	상근	Samsung Research 담당임원	Awair, CDO	Royal Collge of Art(석사)	계열회사 임원	34
김보창	남	1977.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	25
김봉수	남	1971.06	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	49
김상윤	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	49
김상준	남	1976.10	상무	상근	SEG 담당임원	지원팀 Principal Professional	서강대(학사)	계열회사 임원	2
김상하	여	1981.01	상무	상근	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 Principal Engineer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	2
김상현	남	1978.10	상무	상근	SEI 담당임원	SEB법인장	Univ. of Michigan, Ann Arbor (석사)	계열회사 임원	13

김석영	남	1973.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	14
김선기	남	1973.11	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	10
김선길	남	1974.11	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 Principal Professional	전남대(학사)	계열회사 임원	25
김선정	남	1973.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	National Univ. of Singapore (박사)	계열회사 임원	37
김성민	남	1976.03	상무	상근	네트워크 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Southern California (석사)	계열회사 임원	37
김성은	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 기술전략팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
김성현	남	1977.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	2
김성훈	남	1977.02	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	2
김세진	여	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 Principal Professional	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	25
김세훈	남	1975.01	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	25
김수연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	13
김수형	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
김승연	여	1975.04	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김승일	남	1970.07	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 Principal Professional	단국대(학사)	계열회사 임원	
김시우	남	1972.10	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 Principal Engineer	단국대(석사)	계열회사 임원	49
김신	남	1971.12	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
김영대	남	1968.10	상무	상근	Foundry 제품기술팀장	Foundry 기술개발실 담당임원	동국대(석사)	계열회사 임원	
김영무	남	1976.09	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	37
김영상	남	1974.06	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 Principal Professional	Indiana Univ., Bloomington (석사)	계열회사 임원	2
김영아	여	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Adidas, VP	이화여대(학사)	계열회사 임원	5
김영우	남	1972.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	삼성글로벌리서치, 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	19
김영일	남	1974.12	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 미주총괄 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	25
김영정	남	1972.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	37

김영주	남	1973.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	37
김영집	남	1979.05	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	25
김용관	남	1976.04	상무	상근	IR팀 담당임원	Apple, Manager	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	59
김용상	남	1972.08	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSA 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	49
김용완	남	1970.04	상무	상근	TSP총괄 Global운영팀장	메모리 Global운영팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
김용찬	남	1969.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
김용한	남	1976.02	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	37
김용훈	남	1972.11	상무	상근	한국총괄 CE팀장	한국총괄 CE팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	49
김우년	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
김우일	남	1978.02	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC사업팀 Principal Engineer	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	2
김원겸	남	1975.03	상무	상근	SEEG-P법인장	영상디스플레이 Global제조팀 Principal Professional	광운대(학사)	계열회사 임원	2
김원국	남	1975.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	경북대(석사)	계열회사 임원	37
김원우	남	1970.03	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEDA-S 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김원희	남	1971.04	상무	상근	SEI법인장	SEAU법인장	Mcgill Univ.(석사)	계열회사 임원	
김유나	여	1979.01	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	SRPOL연구소장	포항공대(박사)	계열회사 임원	37
김유승	남	1978.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	Intuitive, Staff Engineer	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	12
김윤재	남	1973.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	49
김은경	여	1974.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	단국대(학사)	계열회사 임원	
김은용	남	1979.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
김은하	여	1971.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 Principal Engineer	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	49
김의송	남	1978.05	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	People팀 Principal Professional	한동대(학사)	계열회사 임원	2
김이태	남	1971.01	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 Principal Engineer	포항공대(석사)	계열회사 임원	
김인범	남	1973.05	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	25
김인철	남	1973.12	상무	상근	DS부문 커뮤니케이션팀 담당임원	DX부문 경영지원실 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	14
김인형	남	1973.12	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김재관	남	1976.01	상무	상근	아프리카총괄 지원팀장	SRA 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	13
김재성	남	1972.04	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
김재윤	남	1970.07	상무	상근	하만협력팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	

김재진	남	1969.11	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	49
김재현	남	1977.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	2
김재홍	남	1973.03	상무	상근	지원팀 담당임원	무선 지원팀 Principal Professional	성균관대(석사)	계열회사 임원	49
김재환	남	1969.07	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 Principal Legal Counsel	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	25
김재훈	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Facebook, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	39
김정봉	남	1965.07	상무	상근	육상연맹(파견)	SSC 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
김정수	남	1983.09	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Qualcomm, Principal	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	12
김정헌	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	DL E&C, 전무	경희대(석사)	계열회사 임원	26
김종균	남	1966.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대(학사)	계열회사 임원	
김종민	남	1968.03	상무	상근	SSC 담당임원	전장사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
김종현	남	1972.12	상무	상근	중동총괄 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 Principal Professional	세종대(학사)	계열회사 임원	13
김종현	남	1975.11	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	13
김종희	남	1974.01	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	NXP, Principal	포항공대(박사)	계열회사 임원	14
김주연	남	1974.12	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 Principal Engineer	한양대(박사)	계열회사 임원	25
김준성	남	1975.08	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	25
김준연	남	1973.11	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	삼성디스플레이, 디스플레이연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	9
김준엽	남	1969.10	상무	상근	SERK법인장	SEHC 담당임원	경기대(학사)	계열회사 임원	
김지용	남	1975.06	상무	상근	SEA 담당임원	SEA Principal Professional	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	25
김지훈	남	1971.08	상무	상근	Global CS센터 담당임원	한국총괄 B2B통합오퍼링센터 담당임원	서강대(박사수료)	계열회사 임원	37
김지훈	남	1975.06	상무	상근	SENA법인장	SENA Principal Professional	서울대(학사)	계열회사 임원	2
김진교	남	1973.05	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 Principal Professional	경찰대(학사)	계열회사 임원	37
김진기	남	1972.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 평택단지 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	37
김진만	남	1978.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	동아대(석사)	계열회사 임원	2
김진철	남	1976.11	상무	상근	SEVT 담당임원	Mobile eXperience People팀 Principal Professional	서울대(학사)	계열회사 임원	2
김진호	남	1977.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
김찬호	남	1975.06	상무	상근	SEVT 담당임원	SEIB 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	49
김창수	남	1975.11	상무	상근	SME법인장	SENZ법인장	Univ. of Texas Arlington(석사)	계열회사 임원	2

김창용	남	1973.04	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	SAIT People팀장	고려대(석사)	계열회사 임원	37
김철주	남	1976.07	상무	상근	SRUK연구소장	SRR연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
김철회	남	1977.04	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 기획팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	2
김태경	남	1971.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	20
김태균	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	37
김태수	남	1985.03	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	44
김태영	남	1976.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Kanazawa Univ.(박사)	계열회사 임원	14
김태우	남	1971.05	상무	상근	메모리 기획팀장	메모리 기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김태정	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	49
김태중	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 디자인팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1970.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 평택단지 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1973.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	감사팀 담당임원	단국대(학사)	계열회사 임원	49
김한조	남	1973.09	상무	상근	의료기기 지원팀장	SEA Principal Professional	Univ. of California, Irvine(석사)	계열회사 임원	13
김향희	여	1972.07	상무	상근	SEF 담당임원	SEROM법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	37
김현근	남	1973.07	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	37
김현기	남	1973.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	25
김현덕	남	1981.06	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	24
김현석	남	1976.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	37
김현수	남	1970.09	상무	상근	SAIT 미래기술육성센터장	SR 기술전략팀 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
김현종	남	1977.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	49
김현중	남	1969.05	상무	상근	한국총괄 유통전략팀장	한국총괄 e-Commerce팀장	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김형섭	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김형수	남	1975.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 Principal Engineer	서강대(석사)	계열회사 임원	2
김형옥	남	1979.04	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	14
김형준	남	1972.05	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	숭실대(석사)	계열회사 임원	37
김호균	남	1968.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	중남미총괄 대외협력팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	

김홍민	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience 디자인팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	SAIC(석사)	계열회사 임원	
김후성	남	1972.01	상무	상근	System LSI 품질팀장	System LSI Global Operation실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김훈식	남	1981.07	상무	상근	Mobile eXperience 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	14
김희승	남	1970.09	상무	상근	중국삼성전략협력실 담당임원	System LSI People팀장	고려대(석사)	계열회사 임원	
김희열	남	1975.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	14
나원만	남	1975.06	상무	상근	SEM-P 담당임원	SEM-P Principal Professional	영남대(학사)	계열회사 임원	13
나현수	남	1971.06	상무	상근	중국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
남경인	남	1973.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SELS법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
남덕우	남	1974.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	14
남인호	남	1975.06	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 Principal Professional	건국대(학사)	계열회사 임원	2
남정만	남	1967.06	상무	상근	SEHC 담당임원	생활가전 Global제조팀 담당임원	전남기계공고(고교)	계열회사 임원	
남태호	남	1969.03	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 경영지원실 담당임원	경북대(박사수료)	계열회사 임원	18
노경윤	남	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	Intel, Director	MIT(박사)	계열회사 임원	40
노대용	남	1978.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	2
노미정	여	1971.04	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSA 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
노성원	남	1971.03	상무	상근	People팀 담당임원	삼성바이오에피스, 인사팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	2
노수혁	남	1970.04	상무	상근	생활가전 Global운영팀 담당임원	생활가전 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	49
노승남	남	1973.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	사업지원T/F Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	49
다니엘아라우조	남	1981.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략기획팀 담당임원	사업지원T/F Principal Professional	Univ. Of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	25
드미트리	남	1972.07	상무	상근	SERC 담당임원	SERC VP	Moscow Institute of Physics and Technology(석사)	계열회사 임원	49
류일곤	남	1968.07	상무	상근	Mobile eXperience 구미지원센터장	SEVT 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
류철우	남	1975.04	상무	상근	SEF 담당임원	지원팀 Principal Professional	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	2
류호열	남	1977.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 Principal Professional	한국과학기술원(박사수료)	계열회사 임원	2
류효겸	남	1980.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Broadcom, Principal Engineer	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	50
마띠유	남	1981.10	상무	상근	기획팀 담당임원	사업지원T/F Principal Professional	MIT(석사)	계열회사 임원	

명관주	남	1972.10	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	
명승일	남	1976.11	상무	상근	서남아총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	13
모한	남	1973.07	상무	상근	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 담당임원	Acharya Nagarjuna Univ.(학사)	계열회사 임원	
목진호	남	1968.09	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
문광진	남	1973.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 Principal Engineer	건국대(학사)	계열회사 임원	2
문석진	남	1974.06	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	계명대(학사)	계열회사 임원	14
문준기	남	1975.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	13
문진옥	남	1971.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	
문태호	남	1974.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	TSP총괄 품질팀장	동아대(학사)	계열회사 임원	14
문태화	남	1975.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	경희대(학사)	계열회사 임원	2
민병기	남	1963.02	상무	상근	상생협력센터 담당임원	에스원, 커뮤니케이션팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	37
박두건	남	1981.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	26
박명훈	남	1975.09	상무	상근	SEDA-P(M) 담당임원	생활가전 지원팀 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	2
박민규	남	1976.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	49
박병수	남	1972.12	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	25
박봉일	남	1972.02	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI Custom SOC사업팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
박봉태	남	1974.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	SCS 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
박상교	남	1972.03	상무	상근	Compliance팀 담당임원	중국삼성전략협력실 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상도	남	1973.12	상무	상근	People팀 담당임원	북미총괄 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상영	남	1976.01	상무	상근	구주총괄 People팀장	Mobile eXperience People팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	13
박상욱	남	1978.05	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	14
박상욱	남	1975.10	상무	상근	SIEL-S 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 Principal Professional	경북대(석사)	계열회사 임원	2
박상훈	남	1978.02	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	37
박상훈	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
박석민	남	1970.12	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	생활가전 Global운영팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
박성범	남	1984.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	37

박성우	남	1976.04	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Univ. Of Chicago(석사)	계열회사 임원	13
박승일	남	1976.01	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	2
박영민	남	1975.12	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SCIC 담당임원	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	13
박은중	남	1976.05	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	13
박일한	남	1976.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	2
박장용	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	서울대(학사)	계열회사 임원	49
박재범	남	1977.08	상무	상근	메모리 People팀장	DS부문 People팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	37
박재식	남	1976.08	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	25
박재헌	남	1975.06	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	화재 국내법무그룹 변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	2
박재현	남	1970.07	상무	상근	글로벌마케팅실 담당임원	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	49
박정대	남	1976.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라품질분석팀장	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
박정일	남	1976.08	상무	상근	한국총괄 유통전략팀 담당임원	한국총괄 유통전략팀 Principal Professional	인하대(학사)	계열회사 임원	2
박정재	남	1974.01	상무	상근	재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	
박제임스	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 Principal Professional	California Polytechnic State Univ.(학사)	계열회사 임원	
박종만	남	1971.11	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	37
박종민	남	1968.08	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	Western Digital, Director	한국과학기술원(학사)	계열회사 임원	12
박종우	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서울시립대(학사)	계열회사 임원	37
박준수	남	1967.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	28
박준영	남	1974.10	상무	상근	SEA 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Paris 11(석사)	계열회사 임원	49
박준호	남	1972.05	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
박진표	남	1972.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	DS부문 DSA 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
박찬형	남	1973.06	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	25
박창서	남	1980.06	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	46
박창진	남	1967.01	상무	상근	네트워크 담당임원	네트워크 Global CS팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
박철범	남	1966.03	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
박철웅	남	1973.01	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	37
박충신	남	1973.09	상무	상근	People팀 담당임원	의료기기 People팀장	경북대(석사)	계열회사 임원	49
박태호	남	1969.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SEAG법인장	Univ. of Pittsburgh(석사)	계열회사 임원	

박태훈	남	1974.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	37
박현근	남	1973.01	상무	상근	Foundry 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
박현준	남	1978.01	상무	상근	People팀 담당임원	구주총괄 People팀장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	25
박형민	남	1977.03	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	SEA 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	49
박형신	여	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience 디자인팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	제주대(학사)	계열회사 임원	13
박혜린	여	1975.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	2
박호우	남	1971.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	37
박환홍	남	1973.10	상무	상근	지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	13
박훈철	남	1974.05	상무	상근	SEHC 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	37
반수형	남	1972.06	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	25
반일승	남	1974.11	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	SEJ Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	
방지훈	남	1973.11	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	
배범희	남	1985.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	생산기술연구소 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
배상기	남	1974.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	SAS 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
배윤수	남	1974.12	상무	상근	재경팀 담당임원	기획팀 Principal Professional	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	13
배희선	여	1974.02	상무	상근	SCIC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	49
백기열	남	1967.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	삼성SDS, 품질팀장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	25
백상훈	남	1976.01	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	2
백아론	남	1979.10	상무	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	Samsung Research 차세대 가전연구팀 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	37
백피터	남	1971.06	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	법무실 IP센터 Principal Legal Counsel	Univ. of Minnesota, Minneapolis(석사)	계열회사 임원	
백혜성	여	1980.02	상무	상근	생활가전 Air Solution Business팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	13
변준호	남	1972.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Southern Illinois Univ.(박사)	계열회사 임원	
서경헌	남	1970.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	37
서상원	남	1979.06	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	Apple, Engineer/Manager	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	26
서성기	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	
서재홍	남	1974.03	상무	상근	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 Principal Professional	아주대(석사)	계열회사 임원	2
서정혁	남	1972.07	상무	상근	Samsung Research People팀장	네트워크 인사팀장	건국대(학사)	계열회사 임원	37

서정현	남	1974.04	상무	상근	SAIT 기획지원팀장	SCS 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	
서창우	남	1974.06	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEF 담당임원	Manchester(석사)	계열회사 임원	25
서치영	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	34
서현석	남	1974.06	상무	상근	감사팀 담당임원	감사팀 Principal Professional	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	13
서현정	여	1978.02	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	ERM 코리아, 대표	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	38
석지원	여	1980.06	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 마케팅팀 Principal Professional	서강대(학사)	계열회사 임원	2
선동석	남	1974.04	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
선종우	남	1974.06	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	14
설지윤	남	1974.12	상무	상근	네트워크 상품전략팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
설훈	남	1970.03	상무	상근	SEG 담당임원	SEROM법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	
성낙희	남	1973.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
성백민	남	1971.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 Principal Engineer	한양공고(고교)	계열회사 임원	37
성종훈	남	1978.11	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	2
소재민	남	1983.04	상무	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
손석제	남	1973.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	Nike, Director	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	8
손석준	남	1974.07	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	전남대(석사)	계열회사 임원	49
손성민	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global운영팀 담당임원	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	37
손영아	여	1973.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SELA Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	25
손왕익	남	1984.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	13
손용우	남	1968.09	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
손용훈	남	1973.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	37
손준호	남	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	25
손현석	남	1976.03	상무	상근	SAMEX법인장	SEH-P법인장	홍익대(학사)	계열회사 임원	25
손호민	남	1969.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 담당임원	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
손호성	남	1968.04	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
송기재	남	1970.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	광운대(박사)	계열회사 임원	49
송명숙	여	1972.11	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	

송문경	여	1977.08	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 Principal Professional	한동대(학사)	계열회사 임원	13
송보영	여	1976.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	25
송상철	남	1973.09	상무	상근	글로벌마케팅실 Big Data센터장	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	46
송승호	남	1981.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 Principal Professional	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	2
송영근	남	1970.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Intel, Principal Engineer	건국대(학사)	계열회사 임원	24
송원철	남	1976.01	상무	상근	SAMEX 담당임원	지원팀 Principal Professional	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	25
송윤종	남	1971.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구실 담당임원	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	
송인강	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 기술전략팀 Principal Professional	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	
송정우	남	1977.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	25
송정은	여	1976.12	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 마케팅팀 Principal Professional	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	2
송태중	남	1971.04	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
송택상	남	1978.03	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Rambus, Technical Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	11
송호영	남	1972.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	
쉐인힉비	남	1972.05	상무	상근	SEA 담당임원	SEA VP	Fairleigh Dickinson Univ.(석사)	계열회사 임원	
시티촉	남	1972.11	상무	상근	TSE-S 담당임원	TSE-S VP	Georgia State Univ.(석사)	계열회사 임원	2
신규범	남	1972.06	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 Global CS팀 Principal Professional	부산대(학사)	계열회사 임원	49
신대중	남	1971.11	상무	상근	SEDA-P(M)법인장	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
신무섭	남	1976.01	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SEV Principal Professional	경희사이버대(학사)	계열회사 임원	2
신문선	남	1975.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	한국해양대(학사)	계열회사 임원	25
신민호	남	1970.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	49
신병무	남	1970.08	상무	상근	SEEG-S법인장	SEGR법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	13
신상용	남	1973.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 평택단지 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	25
신승주	남	1972.04	상무	상근	SEASA법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
신용우	남	1974.12	상무	상근	메모리 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	37
신원화	남	1976.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	성균관대(박사)	계열회사 임원	25
신의창	남	1971.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 Principal Professional	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	22
신인철	남	1974.06	상무	상근	TSP총괄 People팀장	DS부문 인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	49

신재영	남	1974.07	상무	상근	SECA법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	2
신현석	남	1969.05	상무	상근	신사업팀 담당임원	신사업T/F 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
심승환	남	1974.04	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Apple, Sr. Development Manager	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	19
심우철	남	1982.06	상무	상근	SRPOL연구소장	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
심재혁	남	1978.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	27
심재황	남	1975.08	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 Principal Engineer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	2
심호준	남	1977.12	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 상품기획실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
심황윤	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	37
아라이	남	1968.08	상무	상근	DS부문 DSJ총괄	DS부문 일본총괄 VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	49
안대현	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 유통전략팀 담당임원	한국총괄 CE팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	49
안덕민	남	1974.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	2
안성준	남	1975.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	System LSI S/W Architecture팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
안승환	남	1970.10	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEA 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
안신현	남	1972.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	37
안영모	남	1973.10	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	경북대(학사)	계열회사 임원	13
안용석	남	1974.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	25
안재용	남	1977.02	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	감사팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	25
안주원	여	1977.03	상무	상근	하만협력팀 담당임원	생활가전 기획팀 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	25
안준	남	1978.02	상무	상근	네트워크 선행개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	39
안진우	남	1969.11	상무	상근	Compliance팀 담당임원	법무실 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
안치용	남	1975.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	성균관대(학사)	계열회사 임원	25
안희영	여	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	25
양시준	남	1974.01	상무	상근	중남미총괄 지원팀장	네트워크 지원팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	49
양종훈	남	1974.05	상무	상근	TSP총괄 구매팀장	DS부문 구매팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	25
양진기	남	1971.05	상무	상근	SRA 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	

양택진	남	1971.08	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	Samsung Research 기술전략팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	
양희철	남	1975.07	상무	상근	Mobile eXperience UX팀장	Mobile eXperience CX실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
엄훈섭	남	1975.06	상무	상근	SEV 담당임원	Mobile eXperience 구매팀 Principal Professional	항공대(학사)	계열회사 임원	2
연지현	여	1974.10	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI 전략마케팅실 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	37
염강수	남	1972.08	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	49
염부호	남	1972.04	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	37
염종범	남	1977.06	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	Mobile eXperience People팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	25
예장희	남	1975.12	상무	상근	SECH법인장	생활가전 전략마케팅팀 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	2
오름	여	1977.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	37
오상진	남	1977.11	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	37
오석민	여	1974.07	상무	상근	Mobile eXperience UX팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	
오성혁	남	1971.09	상무	상근	Mobile eXperience Samsung Care+팀 담당임원	삼성화재, 일반보험전략팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	1
오영기	남	1973.01	상무	상근	인재개발원 담당임원	인재개발원 Principal Professional	충남대(학사)	계열회사 임원	25
오용찬	남	1972.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SIEL-S 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	25
오정환	남	1973.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	25
오준영	남	1969.02	상무	상근	TSP총괄 C.PKG개발팀 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
오창호	남	1971.03	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	49
오혁상	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	
오형석	남	1970.09	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	TSP총괄 구매팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
옥신우	남	1978.05	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	2
올라프	남	1971.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEG VP	Johannes Gutenberg Univ.(석사)	계열회사 임원	37
왕지연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 Principal Designer	홍익대(학사)	계열회사 임원	25
우람찬	남	1978.01	상무	상근	System LSI 기획팀장	System LSI 기획팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	8
우준명	남	1980.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	14
우현수	남	1973.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	14

우형동	남	1970.09	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
원석준	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 담당임원	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
원찬식	남	1975.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 Principal Engineer	서강대(박사)	계열회사 임원	37
유미경	여	1974.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	40
유성종	남	1976.03	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	25
유성호	남	1973.02	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 지원팀 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	37
유송	남	1975.05	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	37
유종민	남	1974.04	상무	상근	People팀 담당임원	SSC 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
유한종	남	1973.10	상무	상근	재경팀 담당임원	SEF 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	49
유화열	남	1971.11	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 Principal Engineer	인하대(석사)	계열회사 임원	
윤가람	여	1983.08	상무	상근	Samsung Research Visual Technology팀 담당임원	Meta, Manager	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	31
윤기영	남	1974.11	상무	상근	SEBN법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	13
윤남호	남	1968.12	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
윤보영	여	1977.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	이화여대(석사)	계열회사 임원	37
윤상용	남	1976.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	14
윤석진	남	1968.11	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	47
윤석호	남	1973.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	한국기계연구원, 열에너지솔루션실장	서울대(박사)	계열회사 임원	24
윤석호	남	1972.07	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	글로벌인프라총괄 LED기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
윤성욱	남	1974.06	상무	상근	구주총괄 담당임원	인사팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	37
윤성현	남	1973.05	상무	상근	SIEL-P(C)법인장	SIEL-P(C)공장장	부산대(학사)	계열회사 임원	13
윤성호	남	1974.01	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	GE, Staff Engineer	Cambridge Univ.(박사)	계열회사 임원	24
윤성환	남	1972.04	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 Principal Engineer	State Univ. of New York, Buffalo(석사)	계열회사 임원	25
윤송호	남	1974.10	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	37
윤승욱	남	1970.01	상무	상근	System LSI 제품기술팀 담당임원	System LSI Global Operation실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
윤원재	남	1975.08	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	2

윤원주	남	1978.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	14
윤찬현	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 구매팀 Principal Professional	영남대(학사)	계열회사 임원	
윤창빈	남	1977.06	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	인하대(학사)	계열회사 임원	2
윤철웅	남	1970.07	상무	상근	SEUK법인장	SELV법인장	인하대(학사)	계열회사 임원	
윤호용	남	1969.12	상무	상근	SEM-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Drexel Univ.(석사)	계열회사 임원	
은성민	남	1977.01	상무	상근	Foundry 지원팀 담당임원	DS부문 DSA 담당임원	Wake Forest Univ.(석사)	계열회사 임원	25
은형래	남	1974.06	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	2
이강승	남	1977.07	상무	상근	System LSI Global운영팀 담당임원	System LSI Global Operation실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
이강호	남	1977.10	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Global Foundries, Principal Member of Technical Staff	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	13
이경우	남	1977.07	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	2
이경준	남	1976.06	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	49
이경호	남	1975.10	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	37
이계원	남	1968.05	상무	상근	한국총괄 SMB팀장	한국총괄 B2B팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이계훈	남	1980.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	37
이광열	남	1974.11	상무	상근	지원팀 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	37
이광재	남	1974.03	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 Principal Engineer	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	13
이규원	남	1974.03	상무	상근	DS부문 DSJ 담당임원	DS부문 일본총괄 Principal Professional	Waseda Univ.(석사)	계열회사 임원	
이규철	남	1973.06	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생산기술연구소 Principal Engineer	서울산업대(학사)	계열회사 임원	13
이근수	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	세종대(학사)	계열회사 임원	
이기욱	남	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
이기철	남	1972.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
이남호	남	1972.02	상무	상근	AI센터 담당임원	DS부문 재경팀 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	48
이동진	남	1971.01	상무	상근	SEH-P법인장	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	49
이동하	남	1968.07	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
이두환	남	1976.12	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 Principal Professional	동국대(학사)	계열회사 임원	2
이두희	남	1973.11	상무	상근	SGE법인장	SEMAG법인장	단국대(석사)	계열회사 임원	25
이명재	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	HEC Paris(석사)	계열회사 임원	13

이명준	남	1976.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실 담당임원	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	14
이문근	남	1976.08	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	고려대(학사)	계열회사 임원	2
이민	남	1978.03	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	9
이민철	남	1970.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	무선 PC사업팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
이병국	남	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	People팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	2
이병일	남	1983.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	25
이병진	남	1970.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 Principal Legal Counsel	Univ. Of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	49
이병철	남	1972.11	상무	상근	의료기기 People팀장	Mobile eXperience People팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	37
이병한	남	1974.05	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 Principal Professional	Univ. Of Wisconsin, Madison(학사)	계열회사 임원	25
이병헌	남	1974.11	상무	상근	기획팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Manchester Business Sch.(석사)	계열회사 임원	37
이병현	남	1977.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	14
이보나	여	1973.02	상무	상근	생활가전 MDE전략팀 담당임원	생활가전 CX팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	37
이보람	여	1973.09	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	World Bank, Senior Consultant	Univ. of Paris 6(박사)	계열회사 임원	8
이상빈	남	1979.02	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 Global제조팀 Principal Professional	한양대(석사)	계열회사 임원	2
이상수	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	아주대(석사)	계열회사 임원	49
이상엽	남	1967.11	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성물산, 상생협력팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	25
이상용	남	1970.02	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	GCT Semiconductor, Senior Director	서울대(박사)	계열회사 임원	
이상욱	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
이상육	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
이상호	남	1973.01	상무	상근	SEAU법인장	SAMCOL법인장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	25
이상희	남	1974.09	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Mask개발팀장	반도체연구소 Mask개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	37
이석림	남	1974.03	상무	상근	SEAS법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	37
이선교	남	1976.01	상무	상근	SIEL-P(N) 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	2
이선웅	남	1976.12	상무	상근	SERC 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	13
이선일	남	1978.02	상무	상근	Samsung Research Visual Technology팀 담당임원	Samsung Research Visual Technology팀 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	2

이선화	여	1975.08	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	CX·MDE센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	37
이성원	남	1976.03	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
이성원	남	1978.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	Qualcomm, Sr. Staff Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	28
이성재	남	1974.12	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	IBM, Principal Manager	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	39
이성준	남	1981.10	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(학사)	계열회사 임원	15
이성진	남	1979.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Amazon, Principal Scientist	포항공대(박사)	계열회사 임원	5
이성훈	남	1975.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	25
이수용	남	1968.03	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당Master	한양대(석사)	계열회사 임원	29
이승목	남	1973.09	상무	상근	한국총괄 People팀장	SAIT People팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
이승민	남	1981.03	상무	상근	Mobile eXperience UX팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	15
이승준	남	1974.04	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	25
이승철	남	1977.11	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	DS부문 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	18
이승철	남	1975.12	상무	상근	영상디스플레이 Global운영팀장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
이승호	남	1973.11	상무	상근	SEVT 담당임원	SEIN-P법인장	서울사이버대(학사)	계열회사 임원	49
이승환	남	1971.05	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	LED사업팀 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	37
이승환	남	1980.07	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	13
이승훈	남	1976.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	25
이신재	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	인하대(학사)	계열회사 임원	
이영아	여	1983.03	상무	상근	생활가전 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 Principal Designer	Carnegie Mellon Univ.(학사)	계열회사 임원	13
이영직	남	1967.08	상무	상근	SEHA법인장	SEH-P법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
이영학	남	1974.09	상무	상근	AI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	25
이우용	남	1975.10	상무	상근	지원팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	25
이원용	남	1978.11	상무	상근	미래사업기획단 담당임원	SAIT 기획지원팀장	MIT(박사)	계열회사 임원	25
이윤경	여	1979.09	상무	상근	글로벌마케팅실 Big Data센터 담당임원	Big Data센터 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	49
이윤수	남	1975.11	상무	상근	Samsung Research Data Intelligence팀장	Samsung Research AI센터 Principal Engineer	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	49
이의형	남	1975.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	25
이인학	남	1975.05	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	DS부문 상생협력센터 Principal Professional	광운대(석사)	계열회사 임원	2
이재영	남	1974.11	상무	상근	네트워크 People팀장	사업지원T/F 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	

이재호	남	1974.08	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 Principal Professional	서강대(석사)	계열회사 임원	13
이재훈	남	1974.01	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SERC 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	37
이정숙	여	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Berlin Art Univ.(석사)	계열회사 임원	
이정원	남	1971.07	상무	상근	네트워크 Global제조팀장	네트워크 Global운영팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	49
이정자	여	1969.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정주	남	1976.07	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	P&G, Sr. Director	고려대(학사)	계열회사 임원	18
이정호	남	1974.11	상무	상근	People팀 담당임원	한국총괄 People팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	37
이종규	남	1970.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	
이종민	남	1973.06	상무	상근	TSP총괄 지원팀장	DS부문 지원팀 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	
이종석	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, CPU Micro Architect	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	26
이종우	남	1978.04	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI Design Platform개발실 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
이종포	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이종필	남	1973.11	상무	상근	Systsem LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당임원	충남대(석사)	계열회사 임원	
이종필	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	경북대(석사)	계열회사 임원	
이종호	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이준표	남	1971.06	상무	상근	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 C&M사업팀 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	38
이중원	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	37
이지석	남	1978.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Stanford Univ.(박사수료)	계열회사 임원	17
이지수	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
이지연	여	1979.06	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	2
이지영	여	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience 디자인팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	제주대(학사)	계열회사 임원	37
이지훈	남	1970.11	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SECA법인장	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	
이지훈	남	1976.02	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	구주총괄 지원팀장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	49
이진우	남	1979.01	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	37
이진욱	남	1972.01	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	DS부문 DS대외협력팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	37
이진원	남	1973.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 Principal Professional	서울대(박사)	계열회사 임원	

이창수	남	1975.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	항공대(학사)	계열회사 임원	2
이치훈	남	1969.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이태선	남	1978.09	상무	상근	SEWA법인장	SEEA법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	2
이태호	남	1974.05	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	원광대(석사)	계열회사 임원	13
이한용	남	1976.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	김앤장, Sr.Foreign Attorney	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	34
이혁	남	1973.02	상무	상근	기획팀 담당임원	Bloom T/F 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	19
이현동	남	1972.02	상무	상근	SESAR법인장	SELV법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	37
이현수	남	1980.12	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 CX팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	13
이현우	남	1974.10	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	49
이현정	여	1971.11	상무	상근	SCIC 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	37
이형철	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	광운대(학사)	계열회사 임원	2
이혜경	여	1978.01	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	Ericsson, Sr.Director	San Diego State Univ.(석사)	계열회사 임원	3
이호	남	1972.07	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
이호신	남	1970.12	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 Principal Legal Counsel	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이훈신	남	1974.09	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global EHS센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	36
이흔철	남	1976.03	상무	상근	네트워크 선행개발팀 담당임원	Ericsson, Sr.Researcher	고려대(박사)	계열회사 임원	4
이희윤	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌EHS/인프라센터장	부산수산대(학사)	계열회사 임원	
인우성	남	1977.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	2
임경욱	여	1978.05	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 People팀 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	2
임산	남	1973.03	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	메모리 상품기획실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	37
임수현	남	1977.07	상무	상근	SESK 담당임원	영상디스플레이 지원팀 Principal Professional	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	2
임영수	남	1969.06	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
임윤모	남	1977.10	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 Principal Professional	인하대(학사)	계열회사 임원	13
임재우	남	1973.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	49
임전식	남	1969.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	
임지운	남	1975.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	2
임지훈	남	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	54

임휘용	남	1965.02	상무	상근	인재개발원 담당임원	네트워크 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
장경모	남	1977.10	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	SEG 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	13
장경훈	남	1970.02	상무	상근	DX부문 CTO 담당임원	Samsung Research Robot센터 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
장세정	남	1974.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 품질실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
장순복	여	1977.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	부산대(학사)	계열회사 임원	49
장실완	남	1973.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	서울대(학사)	계열회사 임원	
장용	남	1970.03	상무	상근	네트워크 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장용일	남	1974.09	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEIL법인장	성균관대(학사)	계열회사 임원	2
장우영	남	1973.02	상무	상근	의료기기 X-ray사업팀장	의료기기 DR사업팀장	서울대(박사수료)	계열회사 임원	49
장욱	남	1973.11	상무	상근	SEJ법인장	SEJ 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	25
장윤형	남	1977.09	상무	상근	중국삼성전략협력실 담당임원	중국삼성전략협력실 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	2
장윤희	남	1974.09	상무	상근	지원팀 담당임원	SIEL-P(N) 담당임원	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	25
장정렬	남	1977.01	상무	상근	SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	중앙대(석사)	계열회사 임원	25
장준희	남	1974.01	상무	상근	SEUK 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	49
장지호	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	GCT, VP	서울대(박사)	계열회사 임원	53
장흥민	남	1972.06	상무	상근	Global CS센터 담당임원	동남아총괄 CS팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	25
저메인클라우제	남	1982.08	상무	상근	동남아총괄 지원팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	25
전대호	남	1971.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 People팀장	제조&기술담당 People팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	49
전범준	남	1976.07	상무	상근	System LSI 지원팀 담당임원	DS부문 CTO 기술기획팀 담당임원	Southern Methodist Univ.(석사)	계열회사 임원	25
전병권	남	1967.02	상무	상근	SAMEX 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	
전상욱	남	1980.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
전성훈	남	1977.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	37
전소영	여	1974.05	상무	상근	IR팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of Texas, Dallas(석사)	계열회사 임원	49
전승수	남	1976.07	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	생활가전 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	49
전승훈	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
전영우	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	HP, Director	York Univ.(석사)	계열회사 임원	10
전중원	남	1976.05	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	2
전지환	남	1977.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 전략마케팅실 Principal Engineer	Univ. Of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	25

전진규	남	1974.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SENA 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	49
전진완	남	1974.03	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	49
전형민	남	1974.03	상무	상근	SEAU 담당임원	SENZ법인장	중앙대(학사)	계열회사 임원	13
전형준	남	1972.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	28
전희정	여	1977.09	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Arizona State Univ.(박사)	계열회사 임원	11
정강일	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 Next Product팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	37
정광섭	남	1970.04	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성물산, 경영정보팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	37
정광희	남	1971.08	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	
정기호	남	1973.08	상무	상근	SEACE 담당임원	생활가전 Air Solution Business팀 담당임원	한국해양대(학사)	계열회사 임원	37
정다운	남	1980.09	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정덕우	남	1976.12	상무	상근	네트워크 선행개발팀 담당임원	Palo Alto Networks, Sr. Principal	Yale Univ.(박사)	계열회사 임원	10
정문일	남	1971.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	법무법인 지평, 전문위원	숭실대(학사)	계열회사 임원	39
정석희	남	1975.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	13
정성엽	남	1974.09	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	4
정성원	남	1974.07	상무	상근	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	37
정성원	남	1971.12	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEWA법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	37
정성훈	남	1976.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	14
정세환	남	1973.10	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국해양대(학사)	계열회사 임원	13
정승일	남	1973.08	상무	상근	SELS법인장	경영혁신센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	25
정승진	남	1972.11	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	49
정신영	여	1973.03	상무	상근	Foundry 품질팀 담당임원	Foundry 제품기술팀 Principal Engineer	Univ. of Florida(석사)	계열회사 임원	37
정연일	남	1975.06	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	TSP총괄 기획팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	25
정영환	남	1971.08	상무	상근	SCIC 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	북단대(석사)	계열회사 임원	25
정용덕	남	1976.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 담당임원	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
정욱진	여	1975.08	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Nike, Director	고려대(석사)	계열회사 임원	2
정원철	남	1973.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
정유진	여	1970.06	상무	상근	SECE법인장	SENA법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
정윤찬	남	1968.09	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	

정의철	남	1969.12	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	Seattle Pacific Univ.(학사)	계열회사 임원	
정인호	남	1975.02	상무	상근	Foundry 지원팀장	TSP총괄 지원팀장	MIT(석사)	계열회사 임원	
정인호	남	1970.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
정인희	여	1974.09	상무	상근	지속가능경영추진센터 담당임원	LG화학, Expert Advisor	Imperial College(석사)	계열회사 임원	37
정일룡	남	1970.10	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 Principal Professional	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	37
정주영	남	1977.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	카카오엔터프라이즈, 부사장	서강대(학사)	계열회사 임원	12
정준수	남	1970.09	상무	상근	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	SEEG-P법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	37
정직한	남	1974.11	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Mythical Games, VP	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	15
정진희	여	1977.11	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 Customer Marketing팀 Principal Professional	전남대(학사)	계열회사 임원	13
정춘화	남	1974.09	상무	상근	SCS 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	14
정택정	남	1979.10	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	구주총괄 Principal Legal Counsel	Univ. of Bonn(석사)	계열회사 임원	2
정한기	남	1976.05	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	25
정혁준	남	1974.09	상무	상근	생활가전 광주지원센터장	생활가전 광주지원센터 Principal Professional	전남대(학사)	계열회사 임원	37
정홍욱	남	1977.10	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Hitotsubashi Univ.(석사)	계열회사 임원	13
정희범	남	1979.06	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	고려대(학사)	계열회사 임원	2
제이콥주	남	1978.11	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	中國科學技術大學(석사)	계열회사 임원	
제희원	남	1978.09	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI CP개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	25
조강욱	남	1977.08	상무	상근	북미총괄 지원팀장	동남아총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	25
조근수	남	1976.06	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 Principal Professional	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	13
조근휘	남	1974.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	14
조나단림	남	1976.12	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Microsoft, Sales Director	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	16
조미선	여	1980.04	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	Ericsson, VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	24
조성욱	남	1980.10	상무	상근	북미총괄 People팀장	사업지원T/F Principal Professional	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	2
조성일	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터장	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조성제	남	1977.04	상무	상근	People팀 담당임원	People팀 Principal Professional	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	25
조성훈	남	1976.01	상무	상근	System LSI People팀장	People팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
조성희	남	1974.08	상무	상근	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	25

조영민	남	1973.03	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	성균관대(석사)	계열회사 임원	2
조영상	남	1980.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Google, Sr.Staff S/W Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	4
조영석	남	1976.11	상무	상근	재경팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	25
조용석	남	1975.11	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이, 중소형 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	1
조욱래	남	1972.03	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	제조&기술담당 지원팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	49
조원희	남	1975.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	2
조유미	여	1971.09	상무	상근	DS부문 글로벌마컴팀장	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	49
조유성	남	1971.06	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global EHS센터 담당임원	서울과학기술대(석사)	계열회사 임원	49
조은경	여	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	삼성카드, 신용관리담당	성균관대(석사)	계열회사 임원	13
조익현	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	49
조지호	남	1972.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	부산대(학사)	계열회사 임원	37
조철민	남	1971.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	
조철용	남	1975.08	상무	상근	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀 Principal Designer	홍익대(학사)	계열회사 임원	25
조철형	남	1971.03	상무	상근	SSEC법인장	SEDA-P(M)공장장	충북대(학사)	계열회사 임원	49
조철호	남	1971.07	상무	상근	SETK법인장	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
조현덕	남	1974.05	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 상품기획실 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	25
조호근	남	1977.11	상무	상근	하만협력팀 담당임원	재경팀 담당임원	Univ. Of California, LA(석사)	계열회사 임원	25
조훈영	남	1973.08	상무	상근	Samsing Research AI센터 담당임원	Samsing Research Global AI센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	35
조희권	남	1976.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	SEA 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
주재완	남	1968.02	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
주현태	남	1972.12	상무	상근	TSE-P법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	울산대(학사)	계열회사 임원	37
주형빈	남	1973.06	상무	상근	SAVINA-S법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	49
진영두	남	1972.06	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 S/W개발팀 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	25
차도현	남	1973.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
차이위엔천	남	1968.01	상무	상근	Foundry 제품기술팀 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	NTUST(석사)	계열회사 임원	27
차지호	남	1976.04	상무	상근	감사팀 담당임원	감사팀 Principal Professional	전남대(학사)	계열회사 임원	2
찰리장	남	1973.10	상무	상근	Samsung Research 차세대 통신연구센터 담당임원	SRA SVP	Univ. of Wisconsin, Madison(박사)	계열회사 임원	13
채교석	남	1978.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	한양대(박사)	계열회사 임원	2

채동혁	남	1973.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	세미브레인, 팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	20
채수연	여	1977.10	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 Principal Professional	경북대(학사)	계열회사 임원	2
천기철	남	1970.09	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	49
천상필	남	1969.05	상무	상근	서남아총괄 대외협력팀장	Global Public Affairs실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
천홍문	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 Principal Engineer	단국대(학사)	계열회사 임원	13
최경수	남	1971.12	상무	상근	감사팀 담당임원	상생협력센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	49
최동규	남	1977.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 설비기술연구소 담당임원	A*STAR, Sr.Principal Scientist	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	2
최명진	남	1974.06	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	13
최민기	남	1977.10	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	Univ. of Wisconsin, Madison(박사)	계열회사 임원	13
최병철	남	1971.06	상무	상근	생활가전 Global운영팀장	영상디스플레이 Global운영팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	49
최삼종	남	1973.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 담당임원	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	49
최상선	남	1975.03	상무	상근	글로벌마케팅실 Big Data센터 담당임원	Big Data센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	13
최서림	남	1972.02	상무	상근	DS부문 감사팀 담당임원	설비기술연구소 기획지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	37
최선일	남	1971.11	상무	상근	System LSI Design Technology팀장	System LSI Design Platform개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	37
최성욱	남	1969.02	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	삼성전자공과대학(전문대)	계열회사 임원	
최승림	남	1972.02	상무	상근	재경팀 담당임원	CIS총괄 지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	37
최연호	남	1975.03	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	13
최영	남	1969.07	상무	상근	한국총괄 유통전략팀 담당임원	한국총괄 MX팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
최영일	남	1973.08	상무	상근	SAS 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	49
최영준	남	1967.09	상무	상근	SEACE 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Minnesota, Twin Cities(석사)	계열회사 임원	53
최원경	여	1973.08	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구팀 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
최원서	남	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	13
최원호	남	1981.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Western Digital, Sr. Technologist	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	12
최유진	여	1979.06	상무	상근	영상디스플레이 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 Principal Designer	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	37
최윤석	남	1974.09	상무	상근	TSP총괄 C.PKG개발팀 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
최윤성	남	1975.05	상무	상근	System LSI 제품기술팀 담당임원	System LSI Global Operation실 담당임원	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	8

최인수	남	1973.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 상품기획실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	25
최일환	남	1972.11	상무	상근	글로벌마케팅실 Big Data센터 담당임원	Big Data센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	37
최장석	남	1973.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 상품기획실 담당임원	충남대(학사)	계열회사 임원	25
최재혁	남	1974.06	상무	상근	감사팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	49
최정연	남	1974.11	상무	상근	메모리 Design Technology팀장	Foundry Design Platform개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
최정화	남	1973.01	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	25
최종구	남	1978.03	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	경찰대(학사)	계열회사 임원	2
최종근	남	1978.01	상무	상근	SCS 담당임원	SAIT 기획지원팀장	MIT(석사)	계열회사 임원	14
최종무	남	1975.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	아주대(석사)	계열회사 임원	49
최종민	남	1976.05	상무	상근	Mobile eXperience Digital Health팀 담당임원	Mobile eXperience Digital Health팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	13
최종성	남	1977.01	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	2
최준일	남	1976.01	상무	상근	Mobile eXperience Digital Health팀 담당임원	Mobile eXperience Digital Health팀 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	2
최중훈	남	1973.01	상무	상근	베트남삼성전략협력실 담당임원	베트남복합단지 Principal Professional	단국대(학사)	계열회사 임원	2
최진필	남	1973.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	SCS 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
최창훈	남	1973.08	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SIEL-S 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	37
최철민	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
최철환	남	1974.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	25
최청호	남	1976.11	상무	상근	법무실 담당임원	광장, 변호사	경북대(학사)	계열회사 임원	24
최황석	남	1969.01	상무	상근	생활가전 Air Solution Business팀장	LG전자, 상무	성균관대(학사)	계열회사 임원	6
최혁승	남	1976.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	25
최호석	남	1978.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Morgan Stanley, VP	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	11
최효석	남	1981.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	14
추민기	남	1975.10	상무	상근	SIEL-S 담당임원	SECE법인장	서강대(학사)	계열회사 임원	25
추민수	남	1973.10	상무	상근	SEPCO법인장	SENZ법인장	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	37
카리야 타카시	남	1969.02	상무	상근	DS부문 DSRJ 담당임원	TDK, 총괄부장	東北大(박사)	계열회사 임원	26

코너피어스	남	1970.04	상무	상근	SEPOL법인장	SEUK 담당임원	Univ. of Dublin(석사)	계열회사 임원	
하경수	남	1979.04	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	37
하지훈	남	1985.08	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Samsung Research 차세대통신연구센터 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	2
하현재	남	1970.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 People팀 Principal Professional	광운대(학사)	계열회사 임원	25
하현재	남	1984.02	상무	상근	Samsung Research SoC Architecture팀장	Meta, H/W System Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	11
한규희	남	1974.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	37
한글라라	여	1976.02	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	25
한기욱	남	1980.12	상무	상근	중국삼성전략협력실 담당임원	중국삼성전략협력실 Principal Legal Counsel	연세대(학사)	계열회사 임원	2
한상섭	남	1972.04	상무	상근	북미총괄 CS팀장	Global CS센터 담당임원	광운대(석사)	계열회사 임원	37
한상욱	남	1974.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	25
한상원	남	1976.05	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 MX팀 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	2
한석근	남	1978.09	상무	상근	SESK법인장	SERK법인장	경기대(학사)	계열회사 임원	13
한의택	남	1974.02	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	
한장수	남	1970.02	상무	상근	북미총괄 법무지원팀장	무선 지원팀 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	
한정남	남	1973.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한종호	남	1976.01	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SEG 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	49
한진규	남	1973.12	상무	상근	Samsung Research 기술표준연구팀장	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
한진우	남	1980.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	32
함민기	남	1975.02	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 Principal Designer	강원대(학사)	계열회사 임원	2
허욱	남	1972.05	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 Principal Professional	Waseda Univ.(학사)	계열회사 임원	25
허일정	남	1978.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 EHS/인프라기술연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	26
허정철	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	13
허준	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	25
허준영	남	1977.02	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	네트워크 People팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	37

허준회	남	1979.03	상무	상근	DSRA-S.LSI 담당임원	System LSI SOC사업팀 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	42
허지영	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
허태영	남	1970.11	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	영상디스플레이 CX팀장	Univ. of California, LA(학사)	계열회사 임원	
허훈	남	1974.08	상무	상근	SECA 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	49
헨릭얀손	남	1975.03	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 담당임원	Chalmers Univ.(석사)	계열회사 임원	24
현대은	남	1975.10	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	49
현재웅	남	1975.09	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 상품기획실 담당임원	RPI(석사)	계열회사 임원	17
현정혁	남	1977.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	25
홍기준	남	1971.05	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
홍순상	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	무선 서비스Biz팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	37
홍연석	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SEIN-P법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	37
홍영주	남	1977.08	상무	상근	CIS총괄 지원팀장	네트워크 지원팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	37
홍유석	남	1972.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	
홍재석	남	1981.11	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	생활가전 지원팀 Principal Legal Counsel	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	2
홍정우	남	1976.02	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	2
홍준식	남	1971.12	상무	상근	SCS 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	전북대(석사)	계열회사 임원	49
홍준화	남	1974.05	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	Nike, Sr.Director	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	5
홍창표	남	1973.05	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	2
홍희일	남	1970.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	
황근철	남	1973.03	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀장	네트워크 시스템솔루션팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
황근하	남	1970.05	상무	상근	영상디스플레이 Global제조팀장	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
황보용	남	1970.10	상무	상근	기획팀 담당임원	창의개발센터장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
황영삼	남	1977.10	상무	상근	동남아총괄 People팀장	People팀 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	25
황용호	남	1975.10	상무	상근	Samsung Research Security&Privacy팀장	Samsung Research Security팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
황일권	남	1973.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	25

황호송	남	1967.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전 센터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	49

※ 미등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 보통주(의결권 있는 주식)98,002,606주(이재용 회장 97,414,196주 등),
우선주(의결권 없는 주식) 177,720주(이재용 회장 137,757주 등)이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)의
'임원・주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참조하십시오.

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 재직기간은 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 기재를 생략하였습니다.

마. 미등기임원의 변동

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다.

구분(사유)	성명	성별	출생연월	직위	담당업무	최대주주와의 관계
임원 선임	원종욱	남	1962.10	부사장	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	계열회사 임원
	김진묵	남	1977.11	상무	Mobile eXperience Samsung Care+팀 담당임원	계열회사 임원
	문성만	남	1976.07	상무	기획팀 담당임원	계열회사 임원
	윤승국	남	1977.10	상무	Samsung Research Robot센터 담당임원	계열회사 임원
임원 사임	강문수	남	1969.08	부사장	Foundry사업부 담당임원	계열회사 임원
	강성철	남	1967.08	부사장	생산기술연구소 담당임원	계열회사 임원
	계종욱	남	1966.10	부사장	Foundry Design Platform개발실장	계열회사 임원
	김경희	여	1969.07	부사장	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	계열회사 임원
	김성윤	남	1966.10	부사장	법무실 IP센터 담당임원	계열회사 임원
	더못라이언	남	1962.09	부사장	DS부문 DSE 담당임원	계열회사 임원
	린준청	남	1970.07	부사장	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구실 담당임원	계열회사 임원
	안길준	남	1969.01	부사장	Mobile eXperience 담당임원	계열회사 임원
	윤세승	남	1965.12	부사장	Foundry Design Platform개발실 담당임원	계열회사 임원
	이지별	남	1971.03	부사장	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	계열회사 임원
	임석환	남	1974.11	부사장	DSRA-S.LSI 연구소장	계열회사 임원
	장우승	남	1970.02	부사장	글로벌마케팅실 담당임원	계열회사 임원
	정기봉	남	1970.01	부사장	DS부문 DSA 담당임원	계열회사 임원
	최진한	남	1973.05	부사장	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실 담당임원	계열회사 임원
	김보성	남	1974.04	상무	Samsung Research 담당임원	계열회사 임원
	김정봉	남	1965.07	상무	육상연맹(파견)	계열회사 임원
	김종균	남	1966.08	상무	경영혁신센터 담당임원	계열회사 임원
	민병기	남	1963.02	상무	상생협력센터 담당임원	계열회사 임원
	박두건	남	1981.01	상무	Mobile eXperience 개발실 담당임원	계열회사 임원
	박석민	남	1970.12	상무	생활가전 지원팀 담당임원	계열회사 임원
	박창진	남	1967.01	상무	네트워크 담당임원	계열회사 임원
	서현정	여	1978.02	상무	DS부문 상생협력센터 담당임원	계열회사 임원
	안진우	남	1969.11	상무	Compliance팀 담당임원	계열회사 임원
	이성원	남	1978.10	상무	System LSI SOC사업팀 담당임원	계열회사 임원
	임휘용	남	1965.02	상무	인재개발원 담당임원	계열회사 임원
	장용	남	1970.03	상무	네트워크 담당임원	계열회사 임원
	전병권	남	1967.02	상무	SAMEX 담당임원	계열회사 임원
	전형준	남	1972.10	상무	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	계열회사 임원
	정문일	남	1971.01	상무	상생협력센터 담당임원	계열회사 임원
	최영준	남	1967.09	상무	SEACE 담당임원	계열회사 임원
	한규희	남	1974.01	상무	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	계열회사 임원

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

바. 직원 등의 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계	
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계							
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)								
DX	남	37,953	-	338	-	38,291	16.9	-	-				-
DX	여	12,410	206	110	-	12,520	13.8	-	-				-
DS	남	56,463	-	159	-	56,622	10.9	-	-				-
DS	여	22,020	179	27	-	22,047	11.3	-	-	29,298	13,291	42,589	-
성별합계	남	94,416	-	497	-	94,913	13.4	12,863,945	139				-
성별합계	여	34,430	385	137	-	34,567	12.2	3,407,173	106				-
합 계		128,846	385	634	-	129,480	13.0	16,271,118	130				-

※ 본사(별도)기준이며 휴직자는 포함하고 등기임원 9명(사내이사 3명, 사외이사 6명)은 제외한 기준입니다.

※ 연간급여 총액과 1인평균 급여액은 「소득세법」 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득

기준입니다.

※ 1인 평균급여액은 평균 재직자 124,553명(남: 92,640명, 여: 31,913명) 기준으로 산출하였습니다.

사. 육아지원제도 및 유연근무제도 사용 현황

(육아지원제도)

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 명)

구 분		당 기	전 기	전전기
육아휴직 사용자 수	남	1,510	1,303	1,349
	여	3,382	3,167	3,237
	전체	4,892	4,470	4,586
육아휴직 사용률	남	13.6%	12.2%	8.3%
	여	97.8%	96.3%	97.0%
	전체	39.5%	37.4%	34.5%
육아휴직 복귀 後 12개월 이상 근속자	남	777	771	518
	여	1,750	1,594	1,687
	전체	2,527	2,365	2,205
육아기 단축근무제 사용자 수		161	148	120
배우자 출산휴가 사용자 수		3,148	2,841	2,989

※ 육아휴직 사용자 수: 당해 연도 육아휴직 사용 이력이 있는 직원 수
※ 육아휴직 사용률: 당해 연말 재/휴직 중이며 당해 출생 자녀를 가진 직원 중
당해 출생 자녀 생일 1년 이내 육아휴직 사용 이력이 있는 직원 수 비율
※ 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자: 당해 전년도 복직한 직원 중, 12개월 이상 근속한 직원의 수
※ 육아기 단축근무제 사용자 수: 당해 연도 육아기 단축근무제 사용 이력이 있는 직원 수
※ 배우자 출산휴가 사용자 수 : 당해 연도 배우자출산휴가 사용 이력이 있는 직원 수

(유연근무제도)

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 명)

구 분	당기	전기	전전기
유연근무제 활용 여부	활용	활용	활용
시차출퇴근제 사용자 수	507	340	365
선택근무제 사용자 수	105,419	100,958	98,162
원격근무제 사용자 수	2,064	3,080	8,063

※ 유연근무제 활용 여부 : 시차출퇴근제, 선택근무제, 원격근무(재택근무 포함) 등 활용
※ 시차출퇴근제 및 선택근무제 사용자 수 : 당해 연말 재직자 기준, 해당 근무제의 적용을 받는 직원 수
※ 선택근무제 사용자 수 : 1개월 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근무의 시작, 종료시각 및 1일 근무시간을 조정하는 제도의 적용을 받는 직원 수
※ 원격근무제 사용자 수 : 연간 원격근무제도(재택근무, 재택교육 등) 활용 건수를 연간 총 평일 수로 나누어 산출

아. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	1,003	653,389	671	-

※ 인원수는 작성기준일 현재 재임 중인 임원을 기준으로 하였으며, '미등기임원 현황'의 임원 중 국내에서 근로소득이 발생하지 않은 인원은 제외하였습니다.

※ 연간급여 총액과 1인평균 급여액은 「소득세법」 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.

※ 연간급여 총액은 성과급 지급 실적을 포함하고 있으며, 성과급 지급 시점은 매년 상이합니다.

※ 1인평균급여액은 평균 재직자 976명을 기준으로 산출하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수

<이사・감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	5	-	-
사외이사	3	-	-
감사위원회 위원	3	-	-
계	11	43,000	-

※ 인원수는 주주총회 승인일 기준입니다.
※ 주주총회 승인금액은「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2024년 3월 20일 주주총회 결의를 통해 승인받은 이사(퇴임이사 포함)의 보수 한도입니다.

(2) 보수지급금액

(2-1) 이사・감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
9	29,770	2,706	-

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임한
등기이사・사외이사・감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다.
※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.
※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여
산정하였으며,「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.
※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

(2-2) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	28,670	5,734	평균보수는 보수총액 대상 임원의 평균임원수 5명 기준
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	3	740	247	상동(평균인원수 3명)
감사위원회 위원	3	360	120	상동(평균인원수 3명)
감사	-	-	-	-

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임한 등기이사・사외이사・감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다.

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며,「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

(3) 보수지급기준

당사는 주주총회의 승인을 받은 이사보수 한도 금액 내에서 당사 임원처우규정 및 사외이사 처우규정에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다.

구 분	보수지급기준
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	・급여: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려하여 보수를 결정 ・설・추석상여: 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브: 부서별 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 0~200% 내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ・성과인센티브: 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ・장기성과인센티브: ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급, 규정에 따라 감액 또는 환수 가능 ・복리후생: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원・건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	・급여: 사외이사 처우규정에 따라 사외이사의 역할, 법적 책임과 위험 정도, 이동거리, 시장에서의 기회비용 등을 종합적으로 고려하여 개별 보수를 결정 ・복리후생: 사외이사 처우규정에 따라 의료지원・건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공

감사위원회 위원	・급여: 사외이사 처우규정에 따라 감사위원인 사외이사의 역할, 법적 책임과 위험 정도, 이동거리, 시장에서의 기회비용 등을 종합적으로 고려하여 개별 보수를 결정 ・복리후생: 사외이사 처우규정에 따라 의료지원・건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공

<보수지급금액 5억원 이상인 이사・감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
한종희	대표이사	5,240	-
경계현	고문	8,036	-
노태문	이사	5,098	-
박학규	사장	3,346	-
이정배	상담역	6,950	-

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임
또는 퇴임한 등기이사・사외이사・감사위원회 위원 기준입니다.
※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여
산정하였으며,「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
대표이사 한종희	근로 소득	급 여	1,617	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부회장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 121백만원, 3월 181백만원, 4월부터 12월까지 매월 133백만원을 지급
		상 여	3,492	·설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ·목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급) ·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2024년 DX부문 매출액 174.9조원, 영업이익 12.4조원을 달성한 점과, 비계량 지표와 관련하여 글로벌 지역별 성장 전략 수립과 제품간 연결성 확대로 사업경쟁력 제고에 기여한 점을 고려하여 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	131	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진,단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
고문 경계현	근로 소득	급 여	1,188	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 99백만원을 지급
		상 여	1,453	·설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ·목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2024년 DS부문 매출액 111.1조원, 영업이익 15.1조원을 기록한 점과 비계량 지표와 관련하여 반도체 사업 Turn-around의 기틀을 마련한 점과 전자의 신사업 방향 정립 및 기회 발굴에 기여한 점을 고려 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	124	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		5,272	·임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 99백만원에 임원 근무기간 16년에 지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출하였음
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이사 노태문	근로 소득	급 여	1,463	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 104백만원, 3월 182백만원, 4월부터 12월까지 매월 119백만원을 지급
		상 여	3,525	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가 세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급(개인별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2024년 MX사업 매출액 114.4조원을 달성한 점과 비계량 지표와 관련하여 AI폰 출시 및 갤럭시 생태계 확장을 통해 견조한 실적을 달성했고, 헬스 등 신사업을 통한 지속 성장기반을 확보 중인 점을 고려하여 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	111	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진,단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
사장 박학규	근로 소득	급 여	1,133	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 85백만원, 3월 127백만원, 4월부터 12월까지 매월 93백만원을 지급
		상 여	2,067	·설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ·목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급(개인별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%,주가상승률 △0.9% 를 기록하였고, 2024년 DX부문 매출액 174.9조원, 영업이익 12.4조원을 달성한 점과, 비계량 지표와 관련하여 효율적 자원 운영 및 리스크 관리를 통해 견조한 실적 달성을 지원했고, 신성장 동력 발굴을 통해 지속 성장 가능한 사업체계 구축에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	146	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진,단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
상담역 이정배	근로 소득	급 여	992	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 83백만원을 지급
		상 여	1,642	·설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ·목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급) ·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급(개인별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2024년 메모리 사업 매출액 84.5조원을 기록한 점과 비계량 지표와 관련하여 고부가가치 메모리 제품 중심의 라인업 최적화 및 확판, 메모리 수익성 개선 등을 통해 사업경쟁력 제고에 기여한 점을 고려하여 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	201	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진,단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		4,114	·임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 83백만원에 임원 근무기간 15년에 지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출하였음
	기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
경계현	고문	8,036	-
이정배	상담역	6,950	-
최시영	상담역	6,900	-
한종희	대표이사	5,240	-
노태문	이사	5,098	-

※ 보수총액은「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
고문 경계현	근로 소득	급 여	1,188	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 99백만원을 지급
		상 여	1,453	·설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ·목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2024년 DS부문 매출액 111.1조원, 영업이익 15.1조원을 기록한 점과 비계량 지표와 관련하여 반도체 사업 Turn-around의 기틀을 마련한 점과 전자의 신사업 방향 정립 및 기회 발굴에 기여한 점을 고려 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	124	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		5,272	·임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 99백만원에 임원 근무기간 16년에 지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출하였음
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
상담역 이정배	근로 소득	급 여	992	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 83백만원을 지급
		상 여	1,642	·설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ·목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급) ·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급(개인별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2024년 메모리 사업 매출액 84.5조원을 기록한 점과 비계량 지표와 관련하여 고부가가치 메모리 제품 중심의 라인업 최적화 및 확판, 메모리 수익성 개선 등을 통해 사업경쟁력 제고에 기여한 점을 고려하여 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	201	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진,단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		4,114	·임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 83백만원에 임원 근무기간 15년에 지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출하였음
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
상담역 최시영	근로 소득	급 여	936	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월 78백만원을 지급
		상 여	1,635	·설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ·목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급(개인별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2024년 DS부문 매출액 111.1조원, 영업이익 15.1조원을 기록한 점과 비계량 지표 관련하여 공정노드별 기술력 확보, 국내외 Fabless 고객들과의 네트워크 강화 및 신규 발굴 등을 통해 중장기 사업경쟁력 제고에 기여한 점을 고려하여 상여금 선정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	175	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		4,154	·임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 78백만원에 임원 근무기간 16년에 지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출하였음
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
대표이사 한종희	근로 소득	급 여	1,617	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부회장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 121백만원, 3월 181백만원, 4월부터 12월까지 매월 133백만원을 지급
		상 여	3,492	·설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ·목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급) ·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2024년 DX부문 매출액 174.9조원, 영업이익 12.4조원을 달성한 점과, 비계량 지표와 관련하여 글로벌 지역별 성장 전략 수립과 제품간 연결성 확대로 사업경쟁력 제고에 기여한 점을 고려하여 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	131	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진,단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이사 노태문	근로 소득	급 여	1,463	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 104백만원, 3월 182백만원, 4월부터 12월까지 매월 119백만원을 지급
		상 여	3,525	・설/추석상여 : 각 월급여 100% 지급 ・목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 200%내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가 세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급(개인별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2020~2022년 사이 ROE 13.2%, 세전이익률 16.6%, 주가상승률 △0.9%를 기록하였고, 2024년 MX사업 매출액 114.4조원을 달성한 점과 비계량 지표와 관련하여 AI폰 출시 및 갤럭시 생태계 확장을 통해 견조한 실적을 달성했고, 헬스 등 신사업을 통한 지속 성장기반을 확보 중인 점을 고려하여 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	111	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진,단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황

2024년말 현재 이사・감사・업무집행지시자 등에게 부여한 미행사 주식매수선택권(누적기준)은 없습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비 고
등기이사	3	-	-
사외이사	3	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
업무집행지시자	1,134	-	-
계	1,143	-	-

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

다. 주식매수선택권을 제외한 주식기준보상제도 운영 현황

당사는 2025년 1월 OPI 주식보상제도를 시행하였으며 임원을 대상으로 이사회 산하 위원회의 결의를 거쳐 성과인센티브의 일부를 양도제한주식(RSA)으로 2026년 1월에 지급하기로 약정하였습니다.

등기임원은 성과급의 100%를, 그 외 상무는 성과급의 50% 이상, 부사장은 70% 이상, 사장은 80% 이상의 범위 내에서 본인이 선택한 비중에 따라 주식으로 지급하기로 약정하였으며, 사장 이상 임원은 지급시점으로부터 2년간, 부사장 이하 임원은 1년간 양도가 제한됩니다. 한편, 2026년 1월 지급시점의 기준주가가 약정시점의 주가보다 하락시 하락률만큼 지급 주식수량도 감소합니다.

※ 기준주가 : 기준일 전일로부터 과거 1주일/1개월/2개월 각각 거래량 가중평균 주가의 산술평균

약정시기	약정 주식	약정 주식수	약정대상 및 인원수	지급시기
'25.1月	보통주	1,176,383	임원, 1,054명	'26.1월

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단에 소속된 회사(요약)

당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 삼성그룹에 속한 계열회사로서,
2024년말 현재 삼성그룹에는 전년말과 동일한 63개의 국내 계열회사가 있습니다.
이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 17개사이며 비상장사는 46개사입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수		
	상장	비상장	계
삼성	17	46	63

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사간 출자현황

[국내]

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : %)

피출자 회사 \ 출자회사	삼성 물산(주)	삼성바이 오로직스 (주)	삼성생명 보험(주)	삼성에스 디아이(주)	삼성에스 디에스(주)	삼성에프 엔위탁관 리부동산 투자회사 (주)	삼성이앤 에이(주)	삼성전기 (주)	삼성전자 (주)	삼성중공 업(주)	삼성증권 (주)	삼성카드 (주)	삼성해상 보험(주)
삼성물산(주)		43.1	19.3		17.1		7.0		5.0	0.1			
삼성바이오로직스(주)													
삼성생명보험(주)	0.1	0.1		0.1	0.1	19.5	0.1	0.1	8.6	3.0	29.4	71.9	15.0
삼성에스디아이(주)							11.7			0.4			
삼성에스디에스(주)													
삼성전기(주)										2.1			
삼성전자(주)		31.2		19.6	22.6			23.7		15.2			
삼성중공업(주)													
삼성증권(주)						0.4							
삼성카드(주)													
삼성화재해상보험(주)						18.7	0.2		1.5				
(주)에스원						0.7							
(주)제일기획										0.1			
(주)호텔신라													
삼성디스플레이(주)													
삼성자산운용(주)													
삼성전자서비스(주)													
(주)미라콤아이앤씨													
(주)삼성글로벌리서치													
Harman International Industries, Inc.													
계	0.1	74.3	19.3	19.7	39.7	39.3	18.9	23.8	15.1	20.9	29.4	71.9	15.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	(주)멀티캠퍼스	(주)에스원	(주)제일기획	(주)호텔신라	삼성디스플레이(주)	삼성메디슨(주)	삼성바이오에피스(주)	삼성벤처투자(주)	삼성생명서비스손해사정(주)	삼성선물(주)	삼성액티브자산운용(주)	삼성에스알에이자산운용(주)
삼성물산(주)								16.7				
삼성바이오로직스(주)							100.0					
삼성생명보험(주)	0.0	5.5	0.3	7.3					99.8			100.0
삼성에스디아이(주)		11.0		0.1	15.2			16.3				
삼성에스디에스(주)	47.2											
삼성전기(주)								17.0				
삼성전자(주)			25.2	5.1	84.8	68.5		16.3				
삼성중공업(주)								17.0				
삼성증권(주)		1.3		3.1				16.7		100.0		
삼성카드(주)		1.9	3.0	1.3								
삼성화재해상보험(주)		1.0										
(주)에스원												
(주)제일기획												
(주)호텔신라												
삼성디스플레이(주)												
삼성자산운용(주)											100.0	
삼성전자서비스(주)												
(주)미라콤아이앤씨												
(주)삼성글로벌리서치	15.2											
Harman International Industries, Inc.												
계	62.4	20.7	28.6	16.9	100.0	68.5	100.0	100.0	99.8	100.0	100.0	100.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	삼성웰스토리(주)	삼성자산운용(주)	삼성전자로지텍(주)	삼성전자서비스(주)	삼성전자서비스씨에스(주)	삼성전자판매(주)	삼성카드고객서비스(주)	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	삼성헤지자산운용(주)	삼성화재서비스손해사정(주)	삼성화재애니카손해사정(주)	세메스(주)
삼성물산(주)	100.0											
삼성바이오로직스(주)												
삼성생명보험(주)		100.0										
삼성에스디아이(주)												
삼성에스디에스(주)												
삼성전기(주)												
삼성전자(주)			100.0	99.3		100.0						91.5
삼성중공업(주)												
삼성증권(주)												
삼성카드(주)							100.0					
삼성화재해상보험(주)										100.0	100.0	
(주)에스원												
(주)제일기획												
(주)호텔신라												
삼성디스플레이(주)								50.0				
삼성자산운용(주)									100.0			
삼성전자서비스(주)					100.0							
(주)미라콤아이앤씨												
(주)삼성글로벌리서치												
Harman International Industries, Inc.												
계	100.0	100.0	100.0	99.3	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	91.5

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	수원삼성 축구단 (주)	스테코 (주)	신라에이 치엠(주)	에스디플 렉스(주)	에스비티 엠(주)	에스원씨 알엠(주)	에스유머 티리얼스 (주)	에스코어 (주)	에스티엠 (주)	에이치디 씨신라면 세점(주)	오픈핸즈 (주)	제일패션 리테일(주)	(주)미라 콤아이앤 씨	(주)미래 로시스템
삼성물산(주)												100.0		
삼성바이오로직스(주)														
삼성생명보험(주)														
삼성에스디아이(주)				50.0					100.0					
삼성에스디에스(주)								81.8			100.0		83.6	
삼성전기(주)														
삼성전자(주)		70.0												
삼성중공업(주)														
삼성증권(주)														
삼성카드(주)														
삼성화재해상보험(주)														
(주)에스원						100.0		0.6					0.6	
(주)제일기획	100.0							5.2					5.4	
(주)호텔신라			100.0		100.0					50.0				
삼성디스플레이(주)							50.0							
삼성자산운용(주)														
삼성전자서비스(주)														
(주)미라콤아이앤씨								0.5						
(주)삼성글로벌리서 치														
Harman International Industries, Inc.														
계	100.0	70.0	100.0	50.0	100.0	100.0	50.0	88.1	100.0	50.0	100.0	100.0	89.6	0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	(주)삼성글로벌리서치	(주)삼성라이온즈	(주)삼성생명금융서비스	(주)삼성화재금융서비스보험대리점	(주)삼우종합건축사사무소	(주)서울레이크사이드	(주)시큐아이	(주)씨브이네트	(주)에스에이치피코퍼레이션	(주)하만인터내셔널코리아	(주)휴먼티에스에스	(주)희망별숲
삼성물산(주)	1.0				100.0	100.0	8.7	40.1				
삼성바이오로직스(주)												
삼성생명보험(주)	14.8		100.0									
삼성에스디아이(주)	29.6											
삼성에스디에스(주)							56.5	9.4				
삼성전기(주)	23.8											
삼성전자(주)	29.8											100.0
삼성중공업(주)	1.0											
삼성증권(주)												
삼성카드(주)												
삼성화재해상보험(주)				100.0								
(주)에스원											100.0	
(주)제일기획		67.5										
(주)호텔신라									100.0			
삼성디스플레이(주)												
삼성자산운용(주)												
삼성전자서비스(주)												
(주)미라콤아이앤씨												
(주)삼성글로벌리서치												
Harman International Industries, Inc.										100.0		
계	100.0	67.5	100.0	100.0	100.0	100.0	65.2	49.5	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

[해외]

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : %)

출자회사	피출자회사	지분율(%)
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO AUSTIN INC	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO (KL) SDN. BHD.	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO Design Consulting Co.,Ltd	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Construction Inc.	100.0
Samsung C&T America Inc.	QSSC, S.A. de C.V.	20.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Energy LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Equipment Trading Solutions Group, LLC	70.0
Samsung C&T America Inc.	SAMSUNG C&T CHARGING SOLUTIONS LLC	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Armow Wind Ontario LP	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Belle River Wind LP	42.5
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	North Kent Wind 1 LP	35.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Wind GP Holding Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	South Kent Wind LP Inc.	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	45.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Windsor Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Southgate Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Belle River GP Holdings Inc	100.0

Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC GP Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction LP	100.0
SP Armow Wind Ontario GP Inc	SP Armow Wind Ontario LP	0.0
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL Holdings LLC	83.6
SRE GRW EPC GP Inc.	SRE GRW EPC LP	0.0
SRE SKW EPC GP Inc.	SRE SKW EPC LP	0.0
SRE WIND PA GP INC.	SRE WIND PA LP	0.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	Grand Renewable Solar GP Inc.	50.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	SRE GRS Holdings LP	0.0
SRE K2 EPC GP Inc.	SRE K2 EPC LP	0.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	KINGSTON SOLAR GP INC.	50.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	SRE KS HOLDINGS LP	0.0
SP Belle River Wind GP Inc	SP Belle River Wind LP	0.0
SRE Armow EPC GP Inc.	SRE Armow EPC LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Armow Wind Ontario GP Inc	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	South Kent Wind GP Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	Grand Renewable Wind GP Inc.	50.0
South Kent Wind GP Inc.	South Kent Wind LP Inc.	0.0
Grand Renewable Wind GP Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	0.0
North Kent Wind 1 GP Inc	North Kent Wind 1 LP	0.0
SRE Solar Development GP Inc.	SRE Solar Development LP	0.0
SRE Solar Construction Management GP Inc.	SRE Solar Construction Management LP	0.0
SRE BRW EPC GP INC.	SRE BRW EPC LP	0.0
SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	North Kent Wind 1 GP Inc	50.0
SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	0.0
SRE Belle River GP Holdings Inc	SP Belle River Wind GP Inc	50.0
SRE NK1 EPC GP Inc	SRE NK1 EPC LP	0.0
SRE Summerside Construction GP Inc.	SRE Summerside Construction LP	0.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 1 LLC	100.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung C&T Renewables, LLC	100.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 3, LLC	100.0
Samsung C&T Renewables, LLC	5S ENERGY HOLDINGS, LLC	50.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	SungEel Recycling Park Thuringen GmbH	50.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	POSS-SLPC, S.R.O	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Romania 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Samsung C&T Renewable Energy Europe GmbH	100.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	S.C. Otelinox S.A	99.9
Samsung C&T Corporation Poland LLC	Samsung C&T Corporation Romania S.R.L	100.0
Samsung C&T Renewable Energy Europe GmbH	Arteus Partner I HoldCo GmbH & Co. KG	50.0
Samsung C&T Renewable Energy Europe GmbH	Arteus Partner I GP GmbH	50.0
Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	70.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung Chemtech Vina LLC	48.3
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	0.2
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	30.0

Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S&G Biofuel PTE.LTD	12.6
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Gandaerah Hendana	95.0
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Inecda	95.0
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	VISTA CONTRACTING AND DEVELOPMENT BANGLADESH LTD.	100.0
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	Vista NEXT Limited	51.0
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	CME - VISTA JOINT STOCK COMPANY	51.0
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	WELVISTA COMPANY LIMITED	30.0
CHEIL HOLDING INC.	SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	75.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	6.8
Samsung C&T Hongkong Ltd.	SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	45.0
삼성전자(주)	Samsung Japan Corporation	100.0
삼성전자(주)	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics America, Inc.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Canada, Inc.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	63.6
삼성전자(주)	Samsung Electronics Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics (UK) Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Holding GmbH	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Iberia, S.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics France S.A.S	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Italia S.P.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Benelux B.V.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Austria GmbH	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	55.7
삼성전자(주)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	75.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Asia Pte. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung India Electronics Private Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	PT Samsung Electronics Indonesia	100.0
삼성전자(주)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	91.8
삼성전자(주)	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	100.0

삼성전자(주)	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	69.1
삼성전자(주)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	90.0
삼성전자(주)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	73.7
삼성전자(주)	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	87.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Argentina S.A.	98.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Chile Limitada	4.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics Rus Company LLC	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	100.0
삼성바이오로직스(주)	Samsung Biologics America, Inc.	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis United States Inc.	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis NL B.V.	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis CH GmbH	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis PL Sp z o.o.	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Biopeis TW Limited	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis HK Limited	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS IL LTD	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	100.0
삼성디스플레이(주)	Intellectual Keystone Technology LLC	41.9
삼성디스플레이(주)	Samsung Display America Holdings, Inc	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Noida Private Limited	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	95.0
삼성디스플레이(주)	Novaled GmbH	9.9
세메스(주)	SEMES America, Inc.	100.0
세메스(주)	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	100.0
삼성메디슨(주)	Sonio SAS	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NeuroLogica Corp.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Lennox HVAC North America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	SmartThings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Oak Holdings, Inc.	100.0

Samsung Electronics America, Inc.	Joyent, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	TeleWorld Solutions, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Semiconductor, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Research America, Inc	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung International, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Harman International Industries, Inc.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Federal, Inc.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Austin Semiconductor LLC.	100.0
Samsung Electronics Canada, Inc.	AdGear Technologies Inc.	100.0
Samsung Research America, Inc	SAMSUNG NEXT LLC	100.0
SAMSUNG NEXT LLC	SAMSUNG NEXT FUND LLC	100.0
Samsung International, Inc.	Samsung Mexicana S.A. de C.V	100.0
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	100.0
Samsung Display America Holdings, Inc	eMagin Corporation	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Japan Co., Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Industries Canada Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Professional, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Connected Services, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Roon Labs, LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Belgium SA	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman France SNC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Red Bend Software SAS	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Inc. & Co. KG	66.0
Harman International Industries, Inc.	Harman KG Holding, LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	99.9
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	Harman International Estonia OU	100.0
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	99.0
Harman Professional, Inc.	Harman Singapore Pte. Ltd.	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	1.0
Harman Professional, Inc.	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	0.0
Harman Professional, Inc.	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	0.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Engineering Corp.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services AB.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services UK Ltd.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	1.6
Harman Connected Services, Inc.	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	100.0
Samsung Electronics (UK) Ltd.	Samsung Semiconductor Europe Limited	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Semiconductor Europe GmbH	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Electronics GmbH	100.0
Sonio SAS	Sonio Corporation	100.0
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	31.4

Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	44.3
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	36.4
Samsung Electronics Benelux B.V.	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics West Africa Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics East Africa Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	99.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Israel Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	99.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Middle East and North Africa	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Turkiye	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Maghreb Arab	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Venezuela, C.A.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	13.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Chile Limitada	95.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Peru S.A.C.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Ukraine Company LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Ukraine	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Rus LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Central Eurasia LLP	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Corephotonics Ltd.	100.0
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Samsung Nanoradio Design Center	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Harman Professional Denmark ApS	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Studer Professional Audio GmbH	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Martin Professional Japan Ltd.	40.0
Harman Becker Automotive Systems GmbH	Harman International Romania SRL	0.0
Harman Becker Automotive Systems GmbH	Apostera UA, LLC	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Becker Automotive Systems GmbH	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Deutschland GmbH	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman RUS CIS LLC	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Holding Gmbh & Co. KG	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Management Gmbh	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Hungary Financing Ltd.	100.0
Harman Connected Services GmbH	Harman Connected Services OOO	100.0
Harman KG Holding, LLC	Harman Inc. & Co. KG	34.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Professional Kft	100.0

Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Consumer Nederland B.V.	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman International Romania SRL	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Red Bend Ltd.	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	100.0
Harman Hungary Financing Ltd.	Harman International Industries Limited	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	AKG Acoustics Gmbh	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Holding Limited	100.0
Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	Harman France SNC	0.0
Harman Connected Services AB.	Harman Finland Oy	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services GmbH	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman International Industries PTY Ltd.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	100.0
Harman Connected Services UK Ltd.	Harman Connected Services Morocco	100.0
Samsung Electronics Austria GmbH	Samsung Electronics Switzerland GmbH	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	68.6
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Romania LLC	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	49.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Greece S.M.S.A	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	FOODIENT LTD.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	OXFORD SEMANTIC TECHNOLOGIES LIMITED	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Denmark Research Center ApS	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Novaled GmbH	40.0
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	25.0

Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics New Zealand Limited	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Philippines Corporation	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd.	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd.	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	100.0
PT Samsung Electronics Indonesia	PT Samsung Telecommunications Indonesia	100.0
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	100.0
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	42.0
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	19.2
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung R&D Institute China-Shenzhen	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Beijing Samsung Telecom R&D Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	26.3
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics China R&D Center	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	100.0
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
Samsung Electronics Maghreb Arab	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	1.0
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Harman International (India) Private Limited	100.0
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	98.4
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S.A.	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S.A.	Samsung Electronica Colombia S.A.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S.A.	Samsung Electronics Panama. S.A.	100.0
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	Samsung Electronics Argentina S.A.	2.0
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	100.0
Samsung Electronics Central Eurasia LLP	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	0.0
삼성에스디아이(주)	Intellectual Keystone Technology LLC	41.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Japan Co., Ltd.	89.2
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI America Inc.	91.7
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Hungary Zrt.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Europe GmbH	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Battery Systems GmbH	100.0

삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Energy Malaysia Sdn. Bhd.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI India Private Limited	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	97.6
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI China Co., Ltd.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	65.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	80.0
삼성에스디아이(주)	StarPlus Energy LLC.	51.0
삼성에스디아이(주)	Novaled GmbH	50.1
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Southeast Asia PTE. LTD.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Wuxi Co., Ltd.	100.0
삼성에스디아이(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Samsung SDI India Private Limited	0.0
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	80.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Mexico, S.A. de C.V.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics GmbH	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	100.0
삼성전기(주)	Calamba Premier Realty Corporation	39.8
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	99.9
삼성전기(주)	Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	81.8
삼성전기(주)	Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	95.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	Samsung Electro-Mechanics Mexico, S.A. de C.V.	0.0
Calamba Premier Realty Corporation	Batino Realty Corporation	100.0
Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	0.1
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Management Corporation	100.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD.	100.0
삼성화재해상보험(주)	PT. Asuransi Samsung Tugu	70.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED	75.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Reinsurance Pte. Ltd.	100.0
삼성화재해상보험(주)	삼성재산보험 (중국) 유한공사	37.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited	100.0
삼성중공업(주)	Camellia Consulting Corporation	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	100.0
삼성중공업(주)	삼성중공업(영성)유한공사	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	100.0

삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries Mozambique LDA	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries Rus LLC	100.0
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	SHI - MCI FZE	70.0
삼성생명보험(주)	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	51.0
삼성생명보험(주)	Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd	48.9
삼성생명보험(주)	Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	90.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (New York), Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management U.S. Holdings, Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Fund 2022 GP, Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Co-Investment 2021 GP, Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management(London) Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Japan Corporation	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T America Inc.	100.0
삼성물산(주)	Samsung E&C America, INC.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Renewable Energy Inc.	100.0
삼성물산(주)	QSSC, S.A. de C.V.	80.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Lima S.A.C.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Deutschland GmbH	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T U.K. Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T ECUK Limited	100.0
삼성물산(주)	Whessoe engineering Limited	100.0
삼성물산(주)	POSS-SLPC, S.R.O	50.0
삼성물산(주)	Solluce Romania 1 B.V.	80.0
삼성물산(주)	SAM investment Manzanilo.B.V	53.3
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation Poland LLC	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	100.0
삼성물산(주)	Erdsam Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Chemtech Vina LLC	51.7
삼성물산(주)	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	93.0
삼성물산(주)	Samsung C&T India Private Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation India Private Limited	100.0
삼성물산(주)	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	70.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	S&G Biofuel PTE.LTD	50.5
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	70.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	100.0
삼성물산(주)	S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	100.0
삼성물산(주)	VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY	70.0
삼성물산(주)	Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	25.0

삼성물산(주)	CHEIL HOLDING INC.	40.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Renewable Energy Australia Pty Ltd	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T PHILIPPINES, CORP.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Hongkong Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	55.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	30.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	100.0
삼성물산(주)	SAM Gulf Investment Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Chile Copper SpA	100.0
삼성물산(주)	SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation Rus LLC	100.0
삼성물산(주)	Samsung SDI America Inc.	8.3
삼성물산(주)	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	2.4
삼성물산(주)	Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	10.0
삼성물산(주)	CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	100.0
삼성물산(주)	Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	60.0
삼성웰스토리(주)	Welstory Hungary Kft.	100.0
삼성웰스토리(주)	WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	100.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	85.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Welstory Food Company Limited	81.6
(주)멀티캠퍼스	LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC.	82.4
WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	WELVISTA COMPANY LIMITED	70.0
Pengtai Greater China Company Limited	PENGTAI CHINA CO.,LTD.	100.0
Pengtai Greater China Company Limited	PengTai Taiwan Co., Ltd.	100.0
PENGTAI CHINA CO.,LTD.	PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD	100.0
PENGTAI CHINA CO.,LTD.	Beijing Pengtai Borui E-commerce Co.,Ltd.	100.0
PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	Medialytics Inc.	100.0
PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.	51.0
iMarket Asia Co., Ltd.	iMarket China Co., Ltd.	80.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (America), Inc.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Europe) Limited.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Asia) Limited.	100.0
삼성에스디에스(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	40.6
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS America, Inc.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Europe, Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung GSCL Sweden AB	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL France SAS	100.0

삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung Data Systems India Private Limited	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS MALAYSIA SDN. BHD.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Australia Pty.,Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	SDS-ACUTECH CO., Ltd.	50.0
삼성에스디에스(주)	ALS SDS Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스(주)	SDS-MP Logistics Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS China Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Hong Kong Limited	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS Global SCL Egypt	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Latin America Tecnologia E Logistica LTDA.	99.7
삼성에스디에스(주)	INTE-SDS Logistics S.A. de C.V.	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Rus Limited Liability Company	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	99.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Panama S.A.	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Latin America Tecnologia E Logistica LTDA.	0.3
Samsung SDS Europe, Ltd.	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Rus Limited Liability Company	0.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A America Inc.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung Project Management Inc.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Hungary Co. Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung Engineering Italy S.R.L.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Malaysia SDN. BHD.	100.0
삼성이앤에이(주)	PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd.	81.0

삼성이앤에이(주)	Samsung E&A India Private Limited	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	GLOBAL MODULE CENTER JOINT STOCK COMPANY	49.6
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Global Private limited	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Shanghai Co., Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Xi' an Co., Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Arabia Co., Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	99.8
삼성이앤에이(주)	Muharraq STP Company B.S.C.	6.6
삼성이앤에이(주)	Muharraq Holding Company 1 Ltd.	65.0
삼성이앤에이(주)	SAMSUNG ENGINEERING NEC COMPANY LIMITED	60.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Mexico S.A. de C.V.	99.9
삼성이앤에이(주)	Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Manzanillo S.A. De C.V. (SIMA)	99.9
삼성이앤에이(주)	Grupo Samsung E&A Mexico, S.A. De C.V. (GSIM)	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Energia S.A. De C.V.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Bolivia S.A	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A DUBA S.A. De C.V.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P.	100.0
Samsung E&A America Inc.	Samsung E&A America Construction LLC	100.0
Samsung E&A America Inc.	Samsung E&A Louisiana Construction LLC	100.0
Samsung E&A Malaysia SDN. BHD.	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	0.3
Samsung E&A India Private Limited	Samsung E&A Global Private limited	0.0
Samsung E&A India Private Limited	Samsung E&A Arabia Co., Ltd.	0.0
Samsung E&A Arabia Co., Ltd.	Samsung EPC Company Ltd.	75.0
Muharraq Holding Company 1 Ltd.	Muharraq Holding Company 2 Ltd.	100.0
Muharraq Holding Company 2 Ltd.	Muharraq STP Company B.S.C.	89.9
Samsung E&A DUBA S.A. De C.V.	Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V.	49.0
(주)에스원	S-1 CORPORATION HUNGARY LLC	100.0
(주)에스원	S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
(주)에스원	Samsung Beijing Security Systems	100.0
(주)제일기획	Pengtai Greater China Company Limited	98.8
(주)제일기획	PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	100.0
(주)제일기획	Cheil USA Inc.	100.0
(주)제일기획	Cheil Central America Inc.	100.0
(주)제일기획	Iris Worldwide Holdings Limited	100.0
(주)제일기획	CHEIL EUROPE LIMITED	100.0
(주)제일기획	Cheil Germany GmbH	100.0
(주)제일기획	Cheil France SAS	100.0
(주)제일기획	CHEIL SPAIN S.L	100.0
(주)제일기획	Cheil Benelux B.V.	100.0
(주)제일기획	Cheil Nordic AB	100.0
(주)제일기획	Cheil India Private Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil (Thailand) Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Singapore Pte. Ltd.	100.0
(주)제일기획	CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED	99.0

(주)제일기획	Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	100.0
(주)제일기획	CHEIL MALAYSIA SDN. BHD.	100.0
(주)제일기획	Cheil New Zealand Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil Worldwide Australia Pty Ltd	100.0
(주)제일기획	CHEIL CHINA	100.0
(주)제일기획	Cheil Hong Kong Ltd.	100.0
(주)제일기획	Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd	100.0
(주)제일기획	Cheil MEA FZ-LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil South Africa (Pty) Ltd	100.0
(주)제일기획	CHEIL KENYA LIMITED	99.0
(주)제일기획	Cheil Communications Nigeria Ltd.	99.0
(주)제일기획	Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.	100.0
(주)제일기획	Cheil Ghana Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil Egypt LLC	99.9
(주)제일기획	Cheil Maghreb LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	100.0
(주)제일기획	Cheil Mexico, S.A. de C.V.	98.0
(주)제일기획	Cheil Chile SpA.	100.0
(주)제일기획	Cheil Peru S.A.C.	100.0
(주)제일기획	CHEIL ARGENTINA S.A.	99.9
(주)제일기획	Cheil Rus LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Ukraine LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Kazakhstan LLC	100.0
(주)호텔신라	Samsung Hospitality America Inc.	100.0
(주)호텔신라	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	100.0
(주)호텔신라	Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	100.0
(주)호텔신라	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	100.0
에이치디씨신라면세점(주)	HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality U.K. Ltd.	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Europe GmbH	100.0
에스비티엠(주)	SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	99.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Philippines Inc.	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality India Private Limited	100.0
삼성벤처투자(주)	Samsung Venture Investment (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris (USA) Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Atlanta, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	89 Degrees, Inc.	100.0
Cheil USA Inc.	The Barbarian Group LLC	100.0
Cheil USA Inc.	McKinney Ventures LLC	100.0
Cheil USA Inc.	Cheil India Private Limited	0.0
Cheil USA Inc.	Cheil Mexico, S.A. de C.V.	2.0
McKinney Ventures LLC	Lockard & Wechsler LLC	100.0
Iris Worldwide Holdings Limited	Iris Nation Worldwide Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Americas, Inc.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	100.0

Iris Nation Worldwide Limited	Pricing Solutions Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris London Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Promotional Marketing Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures 1 Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Founded Partners Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Digital Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures (Worldwide) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	WDMP Limited	49.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Services Limited Dooel Skopje	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Singapore Pte. ltd.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide (Thailand) Limited	100.0
Iris London Limited	Iris Partners LLP	100.0
Iris Promotional Marketing Ltd	Holdings BR185 Limited	100.0
Iris Ventures 1 Limited	Iris Germany GmbH	100.0
Founded Partners Limited	Founded, Inc.	100.0
Iris Germany GmbH	Pepper NA, Inc.	100.0
CHEIL EUROPE LIMITED	Beattie McGuinness Bungay Limited	100.0
CHEIL EUROPE LIMITED	Cheil Italia S.r.l	100.0
Cheil Germany GmbH	Cheil Austria GmbH	100.0
Cheil Germany GmbH	Centrade Integrated SRL	100.0
Centrade Integrated SRL	Centrade Cheil HU Kft.	100.0
Centrade Integrated SRL	Centrade Cheil Adriatic D.O.O.	100.0
Cheil India Private Limited	Experience Commerce Software Private Limited	100.0
Cheil India Private Limited	Diginfluenz Private Limited	51.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	100.0
Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Cheil Philippines Inc.	30.0
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	Shilla Retail Plus Pte. Ltd.	100.0
Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	100.0
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	Shilla Retail Limited	100.0
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	BNY Trading Hong Kong Limited	100.0
BNY Trading Hong Kong Limited	LOFAN LIMITED	100.0
BNY Trading Hong Kong Limited	KINGMA LIMITED	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One Agency FZ-LLC	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	0.0
Cheil MEA FZ-LLC	Cheil Egypt LLC	0.1
Cheil South Africa (Pty) Ltd	CHEIL KENYA LIMITED	1.0
Cheil South Africa (Pty) Ltd	Cheil Communications Nigeria Ltd.	1.0
One Agency FZ-LLC	ONE RETAIL EXPERIENCE KOREA LIMITED	100.0
One Agency FZ-LLC	One RX India Private Limited	100.0
One Agency FZ-LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	100.0
One Agency FZ-LLC	ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	100.0
One Agency FZ-LLC	ONE AGENCY PRINTING L.L.C	100.0

ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	One RX India Private Limited	0.0
Holdings BR185 Limited	Brazil 185 Participacoes Ltda	100.0
Brazil 185 Participacoes Ltda	Iris Router Marketing Ltda	100.0
Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	CHEIL ARGENTINA S.A.	0.1

다. 관련법령상의 규제내용 등

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 상호출자제한기업집단 등
① 지정시기: 2024년 5월 14일
② 규제내용 요약
・상호출자의 금지
・계열사 채무보증 금지
・금융・보험사의 계열사 의결권 제한
・대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
・비상장사 중요사항 공시
・기업집단 현황 등에 관한 공시

라.회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일)

겸직자		계열회사 겸직현황		
성명	직위	기업명	직위	상근 여부
김성욱	부사장	삼성전자판매㈜	기타비상무이사	비상근
강성욱	상무	삼성전자로지텍㈜	감사	비상근
남경인	상무	삼성전자로지텍㈜	기타비상무이사	비상근
고재윤	부사장	삼성전자서비스㈜	감사	비상근
장흥민	상무	삼성전자서비스㈜	기타비상무이사	비상근
유규태	부사장	삼성메디슨㈜	대표이사	상근
심재현	부사장	삼성메디슨㈜	감사	비상근
박순철	부사장	삼성벤처투자㈜	감사	비상근
유한종	상무	㈜삼성글로벌리서치	감사	비상근
고크리스토퍼한승	사장	삼성바이오에피스(주)	사내이사	비상근
오재균	부사장	삼성디스플레이㈜	감사	비상근
조기재	부사장	세메스㈜	감사	비상근
황희돈	부사장	세메스㈜	기타비상무이사	비상근
성덕용	부사장	세메스㈜	기타비상무이사	비상근
오종훈	부사장	스테코㈜	감사	비상근
정용덕	상무	㈜미래로시스템	기타비상무이사	비상근

2. 타법인 출자 현황(요약)

2024년말 현재 당사 타법인 출자 금액은 장부금액 기준 59조 6,035억원이며, 경영참여 등 목적으로 출자하였습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액			
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
					취득 (처분)	평가 손익	
경영참여	20	79	99	59,178,553	21,342	297,046	59,496,941
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	5	26	31	68,389	-2,943	41,155	106,601
계	25	105	130	59,246,942	18,399	338,201	59,603,542

※ 별도 기준입니다.

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 2024년말 현재 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 해외종속법인의 유연한 자금조달을 위하여 통합채무보증을 제공하고 있습니다

(단위 : 천US$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2024.04.20	2025.11.08	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2024.03.28	2025.12.16	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2024.10.01	2025.12.16	329,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	62,000	64,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2024.06.01	2025.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.12.16	96,000	46,000	8,065	△8,065	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	917,000	947,000	320,893	174,428	495,321	47.5%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.12.16	70,000	70,000	-	-	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	114,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2024.04.28	2025.12.16	835,508	808,270	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	125,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	537,000	537,000	-	-	-	
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	888,400	906,400	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	15,600	15,600	-	-	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	270,000	270,000	-	-	-	
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	30,000	30,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	10,000	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증 시작일	보증 종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
합 계							8,129,508	8,102,270	328,958	166,363	495,321	

※ 별도 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정 됩니다.

※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를 수취하고 있습니다.당사는 2024년 중 US$2,215천의 수수료를 청구하였으며, 2024년말 현재 미수취하였습니다.

당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우 유동성 위험에 대응하고 있습니다. 권역 내 Cash Pooling 참여법인들은 Pooling 모법인(SEA, SEEH, SAPL, SCIC 등)으로부터 상시 자금조달이 가능한 바, 별도 본사 지급보증을 통한 차입의 필요성은 낮으나 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 Pooling 모법인이 활용할 수 있는 차입한도를 별도 배정하고 있습니다. 또한 현지 규제 등으로 Cash Pooling이 불가능한 지역에 대해서는 통합채무보증을 통해 법인별로 보증한도를 설정하고 유동성 위험에 효율적으로 대응하고 있습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2024년 중 법인의 생산설비 증설 등 목적으로 자산을 Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS) 등의 계열회사에 매각하였으며, 생산 효율화 등을 위해 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SESS	계열회사	자산매각/매입	2024.11.29	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	28,923	5,672
SCS	계열회사	자산매각/매입	2024.11.05	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	18,152	8,503
SEVT	계열회사	자산매각/매입	2024.12.20	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	4,532	26
SII	계열회사	자산매각	2024.02.15	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	1,753	60
TSLED	계열회사	자산매각	2024.10.22	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	852	273
SEHC	계열회사	자산매각	2024.08.07	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	272	△8
SSEC	계열회사	자산매각	2024.04.14	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	250	2
SEDA	계열회사	자산매각	2024.04.23	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	149	-
SEV	계열회사	자산매입	2024.01.17	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	132	-
삼성바이오로직스㈜	계열회사	자산매각	2024.12.31	차량운반구	자산 효율화	122	△14

※ 별도 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었으며, 거래 다음달 15일・30일 이내
현금 지급조건 등통상적인 조건으로 거래되었습니다.

※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상이 아닙니다.

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 거래금액이 1억원 미만인 경우에는 기재를 생략하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

2024년 중 계열회사인 Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) 등과 매출, 매입 등의 영업거래를 하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SSI	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.12	반도체 매출 등	43,946,256
SEA	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.12	스마트폰 및 가전제품 매출입 등	29,431,324
SSS	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.12	반도체 매출 등	28,414,204
SEVT	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.12	스마트폰 매출입 등	24,843,519
SEV	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.12	스마트폰 매출입 등	16,107,955
SCS	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.12	반도체 매입 등	11,485,734
SIEL	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.12	스마트폰 및 가전제품 매출입 등	9,629,072

※ 별도 기준입니다.

※ 공시대상은 최근사업연도 매출액의 5% 이상 기준입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2024년말 현재 제품경쟁력 제고, 상생경영을 위한 협력사 지원 및 종업원 복리후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 1,353억원의 대여금이 있습니다.

(단위 : 백만원)

성 명 (법인명)	관 계	계정과목	대여금 변동 내역		
			기초	증감	기말
㈜이랜텍 등	협력업체 및 종업원	단기대여금	46,069	3,515	49,584
대덕전자㈜ 등	협력업체 및 종업원	장기대여금	89,253	△3,558	85,695
합 계			135,322	△43	135,279

※ 별도 기준입니다.

※ 대여금은 현재가치할인차금 차감후, 대손충당금(손실충당금) 차감전 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건등

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등을 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

당사(삼성전자㈜, 삼성디스플레이㈜ 등)는 분할된 삼성디스플레이㈜ 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

나. 채무보증내역

(단위 : 천US$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2024.04.20	2025.11.08	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2024.03.28	2025.12.16	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2024.10.01	2025.12.16	329,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	62,000	64,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2024.06.01	2025.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.12.16	96,000	46,000	8,065	△8,065	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	917,000	947,000	320,893	174,428	495,321	47.5%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.12.16	70,000	70,000	-	-	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	114,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2024.04.28	2025.12.16	835,508	808,270	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	125,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	537,000	537,000	-	-	-	
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	888,400	906,400	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	15,600	15,600	-	-	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.12.16	270,000	270,000	-	-	-	
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	30,000	30,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2024.12.17	2025.12.16	10,000	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증 시작일	보증 종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2024.11.09	2025.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2023.02.17	2027.11.24	601,149	584,785	510,977	△13,910	497,067	8.36%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무소멸시	340,000	340,000	-	-	-	
SEA	계열회사	US Government	지급보증	보조금	2024.12.20	채무소멸시	-	6,435,000	-	-	-	
합 계							9,070,657	15,462,055	839,935	152,453	992,388	

※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA가 각각 채무보증인입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를 수취하고 있습니다.당사는 2024년 중 US$2,215천의 수수료를 청구하였으며, 2024년말 현재 미수취하였습니다.

한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2024년 중 $2,982천 수수료를 청구하였으며, 2024년말 현재 미수취하였습니다.

※ SEA의 US Government 채무는 SAS가 반도체 보조금 계약 불이행시 미 상무부에 반환해야하는 금액에 대한 모법인의 지급보증 계약입니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사・사법기관의 제재현황

[요약] (단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	횡령·배임등 금액	근거 법령
2022.07.07	광주지방법원	당사 임직원	벌금	6	-	「환경분야 시험・검사 등에 관한 법률」 제33조 7호, 제34조, 제18조 1항 등
2023.02.09	광주지방법원	당사 및 당사 임직원	벌금	25	-	「구.산업안전보건법」 제10조 제1항, 「 산업안전보건법」 제57조 제1항 등

광주지방법원 순천지원은 2021년 1월 20일「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조 등 위반으로 당사 직원 A프로(근속연수 11년), B프로(근속연수 8년)에게 각 벌금(3백만원)을 선고하였고, 광주지방법원은 2022년 7월 7일 이 사건 항소심에서 항소 기각 판결을 선고하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

광주지방법원은 2023년 2월 9일「구.산업안전보건법」 제10조 제1항,「산업안전보건법」 제57조 제1항 등 위반으로 당사 및 당사 직원 5명에 대해 약식명령을 발령하였습니다. 당사 및 당사 직원 5명은 이에 대해 정식재판을 청구하지 않아 해당 약식명령은 확정되었고(당사 벌금 15백만원, 당사 직원 벌금 각 2백만원), 당사는 벌금 납부를 완료하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 환경안전담당자 및 관리감독자 대상으로 특별 교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

나. 행정기관의 제재현황

(1) 공정거래위원회의 제재현황

[요약] (단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유 및 근거 법령
2021.06.22	공정거래위원회	당사 및 당사 임직원	검찰고발	-	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호
2021.08.27	공정거래위원회	당사	시정조치 과징금	101,217	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호
		자회사 (삼성디스플레이㈜)	시정조치 과징금	22,857	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호
2022.03.17	공정거래위원회	당사 임직원	경고	-	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조(상호출자제한기업집단 등의 지정 등) 제4항
2022.06.27	공정거래위원회	당사	과태료	10	「대리점거래의 공정화에 관한 법률」 제5조(대리점거래 계약서의 작성의무) 제1항
2024.04.07	공정거래위원회	당사	시정조치	-	「대리점거래의 공정화에 관한 법률」 제10조(경영활동 간섭 금지) 제1항
2024.12.13	공정거래위원회	㈜미래로시스템	과태료	0.8	「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제 133조(하도급대금의 결제조건 등에 관한 공시) 제3항

공정거래위원회는 2021년 6월 22일 삼성웰스토리㈜와의 단체급식 거래와 관련하여 검찰에 당사 및 퇴직 임원인 최지성 전 미래전략실장을「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호 위반 혐의로 고발하였습니다.

또한 당사와 삼성디스플레이㈜는 삼성웰스토리㈜와의 단체급식 거래와 관련하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제23조 제1항 제7호 위반 혐의로 공정거래위원회로부터 2021년 8월 27일 시정조치 및 과징금(당사: 1,012억 17백만원, 삼성디스플레이㈜: 228억 57백만원) 처분을 받았습니다. 동 처분에 대해 현재 행정소송이 진행 중이며, 시정조치에 대해 2022년 1월 27일 집행정지 결정이 확정되었습니다.

공정거래위원회는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제31조 제4항에 따른 2018년과 2019년 지정자료 제출시 삼성카드㈜의 사외이사가 지배하는 회사인 발벡케이피엘코리아㈜, 발벡케이피엘파트너스㈜, 발벡케이피엘자산운용㈜ 3개사를 상호출자제한기업집단「삼성」의 소속회사에서 누락했다는 이유로 2022년 3월 17일 당사의 이재용 부회장에 대해「경고」처분 하였습니다.

당사는 2022년 6월 27일 공정거래위원회로부터 '대리점거래의 공정화에 관한 법률' 제5조(대리점거래 계약서의 작성의무) 제1항 위반 혐의로 과태료 1천만원을 부과 받았으며, 이에 대하여 현재 이의신청 절차가 진행 중입니다.

또한 당사는 2024년 4월 7일 공정거래위원회로부터 '대리점거래의 공정화에 관한 법률' 제10조(경영활동 간섭 금지) 제1항 및 동 법 시행령 제7조 제2호(영업상 비밀 정보 제공 요구)위반 혐의로 시정명령을 부과 받았습니다.

자회사 (주)미래로시스템은 2024년 12월 13일 공정거래위원회로부터 '하도급거래 공정화에 관한 법률' 제 133조(하도급대금의 결제조건 등에 관한 공시) 제3항 등 위반으로 과태료 (0.8백만원)를 부과 받았습니다.

당사는 공정거래법, 표시광고법, 대리점법 등 법률 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대해 관련 예방교육을 시행하고 있습니다.

(2) 기타 행정・공공기관(금융감독・과세 당국 등 포함)의 제재현황

[요약] (단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유 및 근거 법령
2022.04.21	고용노동부	당사 (온양사업장)	과태료	0.6	「산업안전보건법」 제46조 제1항 등
2022.10.13	광주광역시청	당사 (광주사업장)	과태료	3.2	「대기환경보전법」 제39조 제1항
2022.12.14	환경부	당사 (한국총괄)	과태료	2.0	「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제17조 제2항
2022.12.22	환경부	당사 (광주사업장)	과태료	1.6	「대기환경보전법」 제31조 제1항
2022.12.23	고용노동부	당사 (광주사업장)	과태료	0.08	「산업안전보건법」 제37조 제1항
2023.01.16	고용노동부	당사 (광주사업장)	과태료	0.16	「산업안전보건법」 제37조 제1항, 제115조 제2항
2023.08.16	구미소방서	당사 (구미사업장)	조치명령	-	「위험물안전관리법」 제5조 제1항, 제6조 제1항
2023.08.18	개인정보 보호위원회	당사	과징금	875.6	「개인정보보호법」 제29조, 동법 시행령 제48조의2 제1항 제2호
			과태료	2.4	
2023.08.23	광주광역시청	당사 (광주사업장)	과태료	2.0	「대기환경보전법」 제31조 제2항
2023.09.04	산업통상자원부	자회사 (삼성메디슨㈜)	교육명령 (2인)	-	「대외무역법」 제19조, 제31조, 제49조
2024.10.22	고용노동부	당사 (기흥사업장)	과태료	30	「산업안전보건법」 제54조 (중대재해 발생 시 사업주의 조치) 제2항
2024.10.29	원자력 안전위원회	당사 (기흥사업장)	과태료	16.5	「원자력안전법」 제91조(방사선장해방해조치) 제4항 등
2024.11.26	고용노동부	당사 (기흥,화성사업장)	과태료	68	「산업안전보건법」 제16조(관리 감독자) 제1항, 「산업안전보건법」 제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제3항 등
2024.12.16	금강유역환경청	당사 (천안사업장)	과태료	6	「화학물질관리법」 제31조(유해화학물질 취급의 도급신고 등) 제1항

당사는 2022년 2월 21일부터 2월 23일까지 진행된 온양사업장에 대한 고용노동부의PSM 이행상태 정기평가와 관련하여 PSM 평가 등급은 한 단계 향상되었으나, 4월 21일「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(60만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 위반사항에 대해서 조치 후 고용노동부에 개선 결과를 제출하였으며, PSM 혁신조직을 신설하여 인허가, 설계 반영, 12대 실천과제, 전문성 향상 활동을 통해 PSM 상시 운영체계를 구축하여 운영 중에 있으며, 현장 공정안전 전문가를 육성하고 공정안전 자체평가를 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

2022년 7월 7일 광주지방법원에서 당사 임직원 2명에게 「환경분야 시험・검사 등에 관한 법률」 제18조 등 위반에 대한 선고가 완료됨에 따라 2022년 10월 13일 광주광역시청으로

부터 대기오염물질 자가측정결과 기록과 관련하여「대기환경보전법」
제39조 (자가측정) 제1항 위반으로 과태료(3.2백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 측정값에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

당사는 2022년 11월 28일부터 29일까지 광주사업장에 대한 환경부의 대기방지시설 감독과 관련하여, 2022년 12월 22일「대기환경보전법」제31조 (배출시설과 방지시설의 운영) 제1항 위반으로 과태료(1.6백만원)가 발생하여 자진납부 완료하였습니다.
당사는 대기방지시설 점검을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 환경부로부터 2022년 12월 14일「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제17조 (배출권 할당의 취소) 제2항 위반으로 과태료(2백만원)를 부과 받았으며, 납부 완료하였습니다. 당사는 온실가스 배출 사업장 현황 관리를 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2022년 12월 19일부터 21일까지 광주사업장에 대한 고용노동부의 산업안전보건관리 감독과 관련하여, 2022년 12월 23일「산업안전보건법」제37조 (안전보건표지의 설치·부착) 제1항 위반으로 과태료(8만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 또한, 2023년 1월 9일부터 1월 11일까지 광주사업장에 대한 고용노동부의 산업안전보건관리 감독과 관련하여, 2023년 1월 16일「산업안전보건법」제115조
(물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시) 제2항, 제37조 (안전보건표지의 설치·부착) 제1항 위반으로 과태료(16만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 안전표지판 설치 및 부착 점검을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 구미소방서로부터 2023년 8월 16일 구미사업장에 대한「위험물안전관리법」 제5조 (위험물의 저장 및 취급의 제한) 제1항 및 제6조 (위험물시설의 설치 및 변경 등) 제1항 위반으로 조치명령을 받아 위험물취급소 설치허가신청 등 조치를 완료하였습니다. 당사는 위험물 시설에 대해 인허가 관리를 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 개인정보보호위원회로부터 2023년 8월 18일「개인정보보호법」제29조 (안전조치의무) 및 동법 시행령 제48조의2 (개인정보의 안전성 확보 조치에 관한 특례) 제1항 제2호 위반으로 시정조치 처분과 과징금(875.6백만원) 및 과태료(2.4백만원)를 부과 받았으며, 납부 완료하였습니다. 당사는 시스템 운영 협력업체 대상 교육 및 보안관련 계약을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 광주광역시청으로부터 2023년 8월 23일 광주사업장에 대한 「대기환경보전법」제31조 (배출시설과 방지시설의 운영) 제2항 위반으로 행정처분(경고) 및 과태료(2백만원)를 부과 받았으며, 과태료는 납부 완료하였습니다. 당사는 대기 배출시설과방지시설의 운영 상황에 대한 전산 입력 관리 프로세스를 강화하여 관련 법규 준수를위해 노력하고 있습니다.

당사는 2024년 5월 27일 발생한 기흥사업장의 방사선 피폭사건과 관련하여, 2024년10월 22일 고용노동부 경기지청으로부터 「산업안전보건법」 제54조(중대재해 발생 시 사업주의 조치) 제2항 위반을 원인으로 과태료(30백만원) 부과를 고지받았습니다. 다만, 당사는 위 법조에서 정한 보고의무가 발생하였는지 법적 판단을 받아보고자 2024년 12월 17일 이의제기서를 제출하였고, 현재 관련 재판 절차(과태료 재판) 진행 중입니다. 또한 2024년 7월 8일부터 7월 10일까지 진행된 원자력안전위원회의 특별점검에 따라 2024년 10월29일 「원자력안전법」제91조(방사선장해방해조치) 제4항 등 위반으로 과태료(16.5백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였고, 2024년
11월4일부터 2024년11월15일까지 기흥사업장에서 진행된 고용노동부의 일반감독에 따라 2024년 11월26일 기흥사업장은「산업안전보건법」제16조(관리 감독자) 제1항 등 위반으로 과태료(61백만원), 화성사업장은「산업안전보건법」제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제 3항 위반에 따른 과태료(7백만원)가 발생하여 자진납부 완료하였습니다. 당사는 위반사항에 대해서 조치 후 고용노동부와 원자력안전위원회 측에 개선 결과를 제출하고 있으며, 안전보건조직 하에 방사선안전관리자 육성, 방사선 전문업체 유지보수, 전자 선량계 지급 등 방사선 안전 관리 상시 운영체계를 구축하고 산업재해조사표 제출 프로세스를 개선하여 안전한 사업장이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.

2024년 9월 19일 발생한 천안사업장의 수산화칼륨 접액사고와 관련하여, 2024년
12월 16일 화학물질관리법 제31조(유해화학물질 취급의 도급신고 등) 제1항 위반으로 과태료(6백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.당사는 재발 방지를 위하여 생산 설비 설치 및 유지보수 업체 전수 도급신고를 진행하는 등 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성메디슨㈜는 상황허가 대상 일부 품목에 대해 산업통상자원부의 사전 허가를 받지않고 수출하여 2023년 9월 4일 산업통상자원부로부터「대외무역법」제19조(전략물자의 고시 및 수출허가 등) 등 위반으로 교육명령(2인) 행정처분을 부과받았으며,
2023년 11월 7일 산업통상자원부의 교육과정을 이수하였습니다. 삼성메디슨㈜는 재발 방지를 위하여 전략물자 관리담당자의 교육활동을 강화하고 내부 프로세스를 보완하는 등 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재현황

해당사항 없습니다

라. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항

해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.

나. 대외후원 현황

현 황	금 액	내 용	비 고
2022년 사회공헌 매칭기금 운영계획	117.5억원	· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2022년 회사매칭기금으로 117.5억원 운영 · 청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	2022.02.15 이사회 결의
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	23.24억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	
삼성복지재단 등 기부금 출연	468억원	· 저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영 (삼성복지재단, 44억원) · 삼성서울병원 리모델링 공사비 지원(삼성생명공익재단, 232억원) · 교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 150억원) · 학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상(호암재단, 42억원)	2022.04.28 이사회 결의
DS부문 우수협력사 인센티브	약 740억원	· 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업	
서울대 반도체공동연구소 운영비 기부금 출연	50억원	· 서울대학교 반도체공동연구소의 교육 장비 인프라 및 연구 인력 채용을 위한 운영비 지원	2022.07.28 이사회 결의
이태원 사고 관련 지원 및 사회안전시스템 구축 성금	40억원	· 이태원 사고 관련 지원 및 사회안전시스템 구축을 위해 총 40억원을 사단법인 전국재해구호협회에 현금 기부	2022.11.03 이사회 결의
희망2023 나눔캠페인 기부금 출연	183.7억원	· 연말 이웃사랑 성금 보금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회 복지공동모금회에 출연	2022.11.30 이사회 결의
Samsung Global Goals 기부금 출연	$7,188,329 (약 95.7억원)	· United Nations Development Programme(UNDP)에 전달하여, 각 국의 구호활동 등에 활용	
국제기능올림픽 후원	165만 유로 (약22.5억원)	· 제47회 프랑스 리옹 국제기능올림픽대회 및 국제기능올림픽위원회(WorldSkills International) 후원	
2023년 사회공헌 매칭기금 운영계획	123.4억원	· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2023년 회사매칭기금으로 123.4억원 운영 · 청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	2023.02.14 이사회 결의
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	23.78억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	
스마트공장 지원사업 추진	224억원	· 스마트공장 지원을 통한 국내 제조경쟁력 강화 및 지역균형 발전에 기여	2023.04.27 이사회 결의
DS부문 우수협력사 인센티브	801억원	· 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업	
삼성복지재단 등	328.3억원	· 삼성서울병원 리모델링 공사비 지원(삼성생명공익재단, 171.9억원)	2023.07.27

기부금 출연		・교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 122.4억원) ・과학(물리・수학)/과학(화학・생명)/공학/의학/예술/사회봉사 6개 부문 시상(호암재단, 34억원)	이사회 결의
희망2024 나눔 캠페인 기부금 출연	86.5억원	・연말 이웃사랑 성금 모금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회복지공동모금회에 출연	2023.11.30 이사회 결의
Samsung Global Goals 기부금 출연	$4,366,270 (56.8억원)	・United Nations Development Programme(UNDP)에 전달하여, 각 국의 구호활동 등에 활용	
2024년 사회공헌 매칭기금 운영계획	122.7억원	・당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금 으로 구성되며, 2024년 회사매칭기금으로 122.7억원 운영 ・청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	2024.2.20 이사회 결의
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	24.69억원	・지역 교육 환경 개선 도모	
사회공헌 기부금 출연	357.3억원	・삼성서울병원 리모델링 공사비 지원(삼성생명공익재단, 200억원) ・삼성장학금 및 교직원 법정부담금 지원(성균관대학, 123.2억원) ・과학(물리・수학)/과학(화학・생명)/공학/의학/예술/사회봉사 6개 부문 시상(호암재단, 34.1억원)	2024.07.31 이사회 결의
DS부문 우수협력사 인센티브	224억원	・사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 ・대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업	2024.10.31 이사회 결의
희망2025 나눔 캠페인 기부금 출연	85.3억원	・연말 이웃사랑 성금 모금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회복지공동모금회에 출연	2024.11.29 이사회 결의
Samsung Global Goals 기부금 출연	$2,939,972 (41.1억원)	・United Nations Development Programme(UNDP)에 전달하여, 각 국의 구호활동 등에 활용	

※ 대외후원 현황 및 금액은 이사회 결의 기준으로 기재하였습니다.

다. 녹색경영

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기업 지정' 및 '녹색기술 인증'을 확대하고 있습니다. 특히 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스배출량'과 '에너지 사용량'을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(녹색기업 지정)

당사는 오염물질 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 녹색경영체제의 구축 등 친환경기업으로서의 책임을 다하고 있으며,「환경기술 및 환경산업 지원법」
제16조의2(녹색기업의 지정 등)에 따라 2024년 반기말 현재(별도 기준) 수원사업장, 구미사업장, 기흥・화성사업장, 평택사업장, 온양사업장, 천안사업장이 녹색기업으로 지정되어 있습니다.

(녹색기술 인증)

당사는「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」제60조 (녹색기술・녹색산업의 표준화 및 인증 등) 2항에 따라 '녹색기술 인증'을 취득하고 있습니다. 당사는 인증 제도가 시작된 2010년부터 지속적으로 녹색기술을 발굴하여 인증을 취득해왔으며 2024년말 기준 총 7건의 녹색기술에 대한 유효 인증을 보유하고 있고 해당 녹색기술이 적용된 125개 모델에 대해 '녹색기술제품 확인' 인증을 보유 중입니다.

2024년말 현재 녹색기술 인증 현황은 다음과 같습니다.

인증번호	기술 명칭	인증일자	유효기간
GT-24-02123	하이브리드 대전 방식을 이용한 공기청정기용 워셔블 전기집진필터 기술	2024.10.24	2027.10.23
GT-21-01248	고효율 전력 변환 기술을 활용한 노트북 대기전력 저감 기술	2021.10.14	2027.10.13
GT-23-01728	배출가스 저감장치가 적용된 히트펌프의 고효율 운전을 위한 저부하 운전 촉매 활성화 기술	2023.07.27	2026.07.26
GT-20-00880	고효율 히트펌프와 열교환기를 적용한 의류건조기 에너지 효율 향상 기술	2020.05.21	2026.05.20
GT-20-00826	미세 다공 홀 구조가 적용된 천장형 무풍 에어컨 기술	2020.01.30	2026.01.29
GT-22-01562	노점 온도를 이용한 절전 제습 기술	2022.11.24	2025.11.23
GT-19-00664	Self Wake-Up 기능을 갖는 모니터 대기전력 저감 기술	2019.05.16	2025.05.15

※ 별도 기준입니다.

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는「기후위기 대응을 위한 탄소중립・녹색성장 기본법」제27조 (관리업체의 온실가스 목표관리)에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제27조3항 및「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제24조 (배출량의 보고 및 검증)에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을
2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO_2-eq, TJ)

구 분	2024년	2023년	2022년
온실가스(tCO_2-eq)	13,962,940	13,292,087	14,925,633
에너지(TJ)	264,060	240,882	222,875

※ 별도 기준입니다.

※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.

※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.

※ 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조 (할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당대상업체에 해당합니다.

라. 건강친화기업 인증

당사는 임직원 건강증진을 위해 사내부속의원, 물리치료실, 근골격계예방센터, 마음건강클리닉 등 다양한 의료시설을 운영하고 있고, 건강증진 프로그램을 통해 직원 스스로가 건강관리를 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이를 인정받아 DS 부문은 「국민건강증진법」 제6조의2 제1항에 따라 2022년 12월 7일 보건복지부 장관으로부터 건강친화기업 인증을 취득하였고(유효기간 : 2022년 12월 7일 ~ 2025년 12월 6일), DX부문은 2024년 12월 1일 건강친화기업 인증을 취득하였습니다. (유효기간 : 2024년 12월 1일 ~ 2027년 11월 30일)

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

당사의 연결대상 종속기업은 2024년말 현재 228개사입니다. 전년말 대비 6개 기업이 증가하고 10개 기업이 감소하였습니다.

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	1978. 07	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA	전자제품 판매	50,777,503	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	O
Samsung International, Inc. (SII)	1983. 10	9335 Airway Rd. #105, San Diego, California, USA	전자제품 생산	2,300,160	상동	O
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	1988. 03	Parque Ind., El Florido 1ra y 2da Secc, Tijuana, B.C., Mexico	전자제품 생산	186,818	상동	O
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	2017. 08	284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina, USA	가전제품 생산	456,802	상동	O
Samsung Research America, Inc (SRA)	1988. 10	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	R&D	1,323,357	상동	O
SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	2016. 08	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	해외자회사 관리	441,037	상동	O
SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	2016. 08	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	신기술사업자, 벤처기업 투자	516,941	상동	O
NeuroLogica Corp.	2004. 02	14 Electronics Ave., Danvers, Massachusetts, USA	의료기기 생산 및 판매	299,073	상동	O
Samsung HVAC America, LLC	2001. 07	3001 Northern Cross Blvd. #361, Fort Worth, Texas, USA	에어컨공조 판매	160,981	상동	O
Joyent, Inc.	2005. 03	655 Montgomery St. #1600, San Francisco, California, USA	클라우드서비스	240,091	상동	O
SmartThings, Inc.	2012. 04	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	스마트홈 플랫폼	253,933	상동	O
TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	2002. 05	43130 Amberwood Plaza #210, Chantilly, Virginia, USA	네트워크장비 설치 및 최적화	31,814	상동	X
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	1983. 07	3655 N. 1st St., San Jose, California, USA	반도체・디스플레이 패널 판매	21,719,875	상동	O
Samsung Federal, Inc. (SFI)	2023. 05	3655 N. First St., San Jose CA 95134	R&D	711	상동	X
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	1996. 02	12100 Samsung Blvd., Austin, Texas, USA	반도체 생산	27,546,958	상동	O
Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	2016. 06	3655 N. 1st St., San Jose, California, USA	해외자회사 관리	715,483	상동	O
SEMES America, Inc.	1998. 10	13400 Immanuel Rd., Pflugerville, Texas, USA	반도체 장비 서비스	3,756	상동	X
Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	2023. 05	3655 N 1st St San Jose CA 95134	해외자회사 관리	369,646	상동	O

eMagin Corporation	2023. 05	700 South Drive Suite # 201 Hopewell Junction, NY 12533700 South Drive Suite # 201 Hopewell Junction, NY 12533	디스플레이 패널 개발 및 생산	427,847	상동	O
Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	1980. 07	2050 Derry Rd. West, Mississauga, Ontario, Canada	전자제품 판매	1,231,281	상동	O
AdGear Technologies Inc.	2010. 08	481 Viger West #300, Montreal, Quebec, Canada	디지털광고 플랫폼	214,087	상동	O
Sonio Corporation	2022. 07	1411 Broadway, 16th floor - New York USA - 10018	의료기기 생산 및 판매	907	상동	X
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	1995. 01	Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil	전자제품 생산 및 판매	4,679,383	상동	O
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	1995. 07	Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, Mexico	전자제품 판매	2,017,910	상동	O
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	2012. 12	Av. Benito Juarez #119, Parque Industrial Qro, Sta. Rosa Jauregui C.P, Queretaro, Mexico	가전제품 생산	1,191,399	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	1989. 04	Calle 50 Edificio PH Credicorp Bank Piso 16, Panama City, Panama	전자제품 판매	828,128	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	1995. 05	9800 NW 41st St. #200, Miami, Florida, USA	전자제품 판매	642,574	상동	O
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	1997. 03	Carrera 7 #114-43 Oficina 606, Bogota, Colombia	전자제품 판매	502,143	상동	O
Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	1996. 06	Bouchard 710 Piso #8, Buenos Aires, Argentina	마케팅 및 서비스	136,040	상동	O
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	2002. 12	Americo Vespucio Sur 100 Oficina 102, Las Condes, Chile	전자제품 판매	557,617	상동	O
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	2010. 04	Av. Rivera Navarrete 501 Piso 6, San Isidro, Lima, Peru	전자제품 판매	365,721	상동	O
Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	2010. 05	Torre Kepler Piso 1, Av. Blandin Castellana, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela	마케팅 및 서비스	2,020	상동	X
Samsung Electronics Panama, S.A. (SEPA)	2012. 07	Torre C Piso 23 Torre de Las Americas, Panama City, Panama	컨설팅	4,276	상동	X
Harman International Industries, Inc.	1980. 01	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	해외자회사 관리	19,196,633	상동	O
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	1981. 06	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA	오디오제품 생산, 판매, R&D	3,781,619	상동	O
Harman Connected Services, Inc.	2002. 02	445 Indio Way Sunnyvale, CA 94085	Connected Service Provider	2,566,274	상동	O
Harman Connected Services Engineering Corp.	2004. 09	445 Indio Way Sunnyvale, CA 94085	Connected Service Provider	-	상동	X
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	2005. 07	Av. Cupiuba 401, Distrito Industrial, Manaus, Amazonas, Brazil	오디오제품 생산, 판매	265,514	상동	O
Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	1997. 02	2290 Ave De Las Torres, Juarez, Chih, Mexico	오디오제품 생산	326,532	상동	O
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	1958. 11	BR-386 KM 435, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, Brazil	오디오제품 판매, R&D	408,017	상동	O
Harman International Industries Canada Ltd.	2005. 05	2900-550 Burrard St., Vancouver, British Columbia, Canada	오디오제품 판매	79	상동	X

Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	2014. 12	2290 Ave De Las Torres, Juarez, Chih, Mexico	오디오제품 판매	37,326	상동	X
Harman KG Holding, LLC	2009. 03	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	해외자회사 관리	-	상동	X
Harman Professional, Inc.	2006. 07	8500 Balboa Blvd., Northridge, California, USA	오디오제품 판매, R&D	965,038	상동	O
Roon Labs, LLC.	2023.11	400 Atlantic Street, 4th Floor Stamford, CT 06901	오디오제품판매	74,651	상동	X
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	2014. 12	89 Nexus Way, Cayman Bay, Grand Cayman, Cayman Islands	벤처기업 투자	26,696	상동	X
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	2017. 09	23 Lime Tree Bay Av., Grand Cayman, Cayman Islands	벤처기업 투자	9,176	상동	X
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	1995. 07	1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	전자제품 판매	3,267,763	상동	O
Samsung Electronics Ltd. (SEL)	1999. 01	1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	해외자회사 관리	8,099	상동	X
Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	1997. 04	No.5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, UK	반도체・디스플레이 패널 판매	130,074	상동	O
Samsung Electronics GmbH (SEG)	1984. 12	Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany	전자제품 판매	2,118,638	상동	O
Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	1982. 02	Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany	해외자회사 관리	623,788	상동	O
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	1987. 12	Koelner Str. 12, Eschborn, Germany	반도체・디스플레이 패널 판매	1,237,224	상동	O
Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	1988. 01	1 Rue Fructidor, Saint-Ouen, France	전자제품 판매	1,311,394	상동	O
Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	1991. 04	Via Mike Bongiorno 9, Milano, Italy	전자제품 판매	1,087,941	상동	O
Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	1989. 01	Parque Empresarial Omega Edf. C Av. de Barajas 32, Alcobendas, Madrid, Spain	전자제품 판매	1,261,660	상동	O
Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	1982. 09	Lagoas, Edificio 5B, Piso 0, Porto Salvo, Portugal	전자제품 판매	320,920	상동	O
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	1989. 10	Samsung ter 1, Jaszfenyszaru, Hungary	전자제품 생산 및 판매	1,636,153	상동	O
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	1991. 05	Olof Palmestraat 10, Delft, Netherlands	물류	1,928,760	상동	O
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	1995. 07	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	전자제품 판매	1,894,968	상동	O
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	2008. 10	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	해외자회사 관리	9,093,393	상동	O
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	1992. 03	Box 1235, 16428, Kista, Sweden	전자제품 판매	699,271	상동	O
Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	2002. 06	Hviezdoslavova 807, Galanta, Slovakia	TV・모니터 생산	1,196,202	상동	O
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	1996. 04	ul.Marynarska 15, Warszawa, Poland	전자제품 판매	1,011,196	상동	O
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	2010. 02	ul. Mickiewicza 52, Wronki, Poland	가전제품 생산	918,199	상동	O
Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	2007. 09	Sos. Pipera-Tunari, nr. 1/VII, Nord City Tower, Voluntari, Romania	전자제품 판매	442,713	상동	O
Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	2002. 01	Praterstraße 31, Vienna, Austria	전자제품 판매	609,920	상동	O
Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	2013. 05	Binzallee 4, Zurich, Switzerland	전자제품 판매	305,710	상동	O
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	2010. 01	V Parku 14, Prague, Czech Republic	전자제품 판매	430,936	상동	O
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	2001. 10	Duntes iela 6, Riga, Latvia	전자제품 판매	134,248	상동	O

Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	2010. 04	280 Kifissias Ave, Halandri 15232, Athens, Greece	전자제품 판매	168,112	상동	O
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	2017. 04	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	에어컨공조 판매	287,625	상동	O
Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	2004. 02	Torshamnsgatan 48, 16440, Kista, Sweden	R&D	29,597	상동	X
Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	2012. 09	c/o Novi Science park, Niels Jernes Vej 10, Aalborg Øst, Denmark	R&D	31,120	상동	X
Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	2012. 09	St. John's Houst, St. John's Innovation Park, Cowley Rd., Cambridge, UK	R&D	210,465	상동	O
SAMSUNG Zhilabs, S.L.	2008. 11	Numancia 69-73, 5F, Barcelona, Spain	네트워크Solution 개발, 판매	16,933	상동	X
FOODIENT LTD.	2012. 03	Cornwall House, 31 Lionel St., Birmingham, UK	R&D	11,191	상동	X
Oxford Semantic Technologies Limited (OST)	2016. 12	2 Littlegate Street, Oxford, England, OX1 1QT	R&D	37,350	상동	X
Sonio SAS	2020. 04	24, rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014, Paris, France	R&D	23,128	상동	X
Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	2006. 10	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia	전자제품 판매	763,783	상동	O
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	2007. 07	1 Vladenie, Perviy Severniy proezd St., Koryakovo, Borovsk, Kaluga, Russia	TV 생산	1,004,032	상동	O
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	2008. 09	75A, Zhylianska St., Kiev, Ukraine	전자제품 판매	441,458	상동	O
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	2022. 02	57 L'va Tolstogo St. Kyiv Ukraine	R&D	13,766	상동	X
Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	2008. 09	Naurizbay batyr st., Almaty, Republic of Kazakhstan	전자제품 판매	426,940	상동	O
Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	2011. 11	12, building 1, Dvintsev St., Moscow, Russia	R&D	56,286	상동	X
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	2014. 10	1065 Bridge Plaza Biz Centre 12F, 6 Bakikhanov St., Baku, Azerbaijan	마케팅	4,172	상동	X
Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	2022. 03	International Business Center, 107 B - Amir Temur str., Tashkent Uzbekistan	마케팅	165,622	상동	O
AKG Acoustics Gmbh	1947. 03	Herrengasse 1, A-1010, Vienna, Austria	오디오제품 생산, 판매	406,261	상동	O
Apostera UA, LLC	2020. 10	3 Sumska St., Kyiv, Ukraine	Connected Service Provider	1,697	상동	X
Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	2012. 11	C/ ERCILLA 17 3ºBILBAO48, Bizkaia, Spain	오디오제품 판매	2,444	상동	X
Harman Becker Automotive Systems GmbH	1990. 07	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	오디오제품 생산, 판매, R&D	4,318,082	상동	O
Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	2005. 12	17, Viale Luigi Majno, Milano (MI), Italy	오디오제품 판매	896	상동	X
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	1994. 08	19 Holland Fasor, Szekesfehervar, Hungary	오디오제품 생산, R&D	3,452,860	상동	O
Harman Belgium SA	1967. 04	4 Drukperstraat, Brussels, Belgium	오디오제품 판매	3,688	상동	X
Harman Connected Services AB.	1984. 10	24 Nordenskioldsgatan, Malmo, Sweden	Connected Service Provider	7,897	상동	X
Harman Finland Oy	1998. 07	Korkeakoulunkatu 7, 33720, Tampere, Finland	Connected Service Provider	313	상동	X
Harman Connected Services GmbH	2005. 12	45 Wittener Str., Bochum, Germany	Connected Service Provider	62,154	상동	X

Harman Connected Services Poland Sp.zoo	2007. 06	UL Kasprzaka 6, Lodz, Poland	Connected Service Provider	17,946	상동	X
Harman Connected Services UK Ltd.	2008. 09	Devonshire House, 60 Goswell Rd., London, UK	Connected Service Provider	58,724	상동	X
Harman Consumer Nederland B.V.	1995. 12	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands	오디오제품 판매	563,023	상동	O
Harman Deutschland GmbH	1998. 03	Parkring 3 B. Munich, Garching, Germany	오디오제품 판매	11,315	상동	X
Harman France SNC	1995. 11	12 bis, rue des Colonnes-du-Trone, Paris, France	오디오제품 판매	9,622	상동	X
Harman Holding Gmbh & Co. KG	2002. 06	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	Management Company	6,701,536	상동	O
Harman Hungary Financing Ltd.	2012. 06	Holland Fasor 19, Szekesfehervar, Hungary	Financing Company	44,368	상동	X
Harman Inc. & Co. KG	2012. 06	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	해외자회사 관리	5,267,083	상동	O
Harman International Estonia OU	2015. 05	Parnu mnt 139a, Tallinna linn, Harju maakond, Estonia	R&D	10	상동	X
Harman International Industries Limited	1980. 03	Westside, Two London Rd, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK	오디오제품 판매, R&D	80,938	상동	O
Harman International Romania SRL	2015. 02	5-7, Bdul. Dimitrie Pompeiu, Metroffice, Cladirea A parter, et. 2 si et. 4, Sec. 2, Bucharest, Romania	R&D	11,671	상동	X
Harman Management Gmbh	2002. 04	Becker Goering St. 16, Karlsbad, Germany	해외자회사 관리	-	상동	X
Harman Professional Kft	2014. 12	Holland Fasor 19, Szekesfehervar, Hungary	오디오제품 생산, R&D	75,201	상동	O
Harman Professional Denmark ApS	1987. 07	Olof Palmes Alle 18., Aarhus, Denmark	오디오제품 판매, R&D	72,136	상동	X
Red Bend Software SAS	2002. 10	Immeuble 15 place Georges Pompidou, MontignyLe Bretonneux, France	소프트웨어 디자인	9,791	상동	X
Studer Professional Audio GmbH	2003. 11	Althardstrasse 30, Regensdorf, Switzerland	오디오제품 판매, R&D	480	상동	X
Harman Connected Services OOO	1998. 11	8 Kovalikhinskaya St., Nizhny Novgorod, Russia	Connected Service Provider	27,543	상동	X
Harman RUS CIS LLC	2011. 08	RS 12/1 Dvintsev street, Moscow, Russia	오디오제품 판매	36,823	상동	X
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	1995. 05	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE	전자제품 판매	1,226,902	상동	O
Samsung Electronics Turkiye (SETK)	1984. 12	Flatofis Is Merkezi Otakcilar Caddesi No.78 Kat 3 No. B3 Eyup, Istanbul, Turkiye	전자제품 판매	1,696,116	상동	O
Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	2021. 02	Flatofis Is Merkezi Otakcilar Caddesi No.78 Kat 3 No. B3 Eyup, Istanbul, Turkiye	전자제품 생산	169,865	상동	O
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	2009. 07	Building Nr.5, King Hussein Business Park, King Abdullah II St., Amman, Jordan	전자제품 판매	534,861	상동	O
Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	2009. 11	Lot N°9 Mandarouna 300 Route Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco	전자제품 판매	303,826	상동	O
Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	2012. 07	62815 Piece No. 98, Engineering Sector, Kom Abu Radi, Al Wasta, BeniSuef, Egypt	전자제품 생산 및 판매	1,110,704	상동	O
Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	2012. 09	Holland Building 1F, Europark, Yakum, Israel	마케팅	20,651	상동	X
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	2012. 09	2eme etage Immeuble Adonis, rue du Lac D'annecy, Tunis, Tunisia	마케팅	6,004	상동	X
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	2012. 11	No.4 1F Park Lane Tower 172 Turfail Rd., Cantt, Lahore, Pakistan	마케팅	5,216	상동	X

Samsung Electronics Middle east and North Africa One Person (SEMENA)	2024. 05	7421-King fahd road Al Olaya Dist. Riyadh KSA 12212	해외자회사 관리	1,783	상동	X
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	2019. 11	Hamad Tower, Olaya District, Riyadh, Saudi Arabia	전자제품 판매	546,555	상동	O
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	2007. 10	10 Oholiav St., Ramat Gan, Israel	R&D	202,194	상동	O
Corephotonics Ltd.	2012. 01	25 Habarzel St., Tel Aviv, Israel	R&D	129,525	상동	O
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	1994. 06	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa	전자제품 판매	565,625	상동	O
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	2014. 07	35 Umkhomazi Drive, La Mercy, Kwa-Zulu Natal, South Africa	TV · 모니터 생산	91,418	상동	O
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	2010. 03	Mulliner Tower, Alfred Rewane Rd., Ikoyi, Lagos, Nigeria	마케팅	28,038	상동	X
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	2011. 12	Milford Suites 4F, Nairobi, Kenya	마케팅	21,412	상동	X
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	2002. 01	International Financial Services Ltd, IFS Court, TwentyEight CyberCity, Ebene, Mauritius	해외자회사 관리	57,325	상동	X
Harman Connected Services Morocco	2012. 04	Technopark, Route Nouaceur, Rs 114 & CT1029, Casablanca, Morocco	Connected Service Provider	74	상동	X
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	2009. 10	IFS Court Twenty Eight Cybercity, Ebene, Mauritius	해외자회사 관리	108,488	상동	O
Red Bend Ltd.	1998. 02	4 HaCharash St., Neve Ne'eman Industrial Park, Hod Ha'Sharon, Israel	오디오제품 생산	133,107	상동	O
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	2006. 07	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore	해외자회사 관리	31,226,978	상동	O
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	2020. 10	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore	전자제품 판매	808,908	상동	O
Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	2003. 05	#E-09-01, Level 9, East Wing, No.1 Jalan 1/68F, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia	전자제품 판매	712,846	상동	O
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	1995. 03	Tuanku Jaafar Industrial Park, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	전자제품 생산	31,018	상동	X
Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	1989. 09	North Klang Straits, Area 21 Industrial Park, Port Klang, Selangor, Malaysia	가전제품 생산	247,849	상동	O
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	1995. 01	938 1A Highway, Linh Trung ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh, Vietnam	전자제품 판매	107,908	상동	O
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	2008. 03	Yentrung Commune, Yenphong Dist, Bacninh, Vietnam	전자제품 생산	7,819,080	상동	O
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	2013. 03	Yen Binh 1, Industrial Park, Pho Yen district, Thai Nguyen, Vietnam	통신제품 생산	13,497,264	상동	O
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	2015. 02	Lot I-11, D2 Road, Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh, Vietnam	전자제품 생산 및 판매	4,863,158	상동	O

Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	2014. 07	Yenphong I I.P, Yentrung Commune, Yenphong Dist, Bacninh, Vietnam	디스플레이 패널 생산	7,724,664	상동	O
PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	1991. 08	Cikarang Industrial Estate, JL. Jababeka Raya Blok F29-33, Cikarang, Bekasi, West Java, Indonesia	전자제품 생산 및 판매	1,260,299	상동	O
PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	2003. 03	Prudential Tower 23F Jl. Jend. Sudirman Kav 79, Jakarta, Indonesia	전자제품 판매 및 서비스	90,159	상동	O
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	1988. 10	313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd, Sriracha Industry Park, T.Bung A.Sriracha Chonburi, Thailand	전자제품 생산 및 판매	2,637,138	상동	O
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	2016. 09	3F Kolao Tower 2, 23 Singha Rd., Vientiane, Laos	마케팅	1,517	상동	X
Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	1996. 03	8F HanjinPhil Building 1128 University Parkway, North Bonifacio, Global City, Taguig, Philippines	전자제품 판매	356,406	상동	O
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	1987. 11	Quad Samsung, 8 Parkview Drive, Homebush Bay 2127, Sydney, Australia	전자제품 판매	619,217	상동	O
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	2013. 09	24 The Warehouse Way, Northcote, Auckland, New Zealand	전자제품 판매	218,565	상동	O
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1995. 08	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India	전자제품 생산 및 판매	9,561,708	상동	O
Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	2012. 01	6th Floor, Salarpuria Sattva Magnificia, Old Madras Road, Bengaluru, Karnataka, India	마케팅	1,386	상동	X
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	2019. 07	B-1, Sector 81, Phase-II, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India	디스플레이 패널 생산	735,189	상동	O
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	2005. 05	Bagmane Tech. Park, Bangalore, Karnataka, India	R&D	669,124	상동	O
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	2010. 08	Gualshan-1, Gulshan Ave., Dhaka, Bangladesh	R&D	20,023	상동	X
Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	2017. 11	Ward No 1, Durbar Marg, Kathmandu Municipality, Kathmandu, Nepal	서비스	882	상동	X
Samsung Japan Corporation (SJC)	1975. 12	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan	반도체・디스플레이 패널 판매	1,695,083	상동	O
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	1992. 08	2-7, Sugasawa-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan	R&D	118,750	상동	O
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	2008. 09	Iidabashi Grand Bloom, 2-10-2, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	전자제품 판매	788,243	상동	O
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	2002. 04	Survey No. 85 & 86, Sadarmangala Village, Krishnarajapuram Hobli, Bangalore, India	Connected Service Provider	408,701	상동	O
Harman International (India) Private Limited	2009. 01	Plot No. 9, Phase I , Doddenakkundi Industrial Area, K.R. Puram Hobli, Bangalore, India	오디오제품 판매, R&D	478,874	상동	O
Harman International Industries PTY Ltd.	2014. 12	Warehouse 25 26-18, Roberna St., Moorabbin, Victoria, Australia	해외자회사 관리	5,024	상동	X

Harman International (Thailand) Co., Ltd.	2024. 06	No. 4/222 Harbor Office Building, Floor 12, Zone 12B01, 12C01, Sukhumvit Road, Tungsukla Sub-district, Sriracha District, Chonburi Province, Thailand	Connected Service Provider	42,827	상동	X
Harman International Japan Co., Ltd.	1991. 06	14F Sumitomo Fudosan Akihabara-ekimae, Kanda, Chiyoda, Tokyo, Japan	오디오제품 판매, R&D	106,926	상동	O
Harman Singapore Pte. Ltd.	2007. 08	108, Pasir Panjang Rd., #02-08 Golden Agri Plaza, Singapore	오디오제품 판매	15,424	상동	X
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	1996. 03	Fortune Financial Center, No5. Dongsanhuan Zhong Rd., Chaoyang, Beijing, China	전자제품 판매	16,111,528	상동	O
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	1988. 09	33F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong	전자제품 판매	1,002,962	상동	O
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	1994. 11	10F, No.399, Rui Guang Rd., Nei Hu, Taipei, Taiwan	전자제품 판매	2,411,145	상동	O
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	1995. 04	No.501, SuHong East Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	가전제품 생산	832,004	상동	O
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	1995. 04	No.501, SuHong East Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	가전제품 생산	382,362	상동	O
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	2002. 09	No.198, Fangzhou Rd., Suzhou Industrial park, Suzhou, China	전자제품 생산, R&D	114,676	상동	O
Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	2001. 03	No.9 WeiWu Rd. Micro Electronic Industrial Park, Xiqing, Tianjin, China	통신제품 생산	724,202	상동	O
Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	2000. 09	12/F Zhongdian fazhan Building, No. 9, xiaguangli, Chaoyang, Beijing, China	R&D	80,864	상동	O
Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	2004. 05	8/F, Huijie Plaza, 268 Zhongshan Rd., Nanjing, China	R&D	37,657	상동	X
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	2010. 01	A3 Building, No.185 Kexue Ave., Science City, Luogang, Guangzhou, China	R&D	44,664	상동	X
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	2013. 03	22F, Building 2C, Shenzhen Software Industry Base, Nanshan District, Shenzhen, China	R&D	31,011	상동	X
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	2001. 10	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China	반도체・디스플레이 패널 판매	6,467,878	상동	O
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	2012. 09	No.1999, Xiaohe Rd., Changan, Xian, China	반도체 생산	18,796,411	상동	O
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	2016. 04	8F Customs Clearance Center, No.5 Tonghai First Rd., Changan, Xian, China	반도체・디스플레이 패널 판매	501,775	상동	O
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	1994. 12	No.15, JinJiHu Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	반도체 임가공	987,955	상동	O
Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	2009. 05	No 1. Weisan Rd., Micro Electronic Industrial Park., Xiqing, Tianjin, China	LED 생산	285,028	상동	O
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	2003. 04	No.15, Jinjihu Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	R&D	87,983	상동	O
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	2001. 11	High Technology Industrial Zone, Houjie, Dongguan, China	디스플레이 패널 생산	812,397	상동	O

Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	2004. 06	No.25, Mip Fourth Rd., Xiqing, Tianjin, China	디스플레이 패널 생산	619,748	상동	O
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	2013. 07	#A501, ZTE PLAZA, No.10 Tangyan South Rd., Gaoxin, Xian, China	반도체・FPD 장비 서비스	4,902	상동	X
Samsung Semiconductor Investment L.P. I	2021. 12	#409, Building 2, No. 599, Wanzhen Road, Zhenxinxincun St., Jiading District, Shanghai, China	신기술사업자, 벤처기업 투자	6,496	상동	X
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	2011. 03	No.68, First Yinquan Rd., Zhengxing, Dandong, China	오디오제품 생산	295,401	상동	O
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	2013. 03	20F, Modern Logistics No.88 Modern Ave., Suzhou, China	오디오제품 판매	6,883	상동	X
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	2006. 09	No.125, Fangzhou Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	오디오제품 생산, R&D	586,792	상동	O
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	2010. 10	Suite 2903B, Level 29, 288, West Nanjing Rd., Huangpu, Shanghai, China	오디오제품 판매	228	상동	X
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	2007. 08	14F, 15F, No 383 Jiaozi Ave., High-tech, Chengdu, China	Connected Service Provider	14,098	상동	X
Harman Holding Limited	2007. 05	Flat/RM A 12F, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong	오디오제품 판매	722,932	상동	O
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	2009. 06	30F, No. 288, Nanjing Road West, Shanghai, China	오디오제품 판매, R&D	763,719	상동	O
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	2004. 09	14F, China Merchants Bureau Port Building, Merchants St., Nanshan, Shenzhen, China	오디오제품 판매, R&D	46,772	상동	X
삼성디스플레이㈜	2012. 04	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)	디스플레이 패널 생산 및 판매	67,541,382	상동	O
에스유머티리얼스㈜	2011. 08	충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-2	디스플레이 패널 부품 생산	37,775	상동	X
스테코㈜	1995. 06	충청남도 천안시 서북구 3공단1로 20(백석동)	반도체 부품 생산	142,277	상동	O
세메스㈜	1993. 01	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 77	반도체・FPD 장비 생산, 판매	2,365,712	상동	O
삼성전자서비스㈜	1998. 10	경기도 수원시 영통구 삼성로 290(원천동)	전자제품 수리 서비스	743,875	상동	O
삼성전자서비스씨에스㈜	2018. 10	경기도 수원시 영통구 중부대로 324(매탄동)	고객상담서비스	24,241	상동	X
삼성전자판매㈜	1996. 07	경기도 성남시 분당구 백현로101번길 30	전자제품 판매	1,221,556	상동	O
삼성전자로지텍㈜	1998. 04	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)	종합물류대행	491,486	상동	O
삼성메디슨㈜	1985. 07	강원도 홍천군 남면 한서로 3366	의료기기 생산 및 판매	761,774	상동	O
주식회사 희망별숲	2022. 12	경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14, 프리미엄원희캐슬 2층	식품 제조 가공	9,008	상동	X
㈜미래로시스템	1994. 01	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동)	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	47,877	상동	X
㈜하만인터내셔널코리아	2005. 01	서울특별시 강남구 테헤란로 223(역삼동), 큰길타워 17층	소프트웨어 개발 및 공급	21,929	상동	X
SVIC 21호 신기술투자조합	2011. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	90,275	상동	O
SVIC 22호 신기술투자조합	2011. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	14,647	상동	X
SVIC 26호 신기술투자조합	2014. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	21,788	상동	X

SVIC 28호 신기술투자조합	2015. 02	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	214,080	상동	O
SVIC 32호 신기술투자조합	2016. 08	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	182,202	상동	O
SVIC 33호 신기술투자조합	2016. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	280,271	상동	O
SVIC 37호 신기술투자조합	2017. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	22,632	상동	X
SVIC 42호 신기술투자조합	2018. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	29,234	상동	X
SVIC 43호 신기술투자조합	2018. 12	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	15,873	상동	X
SVIC 45호 신기술투자조합	2019. 05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	134,945	상동	O
SVIC 52호 신기술투자조합	2021. 05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	61,790	상동	X
SVIC 55호 신기술투자조합	2021. 09	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	142,101	상동	O
SVIC 56호 신기술투자조합	2021. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	48,895	상동	X
SVIC 57호 신기술투자조합	2022. 08	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	67,907	상동	X
SVIC 62호 신기술투자조합	2023. 03	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	11,720	상동	X
SVIC 67호 신기술투자조합	2024. 10	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	39,822	상동	X
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	2017. 03	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	34,169	상동	X
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	2020. 04	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	59,999	상동	X
반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	2023. 07	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	22,754	상동	X

※ 주요 사업에 대한 상세 내역은 'II.사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

※ 주요 종속기업 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상입니다.

(종속기업의 변동)

(단위 : 개사)

구 분	미주	유럽 · CIS	중동 · 아프리카	아시아 (중국 제외)	중국	국내	합계	변동내역	
								증 가	감 소
제53기 (2021년말)	46	71	20	30	30	31	228	-	-
제54기 증감	△1	1	-	2	-	2	4	[유럽・CIS: 4개사] ・Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR) ・Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC (SEUZ) ・Apostera GmbH ・Apostera UA, LLC [아시아(중국 제외): 2개사] ・DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED ・Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd. [국내: 2개사] ・SVIC 57호 신기술투자조합 ・㈜희망별숲	[미주: 1개사] ・Dacor Canada Co. [유럽・CIS: 3개사] ・AMX UK Limited ・Harman International s.r.o ・Apostera GmbH
제54기 (2022년말)	45	72	20	32	30	33	232	-	-
제55기 증감	2	△4	-	-	-	2	-	[미주: 4개사] ・Samsung Federal, Inc. (SFI) ・Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH) ・eMagin Corporation ・Roon Labs, LLC. [국내: 2개사] ・SVIC 62호 신기술투자조합 ・반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	[미주: 2개사] ・Dacor Holdings, Inc. ・Dacor, Inc. [유럽・CIS: 4개사] ・Red Bend Software Ltd. ・Harman Finance International GP S.a.r.l ・Harman Finance International, SCA ・Harman Automotive UK Limited
제55기 (2023년말)	47	68	20	32	30	35	232	-	-

제56기 증감	-	-	1	-	△1	△4	△4	[미주:1개사] ・Sonio Corporation [유럽・CIS: 2개사] ・Oxford Semantic Technologies Limited ・Sonio SAS [아시아(중국 제외): 2개사] ・Harman International (Thailand) Co., Ltd. [중동・아프리카 1개사] ・Samsung Electronics Middle east and North Africa (SEMENA) [국내: 1개사] ・SVIC 67호 신기술투자조합	[미주:1개사] ・Harman Financial Group LLC [유럽・CIS: 2개사] ・Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK) ・Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO) [아시아(중국 제외): 1개사] ・DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED [중국: 1개사] ・Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC) [국내: 5개사] ・㈜도우인시스 ・지에프㈜ ・SVIC 29호 신기술투자조합 ・SVIC 40호 신기술투자조합 ・SVIC 48호 신기술투자조합
제56기 (2024년말)	47	68	21	32	29	31	228		

[△는 부(-)의 값임]

2. 계열회사 현황(상세)

가. 국내 계열회사 현황

2024년말 현재 삼성그룹에는 전년말과 동일한 63개의 국내 계열회사가 있습니다.
이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 17개사이며 비상장사는 46개사입니다.

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	17	삼성물산(주)	1101110015762
		삼성바이오로직스(주)	1201110566317
		삼성생명보험(주)	1101110005953
		삼성에스디아이(주)	1101110394174
		삼성에스디에스(주)	1101110398556
		삼성에프엔위탁관리 부동산투자회사(주)	1101118376893
		삼성이앤에이(주)	1101110240509
		삼성전기(주)	1301110001626
		삼성전자(주)	1301110006246
		삼성중공업(주)	1101110168595
		삼성증권(주)	1101110335649
		삼성카드(주)	1101110346901
		삼성화재해상보험(주)	1101110005078
		(주)멀티캠퍼스	1101111960792
		(주)에스원	1101110221939
		(주)제일기획	1101110139017
		(주)호텔신라	1101110145519
비상장	46	삼성디스플레이(주)	1345110187812
		삼성메디슨(주)	1346110001036
		삼성바이오에피스(주)	1201110601501
		삼성벤처투자(주)	1101111785538
		삼성생명서비스손해사정(주)	1101111855414
		삼성선물(주)	1101110894520
		삼성액티브자산운용(주)	1101116277382
		삼성에스알에이자산운용(주)	1101115004322
		삼성웰스토리(주)	1101115282077
		삼성자산운용(주)	1701110139833

		삼성전자로지텍(주)	1301110046797
		삼성전자서비스(주)	1301110049139
		삼성전자서비스씨에스(주)	1358110352541
		삼성전자판매(주)	1801110210300
		삼성카드고객서비스(주)	1101115291656
		삼성코닝어드밴스드글라스(유)	1648140003466
		삼성헤지자산운용(주)	1101116277390
		삼성화재서비스손해사정(주)	1101111237703
		삼성화재애니카손해사정(주)	1101111595680
		세메스(주)	1615110011795
		수원삼성축구단(주)	1358110160126
		스테코(주)	1647110003490
		신라에이치엠(주)	1101115433927
		에스디플렉스(주)	1760110039005
		에스비티엠(주)	1101116536556
		에스원씨알엠(주)	1358110190199
		에스유머티리얼스(주)	1648110061337
		에스코어(주)	1101113681031
		에스티엠(주)	2301110176840
		에이치디씨신라면세점(주)	1101115722916
		오픈핸즈(주)	1311110266146
		제일패션리테일(주)	1101114736934
		(주)미라콤아이앤씨	1101111617533
		(주)미래로시스템	1101111005366
		(주)삼성글로벌리서치	1101110766670
		(주)삼성라이온즈	1701110015786
		(주)삼성생명금융서비스	1101115714533
		(주)삼성화재금융서비스보험대리점	1101116002424
		(주)삼우종합건축사사무소	1101115494151
		(주)서울레이크사이드	1101110504070
		(주)시큐아이	1101111912503
		(주)씨브이네트	1101111931686
		(주)에스에이치피코퍼레이션	1101118151310
		(주)하만인터내셔널코리아	1101113145673
		(주)휴먼티에스에스	1101114272706
		(주)희망별숲	1345110611259

나. 해외 계열회사 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 사)

상장여부	번호	회사명	소재국
비상장	1	SAMOO AUSTIN INC	USA
	2	SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited	Hungary
	3	SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	India
	4	SAMOO (KL) SDN. BHD.	Malaysia
	5	SAMOO Design Consulting Co.,Ltd	China
	6	Samsung Solar Construction Inc.	USA
	7	QSSC, S.A. de C.V.	Mexico
	8	Samsung Solar Energy LLC	USA
	9	Equipment Trading Solutions Group, LLC	USA
	10	SAMSUNG C&T CHARGING SOLUTIONS LLC	USA
	11	SP Armow Wind Ontario LP	Canada
	12	SRE GRW EPC GP Inc.	Canada
	13	SRE GRW EPC LP	Canada
	14	SRE SKW EPC GP Inc.	Canada
	15	SRE SKW EPC LP	Canada
	16	SRE WIND PA GP INC.	Canada
	17	SRE WIND PA LP	Canada
	18	SRE GRS Holdings GP Inc.	Canada
	19	SRE GRS Holdings LP	Canada
	20	SRE K2 EPC GP Inc.	Canada
	21	SRE K2 EPC LP	Canada
	22	SRE KS HOLDINGS GP INC.	Canada
	23	SRE KS HOLDINGS LP	Canada
	24	SP Belle River Wind LP	Canada
	25	SRE Armow EPC GP Inc.	Canada
	26	SRE Armow EPC LP	Canada
	27	North Kent Wind 1 LP	Canada
	28	SRE Wind GP Holding Inc.	Canada
	29	South Kent Wind LP Inc.	Canada
	30	Grand Renewable Wind LP Inc.	Canada
	31	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	Canada
	32	SRE Solar Development GP Inc.	Canada
	33	SRE Solar Development LP	Canada
	34	SRE Windsor Holdings GP Inc.	Canada
	35	SRE Southgate Holdings GP Inc.	Canada
	36	SRE Solar Construction Management GP Inc.	Canada
	37	SRE Solar Construction Management LP	Canada
	38	SRE BRW EPC GP INC.	Canada
	39	SRE BRW EPC LP	Canada
	40	SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	Canada

	41	SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	Canada
	42	SRE Belle River GP Holdings Inc	Canada
	43	SRE NK1 EPC GP Inc	Canada
	44	SRE NK1 EPC LP	Canada
	45	SRE Summerside Construction GP Inc.	Canada
	46	SRE Summerside Construction LP	Canada
	47	PLL Holdings LLC	USA
	48	Grand Renewable Solar GP Inc.	Canada
	49	KINGSTON SOLAR GP INC.	Canada
	50	SP Armow Wind Ontario GP Inc	Canada
	51	South Kent Wind GP Inc.	Canada
	52	Grand Renewable Wind GP Inc.	Canada
	53	North Kent Wind 1 GP Inc	Canada
	54	SP Belle River Wind GP Inc	Canada
	55	Samsung Solar Energy 1 LLC	USA
	56	Samsung C&T Renewables, LLC	USA
	57	Samsung Solar Energy 3, LLC	USA
	58	5S ENERGY HOLDINGS, LLC	USA
	59	SungEel Recycling Park Thuringen GmbH	Germany
	60	POSS-SLPC, S.R.O	Slovakia
	61	Solluce Romania 1 B.V.	Romania
	62	Samsung C&T Renewable Energy Europe GmbH	Germany
	63	S.C. Otelinox S.A	Romania
	64	Samsung C&T Corporation Romania S.R.L	Romania
	65	Arteus Partner I HoldCo GmbH & Co. KG	Germany
	66	Arteus Partner I GP GmbH	Germany
	67	WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	Malaysia
	68	Samsung Chemtech Vina LLC	Vietnam
	69	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	Thailand
	70	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	Malaysia
	71	S&G Biofuel PTE.LTD	Singapore
	72	PT. Gandaerah Hendana	Indonesia
	73	PT. Inecda	Indonesia
	74	VISTA CONTRACTING AND DEVELOPMENT BANGLADESH LTD.	Bangladesh
	75	Vista NEXT Limited	Bangladesh
	76	CME - VISTA JOINT STOCK COMPANY	Vietnam
	77	WELVISTA COMPANY LIMITED	Vietnam
	78	SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	Philippines
	79	SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	China
	80	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	China
	81	Samsung Japan Corporation	Japan
	82	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	Japan
	83	Samsung Electronics America, Inc.	USA
	84	Samsung Electronics Canada, Inc.	Canada

	85	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Mexico
	86	Samsung Electronics Ltd.	United Kingdom
	87	Samsung Electronics (UK) Ltd.	United Kingdom
	88	Samsung Electronics Holding GmbH	Germany
	89	Samsung Electronics Iberia, S.A.	Spain
	90	Samsung Electronics France S.A.S	France
	91	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Hungary
	92	Samsung Electronics Italia S.P.A.	Italy
	93	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	Netherlands
	94	Samsung Electronics Benelux B.V.	Netherlands
	95	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	Poland
	96	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda.	Portugal
	97	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Sweden
	98	Samsung Electronics Austria GmbH	Austria
	99	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	Slovakia
	100	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Netherlands
	101	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	Malaysia
	102	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	Malaysia
	103	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	Vietnam
	104	Samsung Asia Pte. Ltd.	Singapore
	105	Samsung India Electronics Private Ltd.	India
	106	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	India
	107	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	Australia
	108	PT Samsung Electronics Indonesia	Indonesia
	109	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	Thailand
	110	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	Malaysia
	111	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	Hong Kong
	112	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	China
	113	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	China
	114	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	China
	115	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
	116	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	China
	117	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	China
	118	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	China
	119	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	China
	120	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	China
	121	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.	China
	122	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Utd.Arab Emir.
	123	Samsung Electronics Egypt S.A.E	Egypt
	124	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	South Africa
	125	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Panama
	126	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	Brazil
	127	Samsung Electronics Argentina S.A.	Argentina
	128	Samsung Electronics Chile Limitada	Chile

	129	Samsung Electronics Rus Company LLC	Russian Fed.
	130	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	Russian Fed.
	131	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	China
	132	Samsung Biologics America, Inc.	USA
	133	Samsung Bioepis United States Inc.	USA
	134	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	United Kingdom
	135	Samsung Bioepis NL B.V.	Netherlands
	136	Samsung Bioepis CH GmbH	Switzerland
	137	Samsung Bioepis PL Sp z o.o.	Poland
	138	SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	Australia
	139	SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED	New Zealand
	140	Samsung Biopeis TW Limited	Taiwan
	141	Samsung Bioepis HK Limited	Hong Kong
	142	SAMSUNG BIOEPIS IL LTD	Israel
	143	SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	Brazil
	144	Intellectual Keystone Technology LLC	USA
	145	Samsung Display America Holdings, Inc	USA
	146	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	147	Samsung Display Noida Private Limited	India
	148	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	China
	149	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	China
	150	Novaled GmbH	Germany
	151	SEMES America, Inc.	USA
	152	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	China
	153	Sonio SAS	France
	154	NeuroLogica Corp.	USA
	155	Samsung Lennox HVAC North America, LLC	USA
	156	SmartThings, Inc.	USA
	157	Samsung Oak Holdings, Inc.	USA
	158	Joyent, Inc.	USA
	159	TeleWorld Solutions, Inc.	USA
	160	Samsung Semiconductor, Inc.	USA
	161	Samsung Research America, Inc	USA
	162	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	USA
	163	Samsung International, Inc.	USA
	164	Harman International Industries, Inc.	USA
	165	Samsung Federal, Inc.	USA
	166	Samsung Austin Semiconductor LLC.	USA
	167	AdGear Technologies Inc.	Canada
	168	SAMSUNG NEXT LLC	USA
	169	SAMSUNG NEXT FUND LLC	USA
	170	Samsung Mexicana S.A. de C.V	Mexico
	171	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	Mexico
	172	eMagin Corporation	USA

	173	Harman International Japan Co., Ltd.	Japan
	174	Harman International Industries Canada Ltd.	Canada
	175	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	USA
	176	Harman Professional, Inc.	USA
	177	Harman Connected Services, Inc.	USA
	178	Roon Labs, LLC	USA
	179	Harman Belgium SA	Belgium
	180	Harman France SNC	France
	181	Red Bend Software SAS	France
	182	Harman Inc. & Co. KG	Germany
	183	Harman KG Holding, LLC	USA
	184	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	Italy
	185	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Mauritius
	186	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	Mexico
	187	Harman International Estonia OU	Estonia
	188	Harman Singapore Pte. Ltd.	Singapore
	189	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	Thailand
	190	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Brazil
	191	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Brazil
	192	Harman Connected Services Engineering Corp.	USA
	193	Harman Connected Services AB.	Sweden
	194	Harman Connected Services UK Ltd.	United Kingdom
	195	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	India
	196	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Mauritius
	197	Samsung Semiconductor Europe Limited	United Kingdom
	198	Samsung Semiconductor Europe GmbH	Germany
	199	Samsung Electronics GmbH	Germany
	200	Sonio Corporation	USA
	201	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	Czech Republic
	202	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	Latvia
	203	Samsung Electronics West Africa Ltd.	Nigeria
	204	Samsung Electronics East Africa Ltd.	Kenya
	205	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd.	Saudi Arabia
	206	Samsung Electronics Israel Ltd.	Israel
	207	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	Tunisia
	208	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	Pakistan
	209	Samsung Electronics Middle East and North Africa	Saudi Arabia
	210	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	South Africa
	211	Samsung Electronics Turkiye	Turkiye
	212	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.	Turkiye
	213	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	Israel
	214	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	Jordan
	215	Samsung Electronics Maghreb Arab	Morocco
	216	Samsung Electronics Venezuela, C.A.	Venezuela

	217	Samsung Electronics Peru S.A.C.	Peru
	218	Samsung Electronics Ukraine Company LLC	Ukraine
	219	Samsung R&D Institute Ukraine	Ukraine
	220	Samsung R&D Institute Rus LLC	Russian Fed.
	221	Samsung Electronics Central Eurasia LLP	Kazakhstan
	222	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	Azerbaijan
	223	Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC	Uzbekistan
	224	Corephotonics Ltd.	Israel
	225	Samsung Nanoradio Design Center	Sweden
	226	Harman Professional Denmark ApS	Denmark
	227	Studer Professional Audio GmbH	Switzerland
	228	Martin Professional Japan Ltd.	Japan
	229	Harman International Romania SRL	Romania
	230	Apostera UA, LLC	Ukraine
	231	Harman Becker Automotive Systems GmbH	Germany
	232	Harman Deutschland GmbH	Germany
	233	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Hungary
	234	Harman RUS CIS LLC	Russian Fed.
	235	Harman Holding Gmbh & Co. KG	Germany
	236	Harman Management Gmbh	Germany
	237	Harman Hungary Financing Ltd.	Hungary
	238	Harman Connected Services OOO	Russian Fed.
	239	Harman Professional Kft	Hungary
	240	Harman Consumer Nederland B.V.	Netherlands
	241	Red Bend Ltd.	Israel
	242	Harman International Industries Limited	United Kingdom
	243	AKG Acoustics Gmbh	Austria
	244	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	Spain
	245	Harman Holding Limited	Hong Kong
	246	Harman Finland Oy	Finland
	247	Harman Connected Services GmbH	Germany
	248	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Poland
	249	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	China
	250	Harman International Industries PTY Ltd.	Australia
	251	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	Mexico
	252	Harman Connected Services Morocco	Morocco
	253	Samsung Electronics Switzerland GmbH	Switzerland
	254	Samsung Electronics Romania LLC	Romania
	255	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	Spain
	256	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	Italy
	257	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	Poland
	258	Samsung Electronics Greece S.M.S.A	Greece
	259	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	Netherlands
	260	FOODIENT LTD.	United Kingdom

	261	OXFORD SEMANTIC TECHNOLOGIES LIMITED	United Kingdom
	262	Samsung Denmark Research Center ApS	Denmark
	263	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	United Kingdom
	264	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	Japan
	265	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	Singapore
	266	Samsung Electronics New Zealand Limited	New Zealand
	267	Samsung Electronics Philippines Corporation	Philippines
	268	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited	Bangladesh
	269	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	270	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	Vietnam
	271	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.	Vietnam
	272	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	Nepal
	273	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	India
	274	PT Samsung Telecommunications Indonesia	Indonesia
	275	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	Laos
	276	iMarket Asia Co., Ltd.	Hong Kong
	277	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	China
	278	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	China
	279	Samsung R&D Institute China-Shenzhen	China
	280	Beijing Samsung Telecom R&D Center	China
	281	Samsung Electronics China R&D Center	China
	282	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	China
	283	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	China
	284	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	China
	285	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	China
	286	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	China
	287	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	China
	288	Harman International (India) Private Limited	India
	289	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	USA
	290	Samsung Electronica Colombia S.A.	Colombia
	291	Samsung Electronics Panama. S.A.	Panama
	292	Samsung SDI Japan Co., Ltd.	Japan
	293	Samsung SDI America Inc.	USA
	294	Samsung SDI Hungary Zrt.	Hungary
	295	Samsung SDI Europe GmbH	Germany
	296	Samsung SDI Battery Systems GmbH	Austria
	297	Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	298	Samsung SDI Energy Malaysia Sdn. Bhd.	Malaysia
	299	Samsung SDI India Private Limited	India
	300	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Hong Kong
	301	Samsung SDI China Co., Ltd.	China
	302	Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	China
	303	Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	China
	304	StarPlus Energy LLC.	USA

	305	Samsung SDI Southeast Asia PTE. LTD.	Singapore
	306	Samsung SDI Wuxi Co., Ltd.	China
	307	Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	China
	308	Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd.	Japan
	309	Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	USA
	310	Samsung Electro-Mechanics Mexico, S.A. de C.V.	Mexico
	311	Samsung Electro-Mechanics GmbH	Germany
	312	Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	Philippines
	313	Calamba Premier Realty Corporation	Philippines
	314	Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	Singapore
	315	Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	316	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	India
	317	Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	China
	318	Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	China
	319	Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	China
	320	Batino Realty Corporation	Philippines
	321	Samsung Fire & Marine Management Corporation	USA
	322	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD.	United Kingdom
	323	PT. Asuransi Samsung Tugu	Indonesia
	324	SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED	Vietnam
	325	Samsung Reinsurance Pte. Ltd.	Singapore
	326	삼성재산보험 (중국) 유한공사	China
	327	Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited	Utd.Arab Emir.
	328	Camellia Consulting Corporation	USA
	329	Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	India
	330	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	Malaysia
	331	삼성중공업(영성)유한공사	China
	332	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	Nigeria
	333	Samsung Heavy Industries Mozambique LDA	Mozambique
	334	Samsung Heavy Industries Rus LLC	Russian Fed.
	335	SHI - MCI FZE	Nigeria
	336	Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd	Thailand
	337	Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	China
	338	Samsung Asset Management (New York), Inc.	USA
	339	Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd.	Cayman Islands
	340	Samsung Asset Management U.S. Holdings, Inc.	USA
	341	Samsung Private Equity Fund 2022 GP, Ltd.	Cayman Islands
	342	Samsung Co-Investment 2021 GP, Ltd.	Cayman Islands
	343	Samsung Asset Management(London) Ltd.	United Kingdom
	344	Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd.	Cayman Islands
	345	Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	Hong Kong
	346	Samsung C&T Japan Corporation	Japan

	347	Samsung C&T America Inc.	USA
	348	Samsung E&C America, INC.	USA
	349	Samsung Renewable Energy Inc.	Canada
	350	Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	USA
	351	Samsung C&T Lima S.A.C.	Peru
	352	Samsung C&T Deutschland GmbH	Germany
	353	Samsung C&T U.K. Ltd.	United Kingdom
	354	Samsung C&T ECUK Limited	United Kingdom
	355	Whessoe engineering Limited	United Kingdom
	356	SAM investment Manzanilo.B.V	Netherlands
	357	Samsung C&T Corporation Poland LLC	Poland
	358	Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	Malaysia
	359	Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	Malaysia
	360	Erdsam Co., Ltd.	Hong Kong
	361	Samsung C&T India Private Limited	India
	362	Samsung C&T Corporation India Private Limited	India
	363	Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Singapore
	364	SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	Mongolia
	365	Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	Mongolia
	366	S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	Philippines
	367	VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY	Vietnam
	368	Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	Singapore
	369	CHEIL HOLDING INC.	Philippines
	370	Samsung C&T Renewable Energy Australia Pty Ltd	Australia
	371	SAMSUNG C&T PHILIPPINES, CORP.	Philippines
	372	Samsung C&T Hongkong Ltd.	Hong Kong
	373	Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
	374	SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	China
	375	Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	China
	376	SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	Saudi Arabia
	377	SAM Gulf Investment Limited	Utd.Arab Emir.
	378	Samsung C&T Chile Copper SpA	Chile
	379	SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	Chile
	380	Samsung C&T Corporation Rus LLC	Russian Fed.
	381	CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	Italy
	382	Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	China
	383	SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD	Vietnam
	384	Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	Malaysia
	385	Welstory Hungary Kft.	Hungary
	386	WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	Vietnam
	387	Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	China
	388	Shanghai Welstory Food Company Limited	China
	389	LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC.	USA
	390	PENGTAI CHINA CO.,LTD.	China

	391	PengTai Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
	392	PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD	China
	393	Beijing Pengtai Borui E-commerce Co.,Ltd.	China
	394	Medialytics Inc.	China
	395	Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.	China
	396	iMarket China Co., Ltd.	China
	397	Samsung Securities (America), Inc.	USA
	398	Samsung Securities (Europe) Limited.	United Kingdom
	399	Samsung Securities (Asia) Limited.	Hong Kong
	400	Samsung SDS America, Inc.	USA
	401	SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd.	Canada
	402	Samsung SDS Europe, Ltd.	United Kingdom
	403	Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft.	Hungary
	404	Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O.	Slovakia
	405	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	Poland
	406	Samsung GSCL Sweden AB	Sweden
	407	Samsung SDS Global SCL France SAS	France
	408	Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	Italy
	409	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U	Spain
	410	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Netherlands
	411	Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	Germany
	412	Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	Romania
	413	Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd.	Singapore
	414	Samsung Data Systems India Private Limited	India
	415	Samsung SDS Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	416	PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	Indonesia
	417	Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc.	Philippines
	418	Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	Thailand
	419	SAMSUNG SDS MALAYSIA SDN. BHD.	Malaysia
	420	Samsung SDS Global SCL Australia Pty.,Ltd.	Australia
	421	SDS-ACUTECH CO., Ltd.	Thailand
	422	ALS SDS Joint Stock Company	Vietnam
	423	SDS-MP Logistics Joint Stock Company	Vietnam
	424	Samsung SDS China Co., Ltd.	China
	425	Samsung SDS Global SCL Hong Kong Limited	Hong Kong
	426	SAMSUNG SDS Global SCL Egypt	Egypt
	427	Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	South Africa
	428	Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi	Turkiye
	429	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC	Utd.Arab Emir.
	430	Samsung SDS Latin America Tecnologia E Logistica LTDA.	Brazil
	431	INTE-SDS Logistics S.A. de C.V.	Mexico
	432	Samsung SDS Rus Limited Liability Company	Russian Fed.
	433	Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	Mexico

	434	Samsung SDS Global SCL Panama S.A.	Panama
	435	Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	Chile
	436	Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C	Peru
	437	Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S	Colombia
	438	Samsung E&A America Inc.	USA
	439	Samsung Project Management Inc.	Canada
	440	Samsung E&A Hungary Co. Ltd.	Hungary
	441	Samsung Engineering Italy S.R.L.	Italy
	442	Samsung E&A Malaysia SDN. BHD.	Malaysia
	443	PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	Indonesia
	444	Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd.	Thailand
	445	Samsung E&A India Private Limited	India
	446	Samsung E&A Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	447	GLOBAL MODULE CENTER JOINT STOCK COMPANY	Vietnam
	448	Samsung E&A Global Private limited	India
	449	Samsung E&A Shanghai Co., Ltd.	China
	450	Samsung E&A Xi' an Co., Ltd.	China
	451	Samsung E&A Arabia Co., Ltd.	Saudi Arabia
	452	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	Bahrain
	453	Muharraq STP Company B.S.C.	Bahrain
	454	Muharraq Holding Company 1 Ltd.	Utd.Arab Emir.
	455	SAMSUNG ENGINEERING NEC COMPANY LIMITED	Saudi Arabia
	456	Samsung E&A Mexico S.A. de C.V.	Mexico
	457	Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	Trinidad,Tobago
	458	Samsung E&A Manzanillo S.A. De C.V. (SIMA)	Mexico
	459	Grupo Samsung E&A Mexico, S.A. De C.V. (GSIM)	Mexico
	460	Samsung E&A Energia S.A. De C.V.	Mexico
	461	Samsung E&A Bolivia S.A	Bolivia
	462	Samsung E&A DUBA S.A. De C.V.	Mexico
	463	Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P.	Kazakhstan
	464	Samsung E&A America Construction LLC	USA
	465	Samsung E&A Louisiana Construction LLC	USA
	466	Samsung EPC Company Ltd.	Saudi Arabia
	467	Muharraq Holding Company 2 Ltd.	Utd.Arab Emir.
	468	Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V.	Mexico
	469	S-1 CORPORATION HUNGARY LLC	Hungary
	470	S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	Vietnam
	471	Samsung Beijing Security Systems	China
	472	Pengtai Greater China Company Limited	Hong Kong
	473	PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	China
	474	Cheil USA Inc.	USA
	475	Cheil Central America Inc.	USA
	476	Iris Worldwide Holdings Limited	United Kingdom
	477	CHEIL EUROPE LIMITED	United Kingdom

	478	Cheil Germany GmbH	Germany
	479	Cheil France SAS	France
	480	CHEIL SPAIN S.L	Spain
	481	Cheil Benelux B.V.	Netherlands
	482	Cheil Nordic AB	Sweden
	483	Cheil India Private Limited	India
	484	Cheil (Thailand) Ltd.	Thailand
	485	Cheil Singapore Pte. Ltd.	Singapore
	486	CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED	Vietnam
	487	Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Philippines
	488	CHEIL MALAYSIA SDN. BHD.	Malaysia
	489	Cheil New Zealand Limited	New Zealand
	490	Cheil Worldwide Australia Pty Ltd	Australia
	491	CHEIL CHINA	China
	492	Cheil Hong Kong Ltd.	Hong Kong
	493	Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd	China
	494	Cheil MEA FZ-LLC	Utd.Arab Emir.
	495	Cheil South Africa (Pty) Ltd	South Africa
	496	CHEIL KENYA LIMITED	Kenya
	497	Cheil Communications Nigeria Ltd.	Nigeria
	498	Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.	Jordan
	499	Cheil Ghana Limited	Ghana
	500	Cheil Egypt LLC	Egypt
	501	Cheil Maghreb LLC	Morocco
	502	Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	Brazil
	503	Cheil Mexico, S.A. de C.V.	Mexico
	504	Cheil Chile SpA.	Chile
	505	Cheil Peru S.A.C.	Peru
	506	CHEIL ARGENTINA S.A.	Argentina
	507	Cheil Rus LLC	Russian Fed.
	508	Cheil Ukraine LLC	Ukraine
	509	Cheil Kazakhstan LLC	Kazakhstan
	510	Samsung Hospitality America Inc.	USA
	511	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	Singapore
	512	Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	China
	513	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	Hong Kong
	514	HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD	China
	515	Samsung Hospitality U.K. Ltd.	United Kingdom
	516	Samsung Hospitality Europe GmbH	Germany
	517	SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	Romania
	518	Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	519	Samsung Hospitality Philippines Inc.	Philippines
	520	Samsung Hospitality India Private Limited	India
	521	Samsung Venture Investment (Shanghai) Co., Ltd.	China

	522	Iris (USA) Inc.	USA
	523	Iris Atlanta, Inc.	USA
	524	89 Degrees, Inc.	USA
	525	The Barbarian Group LLC	USA
	526	McKinney Ventures LLC	USA
	527	Lockard & Wechsler LLC	USA
	528	Iris Nation Worldwide Limited	United Kingdom
	529	Iris Americas, Inc.	USA
	530	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	Mexico
	531	Pricing Solutions Ltd	Canada
	532	Iris London Limited	United Kingdom
	533	Iris Promotional Marketing Ltd	United Kingdom
	534	Iris Ventures 1 Limited	United Kingdom
	535	Founded Partners Limited	United Kingdom
	536	Iris Digital Limited	United Kingdom
	537	Iris Ventures (Worldwide) Limited	United Kingdom
	538	WDMP Limited	United Kingdom
	539	Iris Services Limited Dooel Skopje	Macedonia
	540	Irisnation Singapore Pte. ltd.	Singapore
	541	Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited	India
	542	Iris Worldwide (Thailand) Limited	Thailand
	543	Iris Partners LLP	United Kingdom
	544	Holdings BR185 Limited	Brit.Virgin Is.
	545	Iris Germany GmbH	Germany
	546	Founded, Inc.	USA
	547	Pepper NA, Inc.	USA
	548	Beattie McGuinness Bungay Limited	United Kingdom
	549	Cheil Italia S.r.l	Italy
	550	Cheil Austria GmbH	Austria
	551	Centrade Integrated SRL	Romania
	552	Centrade Cheil HU Kft.	Hungary
	553	Centrade Cheil Adriatic D.O.O.	Serbia/Monten.
	554	Experience Commerce Software Private Limited	India
	555	Diginfluenz Private Limited	India
	556	PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	Indonesia
	557	Cheil Philippines Inc.	Philippines
	558	Shilla Retail Plus Pte. Ltd.	Singapore
	559	Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	China
	560	Shilla Retail Limited	Macau
	561	BNY Trading Hong Kong Limited	Hong Kong
	562	LOFAN LIMITED	Hong Kong
	563	KINGMA LIMITED	Hong Kong
	564	One Agency FZ-LLC	Utd.Arab Emir.
	565	One RX Project Management Design and Production Limited	Turkiye

		Company	
	566	ONE RETAIL EXPERIENCE KOREA LIMITED	United Kingdom
	567	One RX India Private Limited	India
	568	ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	Utd.Arab Emir.
	569	ONE AGENCY PRINTING L.L.C	Utd.Arab Emir.
	570	Brazil 185 Participacoes Ltda	Brazil
	571	Iris Router Marketing Ltda	Brazil

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
					수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
								수량	금액						
삼성전기㈜	상장	1977.01.01	경영참여	250	17,693	23.7	445,244	0	0	0	17,693	23.7	445,244	12,792,403	703,216
삼성SDI㈜	상장	1977.01.01	경영참여	304	13,463	19.6	1,242,605	0	0	0	13,463	19.6	1,242,605	40,988,647	575,512
삼성중공업㈜	상장	1977.09.01	경영참여	125	134,027	15.2	1,038,711	0	0	475,797	134,027	15.2	1,514,508	17,194,637	53,877
㈜호텔신라	상장	1979.12.01	경영참여	252	2,005	5.1	131,108	0	0	-57,134	2,005	5.1	73,974	3,813,886	-61,501
㈜제일기획	상장	1988.09.01	경영참여	185	29,038	25.2	491,599	0	0	0	29,038	25.2	491,599	3,317,857	208,248
삼성에스디에스㈜	상장	1992.07.01	경영참여	6,160	17,472	22.6	560,827	0	0	0	17,472	22.6	560,827	13,238,330	789,501
삼성바이오로직스㈜	상장	2011.04.21	경영참여	30,000	22,217	31.2	1,595,892	0	0	0	22,217	31.2	1,595,892	17,330,966	1,077,210
삼성디스플레이㈜	비상장	2012.04.01	경영참여	16,009,547	221,969	84.8	18,509,307	0	0	0	221,969	84.8	18,509,307	67,541,382	5,989,037
스테코㈜	비상장	1995.06.29	경영참여	24,000	2,590	70.0	35,861	0	0	0	2,590	70.0	35,861	142,277	466
세메스㈜	비상장	1992.12.31	경영참여	1,000	2,173	91.5	71,906	0	0	0	2,173	91.5	71,906	2,365,712	144,665
삼성전자서비스㈜	비상장	1998.01.01	경영참여	30,000	6,000	99.3	48,121	0	0	0	6,000	99.3	48,121	743,875	1,321
삼성전자판매㈜	비상장	2000.12.21	경영참여	3,100	1,767	100.0	247,523	0	0	0	1,767	100.0	247,523	1,221,556	1,770
삼성전자로지텍㈜	비상장	1999.04.01	경영참여	76	1,011	100.0	46,669	0	0	0	1,011	100.0	46,669	491,486	20,605
삼성메디슨㈜	비상장	2011.02.16	경영참여	286,384	87,350	68.5	464,232	0	0	13,416	87,350	68.5	477,648	761,774	80,568
㈜삼성글로벌리서치	비상장	1991.05.01	경영참여	320	3,576	29.8	24,942	0	0	0	3,576	29.8	24,942	221,095	622
삼성벤처투자㈜	비상장	1999.11.01	경영참여	4,900	980	16.3	32,286	0	0	3,967	980	16.3	36,253	229,783	23,689
SVIC 21호 신기술투자조합	비상장	2011.11.02	경영참여	19,800	0	99.0	99	0	0	0	0	99.0	99	90,275	13,843
SVIC 22호 신기술투자조합	비상장	2011.11.02	경영참여	19,800	0	99.0	14,870	0	-2,495	0	0	99.0	12,375	14,647	-271
SVIC 26호 신기술투자조합	비상장	2014.11.07	경영참여	19,800	1	99.0	60,803	0	-3,237	0	1	99.0	57,565	21,788	-2,574
SVIC 28호 신기술투자조합	비상장	2015.02.13	경영참여	7,425	0	99.0	27,566	0	-27,467	0	0	99.0	99	214,080	-46,095
SVIC 32호 신기술투자조합	비상장	2016.08.09	경영참여	19,800	1	99.0	119,364	0	-19,256	0	1	99.0	100,109	182,202	-21,607
SVIC 33호 신기술투자조합	비상장	2016.11.11	경영참여	4,950	1	99.0	112,524	0	0	0	1	99.0	112,524	280,271	-34,802
SVIC 42호 신기술투자조합	비상장	2018.11.30	경영참여	4,950	0	99.0	44,444	0	-4,058	0	0	99.0	40,386	29,234	336
SVIC 45호 신기술투자조합	비상장	2019.05.10	경영참여	19,800	2	99.0	158,746	0	-17,573	0	1	99.0	141,174	134,945	-23,067
SVIC 52호 신기술투자조합	비상장	2021.05.17	경영참여	9,900	0	99.0	49,599	0	5,821	0	1	99.0	55,420	61,790	-21,264
SVIC 56호 신기술투자조합	비상장	2021.11.12	경영참여	22,084	1	99.0	56,516	0	-416	0	1	99.0	56,100	48,895	-6,751
SVIC 57호 신기술투자조합	비상장	2022.08.10	경영참여	14,850	0	99.0	41,491	0	35,333	0	1	99.0	76,824	67,907	-4,956
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	비상장	2017.03.03	경영참여	500	32,306,980	66.7	32,307	-16,785,792	-16,786	0	15,521,188	66.7	15,521	34,169	10,607
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	비상장	2020.04.27	경영참여	25,000	50,000,000	62.5	50,000	-12,500,000	-12,500	0	37,500,000	62.5	37,500	59,999	192
반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	비상장	2023.07.27	경영참여	500	500,000	66.7	500	-499,985	15,000	0	16	100.0	15,500	22,754	-509
㈜희망별숲	비상장	2022.12.26	경영참여	900	180	100.0	900	0	0	0	180	100.0	900	9,008	1,263
㈜레인보우로보틱스	상장	2023.01.12	경영참여	58,982	2,854	14.8	58,982	0	0	0	2,854	14.8	58,982	139,174	2,709
㈜아이마켓코리아	상장	2000.12.07	경영참여	1,900	647	1.9	5,560	0	0	-382	647	1.9	5,179	1,279,968	34,314
㈜케이티스카이라이프	상장	2001.12.01	단순투자	3,344	240	0.5	1,421	0	0	-287	240	0.5	1,134	1,040,241	-156,079
모나용평㈜	상장	2007.05.11	단순투자	1,869	400	0.8	1,220	0	0	64	400	0.8	1,284	1,013,467	8,801
에이테크솔루션㈜	상장	2009.11.26	단순투자	26,348	1,592	15.9	17,241	0	0	-8,438	1,592	15.9	8,804	285,318	-966
㈜원익홀딩스	상장	2013.12.18	경영참여	15,411	1,759	2.3	5,928	0	0	-1,443	1,759	2.3	4,486	1,894,333	-57,317
㈜원익아이피에스	상장	2016.04.01	경영참여	16,214	1,851	3.8	62,839	0	0	-21,471	1,851	3.8	41,368	1,124,147	20,748

㈜동진쎄미켐	상장	2017.11.01	경영참여	48,277	2,468	4.8	95,507	0	0	-43,929	2,468	4.8	51,579	2,016,989	143,485
솔브레인㈜	상장	2020.07.01	경영참여	24,866	437	5.6	132,951	0	0	-60,615	437	5.6	72,336	1,169,754	122,093
㈜에스앤에스텍	상장	2020.08.14	경영참여	65,933	1,716	8.0	77,740	0	0	-33,807	1,716	8.0	43,933	297,032	30,314
㈜와이씨	상장	2020.08.14	경영참여	47,336	9,602	11.7	47,864	0	0	50,168	9,602	11.7	98,033	576,945	13,114
㈜케이씨텍	상장	2020.11.16	경영참여	20,720	1,022	4.9	27,395	0	0	-767	1,022	4.9	26,629	549,141	52,686
㈜엘오티베큠	상장	2020.11.16	경영참여	18,990	1,268	7.1	25,544	0	0	-14,958	1,268	7.1	10,585	339,223	2,437
㈜뉴파워프라즈마	상장	2020.11.16	경영참여	12,739	2,141	4.9	11,240	0	0	-1,777	2,141	4.9	9,463	930,382	22,189
㈜에프에스티	상장	2021.03.16	경영참여	43,009	1,523	7.0	37,541	0	0	-13,585	1,523	7.0	23,956	504,554	-3,242
㈜디엔에프	상장	2021.08.11	경영참여	20,964	810	7.0	19,400	0	0	-12,256	810	7.0	7,144	161,916	631
Marvell	상장	2021.10.05	단순투자	11,705	173	0.0	13,468	0	0	14,651	173	0.0	28,119	29,700,615	-1,206,338
SoundHound Inc.	상장	2016.12.01	단순투자	7,059	1,703	0.9	4,655	0	0	45,011	1,703	0.9	49,666	814,311	-478,011
한국경제신문㈜	비상장	1987.05.01	단순투자	150	72	0.4	365	0	0	0	72	0.4	365	691,199	29,347
㈜한국비지니스금융대부	비상장	1995.01.01	단순투자	5,000	1,000	17.2	2,964	0	0	0	1,000	17.2	2,964	87,279	1,042
㈜싸이버뱅크	비상장	2000.12.30	단순투자	8,000	1,083	7.5	-	0	0	0	1,083	7.5	-	-	0
화인칩스㈜	비상장	2001.12.01	단순투자	10	2	3.3	10	0	0	0	2	3.3	10	18,222	1,629
㈜인켈	비상장	2006.11.01	단순투자	130	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	7,848	-4,058
인텔렉추얼디스커버리㈜	비상장	2011.05.13	단순투자	5,000	357	10.7	1,922	0	0	0	357	10.7	1,922	71,900	2,188
㈜말타니	비상장	2012.04.01	단순투자	16,544	45	15.0	7,891	0	0	191	45	15.0	8,082	93,407	1,654
㈜팬택자산관리	비상장	2013.06.19	단순투자	53,000	53,000	10.0	-	0	0	0	53,000	10.0	-	-	0
㈜인공지능연구원	비상장	2016.07.28	단순투자	3,000	600	14.3	3,000	0	0	0	600	14.3	3,000	2,765	1,417
㈜미코세라믹스	비상장	2020.11.16	경영참여	21,667	747	13.7	33,973	0	0	15,821	747	13.7	49,794	358,346	63,322
에스지신성건설㈜	비상장	2010.07.29	단순투자	1	0	0.0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
㈜우방	비상장	2010.07.01	단순투자	-	1	0.0	0	0	0	0	1	0.0	0	621,421	-50,282
㈜삼보컴퓨터	비상장	2012.09.27	단순투자	-	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	47,298	-830
대우산업개발㈜	비상장	2012.12.18	단순투자	-	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	117,590	-30,260
대우송도개발㈜	비상장	2012.12.18	단순투자	-	9	0.0	0	0	0	0	9	0.0	0	19,369	-350
자일자동차㈜	비상장	2012.12.18	단순투자	-	1	0.0	0	0	0	0	1	0.0	0	284,044	-43,064
성원건설㈜	비상장	2014.04.30	단순투자	-	1	0.0	0	-1	0	0	-	-	-	-	0
㈜인희	비상장	2014.04.30	단순투자	-	0	0.1	0	0	0	0	0	0.1	0	2,457	301
JNT(반도체펀드)	비상장	2011.02.28	단순투자	1,800	0	24.0	1,240	0	0	0	0	24.0	1,240	2,872	699
L&S(반도체펀드)	비상장	2012.07.30	단순투자	848	-	7.5	1	0	-1	0	-	-	-	-	0
베어포트리조트	비상장	2022.04.18	단순투자	-	51	0.5	0	0	0	0	51	0.5	0	115,380	-9,845
SEA	비상장	1978.07.01	경영참여	59,362	492	100.0	17,166,557	0	0	0	492	100.0	17,166,557	50,777,503	1,628,652
SECA	비상장	1992.08.13	경영참여	3,823	0	100.0	90,922	0	0	0	0	100.0	90,922	1,231,281	-17,001
SEDA	비상장	1994.01.01	경영참여	13,224	77,205,709	87.0	647,620	0	0	0	77,205,709	87.0	647,620	4,679,383	208,102
SEM	비상장	1995.07.01	경영참여	3,032	3,837	63.6	165,638	0	0	0	3,837	63.6	165,638	2,017,910	125,857
SELA	비상장	1989.04.01	경영참여	319	40	100.0	86,962	0	0	0	40	100.0	86,962	832,404	55,515
SEASA	비상장	1996.06.01	경영참여	4,696	21,854	98.0	6,779	0	0	0	21,854	98.0	6,779	136,040	8,755
SECH	비상장	2002.12.19	경영참여	597	-	4.1	597	0	0	0	-	4.1	597	557,617	20,574
SEUK	비상장	1995.07.01	경영참여	33,908	109,546	100.0	433,202	0	0	0	109,546	100.0	433,202	3,267,763	181,457
SEL	비상장	1998.12.31	경영참여	8,280	4,393	100.0	-	0	0	0	4,393	100.0	-	8,099	0
SEHG	비상장	1982.02.01	경영참여	28,042	-	100.0	354,846	0	0	0	-	100.0	354,846	623,788	124,414
SEF	비상장	1991.08.21	경영참여	230	2,700	100.0	234,115	0	0	0	2,700	100.0	234,115	1,311,394	79,382
SEI	비상장	1993.05.24	경영참여	862	677	100.0	143,181	0	0	0	677	100.0	143,181	1,087,941	60,439
SESA	비상장	1989.01.01	경영참여	3,276	8,021	100.0	142,091	0	0	0	8,021	100.0	142,091	1,261,660	59,023
SEP	비상장	1982.09.01	경영참여	204	1,751	100.0	37,616	0	0	0	1,751	100.0	37,616	320,920	12,505
SEH	비상장	1991.05.31	경영참여	1,954	753	100.0	650,157	0	0	0	753	100.0	650,157	1,636,153	134,559
SELS	비상장	1991.05.01	경영참여	18,314	1,306	100.0	24,288	0	0	0	1,306	100.0	24,288	1,928,760	-12,249
SEBN	비상장	1995.07.01	경영참여	236	539,138	100.0	914,751	0	0	0	539,138	100.0	914,751	1,894,968	12,514
SEEH	비상장	2008.01.01	경영참여	4,214	-	100.0	1,369,992	0	0	0	-	100.0	1,369,992	9,093,393	195,012
SENA	비상장	1992.03.01	경영참여	392	1,000	100.0	69,372	0	0	0	1,000	100.0	69,372	699,271	38,544
SESK	비상장	2002.06.01	경영참여	8,976	-	55.7	263,767	0	0	0	-	55.7	263,767	1,196,202	90,937
SEPOL	비상장	1996.04.01	경영참여	5,462	106	100.0	78,267	0	0	0	106	100.0	78,267	1,011,196	94,630
SEAG	비상장	2002.01.01	경영참여	40	-	100.0	32,162	0	0	0	-	100.0	32,162	609,920	31,276
SERC	비상장	2006.01.01	경영참여	24,877	-	100.0	188,290	0	0	0	-	100.0	188,290	763,783	40,174

SERK	비상장	2007.07.19	경영참여	4,600	-	100.0	204,555	0	0	0	-	100.0	204,555	1,004,032	62,772
SEO	비상장	1997.01.01	경영참여	120	0	100.0	-10,043	0	10,043	0	-	-	-	-	0
SGE	비상장	1995.05.25	경영참여	827	0	100.0	32,836	0	0	0	0	100.0	32,836	1,226,902	-6,997
SEEG	비상장	2012.07.09	경영참여	23	-	0.1	39	0	0	0	-	0.1	39	1,110,704	-167,860
SSA	비상장	1998.12.01	경영참여	263	2,000	100.0	32,622	0	0	0	2,000	100.0	32,622	565,625	33,541
SAPL	비상장	2006.07.01	경영참여	793	877,133	100.0	981,483	0	0	0	877,133	100.0	981,483	31,226,978	5,326,248
SME	비상장	2003.05.01	경영참여	4,796	17,100	100.0	7,644	0	0	0	17,100	100.0	7,644	712,846	27,489
SDMA	비상장	1995.03.01	경영참여	21,876	71,400	75.0	18,741	0	0	0	71,400	75.0	18,741	31,018	-23
SEMA	비상장	1989.09.01	경영참여	4,378	16,247	100.0	103,402	0	0	0	16,247	100.0	103,402	247,849	24,242
SAVINA	비상장	1995.01.17	경영참여	5,839	-	100.0	28,365	0	0	0	-	100.0	28,365	107,908	16,441
SEIN	비상장	1991.08.28	경영참여	7,463	46	100.0	118,909	0	0	0	46	100.0	118,909	1,260,299	151,650
TSE	비상장	1988.01.01	경영참여	1,390	11,020	91.8	279,163	0	0	0	11,020	91.8	279,163	2,637,138	166,928
SEAU	비상장	1987.11.01	경영참여	392	53,200	100.0	111,964	0	0	0	53,200	100.0	111,964	619,217	57,473
SIEL	비상장	1995.08.01	경영참여	5,414	216,787	100.0	75,263	0	0	0	216,787	100.0	75,263	9,561,708	1,408,392
SRI-Bangalore	비상장	2005.05.30	경영참여	7,358	17	100.0	31,787	0	0	0	17	100.0	31,787	669,124	80,454
SJC	비상장	1975.12.01	경영참여	273	1,560	100.0	253,108	0	0	0	1,560	100.0	253,108	1,695,083	1,598
SRJ	비상장	1992.08.25	경영참여	3,120	122	100.0	117,257	0	-115,775	0	122	100.0	1,482	118,750	2,784
SCIC	비상장	1996.03.01	경영참여	23,253	-	100.0	640,452	0	0	0	-	100.0	640,452	16,111,528	300,719
SEHK	비상장	1988.09.01	경영참여	349	274,250	100.0	79,033	0	0	0	274,250	100.0	79,033	1,002,962	29,140
SET	비상장	1994.11.01	경영참여	456	27,270	100.0	112,949	0	0	0	27,270	100.0	112,949	2,411,145	62,255
TSEC	비상장	1993.04.01	경영참여	15,064	-	48.2	103,134	0	-103,134	0	-	-	-	-	0
SSEC	비상장	1995.04.01	경영참여	32,128	-	69.1	130,551	0	0	0	-	69.1	130,551	832,004	213,826
SESC	비상장	2002.09.01	경영참여	5,471	-	73.7	34,028	0	0	0	-	73.7	34,028	114,676	10,392
TSTC	비상장	2001.03.01	경영참여	10,813	-	90.0	260,092	0	0	0	-	90.0	260,092	724,202	4,156
SSS	비상장	2001.01.01	경영참여	1,200	-	100.0	19,189	0	0	0	-	100.0	19,189	6,467,878	468,408
SCS	비상장	2012.09.19	경영참여	111,770	-	100.0	5,275,760	0	277,840	0	-	100.0	5,553,600	18,796,411	1,195,361
SSCX	비상장	2016.04.25	경영참여	1,141	-	100.0	1,141	0	0	0	-	100.0	1,141	501,775	35,349
SESS	비상장	1994.12.30	경영참여	18,875	-	100.0	504,313	0	0	0	-	100.0	504,313	987,955	89,820
TSLED	비상장	2012.04.01	경영참여	119,519	-	100.0	119,519	0	0	0	-	100.0	119,519	285,028	23,417
SSCR	비상장	2006.09.01	경영참여	3,405	-	100.0	9,332	0	0	0	-	100.0	9,332	87,983	19,468
TSST Japan	비상장	2004.03.29	경영참여	1,639	30	49.0	-	0	0	0	30	49.0	-	238,955	0
STE	비상장	1996.01.01	경영참여	4,206	2	49.0	-	0	0	0	2	49.0	-	7,816	0
Semiconductor Portal Inc.	비상장	2002.12.01	단순투자	38	0	1.2	10	0	0	0	0	1.2	10	2,069	9
Nanosys Inc.	비상장	2010.08.13	단순투자	4,774	2,000	0.6	-	-2,000	0	0	-	-	-	-	0
One-Blue, LLC	비상장	2011.07.14	경영참여	1,766	-	16.7	1,766	0	0	0	-	16.7	1,766	18,997	151
Sentiance NV	비상장	2012.12.01	단순투자	3,422	7	7.2	3,422	0	0	-3,422	7	7.2	0	2,356	-3,956
Mantis Vision Ltd.	비상장	2014.01.16	단순투자	1,594	355	2.1	0	0	0	0	355	2.1	0	16,092	14,824
Leman Micro Devices SA	비상장	2014.08.14	단순투자	1,019	17	3.4	0	0	0	0	17	3.4	0	1,762	-215
Sensifree LTD	비상장	2016.01.01	단순투자	2,111	666	9.5	0	0	0	0	666	9.5	0	176	-248
Unispectral Ltd.	비상장	2016.02.29	단순투자	1,112	2,308	7.9	803	0	0	-803	2,308	7.9	0	2,431	-3,479
Quobyte, Inc.	비상장	2016.04.28	단순투자	2,865	729	11.8	0	0	0	0	729	11.8	0	4,126	-220
Afero, Inc.	비상장	2016.05.04	단순투자	5,685	723	5.5	5,685	0	0	-5,685	723	5.5	0	27,982	-9,839
Graphcore Limited	비상장	2016.06.30	단순투자	3,494	12,000	1.4	3,069	-12,000	-2,942	-128	-	-	-	-	0
Fasetto, Inc.	비상장	2019.01.29	단순투자	6,701	475	5.1	0	0	0	0	475	5.1	0	8,738	-19,733
합 계					-	-	59,246,942	-29,799,778	18,399	338,201	133,148,682	-	59,603,542	-	-

※ 별도재무제표 기준입니다.

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

※ 당사는 기업회계기준에 따라 금융상품(지분상품)에 대해서는 공정가치로 측정하고 있으며, 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대해서는 매년 손상(감액) 징후가 있는지 검토하고 징후가

있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상 회계처리를 하고 있습니다.

※ 최근사업연도 재무 현황은 일부 법인의 자료 확보가 현실적으로 곤란하여, 대우송도개발㈜는 2017년 12월 31일, Mantis Vision은 2021년 12월 31일, eman Micro Devices,

Sensifree,Uni

spectral, 베어포트리조트, Semiconductor Portal, ㈜인켈, 모나용평㈜는 2023년 12월 31일, Quobyte는 2024년 5월 31일, Afero는 2024년 11월 30일 현재의 재무 현황을 기재하였습니다.

4. 연구개발실적(상세)

☞ 본문 위치로 이동

부문		연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	영상 디스플레이	Neo QLED 8K (~2024.03.)	□ Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV (65・75・85") - QN900 (65・75・85・98") / QN800 (65・75・85") / QN700 (55・65・75") - 세밀한 Mini LED의 향상된 명암비로 더욱 실제를 보는 듯한 QLED 8K 화질 - Neural Quantum Processor 8K 적용하여 입체감과 현실감 있는 시청 경험 제공 - OTS(Object Tracking Sound) 기능으로 공간을 감싸는 입체감 있는 음질 경험 제공
		Neo QLED 4K (~2024.03.)	□ Mini LED 기반 4개 시리즈, 7개 사이즈 (43・50・55・65・75・85・98") - Mini LED 적용을 통한 Slim 구현 및 Bezel-less/Metal를 통한 디자인 프리미엄 Look - Quantum Nano-Layer Multi-Cell 구조를 적용하여 Slim하면서도 높은 광 효율과 광 Profile 조절이 가능한 New LED - 장르별 선호 화질 선택 時, AI 활용하여 장르별 맞춤형 화질 변환 - 편리한 사용성 제공하는 New Home을 통해 빠른 진입점 및 추천경험 제공
		OLED TV (~2024.03.)	□ Quantum Dot 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (55・65・77") - S95 (55・65・77") : 144Hz VRR 적용된 QD-OLED Display와 OLED Glare Free 적용된 True Reality 화질과 Ultra Slim Flat 폼팩터에 Top Speaker가 내장된 Infinity One Design에 Object Tracking Sound 및 ATMOS 까지 모두 적용된 진정한 TV 가치를 제공하는 OLED TV - S90 (55・65・77") : Neo QLED 外, 삼성 OLED 라인업 강화하여 Premium TV 시장 內 포지셔닝 확대를 위해 144Hz VRR 적용된 OLED Display의 화질과 Laser Slim Design에 OTS Lite 및 ATMOS 적용으로 부족함 없는 입체 사운드 경험을 제공하는 OLED TV □ White OLED 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (42・48・55・65・77・83") - S90 (42・48・55・65・77・83") : 상동 - S85 (55・65・77・83") : OLED 판매 확대 및 손익 개선 중심의 신규 라인업으로 기획된 White OLED Display와 최후부까지 곡선으로 날렵하게 이어지는 Contour Design에 OTS Lite 및 ATMOS 적용으로 부족함 없는 입체 사운드 경험을 제공하는 OLED TV
		QLED TV (~2024.03.)	□ Flat QLED 4K TV (32・43・50・55・ 60・65・70・75・82・85・98") - 4K 최고의 화질(AI/밝기/시야각) 및 음질(OTS)을 통한 시청 경험을 극대화한 Flagship QLED - 최고의 명암비, 시야각 Free, Life-like 컬러와 최적의 밝기로 몰입감을 극대화 - 음성인식 및 AI 기술 기반으로 외부 환경 및 사용자 Context를 인지하여 최적의 시청 경험 제공 - 고가의 전문 장비 없이 모바일로 손쉽게 TV 화질을 Calibration - Game Bar를 통한 캐주얼 게이머들을 위한 게임 경험 확대
		UHD TV (~2024.03.)	□ Flat UHD TV (43・50・55・ 58・60・65・70・75・82・85・98") - Slim한 Bezel-less 디자인과 실제 자연색에 가까운 Color를 제공하는 UHD 스마트 TV - Dynamic Crystal Color 및 Dual LED를 통해 원본 콘텐츠의 화질을 그대로 표현하는 UHD 화질 - Multi-media Screen 경험 제공, 풍부한 콘텐츠, Smart Home의 경험을 통해 완성된 Smart 경험 제공 - Game Hub, IoT Hub, Chat Together, Voice Ready, Daily+, SmartThings Mobile Plugin 기능 추가를 통한 Smart 경험 강화
		Lifestyle TV (~2024.04.)	□ The Sero (43") - Modern & Simple 한 세로형 Screen에 판상형 Speaker가 부착된 360도 Design - 다양한 거주공간 어디에도 쉽게 거치 가능, 이동 가능한 Floor 스탠드 제공 - 기울어진 폼팩터에도 외광/실내 조명 반사 없는 화질로 기존 제품의 VoC 대폭 개선 □ The Frame (32・43・50・55・65・75・85") - Real 액자 디자인 및 액자 설치 경험 완성 - 다양한 명화, 사진 등 감상 가능, 인테리어와 조화로운 Lifestyle 디자인 채용

			- 초대형 Life Style 제품 Needs에 따른 85" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 종이와 같은 질감을 표현하는 화질로 Real Frame 경험 완성 □ The Serif (43・50・55・65") - 'I' 형태 Serif Font 디자인으로 확실한 차별화 및 인테리어 감성 극대화 - 대형 사이즈 제품 포지션 확대를 위한 65" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 매트한 질감을 표현하는 화질로 가구와 같은 디자인 완성 - White 외 Dark계열 신규컬러(Ivy Green) 옵션 제공 □ The Terrace (55・65・75") - 옥외에서 휴식과 Entertainment를 동시에 즐기려는 Lifestyle 대응을 위한 차별화된 제품 □ The Premiere (100~130") - 초단초점・레이저・고화질 폼팩터에 업계 최고 Smart UX/OTT 경험 제공 - Blended 디자인으로 벽 근처에 쉽게 놓고 원하는 공간에 적합한 사이즈로 투영 - 당사 TV의 완성된 콘텐츠 경험과 차별화된 화질・음질을 제공하는 프로젝터 □ The Freestyle (30~100") / Freestyle Rev (30~100") - 언제 어디서나 다양한 컨텐츠를 쉽게 감상할 수 있는 Movable Smart Screen - 다양한 공간에 쉽게 놓이며 각도/거리에 상관없이 최적 시청 경험 제공(Auto Focus/Auto Keystone) - 기본 Cradle로 다양한 공간에 거치 사용성이 추가되고 소켓을 통해 신규 설치 확장도 가능
		Micro-LED TV (~2023.12.)	□ Micro-LED Screen (76・89・101・114", TFT 기반) - 프리미엄 고객 및 유통의 Needs를 만족시키는 차세대 Flagship 모델 - TFT Glass기반 12.7" 모듈(Pitch 0.51) Micro-LED Screen 완품형 출시 - MicroLED Processor : AI scaling + HDR enhancing 기반 선명한 입체 화질 구현
		Sound Bar (~2022.03.)	□ Sound Bar Q990B - 업계 최초, TV에서 사운드바로 무선 ATMOS 전송(Wireless ATMOS) - TV와 Soundbar의 모든 채널을 활용하여 극장과 같은 최상의 Cinema True ATMOS 제공 - 사운드바 자체 공간 보정 기술 탑재
		모니터 (~2023.09.)	□ 스마트 모니터 M80B (32") - 초슬림, Flat Back, Warm White 컬러 적용 Lifestyle 디자인 - Magnetic 방식의 전용 카메라 In-box 영상 커뮤니케이션 - 스마트 경험 강화(VOD 시청/모바일 연결/PC-less기능/IoT/Communication/Game) □ 게이밍 모니터 G85NB (32") - 세계 최초 UHD 240Hz 1ms(GTG) 최고 게이밍 성능 모니터 (1000R Curved) - 새로운 수준 화질 경험을 제공하는 Odyssey Neo (Mini LED, Quantum HDR2000) □ 세계 최초 1000R 대형 게임 스크린 G97NB (55") - 1000R, 16:9, 55" Big Curved Screen으로 근접 환경에서도 시야각 제약 없는 최대 사이즈 화면으로 최고의 몰입감 제공 - 세로로 회전하고 자유로운 각도 조정으로 우주선 조종석에 앉은 것 같은 새로운 몰입 경험 제공 - 4K 165Hz 입출력 및 반응속도 1ms까지 지원 가능한 게임 전용 패널 □ QD-OLED 게이밍 모니터 (G85SB 34") - True RGB 자발광 Display와 Quantum Dot 기술의 조합으로 다양한 컬러를 정교하게 표현 - 0.1ms 최고 응답속도, 175Hz 주사율로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능 - Gaming Hub 적용으로 Cloud Game, 콘솔 등 All-In-One Game Discovery Platform 도입 □ 5K 초고해상도 모니터 (S90PC 27") - 4K 대비 50% 이상 더 많은 픽셀로 더 많은 정보를 담는 5K(5120X2880) 해상도 - 모니터 후드 없이도 빛 반사를 줄여 화면 왜곡을 없애고 눈을 보호하는 Matte Display - MAC/Windows 모두 만족하는 Thunderbolt 4 및 miniDP 제공 - 나의 작업/ 일상/ 공간에 맞춰 활용하는 '스마트스크린' □ DUHD Flagship Gaming 모니터 (G95NC 57")

			- 신규 57”초대형 폼팩터 및 초고화질 Dual UHD(7680X2160)을 통한 '극한의 몰입감' 제공 - 240Hz 주사율, 1ms 최고 응답속도로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능
		사이니지 (~2023.06.)	□ LCD 기반의 B2B Smart Signage (LFD, Hotel-TV, Video Wall, Outdoor 등) (13・24・32・43・49・50・55・65・75 ・85・98") □ LED 소자를 활용한 Indoor / Outdoor 사이니지 □ 부가 장치 일체형 All-in-one Kiosk (24") - Tizen 결제모듈/주문 앱 개발 위한 결제 플랫폼, 항균 코팅
	생활가전	냉장고 (~2024.12.)	□ 구주 177cm 1Door 빌트인 냉장고 신규 진입 - 빌트인 패키지 라인업 확대 - 신규격 기준 에너지 최고등급 구현 - 간냉식 용량 우위 확보 - 식품 신선보관(고습 냉장) 및 변온기능(냉동→냉장) 차별화 □ 북미 48”냉장고 빌트인 시장 교체 및 신규 수요 대응 - 빌트인 27.4cf 대용량 구현 - Ice & Water Solution 차별화(Auto Fill Water, Dual Auto Ice Maker) - Soft Closing 도어 적용으로 감성품질 고급화 □ 한국향 초격차 에너지 모델 도입(초절전 1등급, 1등급-22%달성) - 세계 최고 효율 압축기 적용 (W1, EER 9.3) - Set 열부하 저감(VIP Coverage 증대) - 기계실 방열 증대(Comp 측 Side Cool 추가) □ Global Wide BMF 냉장고 - 고효율 에너지 등급 및 AI Energy mode 적용, 에너지 비용 절감 - SpaceMax 적용으로 내용적 확대로 수납 편의성 - SmartThings 기반 시간대별 고내 조명 자동 조절 등 Smart 서비스 제공 □ 중국 가옥 맞춤 냉장고(W83cm) - 좌우 제로갭 설치로 주방 공간에 딱 맞게 빌트인처럼 매끈하게 설치 가능 - AI에너지 모드 적용으로 실사용 에너지 절감(중국에너지 1등급) - 최적 온도와 습도에서 전문적으로 식재료 특화 보관 제공(건습/보습 Box) - Wide Open 자동 도어 열림 기능 적용 □ Peltier 적용 냉장고 - Peltier 적용 및 폐열 활용을 통한 최고 효율 및 에너지 등급 달성 - 2개 냉각방식(Comp+Peltier)의 장점을 결합하여 소비자 Value 창출 ・ 1등급 -30% 에너지 달성 (기존 1등급 -22%) ・ Peltier 냉각 시스템 Compact化로 내용적 확보(기존 875L → 900L) □ 구주 Built-In BMF 냉장고 - 구주향 빌트인 BMF 대용량(380리터 ↑) 최고 에너지 등급 달성 - AI Energy 적용, 동급比 10% 이상 실사용 에너지 절감 - Full 간냉 및 [냉동→냉장 전환] 기능 제공 □ 한국 4Door 김치냉장고 도입 (소분/숙성 기능 장착) - 식재료 소분 저장/저온 숙성 가능한 별도 공간 제공 ・ 김치숙성, 육류해동, 반죽발효 등 다양한 모드로 활용성 강화 - 개정 에너지 규격 기준 1등급 고효율 모델 도입 □ 한국 오토 오픈 4Door 김치냉장고 도입 - Auto Open Door 적용으로 사용 편의성 강화 - 냄새 저감 김치통 적용으로 다양한 식재료 보관 가능 - 숙성, 해동, 발효 가능한 맞춤숙성실 제공 □ 인도 에너지 규제 대응 TMF 냉장고

			- 외관 디자인 변경 (Flat Door 적용) - AI Energy Mode 적용(전 모델 Wi-fi 적용 및 통합 PBA 반영)
		세탁기 (~2024.12.)	□ 그랑데 AI 24kg 세탁기 - 24kg, Flat Design (Glass Type) - 펫케어 코스 적용(얼룩, 냄새, 알러젠 제거) - Auto open door 적용(세탁 종료 후 자동으로 문 열림) □ BESPOKE 그랑데AI 원바디 Top-Fit - 한국향 BESPOKE 그랑데AI 일체형 Washer - 세탁기(21kg)와 건조기(17kg) 일체형 원바디 디자인 - 심플한 플랫 디자인 □ 세탁건조기 BESPOKE AI 콤보 - ONE 솔루션 : 세탁물 이동없이 편리하게 하나로 세탁건조 - AI 홈 : 터치화면 및 음성인식으로 간편하게 세탁건조 - AI 맞춤코스 : 세탁물에 맞는 최적의 코스로 작동 □ SSEC 24”9kg Slim 콤보 - Space Max 기술 적용: 좁은 주거 환경에서도 대용량 9kg을 한번에 세탁 - AI Energy Mode: 전기 에너지를 한층 더 절감 (AI Energy 사용시 70% 절감) - Ductless 타입 콤보 플랫폼으로 건조 시간 기존 대비 최대 50% 절약 - AI Wash, AI 에코버블, Flex Auto Dispenser 등으로 세탁성능 및 사용 편의성 강화
		에어컨 (~2024.12.)	□ 구주 EHS 신형 플랫폼 적용 및 라인업 강화로 매출 확대 - 저소음 규제 대응 : 독일을 중심으로 구주 국가별 소음 규제 확대 대응 - 저온 성능 강화 : -25℃외기에서 정격 난방 성능 100% 구현 - 고온 토출수 : Heat Pump 단일 사이클 최고 70℃ 토출수 구현 - 디자인 차별화 : 주거 환경에 조화를 이루는 Dark 색상 계열의 1FAN 실외기 □ BESPOKE 무풍에어컨 윈도우핏 - 방안에서도 직바람 없이 시원한 무풍 냉방 - 진동과 소음을 줄여 숙면을 도와주는 32 dB 저소음 모드 - 상황에 맞춰 선택하는 고효율 에너지 맞춤 절전 - 더 강력한 냉방 성능과 더 커진 팬으로 골고루 시원하게 대용량 강력 냉방 - 빈틈없이 쉽고 안전하게 간편 안심 설치킷 □ Infinite Line 1Way BESPOKE 무풍 시스템에어컨 - 자연스럽게 공간의 무드를 만들어내는 은은한 간접조명 엣지 라이팅 - 고효율 에너지 맞춤절전 와이드 무풍 - 공기질부터 내부 관리까지 케어 8단계 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 AI 절약모드 □ 구주 EHS 신 냉매(R290) 신규 플랫폼 - 2027년 냉매 규제에 따른 신 냉매(R290) 솔루션 대응 - 보일러 시장 대체를 위한 고온 토출수 구현 (Max 출수 75℃) - 저소음 구현 (최저 35dB(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유닛(탱크 일체형 및 벽걸이형) 실내기 개발 - 통합 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 편의성 향상(CX-MDE 기반 에너지 절전) - AI Energy 및 업계 최고 급탕효율 성능으로 경쟁사 比 연간 소비 전력량 15% 절감 - Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선점 대응 □ 시스템 에어컨 주력 상품인 DVM S의 혁신 고효율 신규 플랫폼 도입 - 캐나다內 Top 에너지 효율 달성(경쟁사 제품比 IEER 효율 경쟁력 리더쉽 확보) - 캐나다內 최대 용량 달성(단일 Set 최대 20Ton, D社 단일 Set 최대 14Ton) - 캐나다內 최대 난방 운전 온도 범위

			・ 당사 -30~24℃, D사 -25~16℃, X사 -30~16℃ □ 모듈 고효율화 및 실외기 신규 개발을 통한 RAC 경쟁력 확보 - RAC 전모델 Smart 기능 (AI절전) 및 DC화를 통한 제품 경쟁력 확보 - 부품 종수 감축을 통한 원가 경쟁력 제고 - 9/12K STD급 실외기 체적 경쟁력 확보(기존 104리터 대비 85리터, 체적 19%↓) - 이태리 에너지 보조금 조건 충족 - Twin 압축기 적용으로 진동, 소음 저감 및 저부하 운전 영역 확대 □ 북미 냉매 규제 시행 ('25.1.1 통관 기준 시행)에 따른 R32 신모델 도입 - Wi-Fi BLE 기능 적용 - 습도 센서를 이용한 쾌적 제습 운전
		청소기 (~2024.03.)	□ BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션
		렌지후드 (2022.02.)	□ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대 - 기존 제품과의 성능 차별화 ・트리플 센서를 탑재하여 상시배기 시스템으로 최적의 풍량 운전 ・업계 최고 흡입력 780CMH 구현, 업계 최저 소음 (29dB, Quiet Mark 인증) - 전기레인지와 연동 및 스테인리스 필터에 이지 클린 코팅 적용으로 사용편의성 개선 - 소비자의 다양한 니즈 반영한 디자인(BESPOKE 컬러) - Easy Install 및 설치 프로세스 도입으로 B2C 시장 진입
		인버터 제습기 (2022.05.)	□ 에너지 소비효율 1등급 저소음 인버터 제습기 - 와이드 블레이드로 빠르고 강력하게 대용량 제습 - 욕실부터 드레스룸까지 공간을 쾌적하게 스마트 공간 케어 - 스윙 블레이드로 섬세한 의류도 골고루 와이드 의류 건조 - 어디에도 잘 어울리는 심플한 디자인과 컴팩트 사이즈 - 장시간 사용해도 조용한 저소음 모드
		식기세척기 (2022.06.)	□ 구주/한국 시장 경쟁력있는 자체 기술 플랫폼 - 구주 시장 Tall Tub 대응 - 최고 수준 에너지/물/소음 사양 경쟁력 확보 - 한국 세제자동투입, Simple UX 등 차별화를 통한 프리미엄 강화 - Z-wash, Smart, Flexible Basket 사양 차별화
		가스오븐 (~2023.08.)	□ 북미 Dacor 48" Pro-Range - 48" all Gas Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용 - Air Fry, Air Sous-Vide 등 Healthier cooking POD 적용 - 7" Pop-up display 적용 □ 북미 Dacor 48" Pro-Range (Dual Fuel) - 48" Dual Fuel Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용

			- Dual Fuel 연료 형태로 Oven(전기) + Cooktop(가스) - Cooktop부 6 Burners + Griddle 사양 적용 - Small oven 12" (신규 플랫폼), Big oven 36" (기존 플랫폼) 조합 - Steam Assist 기능 제공
	MX	Galaxy 폴더블 (~2024.10.)	□ Galaxy Z Fold4 (2022.08.) - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 67.1mm x 155.1mm x 14.2~15.8mm (펼쳤을 때) 130.1mm x 155.1mm x 6.3mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8+ Gen 1, Android 12.0, One UI 4.1.1 - Nightography 사진/비디오, 고해상도(50M/8K), 고배율줌(30X)로 카메라 사용 경험 완성도 제고 - Taskbar제공으로 쉽고 빨라진 멀티 태스킹 - 다양한 진입점으로 편리하게 생성하는 멀티 윈도우 - 이미지에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 Action 추천 기능
			□ Galaxy Z Flip4 (2022.08.) - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 71.9mm x 84.9mm x 15.9~17.1mm (펼쳤을 때) 71.9mm x 165.2mm x 6.9 mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8+ Gen 1, Android 12.0, One UI 4.1.1 - 25W 충전 지원 및 3700mAh 배터리 제공 - 다양한 각으로 사진/영상 촬영에 최적화된 플렉스 캠 지원 - 플렉스 모드에서 쉽고 빠른 앱 전환 및 조작 - 커버 스크린 기능 확대 (간편 답장, 삼성 월렛 플랫폼, 퀵세팅 확대 등)
			□ Galaxy Z Fold5 (2023.08.) - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 67.1mm x 154.9mm x 13.4mm (펼쳤을 때) 129.9mm x 154.9mm x 6.1mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1.1 - 신규 힌지 적용을 통한 Slim Closed Gap 디자인 구현 : Dumbbell 방식(물방울형) Flex Hinge 적용 - 무게 절감과 두께 축소를 통한 단말 휴대성 및 그립감 향상 - 대화면 최적화를 통한 사용자 경험 개선 ・양손 활용 동작 : 한 손으로 앱/컨텐츠를 선택, 다른 손으로 원하는 동작 실행 ・Taskbar 최적화 : 최근 앱 표시 확대(2→4개), Navigation 영역 자동 확장 ・멀티윈도우 전환 강화 : 홈화면에서 팝업 윈도우를 손쉽게 멀티윈도우로 전환 ・Game 최적화 : 주요 Game에 대한 최적 해상도 사전 확보 - 내구성 강화 : Display내 충격 흡수층 강화 및 세트 힌지부 구조 변경 - 슬림하고 가벼운 S-Pen과 Case : S-Pen 및 Case 형상 변경으로 두께 및 무게 절감
			□ Galaxy Z Flip5 (2023.08.) - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 3.4" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 71.9mm x 85.1mm x 15.1 mm (펼쳤을 때) 71.9mm x 165.1mm x 6.9 mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1.1 - 설계 최적화를 통한 커버스크린 확대(1.9" →3.4") - 신규 힌지 적용을 통한 Slim Closed Gap 및 두께 축소로 그립감 개선 - 대형 커버스크린 활용한 차별화된 사용자 경험 핵심 기능 제공 및 사용성 강화 ・주요 위젯13종(Music, Alarm 等), 주요 앱(삼성Wallet, 메시지 답장), Fast Scroll 기능 제공 ・Quick Setting 6종 →9종 확대(Mobile Data, Screen Recording, Modes 3종) - 대화면 커버스크린을 활용한 다양한 촬영 효과 및 기능 제공

			- 내구성 강화 : Display내 충격 흡수층 강화 및 세트 힌지부 구조 변경
			□ Galaxy Z Fold6 (2024.07.) - 얇고 가벼운 무게로 뛰어난 휴대성 제공을 통한 제품 경쟁력 강화 - 한단계 더 진화된 Galaxy AI를 통해 차별화된 사용자 경험 제공 - 인치(Main/Sub) : 7.6" QXGA+(2160 x 1856) / 6.3" HD+ (968 x 2376) - 사이즈(W x H x D) : Open 132.6 x 153.5 x 5.6 mm, Close 68.1 x 153.5 x 12.1 mm, 239g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, One UI 6.1.1 - 폴더블 폼팩터와 Galaxy AI 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신 ・서클 투 서치, 실시간 통역, 노트/채팅 어시스트 등 ・듀얼 스크린 활용한 '대화 번역 모드' 등 - 향상된 카메라/갤러리 경험 제공 ・포토/그리기 어시스트, 날씨 및 시간 배경 화면 등 - 무게 14g 감소, 두께(Close) 1.3mm 감소, Cover Display 0.1" 증가
			□ Galaxy Z Flip6 (2024.07.) - 내구성 향상을 통한 제품 경쟁력 강화 - 한단계 더 진화된 Galaxy AI를 통해 차별화된 사용자 경험 제공 - 인치(Main/Sub) : 6.7" FHD+ (2640 x 1080) / 3.4" (720 x 748) - 사이즈(W x H x D) : Open 71.9 x 165.1 x 6.9 mm, Close 71.9 x 85.1 x 14.9 mm, 187g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, One UI 6.1.1 - 폴더블 폼팩터와 Galaxy AI 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신 ・서클 투 서치, 실시간 통역, 포토/노트/채팅 어시스트 등 ・듀얼 스크린 활용한 '대화 번역 모드', 플렉스윈도우에서의 '답장 추천' 기능 지원 등 - 고화소 카메라(Wide 50MP) 적용 및 향상된 Flex 카메라 경험 제공 ・저조도/원거리 선명한 디테일 제공 ・플렉스모드에서 카메라 자동줌(Auto Zoom) 기능 지원으로 편리한 핸즈프리 촬영 - Display Folding부 내구성 강화 ・화면 내구성 강화및 폴딩부 굴곡 개선
			□ Galaxy Z Fold SE (2024.10.) - 더 넓고 더 슬림해진 디자인, 핵심 사양을 강화하여 제품 경쟁력 확보 - 한 단계 더 진화된 Galaxy AI를 통해 차별화된 사용자 경험 제공 - 인치(Main/Sub) : 8.0" QXGA+(2184 x 1968) / 6.5" FHD+ (1080 x 2520) - 사이즈(W x H x D) : Open 142.6 x 157.9 x 4.9 mm, Close 72.8 x 157.9 x 10.6 mm, 236g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, One UI 6.1.1 - 폴더블 폼팩터의 기본 사용성 향상 (Z Fold6 比) ・무게 3g 감소, 두께(Close) 1.6mm 감소, Main Display 0.4", Cover Display 0.2"증가 ・Cover Display의 화면 비율(21:9) 개선을 통한 클로즈 상태의 사용성 향상 - 2억 화소 초고해상도 카메라를 적용하여, 폴더블 최고의 카메라 성능 확보 - 더 넓은 화면을 활용한 Galaxy AI 를 통해 Galaxy Intelligence 경험 혁신 ・서클 투 서치, 실시간 통역, 노트/채팅 어시스트, 듀얼 스크린 활용한 '대화 번역 모드' 등
		Galaxy S (~2024.10.)	□ Galaxy S22・S22+・S22 Ultra (2022.02.) - Design: Enhance Galaxy Design attractiveness with geometric bold design and integrity on quality - 인치 : S22 6.1", S22+ 6.6", S22 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S22 70.6 x 146.0 x 7.6 mm, S22+ 75.8 x 157.4 x 7.6 mm, S22 Ultra 77.9 x 163.3 x 8.9 mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 1 /Exynos2200, Android 12.0, One UI 4.1 - 카메라 동영상 촬영 및 저조도 성능 강화

			・동영상 : HDR, OIS+AI Stabilizer성능 개선으로 풍부한 컬러 지원 및 흔들림/지터링 최소화 ・저조도 성능강화 : Big Pixel 센서 및 On-device AI 알고리즘 적용 - S Pen 내장을 통한 Ultra/Note 통합 * Latency 최적화 : 5.6ms(S21 Ultra) → 2.8ms(S22 Ultra) - Display 야외 시인성 개선 * Peak 휘도: 1,500nit(S21 Ultra) → 1,750nit(S22 Ultra) - All day 사용 가능한 배터리와 초고속 45W 충전 속도 (S22 Ultra/S22+) - 내구성 강화 : 10% 개선된 Amor AL, Victus+ Glass 적용 - Galaxy Foundation 경험 완성도 제고 ・One UI 4.1: 감성적 Interaction경험과 사용자 개인경험 고도화 ・Galaxy Eco : End-to-End 완성도 제고 및 체감 편의 경험 강화
			□ Galaxy S23・S23+・S23 Ultra (2023.02.) - Design: Ultimate Premium Experience designed for today and beyond * Unrivalled Camera, Ultimate Gaming Eco-conscious Design - 인치 : S23 6.1", S23+ 6.6", S23 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S23 70.9 x 146.3 x 7.6 mm, S23+ 76.2 x 157.8 x 7.6 mm, 195g S23 Ultra 78.1 x 163.4 x 8.9 mm, 233g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 강화된 AI기반 저조도 및 동영상 경험 완성도 제고 ・AI Scene 분석 기반 컬러 솔루션 개선으로 야간에도 정확한 인물 색감/톤 표현 가능 ・OIS 보정각 확대로 동영상 손떨림 보정 강화 (S22 Ultra 1.5°→ S23 Ultra 3°) - 고화소의 섬세한 디테일 구현 및 고해상도 사진 촬영 경험 제공 ・S23 Ultra, 200MP 초고화소 센서 적용 ・조도 구간별 픽셀 크기 자동 조정으로 최적 화질 제공 - 발열, 낙하 내구성 등 기본 성능 개선 ・소모전류 개선 및 방열 구조 획기적 개선 등 발열 성능 향상을 통한 부드러운 게이밍 경험 제공 ・단품 강도 21% 개선된 Victus 2 Glass 적용으로 낙하 내구성 강화 - S23 Ultra, 내장된 S-Pen으로 더욱 완벽한 Productivity 경험 제공 ・이미지 / 동영상에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 맞춤 Action 제안 - 멀티기기 연동 사용 경험 강화 (폰-PC) ・폰에서 브라우징 하던 웹페이지를 PC에서 이어서 사용 가능 - 컬러부터 소재까지 전반에 걸친 친환경 소재 적용으로 친환경 스토리 구성 ・패키징 박스 100% 재생용지 사용 ・재활용 메탈접합 PBT레진 적용(10%), 재활용 메탈 소재 적용(28%) 사이드키 등 ・전/후면 글라스 재생유리 적용(22%), 메탈 가공시 천연염료 사용, 재활용 PET 필름 사용 등 - Privacy와 Security 강화 ・보안 상태 시각화 / 이미지 공유시 민감 정보 알림 / 제품 수리시 개인 정보 접근 제한
			□ Galaxy S24・S24+・S24 Ultra (2024.01.) - Galaxy AI 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신, 일상에 새로운 경험과 가치를 제공 ・서클 투 서치, 실시간 통역, 포토/노트/채팅 어시스트 등 신규 AI 기능 제공 - 인치 : S24 6.2", S24+ 6.7", S24 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S24 70.6 x 147.0 x 7.6 mm 167g, S24+ 75.9 x 158.5 x 7.7 mm, 196g S24 Ultra 79.0 x 162.3 x 8.6 mm, 232g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3/Exynos 2400, Android 14, One UI 6.1 - Slimmer and even bezels 적용으로 몰입감 있는 디스플레이 경험 강화 - One-mass 디자인을 통한 조형의 일체감 완성 - 향상된 AI ProVisual Engine 탑재로 카메라 촬영 및 갤러리 감상/편집 강화 ・스페이스 줌, 나이토그래피로 선명한 고품질 사진 촬영 ・Instant Slow-mo, Edit Suggestion 기능 제공

			- 디스플레이 야외 시인성 개선 * Peak 밝기: 1,750nit → 2,600nit - S24 Ultra, 메탈 프레임 티타늄 소재 적용을 통한 내구성 강화 및 고급감 극대화 - S24 Ultra, 고화소 망원 카메라 적용 * 10MP (S23 Ultra) → 50MP (S24 Ultra)
			□ Galaxy S24 FE (2024.10.) - 최신 플래그십 경험의 장벽을 낮추는 균형 잡힌 프리미엄 (with Galaxy AI) - 인치 : 6.7" FHD+ Dynamic AMOLED 2x (2340 x 1080) 120Hz - 사이즈(W x H x D) : 77.3 x 162.0 x 8.0 mm, 213g - Platform(H/W, S/W) : Exynos 2400e, Android 14, One UI 6.1 - 전작 대비 향상된 H/W 제공으로 사용자 경험 극대화 ・AP (Exynos2200→Exynos2400e), Display (6.4"→6.7"), Battery (4,500mAh→4,700mAh) - 플래그십 AI기반의 Full Experience 제공 (서클 투 서치, 실시간 통역, AI 사진편집 등) - 향상된 AI ProVisual Engine 탑재로 카메라 촬영 및 갤러리 감상/편집 강화 - 디스플레이 야외 시인성 개선 * Peak 밝기: 1,450nit → 1,900nit
		Galaxy Tab (~2024.10.)	□ Galaxy Tab S8・S8+・S8 Ultra (2022.02.) - 인치 : Tab S8 11" WQXGA (2560 x 1600) Tab S8+ 12.4" WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S8 Ultra 14.6" WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Tab S8 165.3mm x 253.8mm x 6.3mm, 503g Tab S8+ 185.0mm x 285.0mm x 5.7mm, 567g Tab S8 Ultra 208.6mm x 326.4mm x 5.5mm, 726g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 1, Android 12, One UI 4.1 - Memory : 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB / 16G+512G, microSD up to 1TB - 화상 통화 경험 향상 [Tab S8 Ultra] Dual 전면 카메라(12M 80도, 12M 120도) 및 Auto Framing 기능 제공 [Tab S8+ / Tab S8] 12M 120도 전면 카메라 및 Auto Framing 기능 제공 - AP 방열 설계 강화를 통한 AP Sustain 성능 개선(전작비 GPU 70%, CPU 25%↑), 게임 성능 향상 - S Pen Latency 개선 (5.6ms → 2.65ms) 및 Prediction Algorithm 최적화 Writing & Drawing 시 Real Pen과 같이 끊김 없고 정밀한 필기 경험 제공, 밀착감 개선 - 3 MIC Noise Cancelation 성능 강화 (3종 잡음 제거 모드)로 화상 회의 오디오 경험 향상 - 태블릿 최초로 WiFi 6E 기능을 탑재하여 Device 간 대용량 데이터 전송 시간 개선 - D2D 15W 충전 기능 탑재하여 전작 대비 Phone Power Share 충전 시간 절반으로 단축
			□ Galaxy Tab S9・S9+・S9 Ultra (2023.08.) - 인치 : Tab S9 11"WQXGA (2560 x 1600) Tab S9+ 12.4"WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S9 Ultra 14.6"WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Tab S9 165.8 x 254.3 x 5.9 mm, 498g Tab S9+ 185.4 x 285.4 x 5.7 mm, 581g Tab S9 Ultra 208.6 x 326.4 x 5.5 mm, 732g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 풍부한 색감과 환경에 적응하는 대화면 경험 제공 ・Tab S9 시리즈 전 모델 선명하면서도 편안한 Dynamic AMOLED 2X 기술 채용 ・햇빛 아래에서도 선명한 화면을 보여주는 Vision Booster 기술 도입 - 어디서나 걱정 없이 사용 가능하도록 이동성 및 신뢰성 확보 ・최상의 방수/방진 인증 등급 IP68 획득 ・충격과 낙하에서 기기를 안전하게 보호하는 Armor Aluminum ・양방향 충전 적용 S-Pen 및 Ruggedized 액세서리 도입으로 사용성 Eco 확대 ・Tab FE 모델군과 키보드 및 액세서리 공용화로 호환성 강화

			・Vapor Chamber를 이용한 양방향 방열 신규 구조 도입 장시간 사용에도 불편함 없이 사용 - 다양한 분야에 걸친 풍성한 Android App Eco 확보 ・필기, 문서, 브라우징 등 생산성 강화 주요 안드로이드 앱 강화 : 삼성노트, 굿노트 등 ・그림, 사진 및 영상 편집 사용성 개선을 위한 주요 앱 확보 : 루마퓨전, 클립스튜디오 등 - 외관 대형 플라스틱 부위 및 강화 유리 재활용으로 제품 전반에 걸친 친환경 소재 적용 ・S-PEN 부착 부위 대형 재활용 플라스틱 신규 적용 ・디스플레이 강화 유리 신규 재활용 도입 (10%, 고릴라 글래스5) ・패키징 박스 100% 재생 용지 및 재활용 Armor Aluminum 적용(20%), 재활용 플라스틱 내장 자재 사용 등
			□ Galaxy Tab S10+・S10 Ultra (2024.10.) - 인치 : Tab S10 Plus 12.4"WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S10 Ultra 14.6"WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(W x H x D) : Tab S10 Plus 185.4 x 285.4 x 5.6 mm, 571g Tab S10 Ultra 208.6 x 326.4 x 5.4 mm, 718g - Platform(H/W, S/W) : Mediatek Dimensity 9300+, Android 14, One UI 6.1.1 - S펜을 활용한 쉽고 편리한 AI 사용 경험 - Dynamic AMOLED 2X Display, 120Hz, 저반사 코팅
		Galaxy A (~2024.11.)	□ Galaxy A13 5G (2022.01.) - 인치 : 6.5" HD+ (1600 x 720) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.5mm x 164.5mm x 8.8mm, 195g - 6.5" HD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A12 6.5" HD+ 60Hz) - LTE 사용자 Migration 및 5G 시장 확산을 위한 초저가 5G 모델 - Entry 시장 대응을 위한 AP 성능 강화 (P35 → D700) - 50MP 카메라 적용으로 전작(A12 16MP)비 고화소 사진 촬영 가능
			□ Galaxy A23 (2022.03.) - 인치 : 6.6" FHD+ (2408 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : SDM680, Android 12, One UI 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A22 6.4" HD+ 90Hz) - 고화소 50MP OIS 카메라 적용으로 어두운 곳에서 흔들림 없는 선명한 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원
			□ Galaxy A13 LTE (2022.03.) - 인치 : 6.6" FHD+ (2408 x 1080) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.4mm x 165.1mm x 8.8mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : Exynos850, Android 12, One UI Core 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이 적용하여 전작(A12 6.5" HD+)비 향상된 대화면 경험 제공 - 50MP 카메라 적용하여 전작(A12 48MP)비 고화소 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 고용량 배터리 및 AI Power mode 적용하여 1회 충전으로 2 Days 사용 가능
			□ Galaxy A73 5G (2022.04.) - 인치 : 6.7" FHD+ Super AMOLED+ (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.1mm x 163.7mm x 7.6mm, 181g - Platform(H/W, S/W) : SDM778G, Android 12, One UI 4.1 - 108MP 고해상도 화질 및 OIS 지원으로 선명하면서도 어두운 곳에서 흔들림 없는 사진 촬영 가능 - 120Hz 고주사율과 sAMOLED display적용으로 부드럽고 선명한 화면 경험 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원 - Gorilla Glass 5 및 IP67등급 적용으로 강력한 내구성 제공 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공

			□ Galaxy A53 5G (2022.04.) - 인치 : 6.5" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 74.8mm x 159.6mm x 8.1mm, 189g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1 - 8.1t 슬림 디자인 및 5,000mAh 대용량 배터리 적용 (전작比 0.3t↓, 500mAh↑) - 120Hz 고주사율과 빠른 반응속도의 sAMOLED 조합이 제공하는 부드럽고 선명한 화면 경험 - Gorilla Glass 5 적용으로 Glass 내구성 향상 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공
			□ Galaxy A33 5G (2022.04.) - 인치 : 6.4" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 74.0mm x 159.7mm x 8.1mm, 186g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1 - 6.4" FHD+ 디스플레이, 90Hz 지원으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A32-5G HD+ TFT 60Hz) - 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - Gorilla Glass 5 적용, IP67 등급의 방수&방진 지원으로 내구성 향상 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원
			□ Galaxy A23 5G (2022.09.) - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (1080 x 2408) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 197g - Platform(H/W, S/W) : SDM695, Android 12, One UI 4.1 - SDM695 적용하여 전작(A22-5G D700) 대비 AP 성능 강화 - 50MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 (NA 권역 OIS 미지원) - 6.6" FHD+ 적용하여 전작(A22-5G 6.6" FHD+ 90Hz) 대비 향상된 대화면 경험 제공 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 고속충전 지원
			□ Galaxy A14 5G (2023.01.) - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (2408 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.0 x 167.7 x 9.1mm, 201g - Platform(H/W, S/W) : D700/Exynos1330, Android 13, One UI core 5.0 - 전작 (A13-5G) 대비 고사양 Front camera 적용으로 고화소 사진촬영 가능 (5MP → 13MP) - 6.6" FHD+ 대화면 디스플레이 적용으로 전작(A13-5G 6.5" HD+) 대비 향상된 화면 경험 제공 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용
			□ Galaxy A54 5G (2023.03.) - 인치 : 6.4" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.7 x 158.2 x 8.2mm, 202g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1380, Android 13, One UI 5.1 - AP 화질 개선 기능, 조도별 튜닝 세분화 및 1000nit 적용을 통한 시인성 향상 - 120Hz 최적의 주사율 제공을 통한 성능 및 배터리 효율 극대화 - Linear 모터의 정교한 진동 조절을 통한 풍부한 Haptic 경험 제공 - Balanced Design 및 Premium CMF 강화 (6.4", 19.5:9 적용) - One UI 5.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공
			□ Galaxy A34 5G (2023.03.) - 인치 : 6.6" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.1 x 161.3 x 8.2mm, 199g - Platform(H/W, S/W) : D1080, Android 13, One UI 5.1 - 6.6" FHD+, 1,000nit 휘도, 120Hz 주사율 지원으로 향상된 화면 경험 제공 - 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - Linear Motor 탑재하여 플래그십 수준의 햅틱 경험 제공

			□ Galaxy A14 (2023.03.) - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (2408 x 1080) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.0 x 167.7 x 9.1mm, 201g - Platform(H/W, S/W) : Exynos850/G80, Android 13, One UI core 5.1 - 전작 (A13) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP → 13MP) - 5,000mAh 대용량 배터리 적용
			□ Galaxy A24 (2023.05.) - 인치 : 6.5" FHD+ sAMOLED U-Cut (1080 x 2340) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 77.6mm x 162.1mm x 8.3mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : G99, Android 13, One UI core 5.1 - 전작(A23) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP →13MP) - 신규VDIS 적용으로 OIS와 함께 진보된 흔들림 없는 비디오 제공 - 전작(A23) 대비 야외 시인성 향상, 넓어진 색대역 등으로 밝고 편리한 화면 경험 제공
			□ Galaxy A05s (2023.10.) - 인치 : 6.7" FHD+ TFT LCD U-cut (1080 x 2400) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 77.8mm x 168.0mm x 8.8mm, 194g - Platform(H/W, S/W) : SDM680, Android 13, One UI core 5.1 - LTE Entry 시장 물량 및 M/S 견인 - 전작 A04S 比 고성능 AP 탑재 (Exynos850 8nm → SDM680 6nm), 고사양 Front Camera 적용 (5MP → 13MP) - Global 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 급속25W 충전 지원 (15W → 25W)
			□ Galaxy A05 (2023.10.) - 인치 : 6.7" HD+ TFT LCD U-cut (720 x 1600) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.2mm x 168.8mm x 8.8mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : G85, Android 13, One UI Core 5.1 - 6.7" 대화면과 50MP 고화소 카메라 지원으로 향상된 멀티미디어 경험 제공 - 고성능 AP 탑재하여 고객의 제품 사용성 향상 (전작比 CPU 33%↑, GPU 150%) - 25W 고속으로 30분 충전하여 장시간 사용할 수 있는 배터리
			□ Galaxy A25 5G (2024.01.) - 인치 : 6.5"FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz - 사이즈(W x H x D) : 76.5 x 161.0 x 8.3 mm, 197g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1280, Android 14, One UI 6.0 - 6.5" FHD+, 120Hz 주사율을 지원하여 향상된 화면 경험 제공 - 50MP OIS 광각 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용
			□ Galaxy A15 (2024.01.) - 인치 : 6.5"FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 90Hz - 사이즈(W x H x D) : 76.8 x 160.1 x 8.4 mm, 200g - Platform(H/W, S/W): [5G] D6100+ / [LTE] G99, Android 14, One UI 6.0 - 전작(A14) 대비 디스플레이 업그레이드를 통한 화질 향상 (LCD → Super AMOLED) - 25W 고속 충전 가능한 5,000mAh 대용량 배터리 탑재 - Knox Vault 지원으로 보안 및 사생활 보호 강화
			□ Galaxy A55 5G (2024.03.) - 인치 : 6.6"FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz - 사이즈(W x H x D) : 77.4 x 161.1 x 8.2 mm, 213g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1480, Android 14.0, One UI 6.1 - 강화된 카메라 센서 및 AP로 더 완벽해진 Nightography와 비디오 촬영 경험 제공

			- Metal + Glass 적용, Young & Energetic한 CMF 구현으로 디자인 경쟁력 강화 - 6.6" FHD+ 대화면 디스플레이 적용으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A54-5g 6.4")
			□ Galaxy A35 5G (2024.03.) - 인치 : 6.6"FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz - 사이즈(W x H x D) : 78.0 x 161.7 x 8.2 mm, 209g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1380, Android 14, One UI 6.1 - HID(Hole In Display), Back Glass적용하여 디자인 차별화 - Knox Vault로 보안을 강화하고, OS UP 4회 및 Security MR 5회 지원하여 품질 보증 확대
			□ Galaxy A06 (2024.09.) - A05 후속 최저가 LTE 모델로 Entry Seg 물량 확대 - 인치 : 6.7"HD+ TFT LCD (1600 x 720) 60Hz - 사이즈(W x H x D) : 77.3 x 167.3 x 8.0 mm, 189g - Platform(H/W, S/W): G85, Android 14, One UI 6.1 - 대화면 Slim 디자인 (두께 8.00mm) 적용 - 측면 지문 지원 및 Samsung Knox Vault 보안솔루션 탑재로 데이터 보안 강화
			□ Galaxy A16 5G (2024.10.) - A15 5G 후속, Entry 5G 시장 성장 대응 - 인치 : 6.7"FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) : 77.9 x 164.4 x 7.9 mm, 200g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1330 / D6300, Android 14, One UI 6.1 - 6.7"대화면 디스플레이 및 Slim 디자인 (두께 7.9mm) 적용 - OS 6회/SMR 6년 업데이트 지원 및 IP54 방수방진 등급 적용
			□ Galaxy A16 (2024.11.) - A15 후속 Entry LTE 물량 대응 - 인치 : 6.7"FHD+ sA (2340 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) : 77.9 x 164.4 x 7.9 mm, 200g - Platform(H/W, S/W): G99, Android 14, One UI 6.1 - 6.7"대화면 디스플레이 및 Slim 디자인 (두께 7.9mm) 적용 - OS 6회/SMR 6년 업데이트 지원 및 IP54 방수방진 등급 적용
		Galaxy Book (~2024.10.)	□ Galaxy Book2 Pro 360 (2022.04.) - 인치 : 15.6" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 354.85 x 227.97 x 11.9mm, 1.41kg 13.3" 302.5 x 202 x 11.5 mm, 1.04kg - Platform, OS : Intel ® Core™ Processor (12세대), Windows 11 - sAMOLED : Default 370nit/HDR 500nit, Color volume 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원) - SSD : Gen4 SSD , Expendable SSD (M.2 2230) - WiFi 6E 지원 - Battery : 15.6" 68Wh (21hrs), 13.3" 63Wh (21hrs) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 ・QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 Galaxy북에 로그인 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			□ Galaxy Book2 Pro (2022.04.) - 인치 : 15.6" FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% 13.3" FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120%

			- 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 355.4 x 225.8 x 11.7mm, 1.11kg 13.3" 304.4 x 199.8 x 11.2mm, 0.87kg - Platform, OS : Intel ® Core™ Processor (12세대), Windows 11 - AMOLED : Default 400nit/HDR 500nit, Color volume 120% - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원) - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (15.6" Only, M.2 2280) - WiFi 6E, 5G Sub6 (15.6"Only) 지원 - Battery : 15.6" 68Wh (21hrs), 13.3" 63Wh (21hrs) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 ・QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 Galaxy북에 로그인 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			□ Galaxy Book2 Go 5G (2022.12.) - 인치 : 14" IPS (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) : 323.9mm x 224.8mm x 15.5mm - Platform : Snapdragon 7C+ Gen 3, Window 11 - 7C+ Gen3 적용 Mass WoA 제품 개발 (Snapdragon 7C Gen 2 대비 CPU 63%↑, GPU 102%↑) - Display 화질개선 (TN →IPS) - WiFi 6E, 5G Sub6 지원 - 보급형 ENDC/eSIM지원 5G 모델 도입 - 45W 충전 지원 - MIL-STD-810H 8개 항목 보증 ・Shock, High/Low Temperature, Thermal Shock, Dust, Vibration, Low pressure, Humidity
			□ Galaxy Book2 Pro 360(2023) (2022.12.) - 인치 : 13.3" FHD AMOLED (16:9), Touch Screen, Color Volume(DCI-P3) 100%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 13.3" 302.5 x 202.0 x 11.5mm, 1.04kg - Platform, OS : Snapdragon 8cx Gen 3, Windows 11 Home - AMOLED : 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), Color Volume(DCI-P3) 100%, up to 370nit, S Pen - Speakers : Stereo 2 x 4W (Smart AMP), AKG, Dolby Atmos - SSD : eUFS on board, 256GB - WiFi 6E (802.11ax) - Battery : 63Wh (Video Play 35hrs↑) - Galaxy ecosystem : Smart Switch, Samsung Account, Samsung Apps, Keyboard & Touch Pad Sharing between Galaxy devices - Security : 지문 인식, Secured Core PC (Level 3, H/W & F/W Protection) - AI : Noise Reduction, Video Call with Neural Engine
			□ Galaxy Book3 Ultra (2023.02.) - 인치 : 16.0" OLED 120Hz, 370nit/500nit, 16:10 (2880 x 1800, 3K) - 사이즈(W x D x H) : 355.4 x 250.5 x 16.5mm, 1.79kg, - Intel ® Core™ Processor (13세대), Win 11, LPDDR5, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070, 76W Battery, FHD MIPI Camera, A/C/D AI, B Glass, TA 100W - 13세대 Intel® Core™ H-프로세서와 차세대 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 시리즈 그래픽 적용 - WQXGA+를 적용한 3K 고해상도 디스플레이, 컬러 볼륨 120% - 39% 더 넓어진 터치 패드 (Galaxy 북2 Pro 33.7 cm / 39.6cm 대비) - 100W 고속 충전, 30분 충전 시 55% 충전 가능 - Quad Speaker : AKG와 Dolby Atmos 적용 - Galaxy Ecosystem 적용 ・Multi Control : 키보드와 마우스를 스마트폰, 탭에서도 사용할 수 있고, 기기 간 파일을 옮기거나,

			문서/이미지의 복사, 붙여넣기도 가능 ・Second Screen : Galaxy Tab을 듀얼 모니터처럼 활용, PC 화면 확장 또는 복제 가능 ・Quick Share : 폰/태블릿 등 Galaxy 기기 간 무선 파일 공유
			□ Galaxy Book3 Pro 360 (2023.02.) - 인치 : 16.0" WQXGA+ AMOLED (16:10) 2880 x 1800, Touch Screen, DCI-P3 120%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16.0" 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.66kg - Platform, OS : Intel ® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 SSD - WiFi 6E 지원 - Battery : 76Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			□ Galaxy Book3 Pro (2023.02.) - 인치 : 16" WQXGA+ AMOLED (16:10), up to 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% 14" WQXGA+ AMOLED (16:10), up to 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16" 355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg 14" 312.3 x 223.8 x 11.3mm, 1.17kg - Platform, OS : Intel ® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880 x 1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (M.2 2280) - WiFi 6E 지원 - Battery : 16" 76Wh, 14" 63Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			□ Galaxy Book3 360 (2023.02.) - 인치 : 15.6" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), DCI-P3 120% 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), DCI-P3 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 355.4 x 228.0 x 13.7mm, 1.49kg 13.3" 304.4 x 202.0 x 12.9 mm, 1.16kg - Platform, OS : Intel ® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - sAMOLED: 1080p FHD, 500nit(HDR), 60Hz, DCI-P3 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Stereo SPK(Dolby, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 Dramless SSD, Expendable SSD (15.6") - WiFi 6E 지원 - Battery : 15.6" 68Wh, 13.3" 61.1Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
			□ Galaxy Book4 Ultra (2024.01.) - 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective

			- 사이즈(W x D x H) & 무게 : 355.4 x 250.4 x 16.5mm, 1.86kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR) - 그래픽 : NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070 - AKG 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 - Battery : 76Wh
			□ Galaxy Book4 Pro 360 (2024.01.) - 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective, S펜 지원 - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.66kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR), S펜 - 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics - AKG 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 - Battery : 76Wh
			□ Galaxy Book4 Pro (2024.01.) - 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective 14"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg 14"312.3 x 223.8 x 11.6mm, 1.23kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR) - 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics - AKG 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 - Battery : 16"76Wh, 14"63Wh
			□ Galaxy Book4 Edge (2024.06.) - 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective 14"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 250.4 x 12.3mm, 1.55kg 14"312.3 x 223.8 x 10.9mm, 1.16kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon X Elite (12 core), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K (2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit (HDR) - 그래픽 : Qualcomm Adreno - 쿼드 스피커 (16"우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2 / 14"우퍼 Max 4W x 2, 트위터 2.7W x 2), Dolby Atmos, 2M Camera - Memory, SSD : 16"16GB, eUFS 512GB, 1TB / 14"16GB, eUFS 512GB - Bluetooth v5.3, WiFi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be - Battery : 16"61.8Wh, 14"55.9Wh - Next Gen AI PC 시장 선도를 위한 AI 기능 탑재
			□ Galaxy Book5 Pro 360 (2024.09.) - 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective, S펜 지원 - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.69kg

			- Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR), S펜 - 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics - 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 3.3W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.4, WiFi 7, 802.11 be 2x2 - Battery : 76.1Wh
			□ Galaxy Book4 Pro 360 5G (2024.10.) - 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective, S펜 지원 - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.73kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon X Elite (12 core), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K (2880x1800), 120Hz, S펜 - 그래픽 : Qualcomm Adreno - 쿼드 스피커 (우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos, 2M Camera - Battery : 76Wh
			□ Galaxy Book4 Edge (2024.10.) - 인치 : 15.6"FHD 광시야각 LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 356.6 x 229.75 x 15.0mm, 1.5kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon X Plus (8 core), Windows 11 - 그래픽 : Qualcomm Adreno - Bluetooth v5.3, WiFi 7 지원 - 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), Dolby Atmos, 2M Camera - Battery : 61.2 Wh
		Galaxy 워치 (~2024.07.)	□ Galaxy Watch5 & Galaxy Watch5 Pro (2022.08.) - 인치 : Watch5 Pro (46mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI Watch5 (44mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI Watch5 (40mm) : 30.4mm AMOLED (396 x 396) 330PPI - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch5 Pro (46mm) : 45.4 x 45.4 x 10.5 mm, 46.5g Watch5 (44mm) : 44.4 x 43.3 x 9.8 mm, 33.5g Watch5 (40mm) : 40.4 x 39.3 x 9.8 mm, 28.7g - Platform(H/W, S/W) : Exynos W920, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 3.5) - 사파이어 크리스탈 디스플레이 적용한 시그니처 원형 디자인 - 진화된 바이오액티브 센서 탑재로 더 강력해진 통합 건강 관리 기능 ・체성분, 심박, 혈압, 심전도 정확도 개선 및 수면 관리 기능 강화 - Wear OS 기반의 'One UI Watch 4.5' 탑재하여 다양한 구글 모바일 서비스와 앱 활용 - 프리미엄 소재 티타늄 바디, 향상된 GPS 성능으로 아웃도어 스포츠에 최적화 (Watch5 Pro) ・기능 향상과 내구성 제고하여 하이킹/싸이클링과 같은 아웃도어 스포츠 활용도 제고 ・마그네틱 D-버클 스포츠 밴드 제공하여 내구성, 편의성 및 스타일리시한 모습 연출 ・경로운동(Route Workout) 및 GPX(GPS Exchange Format) 파일 이용한 운동경로 저장 및 공유 ・트랙백(Track back) 기능 통해 지나왔던 길찾기 제공 ・큰 용량 배터리(590mAh) 적용으로 장시간 아웃도어 활동 가능
			□ Galaxy Watch6 / Galaxy Watch6 Classic (2023.08.) - 인치 : Watch6 Classic (47mm) : 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch6 Classic (43mm) : 33.3mm Super AMOLED (432 x 432) Watch6 (44mm) : 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch6 (40mm) : 33.3mm Super AMOLED (432 x 432) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch6 Classic (47mm) : 46.5 x 46.5 x 10.9 mm, 59.0g

			Watch6 Classic (43mm) : 42.5 x 42.5 x 10.9 mm, 52.0g Watch6 (44mm) : 44.4 x 42.8 x 9.0 mm, 33.3g Watch6 (40mm) : 40.4 x 38.8 x 9.0 mm, 28.7g - Platform(H/W, S/W) : Exynos W930, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) - 시인성 향상을 구현한 디자인과 성능 · 전작 대비 베젤 축소 및 약 20% 넓어진 대화면 구현 · 고해상도 Super AMOLED 디스플레이 탑재 및 최대 2,000니트 밝기 지원 - 강화된 수면 관리 경험 제공 · 수면 점수를 구성하는 요인을 항목별 심층 분석 및 종합하여 수면 점수 제공 · 향상된 맞춤형 수면 코칭 프로그램 제공 - 보다 개인화된 피트니스 관리 기능 등 신기능 추가 · 심폐 역량에 따라 5가지 심박수 구간 측정으로 사용자에 개인화된 운동 가이드 제공 · 트랙 달리기 기능으로 레인 지정 등 트랙 운동 기록 · 불규칙 심장 리듬 알림 기능 적용 - One-Click 밴드 적용으로 보다 쉽고 편리하게 워치 스트랩 교체 - 배터리 용량 확대로 실사용 성능 강화 · 47/44mm 425mAh, 43/40mm 300mAh 적용
			□ Galaxy Watch7 / Galaxy Watch Ultra (2024.07.) - 인치 : Watch7 (44mm) 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch7 (40mm) 33.3mm Super AMOLED (432 x 432) Watch Ultra (47mm) 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch7 (44mm) 44.4 x 44.4 x 9.7 mm, 33.8g Watch7 (40mm) 40.4 x 40.4 x 9.7 mm, 28.8g Watch Ultra (47mm) 47.1 x 47.4 x 12.1 mm, 60.5g - Platform(H/W, S/W): Exynos W1000(5Core,3nm), Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 5) - 강력한 하드웨어로 높은 사용성 제공 · 3나노 프로세서 탑재하여 빠른 CPU 속도와 소모 전류 효율 개선 · 이중 주파수 GPS 시스템 탑재하여 복잡한 환경에서의 GPS 정확도 개선 - 강화된 건강 모니터링 제공 · 최종당화산물 지표(AGEs Index) 측정 제공 · 수면 무호흡 감지 및 개선된 수면 AI 알고리즘 적용하여 정확한 수면 측정 지원 - 극대화된 성능을 통해 차원 높은 아웃도어 피트니스 경험 제공 (Ultra only) · 시그니처 원형 디자인에 새로운 쿠션 디자인 가미 · 다이나믹 러그 시스템 적용으로 쉬운 체결과 완벽한 착용감 제공 · 10ATM 방수 지원 등 극한 환경에서 다양한 피트니스 활동 측정 · 긴 배터리 수명 제공 : 절전모드 100시간, 운동 중 절전모드 48시간 사용 가능 - 배터리 : 47mm 590mAh, 44mm 425mAh, 40mm 300mAh 적용
		Galaxy 버즈 (~2024.07.)	□ Galaxy Buds 2 Pro (2022.08.) - 24bit 고품질 Hi-Fi 사운드와 편안한 착용감을 제공하는 커널 타입Premium TWS - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 21.6mm x 19.9mm x 18.7mm (Cradle) 50.2mm x 50.1mm x 27.7mm - Platform(H/W, S/W) : BES2700YP 1Chip솔루션, RTOS · 당사 Buds 최초24bit/48kHz Hi-Fi기술 적용하여 원본 음질 손실을 최소화한 고품질 사운드 경험All High-SNR MIC, 소음 제거 솔루션과 대화 감지 기술을 적용한 Intelligence ANC · 멀티 채널 오디오와 향상된 헤드 트래킹 기술을 통해 현장감 있는 360 Audio 청취 경험 강화 · 개선된 VPU와 개인화 Beamforming 기술을 통해 또렷하고 향상된 통화 음질 제공

			- 인체공학적 디자인을 통해 편안하고 안정감 있는 착용감 제공 ・전작 대비 15% 작아진 기기 사이즈와 개선된 통기홀 구조를 적용하여 착용감 개선 - Galaxy Device간 쉬운 연결을 통한 사용 경험 강화 ・오토 스위치 기능 제공을 폰, 태블릿, 워치에서 TV로 확장하고 쉽고 빠르게 기기 전환
			□ Galaxy Buds3 Pro / Buds3 (2024.07.) - 신규 Stem 디자인을 통한 착용성 개선 ・차별화된 Futuristic Blade 디자인으로 선망성 확보 - 오디오 기기 특성을 반영한 AI를 통해 개인 맞춤형 사운드 경험 제공 ・주변 환경에 따른 소음 최적화 및 착용 상태에 따른 실시간 사운드 최적화 - 통역 듣기모드 지원을 통한 자유로운 소통 경험 제공 - 사이즈(H x W x D) : Buds3 Pro 18.1 x 19.8 x 33.2 mm, 5.4g Buds3 18.1 x 20.4 x 31.9 mm, 4.7g Cradle 48.7 x 58.9 x 24.4 mm, 46.5g - Platform(H/W, S/W) : BES2800(6nm)/BES2700(14nm), RTOS - 오디오 음질 개선 ・24bit/96kHz UHQ 지원 *Buds2 Pro(24bit/48kHz Hi-Fi) ・Buds3 Pro 분리형 2 Way Speaker 적용 ・Adaptive EQ 지원 *Buds2 Pro(Fixed EQ) - 설계 최적화를 통한 통화 품질 개선 ・Complex DNN/VPU 솔루션 적용으로 음성 명료도 강화 ・Super Wide Band 통화 지원으로 음성 대역폭 강화 - Cradle 버튼 Pairing 적용으로 직관적인 동작 경험 제공 - Intelligence 기능 경험 강화 ・Buds3 Pro Siren/Voice Detect 및 Adaptive Noise Control 지원 - 배터리 : Buds3 Pro 53mAh, Buds3 48mAh, Cradle 515mAh
		Galaxy 링 (2024.07.)	□ Galaxy 링 (2024.07.) - 일상 중 항시 착용 가능한 디자인으로 Galaxy Health 경험 확장 - 사이즈 : 9종 (5호 ~ 13호) - 크기 & 무게 : (Ring) 7.0(W) x 2.6 mm(D), 2.3g(5호) ~ 3.0g(13호) (Cradle) 48.9(W) x 48.9(H) x 24.5 mm(D), 61.3g - Platform(H/W, S/W) : nRF5340, Zephyr RTOS - 24/7 상시 착용에 용이한 디자인 및 배터리 사용시간 ・슬림하고 가벼운 디자인으로 편안한 착용감 ・한번 충전하면 최대 7일 사용으로 건강 정보 지속 측정 가능 * 5호 18mAh ~ 13호 23.5mAh - 티타늄 소재 및 10ATM, IP68 방수 적용으로 내구성 강화 - 개인 맞춤형 건강 관리 기능 제공 ・개인의 컨디션 관리를 위한 지표 및 개인화된 인사이트 메시지 제공 ・고도화된 수면 분석 및 코칭 지원 ・고/저심박수 알림, 자동 운동 감지 등 일상 활동에 대한 모니터링 - Galaxy 사용자 차별화된 사용 경험 제공 ・단말과 연계된 Easy Pairing, 제스처 컨트롤, 링 위치 찾기 지원 ・워치와 동시 착용 시 사용시간 개선 등 최적의 사용성 제공
	네트워크	RAN S/W Package (~2024.10.)	□ vRAN* SW Package (2023.11.) * vRAN(virtualized RAN): 가상화 기지국 - 당사 vRAN SW Package에 I社 4세대 CPU 연동 개발로 업계 최초 vRAN 상용망 적용 ・당사는 3세대 CPU를 활용한 vRAN 대규모 상용을 旣완료한데 이어, 4세대 CPU를 적용한 vRAN으로 상용망에서 data call 성공

			□ 5G vRAN SW PKG (2024.06.) - RedCap Energy-saving 기능 시험 완료(5G IoT 디바이스의 전력 소모를 줄이는 기능 시험) ・업계 최초로 vRAN 기반 5G RedCap Energy-saving 기술 시험 완료 ・당사는 vRAN RedCap 기술 검증(美 vRAN 상용망 등)을 이어오고 있으며, 향후 tRAN, vRAN 모두 상용 기능 제공할 계획 * tRAN(traditional RAN) : 하드웨어 기반 기지국 * RedCap(Reduced Capability) : 5G 저전력 사물 인터넷(IoT) 기술 □ AI 기반 5G 기지국 품질 최적화 기술(AI-RAN Parameter Recommender) (2024.10.) - 기지국 환경에 맞는 최적의 파라미터(parameter, 매개변수)를 자동으로 추천하는 AI기반 기술을 개발, SKT와 협력하여 상용망에 적용 및 실증 - 향후 기지국 성능 극대화로 체감품질 향상 및 트래픽 변화 빈번한 곳에 확대 적용 예정
		기지국 (~2024.08.)	□ 국내 3.5GHz NR 32T32R TDD MMU (2022.02.) - 당사 최초 Mechanical PSA(Phase Shift Antenna) 적용 * 안테나 기울기(Tilt 0~12°)를 MMU 내부에서 Motor로 자동 제어 □ 고성능 RFIC + DFE 통합 Chip 개발 (2022.04) * RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit): 무선통신에 적합한 고주파 집적 회로 * DFE(Digital Front End): 통신을 위한 Digital 신호처리의 마지막 단계 □ Dish향 FDD RU 2종(Dual Band/Tri Band RU) (2022.09) - ORAN 표준을 준수하고 여러 주파수 대역을 동시에 지원하는 5G FDD RU 제품 개발 * RU 지원 주파수: n71(600MHz), n29(700MHz), n66(AWS: 1.7GHz/2.1GHz), n70(AWS: 1.7GHz/1.9GHz) □ Gen.3 Dual Band NR 2T2R AU (2022.10.) - 세계 최초 Dual Band(28GHz+39GHz) AU 개발 - 기존 2세대 AU 대비 동일 사이즈에 출력 2배 향상, 용량 2배 확대로 제품 성능 개선 □ 국내 3.5GHz NR 64T64R MMU (2022.11.) - 국내向 최초 상용 64T64R Massive MIMO MMU 개발 - 기존 국내向 32T32R MMU(구형) 대비 Antenna Element 2배 증가, 출력 2.7배 증가 □ 3.5GHz CBRS NR Strand Smallcell (2023.03.) - 당사 최초 상용 Strand Smallcell(전선 설치형 소형 기지국) 개발 - Digital Unit, Radio Unit, 안테나 기능을 하나의 form factor로 제공하는 기지국 - 당사가 자체 개발한 최신 2세대 5G 모뎀칩(5G Modem SoC) 탑재하여, 전선 위 설치 가능하도록 소형화 □ 북미向 C-band NR 64T64R MMU (2023.05.) - 1세대 대비 고출력화, 소형화, 경량화, 저전력화 개발 □ 캐나다 n77(3.4~3.8GHz) NR 64T64R 신규 MMU (2024.08.) - 새로운 구조의 New PAM(Power Amplifier Module : 전력 증폭기 모듈) 적용한 고출력의 New MMU 플랫폼 제품 개발 - 기존 제품대비 Wideband 지원(고효율)으로 고출력, 저전력을 요구하는 글로벌 시장 진입이 가능해져 5G 시장 확대에 기여 * Wideband 지원: 넓은 주파수 대역 사용으로 많은 양의 데이터 동시 전송으로 전송속도가 빠름
DS 부문	메모리	모바일용 DRAM (~2024.07.)	□ 업계 최초 LPCAMM 개발 (2023.09.) - LPDDR 기반 모듈 개발로 PC・노트북 등 차세대 모듈 시장 선도 - SO-DIMM 대비 성능 50%↑ 전력 효율 70%↑ 탑재 면적 최대 60% 이상↓ 가능 및

			교체・업그레이드 용이하여 제조 유연성 및 사용자 편의성 증대 - 주요 고객사와 차세대 시스템에서 검증 예정, 2024년 상용화 추진 및 차세대 PC・노트북부터 데이터센터 등으로 응용처 확대 기대 □ 미디어텍과 업계 최고 속도 LPDDR5X 동작 검증 성공 (2024.07.) - 미디어텍 최신 플래그십 모바일AP '디멘시티'에 검증 완료로 고성능 제품 상용화 선도 - 온디바이스 AI 시대에 저전력・고성능 LPDDR D램 역할 증대 - 모바일 분야 넘어 AI 가속기, 서버, HPC, 오토모티브 등 응용처 적극 확대
		서버용 DRAM (~2023.09.)	□ 업계 최선단 12나노급 D램 개발 (2022.12.) - 업계 최초로 '12나노급 16Gb DDR5 D램' 개발, 차세대 컴퓨팅 서비스에 최적화된 '고성능・저전력' 특성 확보 - 기존 대비 소비전력 약 23% 감소, 생산성 약 20% 향상 - 2023년 양산 돌입으로 고객의 차세대 시스템에 최적의 메모리 솔루션 제공, 데이터센터, 인공지능, 차세대 컴퓨팅 등 응용처 확산 기대 □ 업계 최선단 12나노급 D램 양산 (2023.05.) - 14나노 D램 대비 생산성 향상 및 저전력 특성 개선으로 생산성 약 20% 향상, 소비전력 약 23% 감소로 차세대 컴퓨팅 최적화 - 고유전율 신소재 적용 커패시터 등 최신 기술 적용 최선단 공정 완성 - 대용량 컴퓨팅 시장 수요에 맞는 고성능, 고용량 D램 솔루션 제공 및 12나노급 D램 라인업 확대해, 다양한 응용처에 공급 예정 □ 현존 최대 용량 32Gb DDR5 D램 개발 (2023.09.) - 1983년 64Kb D램 개발 40년만에 용량 50만배 확대 - TSV 공정 적용 없이 128GB 모듈 제작 가능 및 12나노급 16Gb 기반 동일 용량의 모듈 대비 소비 전력 10% 개선 - AI에 최적화된 고용량 D램 솔루션 제공, 1TB 모듈 구현 가능 - 연내 양산 예정으로AI, 차세대 컴퓨팅 등 다양한 응용처 공급 예정
		그래픽 DRAM (~2024.10.)	□ 업계 최고 속도 GDDR6 D램 개발 (2022.07.) - 3세대 10나노급(1z) 공정 적용으로 업계 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성능 30% 이상 높여 초당 최대 1.1TB 데이터 처리, 1.1V 동작전압 지원, 전력 효율 20% 높여 다양한 고객 요구 충족 - 국제 반도체 표준화 기구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 차세대 그래픽카드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 □ 첨단 패키징 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 (2022.11.) - GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 적층, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 □ 업계 최초 GDDR7 D램 개발 (2023.07.) - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% 향상 - 패키지 신소재 적용・회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대 □ 업계 최초 24Gb GDDR7 D램 개발 ('24.10.) - 12나노급 미세 공정 적용해 셀 집적도 증가, 업계 최고 용량 24Gb 구현 - 'PAM3 신호 방식' 적용으로 40Gbps의 속도 자랑, 최대 42.5Gbps 가능 - 'Clock 컨트롤 제어 기술' 적용 등으로 저전력 특성 구현 및 전력 효율 극대화

			- 기존 그래픽 D램 응용처부터 AI 워크스테이션, 데이터센터까지 폭넓게 활용
		HBM (~2024.02.)	□ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 (2022.10.) - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 감소 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합된 소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 (2023.10.) - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며, 열전도를 극대화해 열 특성을 또한 개선 - 현재 HBM3 8단, 12단 제품을 양산 중이며, 차세대 제품인 HBM3E도 고객들에게 샘플을 전달 중 □ 업계 최초 36GB HBM3E 12H D램 개발 (2024.02.) - 12단 적층으로 업계 최대 용량 36GB 구현, - Advanced TC NCF 기술로 HBM3 8단과 동일한 높이로 12단 적층 구현 및 성능과 용량 모두 50% 이상 향상 - 업계 최소 7마이크로미터 칩간 간격으로 수직 집적도 개선 및 다양한 사이즈의 범프를 적용 - 고객사에 샘플 제공 시작, 상반기 양산 예정
		NAND (~2024.09.)	□ '8세대 V낸드' 양산 (2022.11.) - 세계 최고 용량의 '1Tb(테라비트) 8세대 V낸드' 양산 - 웨이퍼당 비트 집적도 대폭 향상, 업계 최고 수준 비트 밀도 확보 - 차세대 인터페이스 적용, 2.4Gbps 전송 속도 구현으로 기존대비 성능 1.2배 향상 - 차세대 서버시장 고용량화 주도, 고신뢰성을 요구하는 전장 시장까지 사업 영역 확대 □ 업계 최초 '9세대 V낸드' 양산 (2024.04.) - 업계 최초 '1Tb TLC 9세대 V낸드' 양산 - 더블 스택(Double Stack) 구조로 구현 가능한 최고 단수 V낸드 - 업계 최소 크기 두께, 차세대 인터페이스 적용 등으로 기술 리더십 증명 - 최첨단 기술로 셀 면적은 줄이면서 간섭 현상은 줄여 이전 세대 대비 비트 밀도 1.5배 증가 □ 업계 최초 'QLC 9세대 V낸드' 양산 (2024.09.) - 9세대 V낸드 QLC, TLC 모두 업계 최초 출시로 고용량 QLC・고성능 TLC 통해 차세대 낸드플래시 시장 경쟁력 강화 - '채널 홀 에칭' 기술로 더블 스택 구조 등 혁신 기술 집약을 통해 업계 최고 단수 제품 구현 - 브랜드 제품 시작으로 모바일 UFS, PC・서버 SSD 등 응용처 확대
		eStorage (~2022.05.)	□ 업계 최고 성능 UFS 4.0 개발 (2022.05.) - UFS 3.1 제품 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배로 개선 - 동일한 데이터 처리시, 전력효율 약 46% 향상되어 장시간 사용 가능 - 최신 보안 기술을 적용하여 고객들의 중요 데이터를 읽고 저장하는 성능 개선 - 스마트폰, Automotive 및 VR/AR 등 컨슈머 기기로의 확대 예상
		서버용 SSD (~2022.07.)	□ 연산기능 강화한 '2세대 스마트SSD' 개발 (2022.07.) - 연산 성능 2배 향상, 처리시간 50% 이상, 에너지 70%, CPU 사용 97% - SSD 내에서 데이터 처리, 시스템 성능과 에너지 효율 동시에 향상 - 데이터베이스, 비디오 트랜스코딩 등 다양한 시장 요구에 적극 대응 - 컴퓨테이셔널 스토리지 표준화 주도, 차세대 스토리지 제품 개발 확대
		Client SSD	□ 5나노 기반 컨트롤러 탑재한 PC용 고성능 SSD 'PM9C1a' 양산 (2023.01.)

		(~2024.10.)	- 5나노 기반 신규 컨트롤러와 7세대 V낸드 탑재로 성능 향상 - 기존 대비 속도 최대 1.8배, 전력 효율 최대 70% 가량 향상 - DICE 표준 신규 적용 등 보안솔루션 강화로 디바이스 인증, 증명 기술 지원 □ 업계 최고 성능 최대 용량 PC용 SSD PM9E1 양산 ('24.10월) - 8채널 PCIe 5.0 지원 및 8세대 V낸드 탑재로 업계 최고 성능 구현 - 고용량 4TB 옵션, AI 생성 컨텐츠 등 대용량 파일 저장 가능 - 전작 'PM9A1a' 대비 성능 최대 2배, 전력 효율 50% 이상 개선 - 신규 보안 솔루션인 SPDM 1.2버전 적용으로 데이터 위·변조 방지
		브랜드 SSD (~2024.09.)	□ 성능과 내구성 모두 갖춘 전문가용 포터블 SSD 'T7 실드(Shield)' 출시 (2022.04.) - 방수, 방진, 최대 3미터 낙하 보호 설계 - 고화질 영상 녹화, 편집 등의 성능 저하 없이 안정적으로 데이터 전송 □ 게이밍에 최적화된 고성능 SSD '990 PRO' 공개 (2022.08. - 최신 V낸드 기술과 독자 컨트롤러로 업계 최고 수준 성능 구현 - 전작보다 속도 최대 55%, 전력 효율 최대 50% 향상 - 고성능 그래픽 게임, 4K/8K 고화질 비디오 등 초고속 데이터 처리 작업이 요구되는 환경에 최고 성능 제공 □ 고성능 SSD '990 PRO' 4TB 출시 (2023.09.) - 최첨단 '8세대 V낸드' 적용 및 업계 최고 수준 성능 구현으로 PCIe 4.0 기반 소비자용 SSD 중 가장 빠른 임의 읽기 속도 제공 - 고성능 게임, 3D/4K그래픽 작업 등 초고속 데이터 처리 작업 필요한 환경에 최적화 - 단면 설계, 열 분산 시트/히트싱크 장착으로 호환성, 방열 성능 강화 □ 초고속 포터블 SSD 'T9' 출시 (2023.10.) - 최신 데이터 전송 인터페이스 'USB 3.2 Gen2x2' 지원으로 전세대 대비 연속읽기/쓰기 성능 약 2배 향상 - 대용량 파일 전송 시 발생하는 성능 저하, 발열 현상 개선을 위해 표면 소재 개선 및 S/W 최적화 □ 업계 최대 8TB 용량 포터블 SSD 신제품 'T5 EVO' 출시 (2023.11.) - USB3.2 Gen1 기반 최대 460MB/s 연속 읽기·쓰기 성능 제공 - 컴팩트한 크기와 무게와 메탈링 적용하여 휴대성 강화 - 과열 방지 기술과 하드웨어 데이터 암호화 기술을 적용 □ 성능과 범용성 모두 갖춘 소비자용 SSD '990 EVO' 출시 (2024.01.) - '970 EVO Plus' 대비 읽기·쓰기 속도 최대 43% 향상 - 5나노 신규 컨트롤러 탑재로 전력 효율 최대 70% 개선 - 차세대 인터페이스 PCIe 5.0 x2 지원 - 호스트 메모리 버퍼(HMB) 기술 적용으로 가격 경쟁력 강화 □ PCIe 4.0 기반의 고성능 소비자용 SSD '990 EVO Plus' 출시 (2024.09.) - 8세대 V낸드·5나노 컨트롤러 탑재로 전작 대비 읽기·쓰기 속도 45%, 50% 향상 및 전력 효율 70% 이상 개선 - 고용량 4TB 제품 포함 3가지 용량으로 출시로 소비자 선택지 확대 - 노트북·PC 메인보드에 장착해 성능·용량 간편하게 업그레이드 가능 - 니켈 코팅된 컨트롤러와 열 분산 라벨로 과열 방지, 제품 안정성 강화
		CXL (~2024.06.)	□ 업계 최초 고용량 512GB CXL D램 개발 (2022.05.) - CXL D램 용량 4배 향상, 서버 한 대당 수십 테라바이트 이상 확장 가능 - CXL 전용 컨트롤러 탑재, 데이터 지연 시간 1/5로 감소 □ 고용량 AI 모델을 위한 CXL 기반의 PNM 솔루션 개발 (2022.10.) - PNM(Processing-near-Memory)은 연산기능을 메모리 옆에 위치시켜 CPU-메모리간 발생하는 병목현상을 줄이고 시스템 성능 개선 - 높은 메모리 대역폭을 요구하는 추천 시스템이나 인-메모리 데이터베이스 등의 응용에서

			약 2배 이상 성능이 향상 □ 업계 최초 'CXL 2.0 D램' 개발 (2023.05.) - D램 모듈의 한계 극복, 대역폭과 용량 확장 가능 - CXL D램 영역을 분할 사용하는 '메모리 풀링' 지원으로 서버 운영비용 절감 - 데이터센터, 서버, 칩셋 기업과 지속 협력해 CXL 생태계 확장 및 차세대 컴퓨팅 시장 수요 적기 대응으로 시장 선도 □ 업계 최초 '레드햇 인증 CXL 인프라' 구축 (2024.06.) - 삼성전자 내부 연구시설인 SMRC에 레드햇 인증 CXL 인프라 구축하여 제품부터 소프트웨어까지 모든 서버 구성 요소 자체 검증 가능 - 업계 최초 CMM-D 레드햇 인증 등 신속한 제품 개발 진행, 고객 맞춤 솔루션 제공 - 美 '레드햇 서밋 2024'에서 CXL 기반 서버 성능 향상 기술 시연
		브랜드 Card (~2024.08.)	□ 성능과 내구성을 강화한 메모리카드 'PRO Endurance' 출시 (2022.05.) - 서버급 고품질 낸드 채용, 16년 연속 녹화 가능한 내구성 - CCTV, 블랙박스 등 고해상도(4K, 풀HD) 영상 녹화장치에 최적화 - 극한 환경에서도 안정적 녹화 성능을 유지, 6-proof 보호 적용 - 클래스 10, UHS 클래스 U3, 비디오 스피드 클래스 V30 속도 지원, 풀HD·4K 고해상도 영상 연속 촬영 □ 속도와 안정성 강화한 메모리카드 'PRO Ultimate' 출시 (2023.08.) - UHS-I 규격 최고 수준의 200MB/s 읽기 속도, 130MB/s 쓰기 속도 지원, 기존 대비 전력 효율 37% 향상 및 방수·낙하·마모·엑스레이·온도 등 극한의 외부 환경에서도 데이터 보호 - 전문 포토그래퍼, 크리에이터 및 드론, 액션캠, DSLR 카메라 등 고해상도 콘텐츠 작업에 최적의 SD카드/마이크로SD카드 제공 □ 업계 최초 SD 익스프레스 마이크로SD 카드 개발 (2024.02.) - 마이크로SD 카드 최고 연속 읽기 성능인 초당 800 메가바이트(800MB/s)와 256GB의 고용량을 제공 - SSD에 탑재했던 DTG(Dynamic Thermal Guard) 기술을 최초 적용해 소형 폼팩터에서 발생하는 발열 문제를 효과적으로 해결 □ 최신 V낸드 기반 고용량 1TB UHS-Ⅰ 마이크로 SD카드 양산 (2024.02.) - 8세대 V낸드로 마이크로 SD카드에 테라바이트급 고용량 구현 - 방수, 낙하마모 등 극한 외부환경에서도 데이터를 안전하게 보호 □ 고용량 1TB 마이크로SD 카드 2종 출시 (2024.08.) - 업계 최고 용량 1Tb TLC 8세대 V낸드 적용하여 테라바이트급 고용량 구현 - 최대 용량 1TB로 고성능·고용량 솔루션에 대한 요구 충족 - 28나노 컨트롤러 탑재로 전력 효율 개선, 배터리 소모량 감소
		Automotive (~2024.09.)	□ 초저전력 차량용 UFS 3.1 양산 (2023.07.) - 업계 최저 소비 전력을 가진 차량용 인포테인먼트(IVI) UFS 3.1 양산으로 전기차,자율주행차 등에 최적화 - 전 세대 제품 대비 33% 낮은 소비 전력, 256GB 기준 최대 읽기 속도 2,000MB/s, 최대 쓰기 속도 700MB/s 제공 - 고객의 다양한 요구 충족을 위한 128GB/256GB/512GB 라인업 구축으로 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)용 UFS 3.1 제품과 함께 전장 스토리지 제품 라인업 강화 □ 2025년 전장 메모리 시장 1위 달성을 위한 차량용 핵심 솔루션 공개 (2023.10.) - 스토리지 가상화를 통해 하나의 SSD를 분할해 여러 개의 SoC가 사용할 수 있는 'Detachable AutoSSD(탈부착 가능한 차량용 SSD)' 공개, 최대 6,500MB/s의 연속 읽기 속도를 지원하며 4TB 용량 제공

			- 차량용 고대역폭 GDDR7 및 패키지 크기를 줄인 LPDDR5X 등도 선보임 □ 퀄컴 차량용 솔루션에 'LPDDR4X' 공급 (2024.08.) - 삼성전자-퀄컴, 차량용 반도체 분야에서 첫 협력 시작하여 스냅드래곤 디지털 섀시에 공급 및 프리미엄 차량용 인포테인먼트 지원 - 영하 40℃~영상 105℃까지 극한 환경에서도 안정적 성능 보장 - 글로벌 완성차 및 자동차 부품 업체 등 고객사에 장기 공급 계획 □ 업계 최초 8세대 V낸드 기반 차량용 SSD 개발 (2024.09.) - 256GB SSD 샘플 고객 제공 및 차량 내 AI 기능 지원 최적화 - 8세대 V낸드?5나노 기반 컨트롤러 탑재로 업계 최고 속도 구현 - 고성능 SLC 모드 지원으로 고용량 파일 빠르게 접근 가능 - 내년 초 2TB 제품 출시로 차량용 고용량 SSD 고객 수요 대응
	System LSI	이미지센서 (~2024.12.)	□ 업계 최소 픽셀 크기의 2억화소 이미지센서 공개(HP3, 0.56um/200Mp) - 기존 HP1(0.64um)보다 12% 작아진 픽셀 크기로 카메라 모듈 면적 최대 20% 감소 - '슈퍼 QPD' 기술로 2억개 픽셀 모두 자동 초점 기능 구현 - '테트라 스퀘어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질 - AI기반의 화질처리 솔루션 구현으로 2억화소 화질 해상도 개선 및 5천만 화소 센서 줌 활용도 향상 □ 초고화소 기술 집약된 2억화소 이미지센서 출시(HP2, 0.6um/200Mp) - 업계 최초 '듀얼 버티컬 트랜스퍼 게이트' 적용, 색 표현력 및 화질 개선 - '테트라 스퀘어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질 - '듀얼 슬로프 게인' 적용, 업계 최초 5천만화소에서 센서 자체로 HDR 구현 - '슈퍼 QPD' 적용, 전 화소 이용 위상차 자동 초점 지원 □ 업계 최고 성능 자율주행 이미지센서 출시(1H1, 2.1um/8.3Mp) - 전장 120dB HDR, LFM(LED Flicker Mitigation) 및 Motion-Artifact Free 동시 구현 - 인접 픽셀 간섭 방지 DTI(Deep Trench Isolation) 적용, 저조도 SNR 강화 □ '아이소셀 비전 63D' iTOF(indirect Time of Flight) 센서 공개(63D, 3.5um/0.3Mp) - 빛의 파장을 감지해 사물의 3차원 입체 정보를 측정 - 업계 최초 원칩 iTOF 센서 적용, 전작(33D) 대비 시스템 전력 소모량 40% 감소 - 면광원 및 점광원 모드 동시 지원하여 최대 측정거리 10미터까지 확장 □ '아이소셀 비전 931' 글로벌 셔터(Global Shutter) 센서 공개(931, 2.2um/0.4Mp) - 사람 눈처럼 모든 픽셀 동시에 빛에 노출해 촬영하여 신속성 및 정확성 증가 - 사용자의 눈동자, 얼굴 표정, 손동작 같은 미세한 움직임 인식 가능 □ 업계 최초 망원용 2억화소 모바일 이미지 센서 공개(HP9, 0.56um/200Mp) - 독자 개발 신규 소재 적용 마이크로 렌즈 적용, 저조도 감도 대폭 향상 - 3배 망원 모듈 탑재시 최대 12배 줌까지 선명한 화질 구현 □ 새로운 픽셀 기술의 집약체로 듀얼 픽셀 '아이소셀 GNJ' 출시(GNJ, 1.0um/50Mp) - '센서 자체 줌' 기능 탑재로 잔상, 모아레 현상 없는 선명한 해상력 구현 - 픽셀 간 격벽 물질 변경으로 픽셀 간섭 현상 최소화해 빛 투과율 향상 □ 모든 화각에서 일관된 카메라 경험 선사, '아이소셀 JN5' 출시(JN5, 0.64um/50Mp) - 얇은 옵티컬 포맷 적용하여 광각, 초광각부터 전면, 망원용까지 채용 가능 □ 얇은 스마트폰 구현 가능한 센서 솔루션(ALoP : All Lenses on Prism) 공개 - 렌즈와 프리즘 구조를 재배치하여 렌즈 직경이 커져도 작은 모듈 사이즈 유지
		엑시노스 (~2024.12.)	□ 프리미엄 모바일 AP '엑시노스 2200' 출시 - AMD와 공동 개발한 차세대 GPU '엑스클립스(Xclipse)' 탑재, 게임 성능 및 전력 효율 극대화 - 업계 최초 모바일 기기에서 하드웨어 기반 '광선 추적(Ray Tracing)' 기술 구현 - ARM 최신 CPU 아키텍처 'Armv9' 기반 코어 적용하여 성능 및 보안 강화 - NPU 연산 성능 이전 대비 두 배 이상 향상, 머신러닝 성능 대폭 향상

			□ 5G 기반 위성통신용 모뎀 국제 표준기술 확보(NTN: Non Terrestrial Network) - 이동통신 표준화 기술협력기구(3GPP)의 최신 표준(릴리즈-17) 반영 - 저궤도 위성 위치 예측, 주파수 오류 최소화 기술 적용 - 간단한 문자 메시지 외 영상 등 대용량 데이터 양방향 송수신 가능 □ UWB기반 근거리 무선통신용 반도체 '엑시노스 커넥트 U100' 공개 - 수 센티미터 이내, 5도 이하 정밀 측위 가능 - 저전력 원칩으로 모바일, 전장, 각종 IoT 기기에 최적화 - 해킹 방지 STS(Scrambled Timestamp Sequence) 기능 및 보안 HW 암호화 엔진 적용 - UWB 표준 단체 'FiRa 컨소시엄' 국제 공인 인증 □ 삼성전자-AMD, 차세대 그래픽 설계자산 파트너십 확대 - 스마트폰 외 다양한 기기에서 콘솔 게임 수준의 게이밍 경험 제공 - 차세대 그래픽 솔루션 연구개발 생태계 확장 □ 삼성전자, 현대자동차와 차량용 인포테인먼트 분야 첫 협력 - 프리미엄 인포테인먼트용 '엑시노스 오토 V920', 현대자동차에 공급 - 전작(V910) 대비 대폭 향상된 성능으로 운전자에게 최적의 모빌리티 경험 선사 - 차량용 시스템 안전기준인 '에이실-B' 지원 통해 높은 안정성 제공 □ 최첨단 모바일 AP '엑시노스 2400' 공개 - 업계 최고 수준의 레이 트레이싱 성능, 전작 대비 2.1배 성능 향상 - 향상된 AI성능으로 인터넷 연결없이 온디바이스 생성형 AI 기능 제공 - 비지상 네트워크(NTN : Non-Terrestrial Network) 기술, 엑시노스 최초 탑재 □ 삼성전자, 최신 기술 적용 모바일 AP '엑시노스 1480' 공개 - 최신 4나노 공정 적용, 전작 대비 22% 개선된 전력 효율성 - 강력한 AI성능 기반으로 콘텐츠 인식 이미지 프로세싱 기능 탑재 - AMD RDNA 기반 엑스클립스 530 GPU 탑재로 전 세대 대비 그래픽 성능 향상 □ 삼성전자, 최신 기술 적용 웨어러블 SOC '엑시노스 W1000' 공개 - 웨어러블 최초 3나노 공정 적용 및 Big 코어 탑재, 전작(엑시노스 W930) 대비 싱글코어 3.4배, 멀티코어 3.7배 성능 개선 - 최신 패키지(FO-PLP: Fan-Out Panel Level Packaging, SiP: System in Packaging, ePoP: embedded Package on Package) 적용으로 시스템 실장 공간 확보 극대화 □ 삼성전자, 성능 대폭 개선한 모바일 AP '엑시노스 1580' 공개 - CPU 업그레이드(Armv9) 및 트라이 클러스터 아키텍처 적용으로 탁월한 CPU 성능 - 3세대 커스텀 GPU(Xclipse 540) 탑재로 전세대(1480) 대비 최대 성능 37% 향상 - 2억화소 이미지 센서 처리 기능 및 초당 14.7조 회의 연산(TOPS) 지원 NPU 탑재
		LSI (~2022.01.)	□ 생체인증카드용 원칩 지문인증 IC 출시(S3B512C) - 하드웨어 보안칩(SE, Secure Element), 지문 센서, 보안 프로세서 기능을 하나의 IC로 통합 - 보안 국제 공통 평가 기준(CC, Common Criteria)의 EAL6+ 등급 획득, 글로벌 온라인 카드 결제 기술표준(EMVCo) 인증 및 마스터카드의 생체 인식 평가 통과로 보안성 입증
	Foundry	세계 최초 GAA 기술 적용 3나노 공정 (2022.06.)	□ 세계 최초 Gate-All-Around(GAA) 트랜지스터 기술 적용한 3나노 공정 양산 - 나노시트 활용한 독자적 GAA 기술 'MBCFET' 적용해 전력효율 및 성능 극대화 - 3나노 1세대 공정은 5나노 대비 전력 45%↓, 성능 23%↑, 면적 16%↓ □ GAA는 핀펫의 기술적 한계를 극복하여 공정 미세화 지속을 가능케 하는 기술 - 채널의 모든 면을 게이트가 감싸 전류제어 특성 향상, 동작전압 및 전력소모 감소 - 채널을 수직 적층한 구조로 단위 면적당 채널폭 및 전류량이 증가하며 성능 향상 - 채널 폭을 조절할 수 있어 설계 자유도 향상 □ 에코시스템 파트너들과 검증된 3나노 설계 인프라 및 서비스 제공 중 □ 고성능・저전력HPC용 시스템 반도체, 모바일SOC 등에 적용 확대 계획

		HPC 전용 4나노 4세대 공정 (2024.11.)	□ High-Performance Computing(HPC) 전용 공정인 4나노 4세대 공정 양산 - 고속 동작 트랜지스터와 개선된 후속 배선 공정 (BEOL) 추가를 통한 RC 지연 감소 제공하는 고성능 저전력 HPC용 최적화된 공정 - 2.5D/3D 선행 패키지 기술 지원 가능
SDC	디스플레이 패널	55/65" QD-Display (2022.01.)	□ 세계 최초 TV향 QD-Display (55" UHD, 65" UHD) - BT2020 90% 업계 최고의 넓고 선명한 색 표현 - 전방위 균일하게 빛을 발하는 QD 특성으로 어느 각도에서도 최고의 휘도와 색감 구현 - 뛰어난 HDR 성능, 깊고 디테일한 Black 표현
		34" QD-Display (2022.03.)	□ 세계 최초 모니터향 QD-Display (34" QHD) - 175Hz, 0.1ms, 1800r, HDR True Black, G-Sync 지원으로 최고의 게이밍 경험 제공 - 뛰어난 색, 시야각, 명암비 특성 및 유해 블루라이트를 최소화
		Galaxy Z Fold4용 폴더블 OLED개발 (2022.08.)	□ 전작비 추가적인 개선 진행 - 카메라 성능을 유지하면서 Under Panel Camera 영역 시인성 크게 개선, 대화면 경험 강조 - 투과율이 개선된 에코스퀘어 플러스(Eco2 OLED Plus)로 에너지 효율 증가 - FRP(Fiber Reinforced Plastics)-Digitizer 일체형을 통한 원가 및 무게 저감
		Galaxy북3 프로용 14/16" OLED개발 (2023.02.)	□ 세계최대 Size (16") OCTA 기술 최초 상품화 - 기존 스마트폰에 적용했던 Touch 일체형 기술인 OCTA 기술을 중형 노트북용 OLED로 확대적용 - 신규재료 및 공정기술 개발로 패널 Dead Space 최소화 - 48~120Hz 가변주사율 노트북 OLED 최초 적용으로 소비전력 감소
		HP Elitebook용 16" OLED개발 (2023.04.)	□ OLED 유기재료 성능개선으로 저소비전력, 장수명 달성 - 16" WQ+ (2,880 x 1,800, 16:10) - 48~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 적용하여 AMD Freesync Premium Pro 인증, 최적 Game환경제공
		Google Pixel 8pro용 OLED개발 (2023.10.)	□ 고효율, 장수명 OLED 신규재료 적용으로 고휘도 (HBM 1,600nits, Peak 2,400nits), 저소비전력 구현 - 6.7" WQXGA+ (1,344 x 2,992) - 1~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 및 Dead Space 최소화 기술 적용
		Galaxy S24 AMOLED개발 (2024.01.)	□ Galaxy S24 (6.16"FHD+, 6.66"WQ+, 6.79WQ+) - 고해상도 저소비전력 기술과 패널 Dead Space 최소화 기술 접목 - 고해상도에서 고휘도 및 저전력, Slim Bezel구현. 화질 특성 및 사용자 체감성능 향상
		31.5"UHD, 27"QHD QD-OLED개발 (2024.01.)	□ 31.5"(140ppi), 27"(360Hz) QD-OLED 모니터개발 - 초정밀 잉크젯 프린팅 기술 및 당사 고유 AI 기반 구동 알고리즘 기술로 고해상도(140ppi), 고주사율(360㎐) 자발광 제품 개발
		BMW Mini 13.4" 185ppi개발 (2024.06.)	□13.4", 차량 Center Information Display用 Round OLED Display (1,752 x 1,660) - Automotive向 Round Shape 최초 적용 - 新 보상회로 및 패널구조 개발로, 비정형 Display의 영역별 균일특성 확보 - 대면적 비정형 OCTA 기술 개발
		Surface Pro 10 개발 (2024.05.)	□ 13" WQ+ (2,880x1,920, 3:2) - 30Hz 저주파 구동 노트북 OLED 최초 적용 (30~120Hz 가변주사율)으로 低소비전력 구현
		Galaxy Z Fold6용폴더블 OLED개발 (2024.07.)	□ 7.61" (2,160x1,856) 폴더블用 Display - 광효율 및 시인성 개선 新패널 구조/재료 적용으로 低소비전력 구현, 화질 개선 - 폴더블 내구성 향상 구조/재료 적용
		Google Pixel 9proXL용 OLED개발 (2024.09.)	□6.75"고화질/저전력 스마트폰用 Display · 1,344 x 2,992, Peak 휘도 3,000nit - 低소비전력 패널 구조와 고효율 신규 유기재료 적용으로 밝기와 수명, 화질 개선 및 소비전력 10% 감소

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계